



**QLEC**

**宁波立立电子股份有限公司**

(浙江省宁波市保税区0125-3地块)

**首次公开发行股票  
招股意向书**

**保荐人（主承销商）**

**CITICS** 中信建投证券有限责任公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

## 发行概况

- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：2,600 万股
- 每股面值：人民币 1.00 元
- 每股发行价格：[ ]元
- 预计发行日期：2008 年 6 月 26 日
- 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
- 发行后总股本：10,308 万股
- 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：
- 1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
  - 2、认购公司 2006 年 8 月增发股份的林必清等 54 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。
  - 3、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。  
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
  - 4、公司股东王敏文、李立本、阙端麟、林必清、陈卫忠、杨德仁、马向阳、刘培东、李晓军、田达晰、吴能云作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。
- 保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
- 招股意向书签署日期：2008 年 5 月 5 日

## 发行人声明

发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。认购公司 2006 年 8 月增发股份的林必清等 54 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、2007 年 8 月 12 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

3、报告期内公司出口销售收入占主营业务收入 40%左右。自 2005 年 7 月实施人民币汇率改革以来，人民币兑美元汇率出现一定幅度上升，由于公司进出口结算金额较大，如果人民币对主要外币汇率继续攀升，将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。

4、多晶硅是公司产品生产的主要原材料，近年来由于半导体行业发展迅速，特别是太阳能光伏产业的迅猛发展导致多晶硅在全球范围内供应紧张，价格持续上涨，而与其他多数国家一样，我国多晶硅供给基本依赖进口，获得多晶硅的能力已经成为左右我国半导体硅材料生产企业发展的重要因素。如果多晶硅供给发生困难或者多晶硅采购价格大幅度上升，将对公司的正常生产与盈利能力产生影响。

5、公司的核心技术人员包括李立本、刘培东和田达晰等三人，该等核心技术人员同时也是公司的核心管理人员，其中李立本先生还担任公司董事长职务；刘培东担任公司副总经理职务，负责公司的品质保障工作；田达晰担任公司副总经理，负责公司的技术研发工作。另外，公司的总经理林必清、副总经理陈卫忠、李晓军、吴能云等人多年来在公司内部担负管理工作，也是公司的核心管理人员。公司虽有股权激励措施，上述人员也均为公司股东，但仍不排除其因种种原因不再在公司任职的情形，如出现该类情形将会对公司的经营管理、技术保障和研发

工作产生重大不利影响。由于公司已与公司核心技术人员和核心管理人员均签署了《敬业、保密和保护知识产权协议》，即使上述人员离开公司不再在公司担任职务，但也不能从事与公司存在竞争关系的业务。

6、公司本次募集资金投资项目之一——8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目，是公司向更高档次硅片领域进军的标志，由于 8 英寸以上硅片的技术含量较高，客户的质量要求和技术参数要求更高，目前虽然公司 8 英寸硅外延片的生产技术已经较为成熟，并已经批量生产，销售的 8 英寸硅外延片已经获得了部分客户的认可，但 8 英寸硅外延片项目的市场开拓仍有一定的风险。同时 12 英寸的硅外延片研发项目的顺利完成在技术上仍存在一定的风险。

7、本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目从实施到发挥效益需要一定周期，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

## 目 录

第一节 释 义.....	9
第二节 概 览.....	14
一、发行人简介 .....	14
二、公司控股股东及实际控制人情况 .....	18
三、发行人主要财务数据 .....	18
四、本次发行情况 .....	19
五、募集资金主要用途 .....	20
第三节 本次发行概况.....	21
一、本次发行的基本情况 .....	21
二、本次发行的有关当事人 .....	22
三、本次发行的有关重要日期 .....	24
第四节 风险因素.....	25
一、市场风险 .....	25
二、经营风险 .....	26
三、财务风险 .....	28
四、税收优惠、政府补助政策风险 .....	29
五、技术和管理风险 .....	30
六、汇率风险 .....	31
七、管理风险 .....	33
八、募集资金投资项目实施的风险 .....	33
第五节 发行人基本情况.....	35
一、发行人概况 .....	35
二、发行人改制重组情况 .....	36
三、发行人股本形成及其变化情况 .....	39
四、发行人股本变化对实际控制人的影响情况 .....	55
五、发行人历次重大资产重组和收购兼并 .....	55

六、发行人历次验资情况 .....	73
七、发行人股东结构和组织结构 .....	74
八、发行人所投资的子公司 .....	77
九、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	78
十、发行人的股本情况 .....	81
十一、发行人员工及社会保障 .....	83
十二、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理 人员作出的重要承诺及其履行情况 .....	86
<b>第六节 业务和技术</b> .....	<b>87</b>
一、公司主营业务及其变化情况 .....	87
二、公司所处行业基本情况 .....	87
三、公司所处行业的现状及其发展前景 .....	90
四、公司在行业中的竞争地位 .....	103
五、公司主营业务情况 .....	109
六、公司的固定资产与无形资产 .....	121
七、公司的技术水平及其研发情况 .....	125
八、公司境外经营情况 .....	131
九、公司产品质量控制情况 .....	132
<b>第七节 同业竞争与关联交易</b> .....	<b>134</b>
一、同业竞争 .....	134
二、关联交易 .....	134
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员</b> .....	<b>139</b>
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 .....	139
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 .	142
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其它对外投资情况 ...	143
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及相关联 企业领取年薪情况 .....	144
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 .....	145

六、董事、监事、高管人员及与核心技术人员相互之间的亲属关系	145
七、公司与董事、监事、高管人员及核心技术人员的协议安排	146
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格	146
九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况	146
<b>第九节 公司治理</b>	<b>147</b>
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	147
二、发行人最近三年违法违规行为情况	154
三、发行人最近三年资金占用和对外担保的情况	155
四、公司管理层对内部控制制度的自我评价	155
五、注册会计师对内部控制制度的评价	156
<b>第十节 财务会计信息</b>	<b>157</b>
一、 财务会计报表	157
二、 会计报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况	176
三、 公司主要会计政策和会计估计	177
四、 适用的所得税税率及享受的主要税收优惠政策	187
五、 分部信息	188
六、 发行人最近一年收购兼并情况	190
七、 非经常性损益	190
八、 最近一期末主要资产情况	191
九、 主要债项	193
十、 股东权益	196
十一、 现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	199
十二、 或有事项、期后事项及其他重要事项	199
十三、 发行人主要财务指标	206
十四、 净资产收益率和每股收益	207
十五、 历次验资情况	208
十六、 评估情况	209



十七、 备考利润表 .....	209
<b>第十一节 管理层讨论与分析.....</b>	<b>212</b>
一、 公司财务状况分析 .....	212
二、 盈利能力分析 .....	228
三、 资本性支出 .....	240
四、 现金流量分析 .....	241
五、 盈利前景分析 .....	242
<b>第十二节 业务发展目标.....</b>	<b>245</b>
一、 发行人当年及未来二至三年内的 development 计划.....	245
二、 发行人拟定上述计划所依据的假设条件.....	247
三、 实施上述计划将面临的主要困难.....	247
四、 发展计划与现有业务关系 .....	248
<b>第十三节 募集资金运用.....</b>	<b>249</b>
一、 募集资金运用概况 .....	249
二、 实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排 .....	249
三、 6—8 英寸硅抛光片扩产项目 .....	250
四、 8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目 .....	262
<b>第十四节 股利分配政策.....</b>	<b>273</b>
一、 最近三年股利分配政策和实际股利分配情况 .....	273
二、 滚存利润的分配安排 .....	274
<b>第十五节 其他重要事项.....</b>	<b>275</b>
一、 发行人信息披露制度 .....	275
二、 发行人重要合同 .....	275
一、 备查文件目录 .....	286
二、 文件查阅联系方式 .....	286

## 第一节 释义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

立立电子、公司、	指	宁波立立电子股份有限公司
本公司、发行人		
立立半导体、宁波海纳	指	宁波立立半导体有限公司，即原宁波海纳半导体有限公司
立昂电子	指	杭州立昂电子有限公司
立立科技	指	杭州立立科技实业有限公司
《章程》	指	上市后生效的本公司章程
股票、A 股	指	本公司发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票
本次发行	指	发行人本次向社会公开发行 2600 万股人民币普通股股票（A 股）的行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、中 信建投	指	中信建投证券有限责任公司
发行人律师	指	国浩律师集团（上海）事务所
发行人审计机构、东方 会计师事务所	指	浙江东方会计师事务所有限公司，原浙江东方中 汇会计师事务所有限公司
报告期、近三年	指	2005 年、2006 年以及 2007 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
纳米	指	10 <sup>-9</sup> 米
微米	指	10 <sup>-6</sup> 米
英寸	指	计量半导体硅片直径的常用单位，6 英寸约相当 于 150 毫米，8 英寸约相当于 200 毫米，12 英寸 约相当于 300 毫米。硅片尺寸和线宽指标是集成 电路制造的主要工艺技术标志

<b>IT</b>	指	信息技术 (Information Technology) 的英文缩写, 包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
<b>半导体</b>	指	导电性能介于导体和绝缘体之间的物质, 如: 硅和锗
<b>多晶硅</b>	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体, 各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备硅单晶的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅提纯而来
<b>石英坩埚</b>	指	在直拉硅单晶生长工艺中, 用于盛放高温硅熔体的石英容器
<b>硅单晶</b>	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体。硅单晶是用高纯多晶硅为原料, 通过直拉法或区熔法制得
<b>硅片</b>	指	由硅单晶锭切割形成的圆形片, 经过抛光工艺加工得到抛光硅片, 在抛光硅片上经过外延工艺加工得到硅外延片
<b>器件</b>	指	半导体器件, 即通过对半导体中载流子 (电子和空穴) 输运和复合行为的控制而实现一定功能的产品。如: 二极管、晶体管和集成电路等
<b>芯片</b>	指	制造有半导体器件的硅片
<b>集成电路、IC</b>	指	将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起, 从而实现电路或者系统功能的半导体器件。其英文缩写为 IC
<b>分立器件</b>	指	在一个封装体内只有单一的半导体器件, 如: 晶体管和二极管
<b>二极管</b>	指	一种具有非对称电流-电压特性的两端器件, 在正向电压下具有大电流而在反向电压下只有很小的电流。它分为两大类: PN 结二极管和肖特基 (Schottky) 二极管

<b>晶体管</b>	指 一种通过电压或者电流控制输出电流的三端器件，具有放大和开关功能。它分为两大类：场效应晶体管和双极型晶体管
<b>掺杂</b>	指 在本招股书中是指把磷、砷、锑、硼等掺杂剂中的一种添加到硅晶体中，使其具有特定的导电类型和电阻率
<b>外延</b>	指 在单晶衬底上生长单晶薄膜。如：硅外延片就是在硅单晶衬底上生长一层硅单晶薄膜
<b>溅射</b>	指 一种淀积薄膜的方法。被电场加速的离子撞击靶材，使靶材的原子被撞击出来，它们淀积在衬底表面而形成薄膜
<b>封装</b>	指 晶圆制造后的一系列工序，将晶圆分割成单个的芯片，焊接引线并安放和连接到一个封装体上
<b>掺杂物</b>	指 为确定半导体导电类型或者调控半导体其它性质而引入的物质。如：为了使硅晶体成为 N 型，可以掺入磷、砷或锑；而为了使硅晶体成为 P 型，则可以掺入硼
<b>靶材</b>	指 溅射淀积工艺使用的源材料，通常做成圆盘状或者方块状
<b>SEMI</b>	指 Semiconductor Equipment and Materials Institute，中文名称为国际半导体设备与材料学会
<b>SIA</b>	指 Semiconductor Industry Association，中文名称为美国半导体产业协会
<b>万胜博讯</b>	指 北京万胜博讯高科技发展有限公司
<b>CCID、赛迪顾问</b>	指 赛迪顾问股份有限公司
<b>Hemlock</b>	指 Hemlock Semiconductor Corporation，Hemlock 是全球最大的多晶硅供应商之一
<b>Tokuyama</b>	指 Tokuyama Corporation，是全球最大的多晶硅供应商之一

<b>REC</b>	指 挪威 Renewable Energy Corp, REC 全球最大的多晶硅供应商之一
<b>Wacker</b>	指 Wacker-Chemi AG, 中文名称为德国瓦克公司, 全球最大的多晶硅供应商之一
<b>MEMC</b>	指 MEMC Electronic Materials, Inc., 最大的多晶硅供应商之一
<b>ST</b>	指 ST Microelectronics, 中文名称为意法半导体公司
<b>On Semi</b>	指 On Semiconductor, 中文名称为安森美半导体公司
<b>CR Semi</b>	China Resources Semiconductor co. ltd.即华润半导体有限公司
<b>IR</b>	指 International Rectifier , 中文名称为国际整流器公司
<b>Fairchild</b>	指 Fairchild Semiconductor, 中文名称为仙童半导体公司
<b>TI</b>	指 Texas Instruments, 中文名称为德州仪器
<b>Shin-Etsu 或信越</b>	指 Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd, 中文名称为日本信越工业化学株式会社, 全球最大的硅片生产企业之一
<b>SUMCO</b>	指 Sumitomo Mitsubishi Silicon Corp, 全球最大的硅片生产企业之一
<b>浙大海纳</b>	指 原浙江浙大海纳科技股份有限公司, 现更名为浙江海纳科技股份有限公司
<b>扬州晶新</b>	指 扬州晶新微电子有限公司
<b>华润晶芯</b>	指 华润晶芯半导体有限公司
<b>上海新进</b>	指 上海新进半导体制造有限公司
<b>上海先进</b>	指 上海先进半导体制造有限公司
<b>士兰微</b>	指 杭州士兰微电子股份有限公司
<b>上海贝岭</b>	指 上海贝岭股份有限公司

**济南晶恒**

指 济南晶恒有限责任公司

## 第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

### 一、发行人简介

#### （一）设立情况

发行人名称： 宁波立立电子股份有限公司

英文名称： NINGBO QL ELECTRONICS CO.,LTD.

注册地点： 宁波保税区 0125-3 地块

注册资本： 7,708 万元

法定代表人： 李立本

2000年6月，经宁波市人民政府甬政发[2000]119号文批准，陈伯良等45名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司。经宁波永德会计师事务所有限公司（永德验字[2000]80号）《验资报告》验证，截至2000年6月8日公司注册资本为1,000万元。此后经过数次增、减资和股权转让，截至2007年12月31日，本公司的股东人数为109人（均为自然人），注册资本为7708万元。

#### （二）基本业务情况

本公司主要业务为硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片及功率肖特基二极管芯片的制造和销售，公司目前工商登记的经营范围为：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；数据通讯，计算机软件技术开发；电子技术工程及技改项目的技术咨询、服务；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司是中国最大的硅抛光片和硅外延片生产企业之一，经过多年发展形成了由硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片和功率肖特基二极管芯片构成的半导体产业链。公司产品约 40%销往新加坡、美国、日本、中国台湾、马来西亚、韩国和加拿大等半导体产业发达国家和地区，已成为 ST、On Semi、CR Semi、GlobiTech Incorporated、Microsemi 等国际知名半导体制造商的稳定供应商，并与 ST、On Semi 等重要客户建立起了良好的长期合作关系；同时，公司还是士兰微、华润晶芯、上海先进、上海贝岭等国内主要半导体企业的重要硅片供应商。在原材料供应方面，公司与国际上最大的多晶硅供应商之一德国 Wacker 建立并保持了长期良好合作关系。公司还积极致力于同在国内半导体硅材料研究领域处于领先地位的浙江大学开展全面、战略合作，通过建立联合研发中心等方式展开全方位技术合作，使公司在技术研发和员工培训等方面获得有力支持。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高技术产业化示范工程单位；公司下属子公司立立半导体是国家“863 计划”成果产业化基地，设有企业博士后流动站；公司下属另一子公司立昂电子为浙江省级高新技术企业。公司还被国家发展改革委员会、信息产业部、海关总署和税务总局列入“第一批国家鼓励的集成电路企业名单”（发改高技[2007]1879 号），并被中国半导体行业协会评选为“中国半导体支撑业最具影响力企业”之一。

### （三）公司的竞争优势

#### 1、技术与研发优势

公司非常注重产品研发和技术进步，并拥有一支高度专业化的技术团队，该技术团队具有较强的消化吸收国外先进技术和自主研发、创新的能力。在该技术团队的不懈努力下，公司已熟练掌握了硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片制造技术，特别是在重掺硅片领域有独特优势。目前，公司的硅材料产品以技术含量和附加值较高的重掺硅抛光片、重掺衬底硅外延片产品为主，并在相关技术领域获得了三项国家发明专利，在国内同行业中居领先地位；同时在集成电路用硅片的生产制造上，公司在国内同行中也具有显著优势。公司的重掺硅片制造技术与国际同步发展，已具备与国际同行业知名跨国公司竞争的实力。

公司与浙江大学硅材料国家重点实验室（该领域中的唯一国家重点实验室）



建立了长期、稳定的战略合作关系，并于 2006 年 6 月成立了浙江大学—立立电子硅材料联合研发中心（以下简称“联合研发中心”）。浙江大学硅材料国家重点实验室是在国内外享有较高声誉的硅材料研究机构。联合研发中心的任务是为公司产品质量的提高、新产品开发和人才队伍的建设提供智力支持和技术保障。通过与浙江大学硅材料国家重点实验室积极、有效的技术合作，公司确立了在国内同行业中的技术领先地位。

## 2、高端定位优势

公司自设立以来，始终坚持高品质标准，将满足半导体行业高端客户的要求作为公司努力的目标。为此，公司成立伊始就建立了严格的质量保证体系，先后通过了瑞士 SGS 公司的 QS9000、ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002 等质量体系认证和 ISO14001:2004 环境体系认证。目前，公司能够分别按国际 SEMI 标准、中国国家标准、销售目的地国家标准或顾客特殊要求控制产品质量。在严格和高标准的品质保证之下，公司已经成为国际知名跨国公司的稳定供应商，并通过了这些大公司对产品质量体系、产品工艺和产品质量的严格审核和认证。同时，这些客户的严苛要求和新的需求也进一步推动公司管理水平、质量控制水平的不断提高。

经过多年的努力，公司已开发出一批包括 ST、On Semi、CR Semi、GlobiTech Incorporated、Microsemi 等国际知名跨国公司，以及士兰微、上海先进、上海贝岭、华润晶芯等国内知名公司在内的稳定的高端客户群。半导体硅片行业的客户开发周期较长，这主要是由于集成电路、分立器件厂商对硅片的品质要求较高，一般需要长达半年以上的硅片质量考察，才能确定是否选定为基础材料供应商，因此，成为其硅片供应商的门槛较高。公司与众多高端客户业已建立起的良好互信合作关系，是公司未来持续经营的有力保障。同时由于此类高端客户大都实力雄厚，具有较强的抵御市场风险的能力，生产波动性相对较小，因此其对本公司的产品订单较为稳定。

## 3、规模优势

公司是我国国内半导体硅材料行业的龙头企业之一。根据万胜博讯统计，2006 年我国硅抛光片、硅外延片的产量分别为 25,540 万平方英寸和 6,229 万平方英寸，同期公司硅抛光片、硅外延片的产量分别为 5,561 万平方英寸和 1,001

万平方英寸。本次发行募集资金拟投资项目 6-8 英寸硅抛光片项目和 8-12 英寸硅外延片项目投产后,将进一步确立公司产销规模和产品档次在国内同行业中的优势地位。

#### 4、半导体产业链上下游整合优势

公司作为目前国内唯一一家跨半导体硅材料和分立器件两个半导体子行业的半导体制造企业,涵盖了包括硅单晶拉制、硅抛光片、硅外延片以及分立器件芯片等半导体行业上下游多个生产环节,形成了一条相对完整的半导体产业链,便于发挥产业链上下游整合的优势,具体表现在以下三方面:

(1) 有利于保证公司产品的优良品质。从硅材料生产与器件生产相结合的角度看,公司掌握半导体两个子行业之间的业务衔接和技术衔接,一方面有利于从硅材料行业的上游直接控制和保证下游的产品质量,即从单晶拉制的源头就可以控制、调整相关工艺和技术参数,以生产符合市场需要的硅抛光片、硅外延片以及分立器件芯片;另一方面也有利于根据下游产品的技术要求和工艺要求及时上溯调整、优化上游环节的生产工艺和技术参数,从而实现产业链上下游之间的双向、互动调节,保证了上下游产品的优良品质。

(2) 缩短了新产品开发和市场推广的周期。公司上游产品直接供给下游生产使用,特别是新开发的产品可以在最短的时间内得到使用、验证,从而大大缩短上游新产品的开发、市场推广的时间;公司下游新产品的研制开发可对材料环节直接提出新的要求、进行技术改进,也可以大大缩短下游新产品的开发时间。这种优势在技术更新迅速的半导体产业中具有突出价值。

(3) 有利于提高公司抗风险能力。通过产业链的合理延伸,可以实现公司主导产品所需主要原材料的供给内部化,降低生产成本,提高公司的盈利能力和抗风险能力;另外,公司通过产业链的合理延伸,可以在拓展企业生存空间、提高盈利水平的同时,有效平抑上下游生产环节之间的供求波动或结构失衡。

本公司将秉承“立信、立德、务实、创新”的企业理念,充分利用上述优势,使自身业务能持续稳步发展,最终实现成为世界一流半导体材料供应商的战略目标。

## 二、公司控股股东及实际控制人情况

公司股东全部为自然人，控股股东及实际控制人为王敏文、陈茶花夫妇。王敏文、陈茶花的基本情况详见本招股意向书第五节“发行人基本情况”之“九、发起人、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

截至本招股意向书签署日，王敏文先生持有公司 25.95%的股权，其配偶陈茶花女士持有公司 2.59%的股权，两人合计持有公司 28.54%的股权。

## 三、发行人主要财务数据

根据浙江东方会计师事务所有限公司出具的浙东会审[2008]131号《审计报告》，本公司近三年的合并财务报告主要财务数据如下：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
资产总额	723,764,288.19	574,893,381.84	591,549,998.54
负债总额	360,211,280.47	281,194,661.05	365,615,712.52
归属于母公司股东权益合计	359,507,461.73	289,796,170.71	222,994,699.90
少数股东权益	4,045,545.99	3,902,550.08	2,939,586.12
股东权益合计	363,553,007.72	293,698,720.79	225,934,286.02

### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
营业收入	456,999,439.29	364,379,633.83	258,809,599.85
营业利润	102,803,196.95	72,119,898.63	38,410,788.49
利润总额	105,076,041.09	73,266,327.00	45,553,139.13
归属于母公司股东的净利润	88,981,291.02	56,975,245.10	42,413,915.05
少数股东损益	142,995.91	474,189.67	-251,774.40
净利润	89,124,286.93	57,449,434.77	42,162,140.65

**(三) 合并现金流量表主要数据**

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动现金流量净额	87,188,913.61	110,078,739.06	90,010,809.50
投资活动产生的现金流量净额	-66,517,396.68	-29,460,611.45	-57,379,018.14
筹资活动产生的现金流量净额	21,959,141.72	-64,589,749.93	-45,237,203.90
现金及现金等价物净增加额	41,580,645.42	15,633,925.50	-12,810,757.85

**(四) 主要财务指标**

财务指标	2007 年度	2006 年度	2005 年度
资产负债率（母公司）（%）	38.83	41.69	51.37
每股收益（摊薄）（元）	1.15	0.78	0.60
每股净资产（元）	4.66	3.76	3.14
每股经营活动现金流量净额（元）	1.13	1.43	1.27
净资产收益率（摊薄）（%）	24.75	19.66	19.02

**四、本次发行情况**

股票种类：人民币普通股（A 股）

每股面值：人民币1.00 元

发行股数：2,600万股

发行价格：根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格

发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象

## 五、募集资金主要用途

按项目轻重缓急排序，本次募集资金将用于以下项目：

项目名称	批准/备案文件	项目总投资（万元）
6-8 英寸硅抛光片扩产项目	宁波市企业投资项目备案登记表—甬发改备[2007]31 号	53,735
8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程	国家发展和改革委员会发改高科技[2004]2041 号文、宁波市发展与改革委员会甬发改工业[2007]369 号文	11,323
合 计	-	65,058

上述两个项目预计投资总额为65,058万元，目前政府已为8-12英寸硅外延片高技术产业化示范工程提供了1,250万元的政府补助，若本次发行实际募集资金超出拟投资项目的资金需求量，多余资金用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金低于拟投资项目的资金需求量，公司将采用自筹资金或银行贷款等筹资方式解决。

本次募集资金运用的详细情况参见本招股意向书“第十三章 募集资金运用”。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	人民币 1.00 元
发行股数:	2,600 万股, 占发行后总股本的比例为 25.22%
每股发行价:	根据初步询价结果, 由发行人和主承销商确定
市盈率:	[ ] 倍 (按发行后总股本全面摊薄计算)
市净率:	[ ] 倍 (按发行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产:	4.66 元 (以 2007 年 12 月 31 日经审计净资产值为基础)
发行后每股净资产:	[ ] 元 (按实际募集资金量全面摊薄计算)
发行方式:	本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式:	本次发行采取余额包销方式, 由保荐人 (主承销商) 中信建投证券有限责任公司包销剩余股票
预计募集资金总额和净额:	募集资金总额为 [ ] 万元, 扣除发行费用以后的募集资金净额约为 [ ] 万元
发行费用概算:	本次发行费用总额约为 [ ] 元,
其中:	承销费用及保荐费用: [ ] 万元 审计费用: [ ] 万元 律师费用: [ ] 万元 审核费用: [ ] 万元 发行手续费: [ ] 万元

## 二、本次发行的有关当事人

### （一）发行人：宁波立立电子股份有限公司

住 所：宁波保税区 0125-3 地块

法定代表人：李立本

联 系 人：涂洪浪

电 话： 0574-86821903

传 真： 0574-86881152

互联网网址： [www.ql-electronics.com](http://www.ql-electronics.com)

电子信箱： [securities@ql-electronics.com](mailto:securities@ql-electronics.com)

### （二）保荐人（承销商）：中信建投证券有限责任公司

住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2601 室

法定代表人： 张佑君

保荐代表人：宋永祎、张鸣溪

项目主办人：常亮

项目经办人：郝东旭、赵明、王广学、周菠、冯烜、郭姗姗、潘锋、朱明强、  
翟程

电 话： 021-68801546、68801554

传 真： 021-68801552

### （三）发行人律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

住 所：上海市南京西路 580 号南证大厦 3104-3106 室

联系地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 层

负 责 人：管建军

联系人：倪俊骥、余蕾

电话：021-52341668

传真：021-52341670

（四）发行人审计机构：浙江东方会计师事务所有限公司

住所：杭州市上城区解放路89号星河商务大厦10楼

法定代表人：胡建军

联系人：姜涛、高峰、林国雄

电话：0571-87855319、87559006、81855320

传真：0571-87559002

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）收款银行：工行北京东城支行营业室

户名：中信建投证券有限责任公司

收款帐号：0200080719027304381

（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南东路5045号

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083190

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。



### 三、本次发行的有关重要日期

- 1、 询价推介时间：2008年6月19日—2008年6月23日
- 2、 定价公告刊登日期：2008年6月25日
- 3、 申购日期和缴款日期：2008年6月26日
- 4、 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股意向书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素已按照重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序。

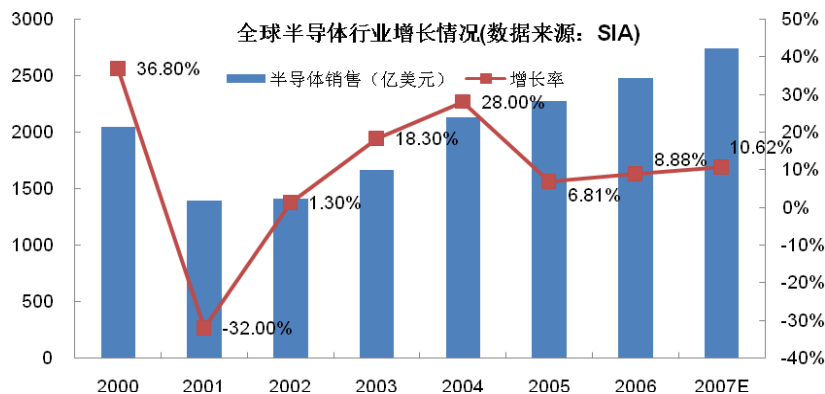
### 一、市场风险

#### （一）市场拓展的风险

本公司目前主营业务为硅抛光片、硅外延片和功率肖特基二极管芯片的研发、生产与销售。由于半导体硅材料行业已形成国际垄断格局，8英寸及以上的大尺寸硅片市场更是由几家国际大型硅片生产企业所垄断；同时，由于硅片对集成电路质量具有关键性作用，集成电路企业在选择供应商时相当慎重，新进入的供应商需要经过一个严格且长期的认证过程，因此市场进入壁垒较高。随着公司生产规模的扩大，特别是募集资金投资项目建成后，公司将积极拓展大尺寸硅片市场，如果公司不能有效地拓展产品市场，将会面临经营业绩难以达到预期的风险。

#### （二）行业周期性变化的风险

半导体行业由于受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等影响，存在着周期性波动，业内通常认为大约每隔四、五年全球半导体产业经历一次“景气循环”。例如，2001年为全球半导体行业的低谷，2004年则是全球半导体行业发展的一个高峰，2005年出现调整，从2006年开始恢复上升（见下图）。



本公司主营业务处于半导体产业链中的半导体材料和分立器件行业，因此业

务发展也受到半导体行业市场“景气周期”的影响，可能出现相应的周期性波动，当全球半导体行业处于发展低谷，公司可能面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

半导体行业景气周期的形成主要是由于半导体行业尤其是集成电路行业的投资规模巨大、产能爆发性增长和技术更新较快所致。但是随着行业趋于成熟，技术更新的成本日益增加，企业产能和库存管理改善，半导体行业景气周期出现了周期波动放缓、峰谷差异缩小的新特征（见上图）。此外，公司所处半导体材料和分立器件行业成熟度较高，投资规模远小于集成电路行业，且产品的生命周期较长，因此周期波动性相对较弱。

## 二、经营风险

### （一）公司主要原材料供应紧张及价格波动的风险

多晶硅是硅片制造的核心基础原材料，多晶硅成本约占公司 2007 年度产品原材料成本的 29%左右。随着半导体行业，特别是太阳能光伏产业的迅猛发展，多晶硅的市场需求急剧膨胀，导致全球范围内供应紧张，价格持续上涨。由于我国多晶硅供给基本依赖进口，获得多晶硅的能力已经成为左右我国硅片生产企业发展的重要因素，同时其持续上涨的价格也影响了硅片生产企业的盈利能力。尽管公司针对多晶硅供应问题已经采取了有效的应对措施，但仍存在多晶硅供给发生困难或者多晶硅采购价格大幅度上升等风险，这对公司的正常生产与盈利能力都将产生不利影响。

### （二）对境外主要供应商依赖度较高的风险

公司生产硅单晶锭的主要原辅材料为多晶硅、石英坩埚以及成品包装盒等。多晶硅的主要供应商为德国 Wacker 等公司，石英坩埚主要供应商为美国 GE Quartz inc.，成品包装盒的主要供应商为 Entegris 等公司，报告期内公司主要原辅材料采购自上述三个供应商的比例见下表：

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
采购自德国 Wacker 占多晶硅总采购量的比例	94.47%	90.31%	87.93%
采购自 GE Quartz inc. 占石英坩埚总采购量的比例	99.68%	99.27%	99.90%
采购自 Entegris 占成品包装盒总采购量的比例	97.23%	99.20%	99.55%

从上表可以看出，公司目前存在重要原材料对境外主要供应商依赖度较高的风险，如果这些供应商中断与本公司的业务合作，或者其自身经营或财务状况出现大的变化导致不能足量及时供货，可能影响本公司生产经营的稳定。

发行人多晶硅原材料的采购主要集中在德国 Wacker 和日本 Tokuyama 等少数供应商。报告期内，公司采购自德国 Wacker 的多晶硅占多晶硅总采购量的比例均在 85%以上，且该比例呈现逐年上升趋势，这主要是由于公司与德国 Wacker 建立了越来越紧密的合作关系，Wacker 给与公司的多晶硅供应量和价格均符合公司的要求，导致报告期内公司多晶硅采购越来越集中于德国 Wacker。公司已经意识到主要原材料供应集中在一个供应商存在的风险，目前正采取措施，在稳定与德国 Wacker 良好的供应关系的基础上，还加强与日本 Tokuyama 的供应关系，同时开拓其他多晶硅供应渠道，以化解多晶硅采购过于集中可能带来的风险。

需要说明的是，公司主要原材料的采购集中于境外主要供应商，具有行业的特殊性。首先，由于半导体硅材料行业已经形成了国际垄断，少数境外供应商掌握了最先进的技术和绝大部分的市场份额，客观上导致了公司的供应商集中；其次，由于国内半导体行业还处于发展阶段，各项配套环节还不完备，国产原辅材料与进口材料在品质上仍有较大差距，为保证产品质量、降低耗材，公司选择品质较高的进口材料；再次，由于公司选择的供应商均为国际知名的大型企业，使用其原辅材料能更好的满足公司客户的要求，有利于公司争取客户。上述行业特点决定了公司主要原辅材料自境外主要供应商集中采购的状况在短期内难以显著改变。

公司主要供应商均为实力雄厚的国际大型企业，经营稳定、信誉良好，且与本公司建立了长期稳定的合作关系。公司一般与其签订全年或者长期的采购合同，保证了原辅料的稳定供应。报告期内，公司未有因原辅材料供应不畅导致生产停顿、交货延迟的情况。

公司仍将进一步巩固和加强与主要境外供应商的稳定合作关系，同时积极开发新的供应商，并进一步完善供应商准入制度，建立更加丰富和完善的供应渠道体系，降低对主要境外供应商的依赖度和原材料供应风险。

### 三、财务风险

#### (一) 应收账款余额较大、占流动资产比例较高的风险

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司应收账款账面余额为 11,151.74 万元, 占流动资产的 26.51%, 占总资产的 15.41%。公司应收账款余额较 2006 年末增加了 74.50%, 其主要原因在于: (1) 2006 年下半年公司产品供不应求, 很多客户为争取货源而加快回款甚至预付货款, 从而使期末应收账款低于通常水平, 较低的比较基数是造成 2007 年 12 月 31 日应收账款余额较 2006 年末增幅较大的主要原因; (2) 2007 年度公司销售收入较上年同期有较大幅度增长, 增幅达 25.42%; (3) 进入 2007 年度, 公司主导产品供不应求的状况有所改变, 为加大营销力度, 巩固市场份额, 公司对部分核心优质客户放宽了销售条件, 适当延长了赊销期。但是, 随着公司主营业务收入的快速增长, 应收账款余额仍有进一步增加的可能, 存在一定的坏账风险。此外, 随着公司产能的不断提高, 市场不断拓展, 公司将与其他新客户建立交易关系, 由于对新客户信用、偿债能力等情况的了解需要时间, 因此开拓新客户所带来的应收账款增加亦会存在一定的信用风险。

#### (二) 存货金额较大的风险

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司存货账面价值为 12,392.06 万元, 占流动资产的 29.46%, 占总资产的 17.12%, 公司存货金额较大。其中, 库存材料、库存商品、在产品、委托加工材料分别占存货账面价值的 35.64%、35.44%、24.21%和 4.61%。

存货中库存材料金额较大的主要原因系原材料在公司主导产品成本构成中所占比重较大。由于多晶硅等重要原材料供应趋紧, 为确保公司生产经营活动正常进行, 公司需保持相当数量的原材料库存。除原材料外, 存货中库存商品也占相当比例, 主要原因是由于公司主导产品具有客户固定和批次生产的特点, 为满足部分主要客户不时发出的定单需求, 同时减少小批次生产带来的较高成本, 公司会采取适度扩大批次生产规模的策略, 该策略在及时满足客户需求和降低单位产品生产成本的同時, 也会造成库存商品的增加。此外, 由于公司产品覆盖产业链较长, 前端产品中相当一部分将用作继续加工生产后端产品, 如公司下属子公司立立半导体生产的硅抛光片约 30% 用于继续加工生产硅外延

片，但仍列为库存商品。

公司基本按照订单安排生产，在产品及库存商品发生损失的可能性较小，但公司仍可能因为原材料市场价格波动、产成品出现质量问题等原因，导致存货跌价损失的风险。

### （三）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目从实施到发挥效益需要一定周期，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

## 四、税收优惠、政府补助政策风险

### （一）税收优惠政策不确定及税收优惠到期的风险

根据《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》（财税[2000]25号）及《关于〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策〉的通知》（财税[2002]70号）之规定，本公司与立立半导体自获利年度起企业所得税执行“两免三减半”政策。2007年为本公司进入减半征收所得税的第三年，立立半导体进入减半征收所得税的第二年。

公司及下属子公司享受的税收优惠政策，对公司的业绩有较大影响。如果财税[2000]25号文件及财税[2002]70号文件关于企业所得税“两免三减半”的政策被废止或者变更，则公司及立立半导体将可能提前全额交纳企业所得税。

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，自2004年1月1日起至2007年6月30日止，硅片的退税率为13%、功率肖特基二极管芯片的退税率为17%。根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的公告》（财税[2007]90号），自2007年7月1日起，硅单晶片的退税率降低为5%，功率肖特基二极管芯片的退税率仍为17%。如果国家出口退税的政策变化，则将影响企业的利润水平。

因上述税收优惠政策存在的不确定性，以及公司目前享受的税收优惠会逐步到期，将对公司盈利情况产生影响。

## （二）政府补助不确定的风险

公司及下属子公司从事半导体硅材料及器件的生产和销售，属于国家产业政策重点支持的行业，公司的发展亦受到当地政府的大力扶持。

2005年、2006年和2007年，公司所获政府补助计入当期损益的金额分别为719.72万元、338.31万元和280.12万元，分别占当年利润总额的15.80%、4.62%和2.67%。尽管公司收到的政府补助占当年利润总额的比例逐年下降，但由于金额较大，对公司的经营业绩仍有一定的影响。由于政府补助具有一定的不确定性，若政府相关鼓励政策发生变化或本公司不再符合取得政府补助的条件，则公司存在因政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。

## 五、技术和管理风险

### （一）新产品开发的风险

为保持公司的可持续发展能力，公司必须保持新产品开发能力，但在新产品开发中，存在因自身研发能力、资金实力有限，造成新产品研发失败或者新产品产业化滞后的风险，不仅使前期投入不能收回，更可能导致公司市场竞争力下降或企业发展速度放慢。

### （二）技术人才及管理人员流失的风险

作为一家高新技术企业，技术人才对于本公司的发展具有重要意义。如果公司的技术人才发生流失、泄露技术秘密，或者技术人才知识结构丧失先进性、研发能力下降，都将会对公司的发展产生不同程度的不利影响。为了加强公司关键技术人员对公司的忠诚度和利益相关度，公司已经通过吸收关键技术人员持股的方式，使其切身利益与公司的长远发展紧密相连。公司还将进一步完善对技术人员的激励机制和奖励机制，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和足够的物质激励，使其能自觉维护公司利益，积极主动地投身于公司的技术研发工作中。在稳定与激励现有技术人员队伍的基础上，公司还将加大力度做好人才的引进和培育工作，使公司形成可持续发展的人才储备。

公司的核心技术人员包括李立本、刘培东和田达晰等三人，该等核心技术人

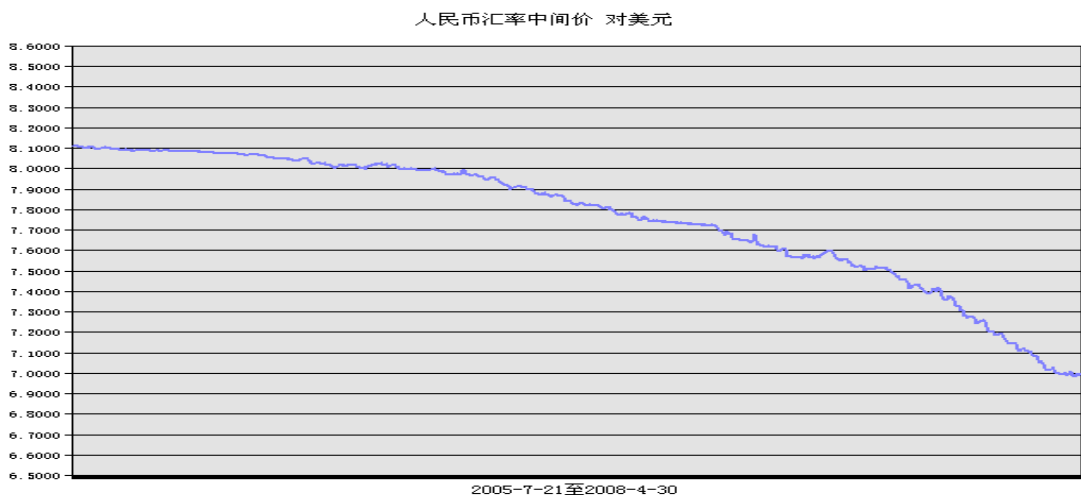
员同时也是公司的核心管理人员，其中李立本先生还担任公司董事长职务；刘培东担任公司副总经理职务，负责公司的品质保障工作；田达晰担任公司副总经理，负责公司的技术研发工作。另外，公司的总经理林必清、副总经理陈卫忠、李晓军、吴能云等人多年来在公司内部担负管理工作，也是公司的核心管理人员。公司虽有股权激励措施，上述人员也均为公司股东，但仍不排除其因各种原因不再在公司任职的情形，如出现该类情形将会对公司的经营管理、技术保障和研发工作产生重大不利影响。由于公司已与公司核心技术人员和核心管理人员均签署了《敬业、保密和保护知识产权协议》，即使上述人员离开公司不再在公司担任职务，但也不能从事与公司存在竞争关系的业务。

## 六、汇率风险

### （一）公司主要外汇业务

公司涉及外汇业务的主要有三种情形：一是产品出口业务，全部以美元结算；二是原辅材料进口业务，以美元、欧元、日元等多外币品种结算；三是设备进口业务，公司大型设备主要依靠进口，多以美元结算。由于欧元和日元对人民币的汇率变动较小，对公司业绩影响较小，可忽略不计。

公司发生的以美元结算的业务量较大，并且近期美元对人民币汇率升值幅度加快，因此美元对人民币汇率的变动对公司业绩有一定影响。汇率改革以来美元对人民币汇率变动趋势如下图所示：



数据来源：中国人民银行网站

### （二）关于汇率变动对公司业绩影响的量化分析



公司产品出口全部以美元结算，在不考虑原辅材料和进口的前提下，美元对人民币贬值对报告期内公司净利润的影响程度如下表所示：

期 间	2007 年度	2006 年度	2005 年度
期末美元兑人民币的汇率	7.3046	7.8087	8.0702
期末汇率较期初下降额	-0.5041	-0.2615	-0.2063
期末汇率较期初下降幅度	-6.46%	-3.24%	-2.49%
出口收入（万美元）	2,486	2,201	1,502
账面出口收入金额（人民币万元）	18,923	17,598	12,307
按期初汇率不变计算 对营业收入的影响（人民币万元）	-489	-165	-124
按期初汇率不变计算 对净利润的影响金额（人民币万元）	-408	-138	-103
按期初汇率不变计算 对净利润的影响金额占实际净利润的比重	-4.58%	-2.39%	-2.45%

报告期内，立立电子每年均有较大金额的原材料进口，2007 年、2006 年、和 2005 年进口原材料的美元结算金额分别为 642 万美元、1064 万美元和 751 万美元，由于美元结算的进口金额可在一定程度上抵销美元结算的出口金额所受汇率影响，因此美元升值对公司毛利的实际影响程度小于上表所示金额。

### （三）汇率风险应对措施

#### 1、适当提高产品价格

由于产品质量优良、稳定，市场需求旺盛，公司具有较强的议价能力，特别是部分产品，公司具有相当的定价主导权。因汇率变动带来的成本上升能够以适当提高产品售价的方式转移给下游客户。

#### 2、通过合同约定分担汇率风险

公司在与海外客户签订的长期合同中已经考虑了汇率变动的影响，在汇率变动导致实际成本显著高于预期的情况下，将由公司和客户共同承担汇率变动的风险。公司拟在 2008 年与国外客户在销售合同中协商约定，在人民币升值超过 5% 的情况下，适当提高产品售价。

#### 3、调整负债币种结构，适当增加美元借款比例

公司目前已开始通过适当增加美元负债来抵消汇率变动风险，2007年12月31日，公司美元短期借款和长期借款分别为915万美元和252.5万美元，今后公司将尽可能加大美元负债的比例，以降低汇率变动风险。

#### 4、加大国内市场的开拓力度

人民币汇率升值对公司的影响主要在于公司出口业务，目前公司正在积极开拓内销市场，随着内销市场的扩大，汇率升值对公司的影响会减小。

## 七、管理风险

本次发行完成后，公司的净资产规模将迅速扩大，其后随着公司的持续发展和募集资金投资项目的建成投产，公司的生产能力将发生大幅提高。由于净资产规模和业务规模的迅速扩张，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战，如果公司未能及时调整经营观念、管理手段，将可能面临企业规模扩张的压力。

## 八、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金拟投资的两个项目，均经过反复论证和审慎的可行性研究分析，项目如果能够顺利实施，将大大增加本公司的产能和提高核心竞争力，进一步扩大产品的市场份额，给本公司带来全新的发展机遇。但由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。公司募集资金投资项目面临的风险主要有以下几个方面：

### （一）产能扩张的市场销售风险

目前，本公司硅抛光片的最大生产能力为年产各类硅抛光片300万片，其中6英寸的硅抛光片的产能为180万片，而8英寸硅抛光片尚未量产。本项目建成投产后，将使公司新增年产6英寸硅抛光片300万片、8英寸硅抛光片60万片的生产能力。相对于公司现有的产销规模，产能扩张将对公司的市场开拓能力提出更高的要求，另外8英寸硅抛光片属于公司新产品品种，较高档次新产品品种的市场开拓也面临一定挑战。

目前，本公司硅外延片的设计生产能力为年产4-6英寸硅外延片80万片，

本项目建成投产后，将使公司新增年产 8 英寸硅外延片 24 万片的生产能力。由于目前仅有极少量 8 英寸硅外延片的销售，虽然原有客户对 8 英寸硅外延片有较大需求，且公司的 8 英寸硅外延片已经得到客户认可，但仍存在一定的市场拓展压力。

虽然公司在技术和市场两方面都做好了应对产能扩张带来销售压力的准备，有能力在产能扩张和核心产品品种投产的同时，实现快速拓展市场的目标，但是发行人不排除因市场开拓不力导致的产能扩张无法消化的风险。

## （二）技术风险

虽然公司已经掌握本次募集资金投资项目所涉及的生产技术，产品的加工工艺也已成熟，且 6 英寸硅抛光片产品已经实现大批量生产，8 英寸硅抛光片和 8 英寸硅外延片也已经实现小批量生产，但半导体产业技术更新迅速，如果公司不能及时跟踪和掌握行业前沿的新技术和新工艺，募集资金投资项目的产品在国内外同行业的竞争优势将受到影响。

另外，项目建成投入后，固定资产将大幅度增加，相应增加了每年折旧，增加了公司的生产成本和费用。此外，如果公司项目管理不善或产品市场开拓不力，或国家宏观经济政策发生变化，将可能使募集资金投资项目不能产生预期经济效益，进而对本公司的经营状况产生不利影响。

## （三）产能利用不足的风险

报告期内 6 英寸硅抛光片每年的产量均低于其产能，如 2005 年、2006 年以及 2007 年的产能分别为 110 万片、130 万片以及 180 万片，而同期的的产量则分别为 86.90 万片、105 万片以及 117 万片。出现以上产量低于产能的原因，主要是由于公司在报告期内，每年都加大 6 英寸硅抛光片固定资产投入，以提高该类产品的产能。而公司披露的产能都是年末公司实际形成的产能，而事实上公司每年产能的扩大都是在原有生产线的基础上改、扩建实现的，从改、扩建到达产需要一个过程，造成全年的实际产量与年末形成的产能相比有一定差异。实际上，公司完全可以利用足现有的产能，目前公司的客户对公司 6 英寸硅抛光片提出的新需求，公司现有的产能尚无法满足。但由于募集资金投资项目实施后，公司 6 英寸硅抛光片产能增加较多，仍有可能面临短期内产能利用不足的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

公司名称：宁波立立电子股份有限公司

英文名称：NINGBO QL ELECTRONICS CO., LTD.

注册资本：7,708 万元

法定代表人：李立本

成立日期：2000 年 6 月 21 日

公司住所：宁波保税区 0125-3 地块

邮政编码：315800

联系电话：0574-86821903

传真号码：0574-86881152

互联网址：[www.ql-electronics.com](http://www.ql-electronics.com)

电子信箱：[securities@ql-electronics.com](mailto:securities@ql-electronics.com)

本公司主要业务为硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片及功率肖特基二极管芯片的制造和销售，是中国最大的重掺硅抛光片和硅外延片生产基地之一，并拥有由硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片和功率肖特基二极管芯片构成的半导体产业链。公司产品约 40%销往新加坡、美国、日本、中国台湾、马来西亚、韩国和加拿大等半导体产业发达国家和地区，已成为 ST、ON Semi、CR Semi、GlobiTech Incorporated、Microsemi 等国际知名半导体制造商的稳定供应商，并与 ON Semi、ST 等重要客户建立起了良好的长期合作关系；同时，公司还是士兰微、华润晶芯、上海先进、上海贝岭等国内主要半导体企业的重要硅片供应商。在原材料供应方面，公司与国际上最大的多晶硅供应商之一德国 Wacker 建立并保持了长期良好合作。公司还积极致力于同在国内半导体硅材料领域处于领先地位的浙江大学开展全面、战略合作，通过建立联合研发中心等方式展开全方位技术合作，使公司在技术研发和员工培训等方面获得有力支持。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高技术产业化示范工程单位；公司下属子公司立立半导体是国家“863 计划”成果产业化基地，设有企业博士后流动站；公司下属另一子公司立昂电子为浙江省级高新技术企业。公司还被国家发展改革委员会、信息产业部、海关总署和税务总局列入“第一批国家鼓励的集成电路企业名单”（发改高技[2007]1879 号），并被中国半导体行业协会评选为“中国半导体支撑业最具影响力企业”之一。

## 二、发行人改制重组情况

### （一）设立方式

2000 年 6 月，经宁波市人民政府甬政发[2000]119 号文批准，陈伯良等 45 名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司，注册资本 1,000 万元。其中：陈伯良等 45 名自然人出资 700 万元，占注册资本的 70%；宁波海纳出资 300 万元，占注册资本的 30%。2000 年 6 月 21 日，公司办理了工商登记注册手续，领有宁波市工商行政管理局核发的注册号为[3302001003823]的企业法人营业执照；2002 年 3 月 6 日，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为[3302002005603]；2007 年 8 月 17 日公司变更登记经营范围，同时，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为[330200000006651]

### （二）发起人

公司发起人为陈伯良等 45 名自然人和宁波海纳。

### （三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时，主要发起人陈伯良除在公司投资外，不存在其它重大投资。发起人宁波海纳主要从事硅抛光片的生产和销售，所拥有的主要资产为硅抛光片生产设备、厂房和土地使用权。

公司成立后，宁波海纳实际从事的主要业务和所拥有的主要资产均未发生变化。

#### （四）公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司成立时用股东投入的股本金购买了硅单晶锭和硅外延片生产设备及土地使用权，并新建厂房；从事的主要业务为硅单晶锭、硅外延片的生产和销售。

#### （五）公司成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

自公司成立后至今，主要发起人陈伯良在公司一直担任监事一职。

公司成立后与发起人宁波海纳之间存在材料采购关联关系，为消除关联交易，2002年3月公司回购并注销了宁波海纳所持公司全部股份；2002年至2004年，公司先后收购宁波海纳90%的股权，并于2004年6月将其更名为立立半导体，现为公司主要子公司之一。详细情况参见本节之“五、历次重大资产重组和收购兼并”。

#### （六）独立运营情况

本公司成立以来，均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作。目前，公司股东全部为自然人。本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

##### 1、业务独立

公司目前主要从事4-6英寸硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片，以及功率肖特基二极管芯片的生产和销售，业务完全独立。公司拥有独立完整的采购系统、生产系统及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。

目前公司股东均为自然人，与公司之间无关联交易；公司主要股东除对本公司投资和在本公司担任相关职务外，不存在其他从事与本公司相同、相似业务的情形，并均已出具避免与本公司发生同业竞争的承诺函，因此不会对本公司的业务独立性产生影响。

##### 2、资产独立

本公司资产独立于公司股东。公司具备完善的生产系统、辅助生产系统和配

套设施，合法拥有与生产经营相关的土地使用权、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等重要资产的所有权及使用权。公司资产与股东个人财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

### 3、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及公司《章程》等有关规定产生，不存在违法兼职情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

### 4、机构独立

公司自成立以来逐步完善法人治理结构，建立有健全的内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立纳税，独立对外签订合同。公司没有为股东及其关联企业提供担保或将以本公司名义的借款借给股东及其关联企业使用。

发行人律师经核查，认为“拟发行人的经营性资产独立完整；拟发行人的人员独立，董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，不存在有关法律法规禁止的兼职情况；拟发行人的组织机构独立，拥有独立运作的生产经营和办公机构；拟发行人已建立了独立的财务核算体系，执行独立的财务管理制度，独立开立银行帐户，独立纳税。”

### 三、发行人股本形成及其变化情况

#### （一）2000年6月公司设立

2000年4月28日，陈伯良等45名自然人和宁波海纳签订了《发起设立宁波立立电子股份有限公司协议书》。2000年6月2日，宁波市人民政府下发（甬政发[2000]119号）文，批准陈伯良等45名自然人和宁波海纳共同发起设立本公司。公司股本总额为1,000万元，每股面值1元。公司全体股东以现金合计1000万元认购公司1000万股。其中宁波海纳以自有资金300万元出资，公司主要自然人股东陈伯良190万元的出资额的资金来源为其家庭收入所得，其他股东的出资额的资金来源为其薪酬收入或家庭其他收入。全体发起人的出资均已实际缴纳完毕，宁波永德会计师事务所出具了（永德验字[2000]80号）《验资报告》，确认截至2000年6月8日宁波海纳及陈伯良等45名自然人以现金出资认缴股本1,000万元，公司实收注册资本为1,000万元。

2000年6月8日，公司召开了创立大会，会议表决通过了公司筹办情况的报告、公司章程，并选举了董事会、监事会成员。2000年6月21日，公司办理了工商注册登记手续，并领有宁波市工商行政管理局核发的注册号为[3302001003823]的《企业法人营业执照》。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东	认购股数 (万股)	持股比例	序号	股东	认购股数 (万股)	持股比例
1	宁波海纳	300	30%	24	李晓军	10	1%
2	陈伯良	190	19%	25	赵榕椿	10	1%
3	杨在亮	40	4%	26	贺云冲	10	1%
4	康蓓华	30	3%	27	陈志云	10	1.00%
5	贾银凤	20	2%	28	李刚	9	0.90%
6	李晓劲	20	2%	29	饶伟星	9	0.90%
7	张锦心	20	2%	30	沈益军	8	0.80%
8	赵松宏	20	2%	31	方杏芬	8	0.80%
9	杨启基	20	2%	32	杨希望	8	0.80%
10	江富琴	16	1.60%	33	肖型奎	8	0.80%
11	陈峪	16	1.60%	34	吕迅	8	0.80%
12	徐京红	15	1.50%	35	唐雪林	8	0.80%
13	施春洪	14	1.40%	36	王云娟	8	0.80%
14	陆晓冬	13	1.30%	37	翁格菲	7	0.70%



序号	股东	认购股数 (万股)	持股比例	序号	股东	认购股数 (万股)	持股比例
15	刘培东	13	1.30%	38	田达晰	7	0.70%
16	羊荣兴	13	1.30%	39	冯春阳	5	0.50%
17	郑建国	13	1.30%	40	林必清	5	0.50%
18	陈亚萍	13	1.30%	41	黄海燕	5	0.50%
19	马向阳	12	1.20%	42	张民杰	5	0.50%
20	杨德仁	12	1.20%	43	倪永明	4	0.40%
21	李莉	10	1%	44	蒋校龙	3	0.30%
22	蔡理	10	1%	45	茹广	3	0.30%
23	方桂琴	10	1%	46	严建良	2	0.20%
合 计						1,000	100%

## (二) 2000年12月公司增资

2000年12月11日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意增发股份302万股，全部由杨在亮等38名原自然人股东按每股人民币1元的价格认购，股份认购价格为新老股东协商后确定，认购股东出资均已实际缴纳完毕。根据宁波永德会计师事务所出具的验资报告（永德验字[2000]169号）之附表，截至2000年12月25日，公司的主要财务状况如下：公司总资产3,035万元、净资产1,410万元、每股净资产1.08元，当期主营业务收入382.9万元、利润总额128万元、每股收益约为0.11元。该次增资，股东新增出资的资金来源均为其薪酬收入或其他家庭收入。

2000年12月19日，宁波市经济体制改革委员会下发（甬股改[2000]31号）文，批准公司总股本由1,000万股增加至1,302万股。本次增资完成后，公司注册资本增至1,302万元，所有增资股本金均已缴纳完毕。宁波永德会计师事务所出具（永德验字[2000]169号）《验资报告》，确认截至2000年12月25日杨在亮等38名自然人以现金出资认缴股本302万元，公司实收注册资本为1,302万元。

2000年12月27日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。此次增资完成后，公司股东及股东人数未发生变化，但持股比例有所调整，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	宁波海纳	300	23.04%	24	羊荣兴	16	1.23%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
2	陈伯良	190	14.59%	25	杨希望	16	1.23%
3	杨在亮	50	3.84%	26	方桂琴	15	1.15%
4	陆晓冬	43	3.30%	27	李晓军	15	1.15%
5	贾银凤	40	3.07%	28	贺云冲	14	1.08%
6	康蓓华	40	3.07%	29	吕迅	14	1.08%
7	陈峪	31	2.38%	30	唐雪林	13	1.00%
8	赵松宏	30	2.30%	31	李刚	12	0.92%
9	杨启基	30	2.30%	32	王云娟	12	0.92%
10	徐京红	30	2.30%	33	饶伟星	11	0.84%
11	李莉	30	2.30%	34	蔡理	10	0.77%
12	杨德仁	27	2.07%	35	赵榕椿	10	0.77%
13	张锦心	25	1.92%	36	肖型奎	10	0.77%
14	郑建国	23	1.77%	37	翁格菲	10	0.77%
15	马向阳	22	1.69%	38	黄海燕	10	0.77%
16	李晓劲	20	1.54%	39	张民杰	10	0.77%
17	江富琴	20	1.54%	40	沈益军	8	0.61%
18	施春洪	20	1.54%	41	茹广	6	0.46%
19	陈亚萍	20	1.54%	42	冯春阳	5	0.38%
20	陈志云	20	1.54%	43	林必清	5	0.38%
21	刘培东	19	1.46%	44	倪永明	5	0.38%
22	田达晰	19	1.46%	45	蒋校龙	4	0.31%
23	方杏芬	18	1.38%	46	严建良	4	0.31%
合 计						1,302	100%

### (三) 2002年3月公司减资

为消除关联交易,2001年9月22日,公司与宁波海纳签订《股份回购合同》,约定公司按每股人民币1.4元的价格回购宁波海纳持有的公司300万股股份,回购价款共计人民币420万元。上述回购价格系依据浙江东方会计师事务所以2001年8月31日为基准日对公司审计并出具的(浙东会审[2001]字第798号)《审计报告》经双方协商确定。根据该《审计报告》,截至2001年8月31日,公司总资产4,271万元、净资产1,480万元、总股本1,302万元、每股净资产为1.14元,2001年1-8月主营业务收入548万元,净利润160万元,每股收益为0.12元。

2001年10月26日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意按每股人民币1.4元的价格回购宁波海纳持有的公司300万股股份，回购完成后公司注册资本减至1,002万元。根据《公司法》的规定，公司先后于2001年11月24日、2001年11月25日和2001年11月26日三次在《宁波日报》上刊载股份回购注销的公告。

2001年11月29日，宁波市经济体制改革委员会下发《关于同意宁波立立电子股份有限公司股本回购方案的批复》（甬股改[2001]41号文），批准公司回购宁波海纳持有的公司300万股股份，注册资本变更为1,002万元。东方会计师事务所出具（浙东会验[2002]字第18号）《验资报告》，确认截至2001年12月25日，公司已减少注册资本300万元，公司实收注册资本为1,002万元。2002年3月6日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。

上述回购减资完成后，公司股东人数减少为45名，全部为自然人。具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例
1	陈伯良	190	18.96%	24	杨希望	16	1.60%
2	杨在亮	50	4.99%	25	方桂琴	15	1.50%
3	陆晓冬	43	4.29%	26	李晓军	15	1.50%
4	贾银凤	40	3.99%	27	贺云冲	14	1.40%
5	康蓓华	40	3.99%	28	吕迅	14	1.40%
6	陈峪	31	3.09%	29	唐雪林	13	1.30%
7	赵松宏	30	2.99%	30	李刚	12	1.20%
8	杨启基	30	2.99%	31	王云娟	12	1.20%
9	徐京红	30	2.99%	32	饶伟星	11	1.10%
10	李莉	30	2.99%	33	蔡理	10	1.00%
11	杨德仁	27	2.69%	34	赵榕椿	10	1.00%
12	张锦心	25	2.50%	35	肖型奎	10	1.00%
13	郑建国	23	2.30%	36	翁格菲	10	1.00%
14	马向阳	22	2.20%	37	黄海燕	10	1.00%
15	李晓劲	20	2.00%	38	张民杰	10	1.00%
16	江富琴	20	2.00%	39	沈益军	8	0.80%
17	施春洪	20	2.00%	40	茹广	6	0.60%
18	陈亚萍	20	2.00%	41	冯春阳	5	0.50%
19	陈志云	20	2.00%	42	林必清	5	0.50%
20	刘培东	19	1.90%	43	倪永明	5	0.50%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
21	田达晰	19	1.90%	44	蒋蛟龙	4	0.40%
22	方杏芬	18	1.80%	45	严建良	4	0.40%
23	羊荣兴	16	1.60%	合计		1,002	100%

#### (四) 2002年7月公司增资

2002年5月18日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司增发股份1,052万股，其中陈伯良等38名老股东认购430.5万股股份，李雪飞等13名自然人认购621.5万股，认购价格为每股人民币3元，该价格为新老股东根据公司财务状况由新老股东共同协商确定。本次增资，陈伯良认购120.95万股，认购资金来源为其家庭收入；陈茶花认购100万股，认购资金来源为其薪酬收入；宋锦认购70万股，认购资金来源为其薪酬收入、个人薪酬以及私人借贷；李立本认购60万股，认购资金来源为薪酬收入、政府奖励、专利收入以及股份分红。

本次增资完成后，公司注册资本增至2,054万元，所有增资股本金均已缴纳完毕。东方会计师事务所出具了（浙东会验[2002]第78号）《验资报告》，确认截至2002年7月1日陈伯良等51名自然人以现金出资认缴股本1,052万元，公司实收注册资本为2,054万元。

根据浙江东方会计师事务所出具的审计报告（浙东会审[2002]字第211号），截至2001年12月31日，公司总资产4,894万元、净资产3,272万元、每股净资产3.26元，2001年全年主营业务收入1,357万元、利润总额580万元、每股收益0.3元。

2002年6月20日，宁波市经济体制改革委员会下发（甬股改[2002]15号）文，批准公司注册资本增至2,054万元。2002年7月4日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	陈伯良	310.95	15.14%	30	林必清	27.3	1.33%
2	李雪飞	100	4.87%	31	陈志云	25.15	1.22%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
3	陈茶花	100	4.87%	32	吴亚东	25	1.22%
4	宋锦	70	3.41%	33	施春洪	24.9	1.21%
5	李立本	60	2.92%	34	方桂琴	23.5	1.14%
6	江作良	57	2.78%	35	李晓军	23.5	1.14%
7	杨在亮	50	2.43%	36	杨希望	22.8	1.11%
8	冯夏婷	50	2.43%	37	李晓劲	21.5	1.05%
9	翁蕴纯	50	2.43%	38	李刚	20.15	0.98%
10	陈峪	49.6	2.42%	39	吕迅	19.3	0.94%
11	赵松宏	47	2.29%	40	贺云冲	19.2	0.94%
12	阙端麟	44	2.14%	41	沈益军	18.6	0.91%
13	陆晓冬	43	2.09%	42	唐雪林	18.3	0.89%
14	杨建松	40.5	1.97%	43	饶伟星	18.15	0.88%
15	贾银凤	40	1.95%	44	方杏芬	18	0.88%
16	康蓓华	40	1.95%	45	王云娟	17.55	0.85%
17	杨德仁	39.2	1.91%	46	张民杰	14	0.68%
18	刘培东	38.55	1.88%	47	翁格菲	13.95	0.68%
19	杨启基	37	1.80%	48	蔡理	13.5	0.66%
20	马向阳	35.7	1.74%	49	赵榕椿	13.5	0.66%
21	郑建国	35.05	1.71%	50	黄海燕	12.25	0.60%
22	李莉	33.5	1.63%	51	肖型奎	10	0.49%
23	张锦心	32	1.56%	52	黄培盟	10	0.49%
24	田达晰	31.95	1.56%	53	王培鑫	10	0.49%
25	江富琴	30.6	1.49%	54	茹广	8.55	0.42%
26	徐京红	30	1.46%	55	倪永明	7.9	0.39%
27	陈亚萍	29.55	1.44%	56	蒋校龙	5.05	0.25%
28	冯春阳	29.5	1.44%	57	徐碧芬	5	0.24%
29	羊荣兴	28.05	1.37%	58	严建良	4.7	0.23%
合 计						2,054	100%

### (五) 2002年9月公司资本公积转增股本

2002年8月25日,公司召开临时股东大会并作出决议,同意公司以资本公积转增股本,转增比例为每10股转增10股,共计转增股份2,054万股,转增完成后公司注册资本增至4,108万元。东方会计师事务所出具了(浙东会验[2002]第115号)《验资报告》,确认截至2002年8月31日公司以资本公积2,054万元转增股本,公司实收注册资本为4,108万元。

2002年9月25日，宁波市经济体制改革委员会下发（甬股改[2002]26号）文，批准公司以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本，公司注册资本增至4,108万元。2002年9月28日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。

上述转增股本完成后，各股东持股比例未发生变化，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例
1	陈伯良	621.9	15.14%	30	林必清	54.6	1.33%
2	李雪飞	200	4.87%	31	陈志云	50.3	1.22%
3	陈茶花	200	4.87%	32	吴亚东	50	1.22%
4	宋锦	140	3.41%	33	施春洪	49.8	1.21%
5	李立本	120	2.92%	34	方桂琴	47	1.14%
6	江作良	114	2.78%	35	李晓军	47	1.14%
7	杨在亮	100	2.43%	36	杨希望	45.6	1.11%
8	冯夏婷	100	2.43%	37	李晓劲	43	1.05%
9	翁蕴纯	100	2.43%	38	李刚	40.3	0.98%
10	陈峪	99.2	2.42%	39	吕迅	38.6	0.94%
11	赵松宏	94	2.29%	40	贺云冲	38.4	0.94%
12	阙端麟	88	2.14%	41	沈益军	37.2	0.91%
13	陆晓冬	86	2.09%	42	唐雪林	36.6	0.89%
14	杨建松	81	1.97%	43	饶伟星	36.3	0.88%
15	贾银凤	80	1.95%	44	方杏芬	36	0.88%
16	康蓓华	80	1.95%	45	王云娟	35.1	0.85%
17	杨德仁	78.4	1.91%	46	张民杰	28	0.68%
18	刘培东	77.1	1.88%	47	翁格菲	27.9	0.68%
19	杨启基	74	1.80%	48	蔡理	27	0.66%
20	马向阳	71.4	1.74%	49	赵榕椿	27	0.66%
21	郑建国	70.1	1.71%	50	黄海燕	24.5	0.60%
22	李莉	67	1.63%	51	肖型奎	20	0.49%
23	张锦心	64	1.56%	52	黄培盟	20	0.49%
24	田达晰	63.9	1.56%	53	王培鑫	20	0.49%
25	江富琴	61.2	1.49%	54	茹广	17.1	0.42%
26	徐京红	60	1.46%	55	倪永明	15.8	0.39%
27	陈亚萍	59.1	1.44%	56	蒋校龙	10.1	0.25%
28	冯春阳	59	1.44%	57	徐碧芬	10	0.24%
29	羊荣兴	56.1	1.37%	58	严建良	9.4	0.23%
合 计						4,108	100%

## （六）2004 年陈伯良等部分股东转让股权

2004 年，陈伯良、李雪飞等 7 名公司股东分别与李立本、林必清等 15 人签订股权转让协议，将其持有公司股份 1,071 万股转让给李立本、林必清等 15 人，转让价格为每股 1.0 元。受让人李立本支付对价的资金来源为其个人薪酬收入、政府奖励、专利收入和股份分红；受让人林必清支付对价的资金来源为其房产转让收入；其他受让人支付对价的资金来源均为家庭收入或个人薪酬。冯春阳、徐京红两公司股东分别与俞升阳、李正明和陈茶花等三人签订股权转让协议，将其持有的公司股份 129 万股转让给后者，转让价格为每股 1.3 元。受让人支付对价的资金来源均为家庭收入或个人薪酬。股东康蓓华与陈卫忠签订股权转让协议，将其持有的公司股份 80 万股转让给后者，转让价格为每股 1.1 元，受让人支付对价的资金来源为家庭收入。以上公司股份转让价格，均由转让双方根据公司的财务状况和经营状况，相互协商确定，股权转让对价均已支付完毕。

根据浙江东方会计师事务所审计报告(浙东会审[2004]第 550 号)，截至 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额 44,693 万元、净资产 8,834 万元、每股净资产 2.15 元，2003 年全年主营业务收入 10,737 万元、利润总额 1,138 万元、每股收益 0.37 元。

2004 年 11 月 12 日，股权转让双方在宁波市产权交易中心办理了股权转让手续。上述股权转让完成后，原公司股东陈伯良等 10 人不再持有公司股份，公司股东人数从 58 名变为 52 名，股权变更后的具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例
1	李立本	582.1	14.17%	27	陈亚萍	59.1	1.44%
2	陈茶花	260	6.33%	28	唐雪林	55.2	1.34%
3	李正明	240	5.84%	29	陈志云	50.3	1.22%
4	林必清	230.6	5.61%	30	吴亚东	50	1.22%
5	宋 锦	140	3.41%	31	施春洪	49.8	1.21%
6	陈 峪	130	3.17%	32	方桂琴	47	1.14%
7	杨在亮	120	2.92%	33	杨希望	45.6	1.11%
8	刘培东	117.1	2.85%	34	李晓劲	43	1.05%
9	江作良	114	2.78%	35	贺云冲	38.4	0.94%
10	阙端麟	103	2.51%	36	沈益军	37.2	0.91%
11	冯夏婷	100	2.43%	37	饶伟星	36.3	0.88%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例
12	翁蕴纯	100	2.43%	38	方杏芬	36	0.88%
13	赵松宏	100	2.43%	39	王云娟	35.1	0.85%
14	杨建松	81	1.97%	40	俞升阳	29	0.71%
15	李晓军	80	1.95%	41	张民杰	28	0.68%
16	陈卫忠	80	1.95%	42	翁格菲	27.9	0.68%
17	杨德仁	78.4	1.91%	43	蔡理	27	0.66%
18	杨启基	74	1.80%	44	赵榕椿	27	0.66%
19	马向阳	71.4	1.74%	45	刘岱阳	24.5	0.60%
20	郑建国	70.1	1.71%	46	黄培萌	20	0.49%
21	李莉	67	1.63%	47	王培鑫	20	0.49%
22	张锦心	64	1.56%	48	徐碧芬	20	0.49%
23	田达晰	63.9	1.56%	49	茹广	17.1	0.42%
24	江富琴	61.2	1.49%	50	倪永明	15.8	0.39%
25	羊荣兴	61.1	1.49%	51	蒋校龙	10.1	0.25%
26	李刚	60.3	1.47%	52	严建良	9.4	0.23%
-				合 计		4,108	100%

### (七) 2004年11月公司增资

2004年7月11日，公司召开2003年年度股东大会并作出决议，同意公司增发股份3,000万股，其中江作良等5名老股东认购850万股，自然人王敏文、马骏分别认购2,000万股和150万股，认购价格为每股人民币1.9元，该认购价格为新老股东协商确定。本次增资，王敏文认购股份的资金来源为其个人薪酬、投资收入和亲属借款；江作良认购股份的资金来源为其个人薪酬和亲属借款；李正明、冯夏婷、陈卫忠和马骏等四人认购股份的资金来源为其家庭收入、个人薪酬；吴亚东认购股份的资金来源为其个人房地产投资收入。

本次增资完成后，公司注册资本增至7,108万元，所有增资股本金均已缴纳完毕。东方会计师事务所出具（浙东会验[2004]第156号）《验资报告》，确认截至2004年10月29日王敏文等7名自然人以现金出资认缴股本3,000万元，公司实收注册资本为7,108万元。

2004年8月3日，宁波市经济体制改革委员会下发（甬股改[2004]22号）文，批准公司注册资本增至7,108万元。2004年11月17日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。



上述增资完成后，公司股东人数变为 54 名，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	王敏文	2,000	28.14%	28	羊荣兴	61.1	0.86%
2	李立本	582.1	8.19%	29	李刚	60.3	0.85%
3	李正明	440	6.19%	30	陈亚萍	59.1	0.83%
4	江作良	414	5.82%	31	唐雪林	55.2	0.78%
5	陈茶花	260	3.66%	32	陈志云	50.3	0.71%
6	冯夏婷	250	3.52%	33	施春洪	49.8	0.70%
7	林必清	230.6	3.24%	34	方桂琴	47	0.66%
8	陈卫忠	230	3.24%	35	杨希望	45.6	0.64%
9	马骏	150	2.11%	36	李晓劲	43	0.61%
10	宋锦	140	1.97%	37	贺云冲	38.4	0.54%
11	陈峪	130	1.83%	38	沈益军	37.2	0.52%
12	杨在亮	120	1.69%	39	饶伟星	36.3	0.51%
13	刘培东	117.1	1.65%	40	方杏芬	36	0.51%
14	阙端麟	103	1.45%	41	王云娟	35.1	0.49%
15	翁蕴纯	100	1.41%	42	俞升阳	29	0.41%
16	赵松宏	100	1.41%	43	张民杰	28	0.39%
17	吴亚东	100	1.41%	44	翁格菲	27.9	0.39%
18	杨建松	81	1.14%	45	蔡理	27	0.38%
19	李晓军	80	1.13%	46	赵榕椿	27	0.38%
20	杨德仁	78.4	1.10%	47	刘岱阳	24.5	0.35%
21	杨启基	74	1.04%	48	黄培萌	20	0.28%
22	马向阳	71.4	1.01%	49	王培鑫	20	0.28%
23	郑建国	70.1	0.99%	50	徐碧芬	20	0.28%
24	李莉	67	0.94%	51	茹广	17.1	0.24%
25	张锦心	64	0.90%	52	倪永明	15.8	0.22%
26	田达晰	63.9	0.90%	53	蒋校龙	10.1	0.14%
27	江富琴	61.2	0.86%	54	严建良	9.4	0.13%
合 计						7,108	100.00%

本次增资完成后，王敏文、陈茶花夫妇合计持有公司股票 2,260 万股，占公司股份总额的 31.80%，成为公司的实际控制人。

### （八）2006 年 1-2 月份部分股东转让股权

2006 年 1 月，李立本分别与丛宏林等 29 名自然人签订《股权转让协议》，将其所持公司 120.70 万股分别转让给丛宏林等 29 名自然人，除向游志朴等三人以 1.3 元价格转让，向金广喜以 1.1 元价格转让以外，向其他人转让的价格均为

1.0 元，转让价格均为转让双方协商确定；2006 年 2 月，李正明与陈茶花签订《股权转让协议》，将其持有的公司 100 万股转让给陈茶花，转让价格为 1.66 元，该转让价格为转让双方协商确定；2006 年 2 月，陈茶花与吴能云签订《股权转让协议》，将其持有的公司 20 万股转让给吴能云，转让价格为 3.0 元，该转让价格为转让双方协商确定。以上受让人支付对价的资金均来自其薪金收入或者家庭其他收入，股权转让对价均已支付完毕。

根据公司审计后的财务报表，截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 59,155 万元，净资产 22,199 万元、每股净资产 3.12 元；2005 年全年主营业务收入 25,881 万元、利润总额 4,555 万元、每股收益 0.60 元。

上述股权转让完成后，公司股东人数从 54 名变为 84 名，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例
1	王敏文	2,000	28.14%	43	张民杰	28	0.39%
2	李立本	461.4	6.49%	44	翁格菲	27.9	0.39%
3	江作良	414	5.82%	45	蔡理	27	0.38%
4	李正明	340	4.78%	46	赵榕椿	27	0.38%
5	陈茶花	340	4.78%	47	刘岱阳	24.5	0.34%
6	冯夏婷	250	3.52%	48	黄培萌	20	0.28%
7	林必清	230.6	3.24%	49	王培鑫	20	0.28%
8	陈卫忠	230	3.24%	50	徐碧芬	20	0.28%
9	马骏	150	2.11%	51	吴能云	20	0.28%
10	宋锦	140	1.97%	52	茹广	17.1	0.24%
11	陈峪	130	1.83%	53	丛宏林	16	0.23%
12	杨在亮	120	1.69%	54	倪永明	15.8	0.22%
13	刘培东	117.1	1.65%	55	顾伟康	13.4	0.19%
14	阙端麟	103	1.45%	56	蒋校龙	10.1	0.14%
15	翁蕴纯	100	1.41%	57	何永增	10	0.14%
16	吴亚东	100	1.41%	58	凤坤	10	0.14%
17	赵松宏	100	1.41%	59	严建良	9.4	0.13%
18	杨建松	81	1.14%	60	陈岳来	7	0.10%
19	李晓军	80	1.13%	61	厉惠宏	5	0.07%
20	杨德仁	78.4	1.10%	62	黄力平	5	0.07%
21	杨启基	74	1.04%	63	叶建萍	4	0.06%
22	马向阳	71.4	1.00%	64	邵成波	4	0.06%
23	郑建国	70.1	0.99%	65	何良恩	4	0.06%
24	李莉	67	0.94%	66	俞国华	3.3	0.05%
25	张锦心	64	0.90%	67	蒋能军	3	0.04%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例
26	田达晰	63.9	0.90%	68	许 峰	3	0.04%
27	江富琴	61.2	0.86%	69	汪建臣	3	0.04%
28	羊荣兴	61.1	0.86%	70	金广喜	3	0.04%
29	李 刚	60.3	0.85%	71	游志朴	3	0.04%
30	陈亚萍	59.1	0.83%	72	乐永幸	2	0.03%
31	唐雪林	55.2	0.78%	73	朱 伟	2	0.03%
32	陈志云	50.3	0.71%	74	潘向阳	2	0.03%
33	施春洪	49.8	0.70%	75	刘迎春	2	0.03%
34	方桂琴	47	0.66%	76	翁屹鸣	2	0.03%
35	杨希望	45.6	0.64%	77	李自炳	2	0.03%
36	李晓劲	43	0.60%	78	钟军辉	2	0.03%
37	贺云冲	38.4	0.54%	79	张亚平	2	0.03%
38	沈益军	37.2	0.52%	80	张雄杰	2	0.03%
39	饶伟星	36.3	0.51%	81	胡孟君	2	0.03%
40	方杏芬	36	0.51%	82	刘莉莉	2	0.03%
41	王云娟	35.1	0.49%	83	张世波	1	0.01%
42	俞升阳	29	0.41%	84	卢 锋	1	0.01%
合 计						7,108	100%

### (九) 2006年8月公司增资

2006年8月6日,公司召开2006年度第一次临时股东大会并作出决议,同意公司增发股份600万股,其中,林必清等29名老股东认购537万股,自然人谌攀等25人认购63万股,认购价格为每股人民币3.2元,认购价格为公司新老股东协商确定。本次公司增发股份的认购股东均为公司的核心技术人员和骨干员工。本次增资完成后,公司注册资本增至7,708万元,所有增资股本金均已缴纳完毕。东方会计师事务所出具了(东方中汇会验[2006]2192号)《验资报告》,确认截至2006年8月18日林必清等54名自然人以现金出资认缴股本600万元,公司实收注册资本为7,708万元。

截至2006年6月30日,公司资产总额57,376万元、净资产23,092万元、每股净资产3.2元,2006年1-6月的主营业务收入17,239万元、利润总额2,966万元、每股收益0.33元。

2006年8月24日,公司在宁波市工商行政管理局办理了变更登记手续。本

次增资中认购股份数较多的股东包括：林必清认购 220 万股，认购资金来源为公司历年分红、证券投资和银行借款；田达晰认购 70 万股，认购资金来源为其薪酬收入和银行借款；陈卫忠认购 50 万股，认购资金来源为其薪酬收入和其他家庭收入；李晓军和吴能云分别认购 40 万股，凤坤和游志朴分别认购 20 万股，认购资金来源均为其薪酬收入和其他家庭收入。

上述增资完成后，股东人数变为 109 名，变更后的股权结构具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	王敏文	2,000	25.95%	56	茹 广	17.1	0.22%
2	李立本	461.4	5.99%	57	顾伟康	13.4	0.17%
3	林必清	450.6	5.85%	58	蒋校龙	10.1	0.13%
4	江作良	414	5.37%	59	何永增	10	0.13%
5	李正明	340	4.41%	60	陈岳来	10	0.13%
6	陈茶花	340	4.41%	61	严建良	9.4	0.12%
7	陈卫忠	280	3.63%	62	黄力平	8	0.10%
8	冯夏婷	250	3.24%	63	厉惠宏	7	0.09%
9	马 骏	150	1.95%	64	何良恩	7	0.09%
10	宋 锦	140	1.82%	65	叶建萍	6	0.08%
11	田达晰	133.9	1.74%	66	李自炳	6	0.08%
12	刘培东	132.1	1.71%	67	谌 攀	6	0.08%
13	陈 峪	130	1.69%	68	邵成波	4	0.05%
14	杨在亮	120	1.56%	69	金广喜	4	0.05%
15	李晓军	120	1.56%	70	张雄杰	4	0.05%
16	赵松宏	105	1.36%	71	张世波	4	0.05%
17	阙端麟	103	1.34%	72	朱乐平	4	0.05%
18	翁蕴纯	100	1.30%	73	俞国华	3.3	0.04%
19	吴亚东	100	1.30%	74	蒋能军	3	0.04%
20	杨建松	81	1.05%	75	许 峰	3	0.04%
21	杨德仁	78.4	1.02%	76	汪建臣	3	0.04%
22	杨启基	74	0.96%	77	刘莉莉	3	0.04%
23	马向阳	71.4	0.93%	78	涂洪浪	3	0.04%
24	郑建国	70.1	0.91%	79	卢 锋	3	0.04%
25	李 莉	67	0.87%	80	周慧敏	3	0.04%
26	羊荣兴	65.1	0.84%	81	刘 虎	3	0.04%
27	张锦心	64	0.83%	82	王继标	3	0.04%
28	李 刚	63.3	0.82%	83	刘 丹	3	0.04%
29	江富琴	61.2	0.79%	84	任瑞祥	3	0.04%
30	吴能云	60	0.78%	85	咸春雷	3	0.04%
31	陈亚萍	59.1	0.77%	86	蒋祖锋	3	0.04%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
32	唐雪林	58.2	0.76%	87	薛伟艺	3	0.04%
33	陈志云	50.3	0.65%	88	乐永幸	2	0.03%
34	施春洪	49.8	0.65%	89	朱伟	2	0.03%
35	方桂琴	47	0.61%	90	潘向阳	2	0.03%
36	李晓劲	46	0.60%	91	刘迎春	2	0.03%
37	杨希望	45.6	0.59%	92	翁屹鸣	2	0.03%
38	贺云冲	42.4	0.55%	93	钟军辉	2	0.03%
39	沈益军	37.2	0.48%	94	张亚平	2	0.03%
40	饶伟星	36.3	0.47%	95	胡孟君	2	0.03%
41	方杏芬	36	0.47%	96	戴劲松	2	0.03%
42	王云娟	35.1	0.46%	97	郑铁波	2	0.03%
43	翁格菲	31.9	0.41%	98	贾海军	2	0.03%
44	凤坤	30	0.39%	99	沈海潮	2	0.03%
45	俞升阳	29	0.38%	100	刘建刚	2	0.03%
46	刘岱阳	28.5	0.37%	101	陈华	2	0.03%
47	张民杰	28	0.36%	102	王笑青	2	0.03%
48	蔡理	27	0.35%	103	王海兵	2	0.03%
49	赵榕椿	27	0.35%	104	楼琦江	2	0.03%
50	游志朴	23	0.30%	105	胡晓光	2	0.03%
51	黄培萌	20	0.26%	106	黄斌	2	0.03%
52	王培鑫	20	0.26%	107	彭兴根	2	0.03%
53	徐碧芬	20	0.26%	108	陈丹凤	1	0.01%
54	丛宏林	20	0.26%	109	边林邈	1	0.01%
55	倪永明	17.8	0.23%	合计		7,708	100%

### (十) 2006年9月部分股东转让股权

2006年9月,公司股东江作良与其配偶李莉签订了《股权转让合同》,将其所持公司股份414万股全部转让给李莉,协议价格为每股1.0元;2006年9月,公司股东马骏与其父马德林签订了《股权转让合同》,将其所持公司股份150万股全部转让给马德林,协议价格为每股3.2元,其支付对价的资金来源为家庭收入和个人薪酬;2006年9月,公司股东陈茶花与俞升阳签订了《股权转让合同》,将其所持公司股份140万股转让给俞升阳,协议价格为每股3.2元,其支付对价的资金来源为家庭收入和个人薪酬;2006年9月,公司股东俞升阳与肖爱英签订了《股权转让合同》,将其所持公司20万股转让给肖爱英,协议价格为每股

3.2 元，其支付对价的资金来源为家庭收入。上述股权转让对价均已支付完毕。

截至本招股意向书签署日，公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例
1	王敏文	2,000	25.95%	56	茹 广	17.1	0.22%
2	李 莉	481	6.24%	57	顾伟康	13.4	0.17%
3	李立本	461.4	5.99%	58	蒋校龙	10.1	0.13%
4	林必清	450.6	5.85%	59	何永增	10	0.13%
5	李正明	340	4.41%	60	陈岳来	10	0.13%
6	陈卫忠	280	3.63%	61	严建良	9.4	0.12%
7	冯夏婷	250	3.24%	62	黄力平	8	0.10%
8	陈茶花	200	2.59%	63	厉惠宏	7	0.09%
9	马德林	150	1.95%	64	何良恩	7	0.09%
10	俞升阳	149	1.93%	65	叶建萍	6	0.08%
11	宋 锦	140	1.82%	66	李自炳	6	0.08%
12	田达晰	133.9	1.74%	67	谌 攀	6	0.08%
13	刘培东	132.1	1.71%	68	邵成波	4	0.05%
14	陈 峪	130	1.69%	69	金广喜	4	0.05%
15	杨在亮	120	1.56%	70	张雄杰	4	0.05%
16	李晓军	120	1.56%	71	张世波	4	0.05%
17	赵松宏	105	1.36%	72	朱乐平	4	0.05%
18	阙端麟	103	1.34%	73	俞国华	3.3	0.04%
19	翁蕴纯	100	1.30%	74	蒋能军	3	0.04%
20	吴亚东	100	1.30%	75	许 峰	3	0.04%
21	杨建松	81	1.05%	76	汪建臣	3	0.04%
22	杨德仁	78.4	1.02%	77	刘莉莉	3	0.04%
23	杨启基	74	0.96%	78	涂洪浪	3	0.04%
24	马向阳	71.4	0.93%	79	卢 锋	3	0.04%
25	郑建国	70.1	0.91%	80	周慧敏	3	0.04%
26	羊荣兴	65.1	0.84%	81	刘 虎	3	0.04%
27	张锦心	64	0.83%	82	王继标	3	0.04%
28	李 刚	63.3	0.82%	83	刘 丹	3	0.04%
29	江富琴	61.2	0.79%	84	任瑞祥	3	0.04%
30	吴能云	60	0.78%	85	咸春雷	3	0.04%
31	陈亚萍	59.1	0.77%	86	蒋祖锋	3	0.04%
32	唐雪林	58.2	0.76%	87	薛伟艺	3	0.04%
33	陈志云	50.3	0.65%	88	乐永幸	2	0.03%
34	施春洪	49.8	0.65%	89	朱 伟	2	0.03%
35	方桂琴	47	0.61%	90	潘向阳	2	0.03%
36	李晓劲	46	0.60%	91	刘迎春	2	0.03%
37	杨希望	45.6	0.59%	92	翁屹鸣	2	0.03%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例
38	贺云冲	42.4	0.55%	93	钟军辉	2	0.03%
39	沈益军	37.2	0.48%	94	张亚平	2	0.03%
40	饶伟星	36.3	0.47%	95	胡孟君	2	0.03%
41	方杏芬	36	0.47%	96	戴劲松	2	0.03%
42	王云娟	35.1	0.46%	97	郑铁波	2	0.03%
43	翁格菲	31.9	0.41%	98	贾海军	2	0.03%
44	凤 坤	30	0.39%	99	沈海潮	2	0.03%
45	刘岱阳	28.5	0.37%	100	刘建刚	2	0.03%
46	张民杰	28	0.36%	101	陈 华	2	0.03%
47	蔡 理	27	0.35%	102	王笑青	2	0.03%
48	赵榕椿	27	0.35%	103	王海兵	2	0.03%
49	游志朴	23	0.30%	104	楼琦江	2	0.03%
50	黄培萌	20	0.26%	105	胡晓光	2	0.03%
51	王培鑫	20	0.26%	106	黄 斌	2	0.03%
52	徐碧芬	20	0.26%	107	彭兴根	2	0.03%
53	丛宏林	20	0.26%	108	陈丹凤	1	0.01%
54	肖爱英	20	0.26%	109	边林邈	1	0.01%
55	倪永明	17.8	0.23%	合 计		7,708	100.00%

根据公司本次公开发行 2,600 万股社会公众股的发行计划，发行前后的股本结构情况如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
王敏文	2,000	25.95%	2000	19.40%
李 莉	481	6.24%	481	4.67%
李立本	461.4	5.99%	461.4	4.48%
林必清	450.6	5.85%	450.6	4.37%
李正明	340	4.41%	340	3.30%
陈卫忠	280	3.63%	280	2.72%
冯夏婷	250	3.24%	250	2.43%
陈茶花	200	2.59%	200	1.94%
马德林	150	1.95%	150	1.46%
俞升阳	149	1.93%	149	1.45%
其他 99 名自然人股东	2946	38.22%	2,946	28.58%
社会公众股	-	-	2,600	25.22%
总股本	7708	100%	1,0308	100%

#### 四、发行人股本变化对实际控制人的影响情况

本公司实际控制人为自然人王敏文、陈茶花夫妇，近三年未发生变动。王敏文、陈茶花夫妇均无其他间接持有本公司股份的情况，且其所持上述股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

王敏文、陈茶花夫妇对本公司的实际控制及其演变情况如下：

2004年11月公司增资时，王敏文先生认购公司增发股份2,000万股，占公司增资后股份总额的28.14%，成为公司第一大股东，此前其配偶陈茶花女士已持有公司股份260万股，占公司增资后股份总额的3.66%，夫妇两人合计持有公司股权比例达31.80%；此后，王敏文、陈茶花夫妇所持公司股份的数量和比例略有变化。截至本招股意向书签署日，王敏文、陈茶花夫妇所持公司股份的数量为2200万股，占公司股份总额的28.54%。

陈茶花之弟陈卫忠，为王敏文、陈茶花夫妇的关联方，三人合计持有股份占公司股份总额的比例达32.17%，远远高于公司其他股东所持股份，且公司其他股东所持股份占公司股份总额的比例较低，持股比例较为分散；除王敏文、陈茶花夫妇以及陈茶花之弟陈卫忠以外，合计持有公司股份43.35%的其他21名股东作出承诺：“本人在持有贵公司股份期间不存在与贵公司的一个或多个其他股东达成一致行动协议或共同行使股东权利的情形。本人进一步承诺，自贵公司首次公开发行之日起三年内，在贵公司股东大会对相关事项进行审议时，自行对该等事项进行调查了解和分析判断，充分行使自己的股东权利，不与贵公司的一个或多个其他股东达成一致行动或共同行使股东权利。该等不一致行使股东权利的承诺不应涵盖本人根据自己的意志和判断委托其他股东在股东大会上对相关事项投赞成票、否决票或弃权票的情形。”因此，王敏文、陈茶花夫妇足以对股东大会的表决结果产生决定性影响，为公司的实际控制人。

#### 五、发行人历次重大资产重组和收购兼并

##### （一）设立、收购及增资立昂电子

1、2002年2月22日，经董事会同意，公司出资人民币1,250.10万元，与浙大海纳、宁波海纳和杭州经济技术开发区北方总公司共同设立立昂电子。该公



司注册资本为 3,000 万元，其中：本公司出资 1,250.10 万元，占该公司注册资本的 41.67%；浙大海纳出资 999.90 万元，占该公司注册资本的 33.33%；宁波海纳出资 300 万元，占该公司注册资本的 10%；杭州经济技术开发区北方总公司出资 450 万元，占该公司注册资本的 15%。

2、2002 年 8 月 1 日，经董事会同意，公司与宁波海纳签订《股权转让合同》，以 300 万元的价格收购宁波海纳持有的立昂电子 10% 股权。发行人与宁波海纳签署《股权转让合同》，确认发行人以人民币 300 万元受让宁波海纳持有的立昂电子 300 万元股权；立昂电子 2002 年 8 月 1 日通过临时股东会决议，同意上述股权转让。股权转让完成后，立昂电子就股权转让事项办理了工商变更登记手续。收购完成后，公司持有立昂电子 51.67% 的股权，宁波海纳不再持有立昂电子股权。

3、2002 年 12 月 17 日，经董事会同意，公司与浙大海纳签订《股权转让合同》，以 1,029.90 万元的价格收购浙大海纳持有的立昂电子 33.33% 股权。立昂电子 2002 年 12 月 20 日通过临时股东会决议，同意上述股权转让合同，立昂电子其他股东同意放弃对上述股权转让的优先购买权。股权转让完成后，立昂电子就股权转让事项办理了工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有立昂电子 85% 的股权，浙大海纳不再持有立昂电子股权。

4、2004 年 10 月 16 日，公司通过董事会决议，同意对立昂电子增资人民币 1800 万元；立昂电子 2004 年 11 月 28 日通过股东会决议，一致同意增资 1,800 万元，由公司现金全部认购。本次增资完成后，立昂电子注册资本增至 4,800 万元，公司持有其 90.625% 的股权。

5、2006 年 3 月 18 日，公司通过 2005 年度股东大会决议，同意对立昂电子增资人民币 2200 万元；立昂电子 2006 年 2 月 12 日通过股东会决议，同意本公司对立昂电子增资 2200 万元，由本公司全部以现金认购。本次增资完成后，立昂电子注册资本增至 7,000 万元，公司持有其 93.571% 的股权。

## （二）收购宁波海纳股权

宁波海纳半导体有限公司（以下简称：“宁波海纳”）成立于 1992 年 12 月 4 日，成立时名称为宁波北仑高智达有限公司，注册资本 500 万元，法定代表人孙

扬远，经济性质为全民所有制企业，股东为浙江大学工业总公司和浙江大学对外技术贸易公司，经营范围为：承接各类工程和技改项目及其设备与器件的生产和销售，参与投资、兴办“三来一补”企业，承办国际技术贸易交流与合作，新技术及设备展销，进出口贸易等。1993年4月24日，宁波北仑高智达有限公司更名为宁波保税区高智达有限公司。1997年12月1日，宁波保税区高智达有限公司根据《公司法》要求由全民所有制企业改制成为有限公司，公司法定代表人李立本，公司注册资本仍为500万元，股东及其出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江半导体技术有限责任公司	330	66%
浙江大学工业总公司	20	4%
杨建松	50	10%
郑建国	50	10%
羊荣兴	50	10%
合 计	500	100%

1999年5月13日，宁波保税区高智达有限公司增加注册资本1,500万元，增资后的公司注册资本为2,000万元，股东出资额情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江半导体技术有限责任公司	1,480	74%
浙江大学工业总公司	20	1%
杨建松	200	10%
郑建国	150	7.50%
羊荣兴	150	7.50%
合 计	2,000	100%

1999年10月22日，宁波保税区高智达有限公司增加注册资本500万元，增资后的注册资本为2,500万元，股东出资额情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江半导体技术有限责任公司	1,730	69.20%
浙江大学工业总公司	20	0.80%
杨建松	250	10%
郑建国	250	10%
羊荣兴	250	10%
合 计	2,500	100%

1999年12月，宁波保税区高智达有限公司更名为宁波海纳半导体有限公司。

2000年11月28日，宁波海纳增资500万元，全部由杨建松以现金出资，增资后的注册资本为3,000万元，股东出资额情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江半导体技术有限责任公司	1,730	57.67%
浙江大学工业总公司	20	0.67%
杨建松	750	25%
郑建国	250	8.33%
羊荣兴	250	8.33%
合 计	3000	100%

2001年7月宁波海纳增资600万元，郑建国和羊荣兴分别以现金出资300万元，增资后的注册资本为3600万元，股东出资额情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江浙大海纳科技股份有限公司	1730	48.06%
浙江大学工业总公司	20	0.55%
杨建松	750	20.83%
郑建国	550	15.28%
羊荣兴	550	15.28%
合 计	3600	100%

注：1997年12月公司股东浙江半导体技术有限责任公司将其持有的公司的66%股权全部转让给浙江大学半导体厂，该股权后于1999年作为出资的一部分注入浙大海纳，浙江大学半导体厂注销。但这两次股东变更均未及时办理工商变更登记，直至2001年2月，才将宁波海纳股东由浙江半导体技术有限责任公司变更为浙大海纳。

2002年3月29日宁波海纳召开股东会通过决议，同意股东羊荣兴将其持有的公司出资额440万元转让给立立电子。2002年4月1日，该股权转让完成工商登记手续。转让后的宁波海纳股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
浙江浙大海纳科技股份有限公司	1,730	48.06%
浙江大学工业总公司	20	0.55%
宁波立立电子股份有限公司	400	11.11%
杨建松	750	20.83%
郑建国	550	15.28%
羊荣兴	150	4.17%
合计	3,600	100%

2002年7月2日宁波海纳召开股东会通过决议，同意股东羊荣兴、杨建松、郑建国分别将其持有的公司出资额150万元、750万元和550万元转让给立立电子。2002年7月4日完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让后的宁波海纳股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	1,850	51.39%
浙江浙大海纳科技股份有限公司	1,730	48.06%
浙江大学工业总公司	20	0.55%
合 计	3,600	100%

2002年10月30日，根据浙江大学对校产管理的总体安排，浙江大学工业总公司并入浙江大学企业集团控股有限公司，原浙江大学工业总公司持有的宁波海纳20万元的出资额全部无偿划转入浙江大学企业集团控股有限公司，并办理工商变更登记手续。此次股权变更后，宁波海纳股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	1,850	51.39%
浙江浙大海纳科技股份有限公司	1,730	48.06%
浙江大学企业集团控股有限公司	20	0.55%
合 计	3,600	100%

2002年11月7日，宁波海纳召开股东会通过决议，同意宁波海纳增资1,400万元，各股东按照原出资比例增资，本次增资于2002年11月15日完成工商变更登记手续，增资后宁波海纳注册资本变更为5,000万元。各股东出资额情况为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	2,569.32	51.39%
浙江浙大海纳科技股份有限公司	2,402.84	48.06%
浙江大学企业集团控股有限公司	27.84	0.55%
合 计	5,000	100%

2003年2月10日，宁波海纳召开股东会通过决议，同意将浙江大学企业集团控股有限公司持有的宁波海纳的0.55%的股权转让给浙大海纳。转让后的公司股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	2,569.32	51.39%
浙江浙大海纳科技股份有限公司	2,430.68	48.61%
合 计	5,000	100%

2003年12月20日，宁波海纳召开股东会通过决议，同意股东浙大海纳将其持有的公司48.61%股权，转让给宁波保税区投资开发有限责任公司。同年12月23日，完成工商变更登记。转让后的公司股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	2,569.32	51.39%
宁波保税区投资开发有限责任公司	2,430.68	48.61%

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
合计	5,000	100%

2004年6月22日，宁波海纳召开股东会通过决议，同意将公司名称变更为宁波立立半导体有限公司。

2004年11月12日，立立半导体召开股东会通过决议，同意股东宁波保税区投资开发有限责任公司将其持有的立立半导体全部股权分别转让给立立电子和立昂电子。2004年11月15日，立立电子、立昂电子分别与宁波保税区投资开发有限责任公司签订股权转让协议，分别以2,367.08万元和612.92万元的价格收购宁波保税区投资开发有限责任公司持有的立立半导体38.62%和10%的股权。上述股权转让行为已经宁波保税区国有资产管理办公室甬包国资[2004]7号文批准，并于2004年11月25日完成工商变更登记。转让后的公司股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
宁波立立电子股份有限公司	4,500	90%
杭州立昂电子有限公司	500	10%
合计	5,000	100%

截至目前，立立半导体的股权没有发生变化。

### （三）重组对公司的影响

公司设立之初时，主要从事硅单晶锭的拉制和硅外延片的生产、销售，而宁波海纳和立昂电子分别从事硅抛光片、功率肖特基二极管芯片的生产和销售，与公司业务存在上、下游产业关系，互补性较强，并存在关联交易。通过上述重组，公司逐步提高了对立立半导体和立昂电子的持股比例，使其所经营的业务成为公司主营业务的重要组成部分，合理延伸了产业链，丰富、完善了公司业务和产品结构，扩大了公司资产和业务规模，有效整合了公司的研发、生产、销售能力，提升了公司的竞争力和市场地位，为公司今后的长期业绩增长奠定了良好的基础。

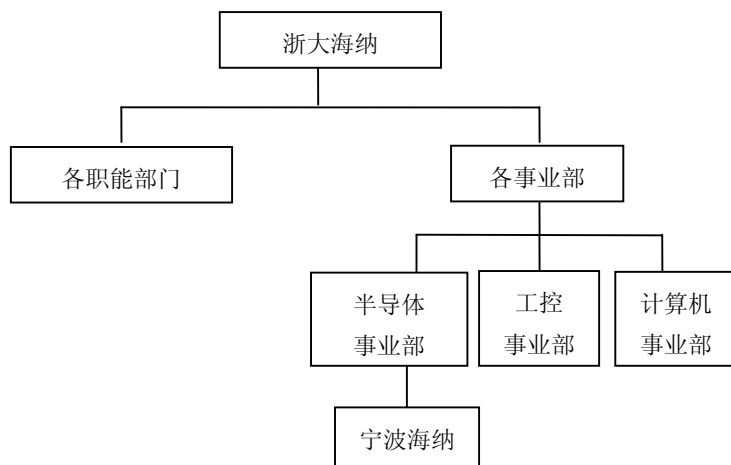
上述重组未对公司控制权和高级管理人员稳定性产生影响。

## （四）浙大海纳的历史沿革及其与宁波海纳、立立电子之间的产权和业务关系

### 1、1999 年浙大海纳募集设立及发行上市

浙大海纳原名浙江浙大海纳科技股份有限公司，是经浙江省人民政府浙政[1998]224 号文批准，由浙江大学企业集团控股有限公司(简称“浙大企业集团”)联合浙江省科技风险投资公司以及李立本、褚健、赵建、张锦心四名自然人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。浙大海纳主发起人浙大企业集团以其下属浙江大学半导体厂（其主要经营业务为硅单晶锭控制和硅研磨片的生产与销售）、杭州浙大中控自动化公司（其主要经营业务为自动化控制系统的开发、生产和应用）、浙江大学快威科技产业总公司（其主要经营业务为计算机应用软件开发和系统集成）经评估后的经营性净资产 8,556.16 万元投入浙大海纳，按 65.68%的比例折成 5,620 万股国有法人股，占浙大海纳总股本的 62.45%；发起人浙江省科技风险投资公司以现金 304.51 万元投入浙大海纳，按相同比例折成 200 万股国有法人股，占浙大海纳总股本的 2.22%；发起人李立本、褚健、赵建、张锦心分别以现金 68.51 万元投入浙大海纳，按相同比例折成 45 万股，分别占浙大海纳总股本的 0.5%。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]47 号文件批准，浙大海纳于 1999 年 5 月 7 向社会公开发行 3,000 万股社会公众股，发行后注册资金为 9,000 万元。

浙大海纳发行上市时主要从事的业务包括：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；工业自动化控制系统 SUPCON 系列产品及仪器仪表 JX 系列产品的开发、制造、销售与技术服务；计算机系统集成与电子工程的销售与服务等。当时浙大海纳的组织和业务结构如下图所示：



## 2、浙大海纳 2001-2003 年产业重组相关情况

### (1) 背景

自 20 世纪 90 年代中期起,国内众多高校下属企业纷纷改制上市进入资本市场,但到了 2000 年前后,不少高校控股的上市公司出现经营困难,教育界也一度出现了主张上市公司不得以高校冠名、高校应退出盈利性产业的观点。浙江大学当时的管理层也主张高校办企业弊端多,企业应当与大学相脱离。

自 2000 年下半年开始,浙大海纳当时三大主导产业之一的半导体产业出现全球性大衰退,2001 则陷入半导体产业低谷,此后三年全球半导体产业虽略有回升,但直到 2004 年才基本恢复到 2000 年市场销售水平。根据美国半导体行业协会(SIA)统计资料,2001 年、2002 年、2003 年以及 2004 年全球半导体销售额分别仅相当于 2000 年全球半导体销售额的 68%、70%、83%和 106%。在这种背景下,浙大海纳经营业绩相应也出现大幅度下降,2001 年、2002 年净利润分别较上年大幅下滑 36%和 35%。1999-2003 年浙大海纳业绩情况如下表所示:

年 度	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年
主营业务收入	13,271.17	23,354.22	17,070.96	17,340.20	13,421.11
净利润	2,917.87	3,052.74	1,948.55	1,265.43	1,186.45

正是在上述背景下,由当时的控股股东浙大企业集团主导,浙大海纳开始了产业重组和转让上市公司控股权的运作。

### (2) 产业重组的具体情况

根据浙大海纳公开信息披露相关资料,其产业重组具体包括:

①2001 年 7 月,浙大海纳将所持有浙江浙大海纳快威科技股份有限公司 98.33%的股权转让给浙江天然科技股份有限公司。该次股权转让完成后,浙大海纳退出了最初上市时主要的业务之一——“计算机应用软件开发和系统集成”。

②2002 年 2 月,立立电子回购宁波海纳(浙大海纳的控股子公司)所持有的 300 万股立立电子的股份。自该次股权回购始,浙大海纳开始退出部分业绩较差的半导体业务。

③2002 年 8 月和 12 月,浙大海纳分两次将其持有的尚未正常开展业务的立昂电子 43.33%股权转让给立立电子,继续退出部分半导体产业。

④2003年1月，浙大海纳将所持有浙江浙大海纳软件有限公司（该公司于2003年1月30日更名为浙江浙大中控信息技术有限公司）98.33%的股权转让给章全等5位自然人。该次股权转让完成后，浙大海纳退出了最初上市时主要的业务之一——“自动化控制系统的开发、生产和应用”。

⑤2003年1月，浙大海纳将所持有的浙江大学创业投资有限公司18%的股权转让给浙江大学药业有限公司。

上述产业重组均发生在浙大企业集团将浙大海纳控股权转让给邱忠保之前，邱忠保入主浙大海纳后，浙大海纳又于2003年12月将所持有宁波海纳半导体有限公司48.62%的股权转让给宁波保税区投资开发有限责任公司。

上述产业重组完成后，浙大海纳最初上市时的三大主要业务中的两块，即计算机应用软件开发和系统集成业务及自动化控制系统的开发、生产和应用业务被浙大海纳完全放弃；对于另一块主要业务即半导体硅材料业务，浙大海纳也只保留了其中经营效益较好的资产——杭州海纳半导体有限公司（该公司主营业务为硅研磨片），而将当时经营状况不佳的宁波海纳以及尚未正常经营的立昂电子等公司的股权先后转让出去。

### 3、邱忠保获得浙大海纳控股权及其对浙大海纳的侵害

2003年2月14日浙大海纳第一大股东浙大企业集团分别与珠海经济特区溶信投资有限公司（后改名为“深圳市瑞富控股有限公司”，下称“珠海溶信”）、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司（下称“海南皇冠”）签署股权转让协议，将其所持浙大海纳5,620万股国有法人股中的4,720万股分别转让给珠海溶信2,560万股（占浙大海纳总股本28.44%）、海南皇冠2,160万股（占浙大海纳总股本24%），并于同年6月20日签署“股权托管协议”，约定将其所持浙大海纳股权委托后者管理，后者代表前者依法行使除股权处置权外的股东其他权利。2004年2月5日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于批复浙江浙大海纳科技股份有限公司国有股转让有关问题的函》（国资产权[2004]60号）批准上述转让，2004年3月10日完成过户手续。转让后浙大海纳股东持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
珠海经济特区溶信投资有限公司	25,600,000	28.44
海南皇冠假日滨海温泉酒店	21,600,000	24



浙江大学企业集团控股有限公司	9,000,000	10
浙江省科技风险投资有限公司	2,000,000	2.22
其他	31,800,000	35.33
总股本	90,000,000	100

珠海经济特区溶信投资有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司的实际控制人均均为邱忠宝。

根据中国证监会下达《行政处罚决定书》（证监罚字[2007]14号），邱忠宝在获得浙大海纳实际控制权之后，利用其控制地位，违法违规挪用浙大海纳资金，并让浙大海纳为其控制的其它关联企业借款及欠款提供连带责任保证担保，使浙江海纳资产质量严重下降，负债金额急剧增加，陷入资不抵债、濒临破产的境地。

2005年4月14日，浙大海纳因虚假信息披露被中国证监会立案调查。2005年6月24日，深圳证券交易所因浙大海纳存在大量违规担保未披露、股权质押和冻结事项未披露、定期报告中财务信息披露不准确等违规行为，对浙大海纳及负有主要责任薛卫国等7名董事予以公开谴责。2006年3月7日，浙大海纳公告其实际控制人邱忠保因涉嫌违反证券法规，于2006年2月25日被上海市公安机关调查，现仍在侦查中。2007年4月24日，中国证监会下达《行政处罚决定书》（证监罚字[2007]14号），对浙大海纳处以罚款40万元的处罚，对原董事长薛卫国等相关责任人分别给予警告或/和罚款的行政处罚，同时作出《关于对邱忠保等3人实施市场禁入的决定》（证监禁入字[2007]5号），对邱忠保实施永久性市场禁入。

#### 4、浙大海纳现状

##### （1）浙大海纳公司重整及资产重组现状

2006年1月18日浙大海纳更名为浙江海纳科技股份有限公司，股票简称“S\*ST海纳”。

2005年11月21日，深圳市中级人民法院于作出(2005)深中法执字第799—2号民事裁定书，将珠海溶信所持有的浙大海纳1,780万股股份（占本公司总股本19.78%）按4,200.8万元抵债并过户给深圳市科铭实业有限公司（下称“深圳科铭”），股权过户手续已于2006年3月6日办理完毕，深圳科铭由此成为浙大海纳第二大股东。

2007年4月30日，海南省海口市中级人民法院于作出（2005）海中法执字58-7号、（2007）海中法委执字第3-1号、（2007）海中法执提字第11-1号民

事裁定书,裁定将海南皇冠持有 S\*ST 海纳 2,160 万股股份(占本公司总股本 24%)按第三次拍卖保留价人民币 4916.38 元的价格抵债并过户给深圳市大地投资发展有限公司(下称“大地投资”),由于该公司尚未启动股改程序,该股权转让目前尚未完成过户手续。

2006 年 6 月 20 日, S\*ST 海纳召开 2005 年年度股东大会,对董事会和管理层进行了改选,使 S\*ST 海纳基本脱离了邱忠保的控制,同时积极解决邱忠保遗留的问题,各项业务工作开始重回正轨。

现浙大海纳的股东持股情况如下表所示:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司	2,160	24
深圳市科铭实业有限公司	1,780	19.78
浙江浙大圆正集团有限公司(即原浙大企业集团)	900	10
深圳市瑞富控股有限公司(即原珠海溶信)	780	8.67
浙江省科技风险投资有限公司	200	2.22
其他股东	3,180	35.33
总股本	9,000	100

为重新获得对浙大海纳的控制权,浙大圆正通过其所控制的关联企业间接收购了大地投资 100%股权,从而获得其所持有 2,160 万股股份(占本公司总股本 24%),合计持股比例达到 34%,并于 2007 年 7 月 21 日公告了《收购报告书摘要》。

2007 年 9 月 14 日,杭州中院接受了债权人袁建华申请浙大海纳破产重整一案; 2007 年 10 月 24 日 S\*ST 海纳第一次债权人会议通过了《重整计划草案》; 2007 年 11 月 23 日杭州中院裁定批准公司债权人会议通过的《重整计划》,终止了重整程序。根据该《重整计划》, S\*ST 海纳实际大股东大地投资以浙江海纳持续经营条件下的资产价值 11,072.87 万元为基数,提供等值现金用于完成浙江海纳重整计划。其中 1,227.26 万元现金用于购买 S\*ST 海纳截至重整受理日的全部对外应收款,以提高其资产质量,同时使其彻底摆脱飞天系造成的不利影响,转让价格为上述资产的帐面价值。转让完成后,大地投资自行向债务企业行使权利,承担收回不能的风险, S\*ST 海纳收到转让款后,优先支付重整期间发生的重整费用和共益债权 799 万元,剩余 428.26 万元全部用于清偿债权人;另外 9,845.61 万元现金由大地投资代 S\*ST 海纳直接用于清偿债权人,大地投资代偿后,形成对 S\*ST 海纳 9,845.61 万元新的债权。由此,可用于清偿债权的现金合计为

10,273.87 万元，普通债权本金将获得 25.35% 的清偿。普通债权人在重整计划执行期内获得上述比例现金一次性清偿后，将免除 S\*ST 海纳剩余本金债权和全部利息债权及其他债权。

2008 年 1 月 2 日，S\*ST 海纳公告浙大海纳及其实际大股东大地投资已按照法院裁定批准的《重整计划》支付了全部清偿款。2008 年 1 月 4 日 S\*ST 海纳公告，杭州中院于作出《民事裁定书》[（2007）杭民二初字第 184-4 号]，S\*ST 海纳管理人的监督期限届满，自 2007 年 12 月 24 日起，S\*ST 海纳管理人的监督职责终止；2、按照重整计划减免的债务，S\*ST 海纳不再承担清偿责任。根据 S\*ST 海纳的最新公告，该公司拟实施资产重组。

自 2007 年 4 月 20 日 2008 年 4 月 10 日，S\*ST 海纳一直处于停牌状态，2008 年 4 月 11 日，S\*ST 海纳复牌交易。

## （2）S\*ST 海纳经营现状

根据 S\*ST 海纳 2007 年度报告，该公司的财务状况如下：

单位：元

项 目	2007-12-31	项 目	2007 年度
资产总额	222,985,552.06	营业收入	133,264,439.01
负债总额	114,213,815.72	营业利润	23,290,296.21
归属于母公司股东权益合计	102,952,324.87	利润总额	398,723,500.79
少数股东权益	5,819,411.47	归属于母公司股东的净利润	391,050,950.05
股东权益合计	108,771,736.34	净利润	391,632,355.13

单位：元

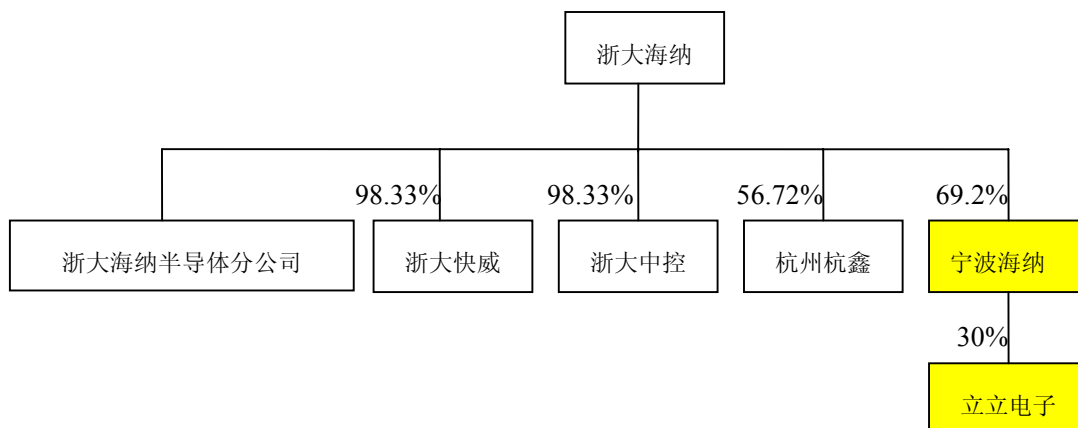
项 目	2007 年度	财务指标	2007 年度
经营活动现金流量净额	36,933,985.11	基本每股收益（元）	4.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,851,218.09	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.16
筹资活动产生的现金流量净额	-325,300.00	净资产收益率	379.84%
现金及现金等价物净增加额	38,734,563.97	扣除非经常性损益后的净资产收益率	14.18%

根据 S\*ST 海纳公开披露的财务报告，该公司的主营业务收入来源仍为硅单晶及其制品（研磨片）。根据 S\*ST 海纳 2007 年度财务报告，该公司主营业务——单晶硅及其制品的销售收入为 13,218.32 万元，占其营业收入的 99.19%，而该项主营业务目前仍为其控股子公司杭州海纳半导体有限公司经营。

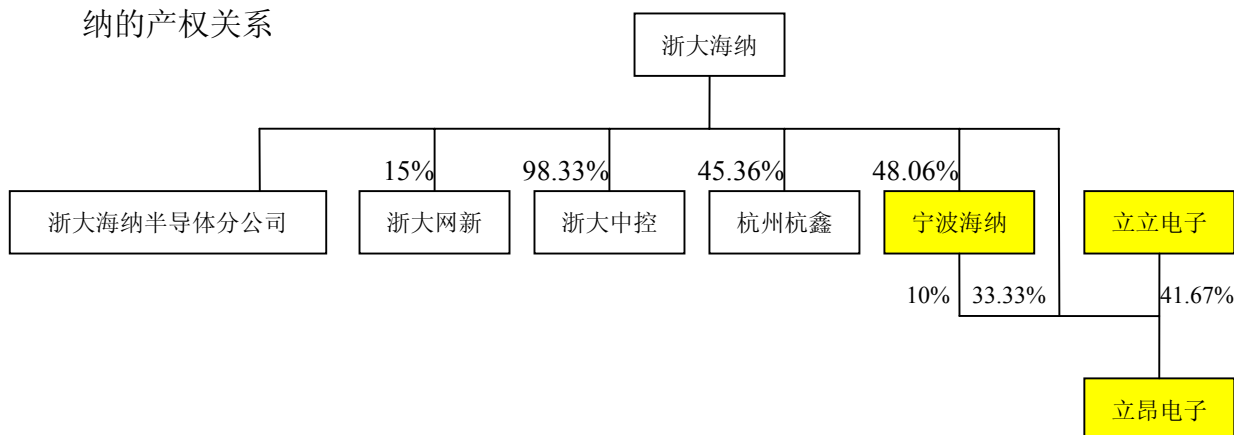
### 5、立立电子、宁波海纳与浙大海纳之间的产权和业务关系

#### (1) 产权关系

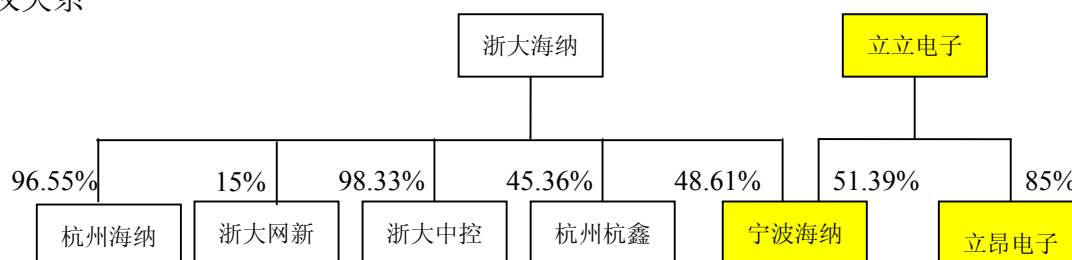
##### ①2000年6月立立电子成立时与浙大海纳、宁波海纳的产权关系



##### ②2002年3月立立电子回购宁波海纳所持30%股权后与浙大海纳、宁波海纳的产权关系



##### ③2003年2月立立电子完成对宁波海纳、立昂电子收购后，与浙大海纳的产权关系



注：杭州海纳，即在原浙大海纳在其原半导体业务的基础上，于2002年9月成立的子公司。

2003年12月，浙大海纳将所持有的宁波海纳剩余48.61%的股权全部转让给宁波保税区投资开发有限责任公司后，与立立电子、宁波海纳即无任何产权关系。

#### (2) 业务关系

浙大海纳本部（2002年9月改设为杭州海纳半导体有限公司）、宁波海纳和立立电子所属行业均为半导体硅材料行业，但各自的产品、客户群均不相同，如下表所示：

单位	主要产品	客户群
浙大海纳本部(杭州海纳)	硅研磨片	使用研磨片的分立器件厂商
宁波海纳	硅抛光片	集成电路厂商和外延片厂商
立立电子本部	硅外延片	高端分立器件厂商（如肖特基、MOSFET 器件）、集成电路厂商

## 6、立立电子与浙大海纳之间的交易情况

2000-2003年，立立电子与浙大海纳之间发生的主要交易情况如下：

时间	类型	具体内容	金额（万元）
2000年	股权投资	浙大海纳下属子公司宁波海纳出资300万元设立立立电子，占立立电子总股本的30%；浙大海纳董事、总裁李立本先生出任立立电子董事、总经理	-
	提供技术服务	立立电子为浙大海纳半导体事业部及控股子公司杭鑫电子提供技术服务，分别收取费用50万元	100
2001年	销售产品	立立电子按协议价向浙大海纳销售产品	794.27
	提供技术开发服务	立立电子为浙大海纳提供技术开发服务	130
	购买资产	立立电子按成本价向宁波海纳购买固定资产	241.33
	提供担保	立立电子为宁波海纳2,000万元借款提供担保，借款期限为2001年12月28日至2002年3月27日	-
2002年	股权转让	立立电子以1.4元/股回购宁波海纳所持立立电子全部股份	420
	股权投资	立立电子与浙大海纳、宁波海纳及杭州经济技术开发区北方总公司共同出资组建立昂电子，注册资本3,000万元，其中立立电子、浙大海纳、宁波海纳各出资1,250.1万元、999.9万元和300万元，占立昂电子股权比例分别为41.67%、33.33%和10%	-
	股权转让	立立电子收购宁波海纳所持立昂电子10%股权（300万元出资额）	300
	股权转让	立立电子收购浙大海纳所持立昂电子33.33%的股权（999.9万元出资额），浙大海纳取得投资收益30万元	1,029.90

时间	类型	具体内容	金额（万元）
	资金往来	浙大海纳下属浙大海纳半导体分公司借给立立电子 1,250 万元，当年 6 月收回	1,250
2003 年	资金往来	浙大海纳下属浙江海纳半导体分公司借给宁波海纳 4,500 万元，期限 1 年，利率 1.98%，年底收回	4,500
	购买设备	浙大海纳下属浙江海纳半导体分公司按账面净值向宁波海纳转让一批设备（系代购性质）	13.57
	出售设备	浙大海纳下属浙江海纳半导体分公司向宁波海纳购买两台进口设备（系代购性质，均按照采购原价转让）	774.76
	提供技术开发服务	立立电子为浙大海纳提供技术开发服务	120

注：宁波海纳自 2002 年 7 月起成为立立电子控股子公司

上述交易中可分成以下几种情况：

#### （1）正常经营性往来

主要包括销售产品、提供服务，该类交易为正常业务往来，且金额较小，影响不大。

#### （2）资金往来和资产买卖

2002 年立立电子自浙大海纳借入 1,250 万元为短期暂借款，3 个月后即归还；2003 年宁波海纳自浙大海纳借入 4,500 万元，主要是宁波海纳为克服行业不景气而向股东方融入短期资金，以缓解资金压力，宁波海纳按期归还并向浙大海纳支付了资金利息。

2001-2003 年期间，立立电子与浙大海纳之间的资产买卖均为双方根据各自业务需要而进行的正常交易，金额不大。

#### （3）股权投资和转让

2001-2003 年期间，立立电子与浙大海纳之间发生了多起股权投资和转让的交易，通过这些交易，立立电子使自身独立于浙大海纳，同时收购并控股了立昂电子。如前所述浙大海纳进行业务重组背景，这些交易实际上是浙大海纳当时的控股股东为出让上市公司控股权、引入邱忠保作为新的控股股东而实施的一系列业务重组的一部分；同时由于 2000 年下半年至 2003 年下半年半导体行业出现了一次全球性大衰退，再加上当时宁波海纳抛光片业务刚起步，其技术工艺尚不过

关，管理亟需提高，导致抛光片产成品率较低、产品质量不稳定、市场开拓不力，经营状况面临极为困难的境地。在此背景下，浙大海纳作出了退出部分效益不佳的半导体产业的战略决策，将相关企业股权转让给管理层和职工，只保留了盈利状况较好的杭州海纳所从事的硅研磨片业务。

2000-2003 年间，浙大海纳的半导体业务经营状况如下表所示：

单位：万元

项目	2003 年度	2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入	13,421	12,938	14,861	14,127
主营业务利润	3,686	2,821	2,551	3,714
主营业务利润率	27.46%	21.80%	17.17%	26.29%

注：2000 年、2001 年浙大海纳的主营业务收入包括宁波海纳。自 2002 年起，由于宁波海纳控股权发生变化，该公司不再作为浙大海纳的并表子公司。

2000-2003 年间，宁波海纳硅材料业务经营状况如下表所示：

单位：万元

项目	2003 年	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	6,277	6,610	4,166	3,065
主营业务利润	275	885	333	732
主营业务利润率	4.38%	13.39%	7.99%	23.88%

注：宁波海纳的硅材料业务主要是硅抛光片业务

从上表可以看出，立立电子收购宁波海纳时正值半导体行业低谷，宁波海纳本身的主营业务利润率较低，对浙大海纳主营业务利润的贡献也较低，行业和企业发展前景均存在较大不确定性；立昂电子 2002 年成立，由于建设周期较长且外资合作方遇到困难，成立当年公司未正常开展业务，此后三年连续亏损，自 2003-2005 年立昂电子连续三年亏损，亏损额分别为-977 万元、-1252 万元和-521 万元，累计亏损额为-2,750 万元，经营压力巨大。

面对上述内部和外部的种种不利情况，以中国半导体硅材料行业知名专家阙端麟院士、李立本教授为首的立立电子核心管理层，坚守一定要把中国半导体硅材料产业做强做大的信念，纷纷拿出毕生积蓄，并采取引入战略投资者等多种方式筹集资金，逐步形成了以目前立立电子为中心的硅抛光片、外延片和肖特基芯片产业链。经过全体员工的艰苦努力，立立电子取得了成功，现已成为中国半导体硅材料行业的龙头企业之一。

发行人律师对上述股权转让发表法律意见如下：“发行人已经履行了必需的程序，上述股权回购及股权转让行为合法有效，对交易各方具有法律约束力，至本补充法律意见出具之日，上述股权交易已发生超过 36 个月。”

## 7、立立电子股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在浙大海纳的任职及出资情况

### (1) 在浙大海纳任职情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员历史上在浙大海纳及其子公司中的任职情况如下：

序号	姓名	在立立电子及其子公司现任职务情况	曾在浙大海纳及其子公司任职情况	
			公司名称及职务	起止日
1	李立本	董事长	浙大海纳董事	1999.5-2003.7
			浙大海纳总裁	1999.5-2003.6
2	林必清	董事、总经理	浙大海纳中层	1999.5-2002.12
3	阙端麟	董事	浙大海纳董事	1999.5-2002.11
4	杨德仁	董事	浙大海纳董事	2001.5-2002.11
5	陈伯良	监事	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2004.1
6	田达晰	副总经理	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2002.8
7	刘培东	副总经理	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2001.3
8	李晓军	副总经理	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2004.8
10	翁格菲	立昂电子副总经理	浙大海纳半导体分公司职员	1999.5-2002.3
9	羊荣兴	立昂电子中层	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2002.3
11	李晓劲	立昂电子中层	浙大海纳半导体分公司职员	1999.5-2002.3
12	贺云冲	立昂电子中层	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2002.3

公司股东历史上在浙大海纳及其子公司中的任职情况如下：

序号	姓名	曾在浙大海纳及其子公司任职情况	
		公司名称及职务	起止日
1	赵松宏	浙大海纳监事	2001.11-2005.4
2	杨建松	浙大海纳副总经理、宁波海纳总经理	1999.5-2002.12
3	杨启基	浙大海纳监事	1999.5-2001.11
4	郑建国	杭州海纳副总经理	1999.5 至今
5	张锦心	浙大海纳半导体分公司副总经理	1999.5 至今
6	李刚	宁波海纳半导体公司中层	1999.5 至今
7	方桂琴	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2003.6
8	沈益军	浙大海纳董事/杭州海纳总经理	1999.5 至今
9	赵榕椿	浙大海纳半导体分公司中层	1999.5-2003.
10	茹广	杭州海纳中层	1999.5.至今



11	顾伟康	浙大海纳董事	1999.5-2001.11
----	-----	--------	----------------

2000年6月立立电子设立时，宁波海纳为持股30%的第一大股东，而宁波海纳为浙大海纳控股子公司；2002年3月立立电子完成回购宁波海纳所持30%股权后，与浙大海纳不存在股权投资关系。因此，从2000年6月至2002年3月，由于立立电子为浙大海纳相对控股的孙公司，相关人员同时担任浙大海纳和立立电子的管理职务符合相关法规规定。

2002年3月后，由于立立电子已与浙大海纳不存在股权投资关系，且两者均属于半导体硅材料行业，根据当时《公司法》第61条的有关规定，相关人员不能同时在两家公司兼任行政管理职务。

上述人员中除李立本之外，其他人员均系自浙大海纳及其子公司正式离职后方任职于立立电子。李立本先生在2002年3月至2003年6月期间同时担任浙大海纳和立立电子的管理职务，不符合当时生效的《公司法》第61条的有关规定。

但上述情况的出现有其特殊的历史原因。浙大海纳原实际控制人自2001年起便有意出让上市公司控股权并退出部分盈利不佳的半导体业务，并开始业务重组和引入新的控股股东的工作，而时任浙大海纳董事、总裁同时兼任立立电子总经理的李立本由于有不同意见，遂提出辞去浙大海纳董事、总裁职务，但由于当时引入新的控股股东工作尚在进行中，浙大海纳原实际控制人极力挽留，要求其留任至新股东入主后改选管理层时。在此情况下，李立本虽已淡出日常管理，但无法辞去在浙大海纳的董事、总裁职务。直到2003年6月、7月，浙大海纳才先后接受李立本辞去总裁和董事职务。

关于李立本兼职问题，发行人律师均进行了核查，并据此出具了补充法律意见，具体内容如下：经核查，自2000年6月公司成立至2002年3月期间，发行人的控股股东为宁波海纳，而宁波海纳当时系浙大海纳的控股子公司，因此发行人当时系浙大海纳间接控股的子公司。李立本在发行人作为浙大海纳间接控股的子公司兼任发行人的总经理未违反当时《公司法》第61条有关竞业禁止的规定。2002年3月发行人完成其对宁波海纳所持300万股股份的回购后，发行人与浙大海纳之间不再存在股权投资关系，李立本虽然随后已经提出辞去董事及总裁职务，但未能及时获得批准，在客观上导致了其担任发行人总经理的行为违反了《公司法》第61条有关高级管理人员竞业禁止的规定。

## (2) 在浙大海纳出资情况

根据浙大海纳 1999 年首次公开发行时披露的《浙江浙大辰光科技股份有限公司(筹)招股说明书概要》，李立本、张锦心为浙大海纳发起股东，分别出资 68.51 万元现金，按 65.68%的比例折成 45 万股，占发行后总股本的 0.5%。截至目前，该两人所持浙大海纳股份没有发生变化。

## 六、发行人历次验资情况

公司自成立以来，共进行了七次验资，具体情况如下：

1、2000 年 6 月 8 日，宁波永德会计师事务所对公司设立时的实收资本情况进行了验证，并出具了（永德验字[2000]80 号）《验资报告》，确认截至 2000 年 6 月 8 日宁波海纳及陈伯良等 45 名自然人现金出资 1,000 万元，公司实收注册资本为 1,000 万元。

2、2000 年 12 月 25 日，宁波永德会计师事务所对公司注册资本由 1,000 万元增加到 1,302 万元的实收资本情况进行了验证，并出具（永德验字[2000]169 号）《验资报告》，确认截至 2000 年 12 月 25 日杨在亮等 38 名自然人现金出资 302 万元，公司实收注册资本为 1,302 万元。

3、2002 年 2 月 26 日，东方会计师事务所对公司减少注册资本 300 万元的实收资本情况进行了验证，并出具（浙东会验[2002]字第 18 号）《验资报告》，确认截至 2001 年 12 月 25 日，公司已减少注册资本 300 万元，公司实收注册资本为 1,002 万元。

4、2002 年 7 月 1 日，东方会计师事务所对公司注册资本由 1,002 万元增加到 2,054 万元的实收资本情况进行了验证，并出具了（浙东会验 [2002] 第 78 号）《验资报告》，确认截至 2002 年 7 月 1 日陈伯良等 51 名自然人现金出资 1,052 万元，公司实收注册资本为 2,054 万元。

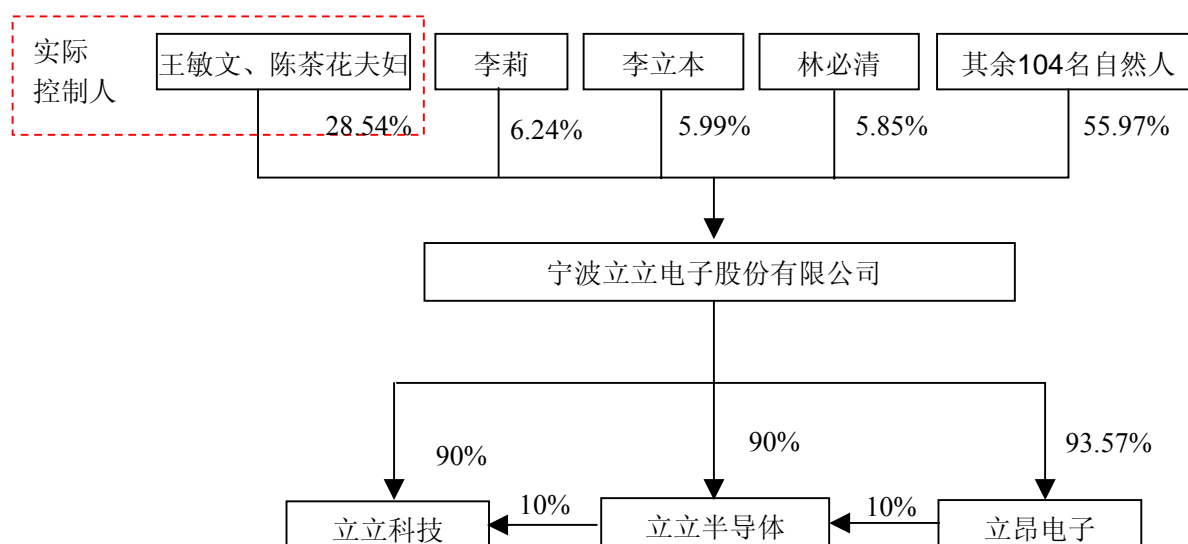
5、2002 年 9 月 11 日，东方会计师事务所对公司注册资本由 2,054 万元增加到 4,108 万元的实收资本情况进行了验证，并出具了（浙东会验[2002]第 115 号）《验资报告》，确认截至 2002 年 8 月 31 日公司以资本公积 2,054 万元转增股本，公司实收注册资本为 4,108 万元。

6、2004年11月2日，东方会计师事务所对公司注册资本由4,108万元增加到7,108万元的实收资本情况进行了验证，并出具（浙东会验[2004]第156号）《验资报告》，确认截至2004年10月29日王敏文等7名自然人现金出资3,000万元，公司实收注册资本为7,108万元。

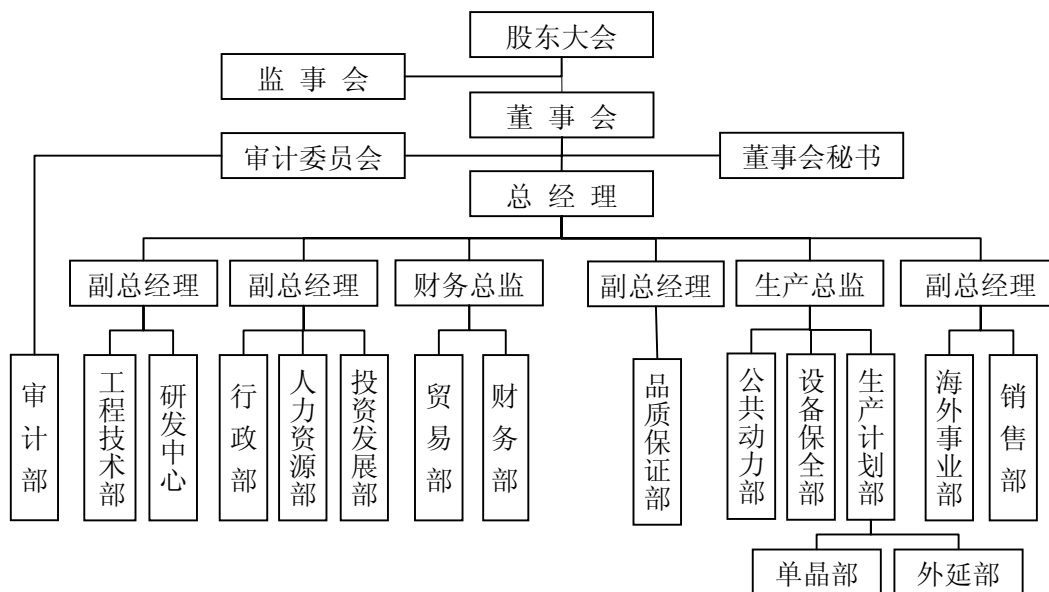
7、2006年8月21日，东方会计师事务所对公司注册资本由7,108万元增加到7,708万元的实收资本情况进行了验证，并出具了（东方中汇会验[2006]2192号）《验资报告》，确认截至2006年8月18日林必清等54名自然人现金出资600万元，公司实收注册资本为7,708万元。

## 七、发行人股东结构和组织结构

### （一）公司的股权结构图



## （二）公司内部组织结构图



## （三）公司内部职能部门职责

1、行政部职责：公司外事活动的组织、接待；日常行政管理事务；公司的宣传推广、商务公关；工商登记、年检事务；国外主要竞争对手情报资料的翻译；新政策法规的收集、传达以及法律、政策咨询。

2、人力资源部职责：公司人力资源年度需求与执行计划的制定；人力资源管理制度以及各部门、岗位职责和任职资格说明书的制定、完善；员工招聘及新员工的培训和技能评估；员工业绩考核、薪资的日常管理；人才市场供求、薪资行情的预测、分析；员工的福利落实、咨询服务及各类培训；劳动、人事档案纠纷的处理；员工的定岗、定编、定员工作。

3、投资发展部职责：公司资本运营、股权管理、信息披露、“三会”筹备等工作；国内与国际资本市场研究。

4、工程技术部职责：生产线工艺技术的设计、维护及相关规范的制订；新品、新工艺开发；原辅材料采购标准的制定；产品样品的试制；技改项目的可行性分析及规划方案的拟订；技改项目的实施与监控；生产区的基建、房屋维修、生产设施改造工程的计划编制；新建（扩建）厂房的招标文件的起草、审核和招标；基建项目的管理。

5、研发中心职责：研发计划的制定、监督；政府研发项目的申报技术论证、研发项目的评审、鉴定、验收；技术专利的申报；生产过程中重点、难点问题的攻关；新产品、新工艺的开发；公司战略领域的确定。

6、财务部职责：公司财会会计制度、管理办法的制定、实施；各项财务指标的分析统计；会计报告、财务分析报告的编制；年度、季度财务预算及成本（费用）预算的编制；资金收支计划、信贷计划、资金调配计划的编制、调整；资金的筹措；信用风险、帐款回笼的协同管理；各类资产的统一管理；税务的申报、缴纳；员工工资的发放、管理；与会计师事务所、财政、税务等管理部门的沟通、协调；会计档案的归档、管理。

7、品质保证部职责：日常生产全过程的质量检验和监控；质量/环境体系的建立、运行；相关管理规章的编写、修订；产品质量的宣传推广；质量相关信息的收集、整理、分析；重大质量事故的纠察、纠正；产品质量成本的统计；质量检验人员的培训、考核；产品质量的售后服务。

8、公共动力部职责：各类厂务设施、设备的日常管理、维护；相关规章制度的制定；采购厂务设施、设备的验收、安装、调试；各类设施设备档案资料的归档；废水、废气、废料的治理；水、电、气的计量与管理。

9、贸易部职责：物料采购方案的制定；采购合同的谈判、签订；各类管理报表的编制；各类进出口业务手续的办理；海关年审及异地备案注册；部分工程的维修管理；采购商品资讯的搜集、分析；供应商资料库、采购记录的建立、归档。

10、生产计划部职责：生产计划的审核、编制与分解；生产全过程的监督、管理；各工序生产能力之间的协调；关键原辅材料采购计划的编制；成品、半成品、原辅材料的出入库、保管、领用、发放、交付、统计工作；各部门的产量、成品率的统计；指导各制造部门提升管理水平。

11、设备保全部职责：各类设备的维修、维护和管理；设备维护、改造规章制度的制定；采购设备的验收、安装调试；设备报损、报废的审核管理；设备技术档案的建立。

12、销售部和海外事业部职责：产品销售的筹划；年度销售计划编制、分解

和落实；公司及产品品牌形象的塑造、推广；客户的维护、开发；市场的研究及产品销售预测；客户定单的接收、跟踪；销售合同的评审、签订；应收帐款的回笼；产品销售报表的编制、统计；产品的售后服务；客户反馈信息收集、整理、归档。其中，销售部负责境内销售业务，海外事业部负责境外销售。

13、审计部职责：对各部门的财务收支及经济活动情况进行内部审计、监督；审查公司高管人员任期目标 and 责任指标；审查财务账目和会计报表，对公司高管人员进行离任审计；对有关合作单位和合作项目的财务审计；协助各有关部门进行财务清理、整顿和提高。

## 八、发行人所投资的子公司

本公司共投资控股了三家子公司，分别为：

### （一）宁波立立半导体有限公司

立立半导体是由本公司与控股子公司立昂电子共同投资的有限责任公司，双方出资比例分别为 90%和 10%。该公司成立于 1993 年 4 月 24 日，位于宁波保税区东区，现注册资本为 5,000 万元，法定代表人李立本。

经东方会计师事务所审计，最近两年立立半导体的相关财务信息如下：

单位：万元

项 目	2007-12-31	2006-12-31
总资产	21,923.62	21,261.15
净资产	9,032.97	9,758.78
项 目	2007 年度	2006 年度
净利润	2,274.18	1,741.29

立立半导体的主要业务为硅抛光片的生产与销售，目前主导产品为 4-6 英寸硅抛光片，生产能力达 6,630 万平方英寸，产销规模位居国内同行业前列。

### （二）杭州立昂电子有限公司

立昂电子是由本公司与杭州经济技术开发区北方总公司共同投资的有限责任公司，双方出资比例分别为 93.57%和 6.43%。该公司成立于 2002 年 3 月 19 日，住所位于杭州经济技术开发区 14 号大街 17 号招商中心大楼，现注册资本为 7,000 万元，法定代表人李立本。

经东方会计师事务所审计，最近两年立昂电子的相关财务信息如下：

单位：万元

项 目	2007-12-31	2006-12-31
总资产	13,731.28	14,522.46
净资产	6,001.78	5,707.31
项 目	2007 年度	2006 年度
净利润	294.47	560.54

立昂电子的主要业务为功率肖特基二极管芯片的生产与销售，现为国内高压和大电流电阻功率肖特基二极管芯片的主要生产企业，生产能力达 14.40 万片。

### （三）杭州立立科技实业有限公司

立立科技是本公司与立立半导体共同投资设立的有限责任公司，双方出资比例分别为 90%和 10%。该公司成立于 2005 年 12 月 1 日，住所位于杭州市滨江区南环路 4028 号 1 号楼 601-616 室，现注册资本 500 万元，法定代表人李立本。

经东方会计师事务所审计，最近两年立立科技的相关财务信息如下：

单位：万元

项 目	2007-12-31	2006-12-31
总资产	690.39	532.24
净资产	578.97	524.99
项 目	2007 年度	2006 年度
净利润	53.98	16.83

立立科技的主要业务为集成电路及应用软件、半导体高新材料的开发和销售。

## 九、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

### （一）发起人

#### 1、45 名自然人发起人

姓名	持股比例	身份证号码	住 所
陈伯良	19.00%	330106440120041	杭州市西湖区求是村 28 幢 108 号 306 室
杨在亮	4.00%	330106331004042	杭州市西湖区求是村 1 幢 2 号
贾银凤	2.00%	330106391221042	杭州市西湖区求是村 64 幢 211 号 404 室

姓名	持股比例	身份证号码	住所
李晓劲	2.00%	330106700501041	杭州市西湖区求是村 52 幢
康蓓华	3.00%	330103640225102	杭州市西湖区求是新村留博楼 1003 室
张锦心	2.00%	330106420717042	杭州市西湖区求是村 43 幢 148 号
赵松宏	2.00%	330106590526041	杭州市西湖区求是村 58 幢 196 号
杨启基	2.00%	330106420310041	杭州市西湖区求是村 36 幢 127 号
冯春阳	0.50%	130105660128181	杭州市西湖区西溪河下 76 号 1 单元 502 室
徐京红	1.50%	330106690104004	杭州市西湖区文二路师苑新村 4 幢 2 号
沈益军	0.80%	330106690815041	杭州市西湖区浙大路 20 号
方杏芬	0.80%	330102710120124	杭州市西湖区浙大路 20 号
江富琴	1.60%	330106690920007	杭州市西湖区浙大路 20 号
林必清	0.50%	330106196411290215	杭州市西湖区上宁新村 7 幢 1-602
陆晓冬	1.30%	330106641108008	杭州市上城区小塔儿巷 7 号 102 室
施春洪	1.40%	330103410302101	杭州市下城区天水巷 19 号
刘培东	1.30%	320622630519113	杭州市西湖区浙大路 20 号
羊荣兴	1.30%	330106640903041	杭州市西湖区教工路 1 号
郑建国	1.30%	330105530218001	杭州市拱墅区沈塘桥弄
陈峪	1.60%	330106740311041	杭州市西湖区求是村 46 幢 154 号 12 室
陈亚萍	1.30%	330104561025162	杭州市西湖区九莲新村 30 幢 105 号 205 室
马向阳	1.20%	510102691222847	杭州市西湖区浙大路 20 号
杨德仁	1.20%	330106640429045	杭州市西湖区求是村 54 幢 184 号 2 室
蒋校龙	0.30%	420106660128497	宁波市海曙区穆家巷 46 号 612 室
李莉	1.00%	342822700409002	广州市广卫路 4 号
蔡理	1.00%	320103670924076	南京市鼓楼区广东路 38 号平房 12 号
方桂琴	1.00%	330106530623042	杭州市西湖区求是村 4 幢 13 号 605 室
李晓军	1.00%	330106670702002	杭州市西湖区求是村 61 幢 601 室
赵榕椿	1.00%	330106430207041	杭州市西湖区求是村 43 幢 148 号
贺云冲	1.00%	332603740615001	杭州市西湖区文一路 65 号
李刚	0.90%	620102680207537	杭州市西湖区浙大路 20 号
饶伟星	0.90%	330822710912121	杭州市西湖区浙大路 20 号
杨希望	0.80%	330106670726053	杭州市西湖区浙大路 20 号
肖型奎	0.80%	422429700304445	杭州市西湖区文三路 27 号
吕迅	0.80%	330106641130047	杭州市拱墅区济良弄 6 幢 7 号
唐雪林	0.80%	310222641226036	杭州市西湖区文三路 27 号
王云娟	0.80%	330106521119152	杭州市西湖区友谊新村
陈志云	1.00%	330122750516251	杭州市西湖区浙大路 20 号
翁格菲	0.70%	330222751105317	杭州市西湖区浙大路 20 号
黄海燕	0.50%	330722741025452	杭州市西湖区浙大路 20 号
张民杰	0.50%	330105580112001	杭州市拱墅区莫干新村 7 幢 40 号
田达晰	0.70%	330106660323043	杭州市西湖区浙大路 20 号
倪永明	0.40%	330103690702071	杭州市下城区天水巷 19 号
茹广	0.30%	330602761023055	杭州市西湖区文一路 65 号
严建良	0.20%	330106611127081	杭州市西湖区求是村 63 幢 405 室



上述发起人均为中国国籍，且无境外永久境外居留权。

## 2、宁波海纳

该公司成立于 1993 年 4 月 24 日，位于宁波保税区东区，成立时注册资本为 5,000 万元，法定代表人李立本。参与发起设立本公司时，该公司为浙大海纳控股子公司，主营业务为硅抛光片的生产与销售。为消除关联交易，2002 年 3 月公司回购了宁波海纳所持公司全部股份，详细情况请参见本节之“五、历次重大资产重组和收购兼并”。

### （二）持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况

姓名	持股比例	国籍	永久境外居留权	身份证号码	住所
王敏文	25.95%	中国	不拥有	310110631103629	上海卢湾区打浦路 457 弄 2 号 1807 室
李莉	6.24%	中国	不拥有	342822197004090028	广州市广卫路 4 号
李立本	5.99%	中国	不拥有	330106194001130412	杭州西湖区求是村 64 幢 211 号 404 室
林必清	5.85%	中国	不拥有	330106196411290215	杭州市西湖区上宁新村 7 幢 1-602

### （三）实际控制人

本公司实际控制人为自然人王敏文、陈茶花夫妇。王敏文，男，中国籍，44 岁，MBA，工程师。曾任申能股份有限公司助理经济师、投资部经理助理、策划部经理、董事，申能（集团）有限公司副总经理，申能资产管理公司总经理、董事长，上海电气集团股份有限公司董事、东方证券股份有限公司副董事长等，现任本公司董事。陈茶花，女、中国籍，42 岁，本科，工程师，无永久境外居留权，身份证号码为 310103196503130048，曾任总参二局 57334 部队工程师，太平洋保险信息技术部项目经理。

王敏文、陈茶花夫妇实际控制权的历史演变情况参见本节之“四、公司股本变化对实际控制人的影响情况”。

### （四）实际控制人控制的其他企业

本公司实际控制人无其他控制的企业。

## （五）实际控制人持有公司股份质押或其他有争议的情况

本公司实际控制人所持公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 十、发行人的股本情况

### （一）本次发行前后的公司股本结构

本次发行前公司总股本为 7,708 万股，本次拟向社会公开发行股票数量为 2,600 万股，占发行后总股本的比例为 25.22%。

### （二）前十名股东持股情况以及在公司的任职情况

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	在公司的任职情况
1	王敏文	2,000	25.95%	董事
2	李 莉	481	6.24%	无
3	李立本	461.40	5.99%	董事长
4	林必清	450.60	5.85%	董事、总经理
5	李正明	340	4.41%	无
6	陈卫忠	280	3.63%	董事、副总经理
7	冯夏婷	250	3.24%	无
8	陈茶花	200	2.59%	无
9	马德林	150	1.95%	无
10	俞升阳	149	1.93%	无

### （三）发行人股东之间的关联关系

本次发行前，公司有自然人股东 109 名，部分股东之间存在关联关系，具体情况如下：

股东姓名	持股比例	关联股东姓名	关联关系	持股比例
王敏文	25.95%	陈茶花	配偶	2.59%
		陈卫忠	配偶之弟	3.63%
李立本	5.99%	李晓军	父女	1.56%
		李晓劲	父子	0.60%
马德林	1.95%	宋 锦	儿媳	1.82%

股东姓名	持股比例	关联股东姓名	关联关系	持股比例
阙端麟	1.34%	杨在亮	配偶	1.56%
张锦心	0.90%	赵榕椿	配偶	0.35%
沈益军	0.52%	方杏芬	配偶	0.47%

#### （四）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2006 年 8 月公司增资时，认购公司增发新股人员均为公司的核心技术人员和骨干员工，该次认购公司新股的人员名称及其认购股数情况如下表所示：

序号	股东姓名	认购股数 (万股)	序号	股东姓名	认购股数 (万股)
1	林必清	220	28	涂洪浪	3
2	田达晰	70	29	黄力平	3
3	陈卫忠	50	30	咸春雷	3
4	李晓军	40	31	李晓劲	3
5	吴能云	40	32	蒋祖锋	3
6	凤坤	20	33	薛伟艺	3
7	游志朴	20	34	戴劲松	2
8	刘培东	15	35	张雄杰	2
9	谌攀	6	36	郑铁波	2
10	赵松宏	5	37	倪永明	2
11	朱乐平	4	38	贾海军	2
12	李自炳	4	39	沈海潮	2
13	丛宏林	4	40	卢锋	2
14	刘岱阳	4	41	刘建刚	2
15	翁格菲	4	42	陈华	2
16	羊荣兴	4	43	王笑青	2
17	贺云冲	4	44	王海兵	2
18	周慧敏	3	45	楼琦江	2
19	唐雪林	3	46	厉惠宏	2
20	张世波	3	47	胡晓光	2
21	何良恩	3	48	黄斌	2
22	刘虎	3	49	叶建萍	2

序号	股东姓名	认购股数 (万股)	序号	股东姓名	认购股数 (万股)
23	王继标	3	50	彭兴根	2
24	刘丹	3	51	刘莉莉	1
25	任瑞祥	3	52	陈丹凤	1
26	陈岳来	3	53	边林邈	1
27	李刚	3	54	金广喜	1
合 计					600

认购公司 2006 年 8 月增发股份的林必清等上述 54 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东王敏文、李立本、阙端麟、林必清、陈卫忠、杨德仁、马向阳、刘培东、李晓军、田达晰、吴能云作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

## （五）发行人内部职工股情况

公司未曾发行过内部职工股。

## （六）工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股等情况

公司未曾有工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股以及股东数量超过 200 人的情形。

## 十一、发行人员工及社会保障

### （一）员工人数及变化情况

1、公司、立立半导体、立昂电子以及立立科技近三年期末在册员工人数。

单位：人

	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
立立电子	188	170	154
立立半导体	195	196	187
立昂电子	134	164	160
立立科技	11	7	-
合 计	528	537	501

2、截至 2007 年 12 月 31 日，公司、立立半导体、立昂电子以及立立科技在册员工人数及构成情况如下：

岗位类别	员工人数（人）	所占比例（%）
管理人员	67	12.69
技术人员	101	19.13
生产人员	347	65.72
销售人员	13	2.46
合 计	528	100

员工受教育程度情况如下：

学 历	员工人数（人）	所占比例（%）
博 士	3	0.57
研究生	39	7.39
本 科	90	17.05
大专及以下	396	75.00
合 计	528	100

员工年龄分布情况情况如下：

年龄区间	员工人数（人）	所占比例（%）
50 岁以上	3	0.57
41-50 岁	21	3.98
31-40 岁	54	10.23
30 岁以下	450	85.23
合 计	528	100

## （二）员工执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司实行全员劳动合同制。公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工提

供假期福利及各项补贴福利，同时为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，具体情况如下：

**养老保险：**公司、立立半导体、立昂电子和立立科技按照《浙江省职工基本养老保险条例》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 20%，个人缴费比例为 8%。

**医疗保险：**公司和立立半导体按照《宁波市城镇职工基本医疗保险暂行规定》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 11%，个人缴费比例为 2%；立昂电子、立立科技按照《杭州市城镇基本医疗保险办法》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 11.5%，个人缴费比例为 2%。

**失业保险：**公司、立立半导体、立昂电子和立立科技按照《浙江省失业保险条例》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 2%，个人缴费比例为 1%。

**工伤保险：**公司和立立半导体按照《宁波市企业职工工伤保险暂行办法》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 0.4%；立昂电子和立立科技按照《关于杭州市企业职工工伤保险暂行办法的实施意见》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 0.6%。

**生育保险：**公司和立立半导体按照《宁波市城镇企业职工生育保险暂行办法》等规定为员工缴纳，公司缴费比例为 0.7%；立昂电子和立立科技按照《杭州市职工生育保险办法》等规定为员工缴纳，公司缴费比例为 0.6%。

**住房公积金：**公司和立立半导体按照《浙江省住房公积金条例》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 10%，个人缴费比例为 10%；立昂电子公司和立立科技按照《关于规范杭州市住房公积金管理若干问题的通知》等规定为全体员工缴纳，公司缴费比例为 10%，个人缴费比例为 10%。

宁波保税区（出口加工区）人事劳动社会保障局已出具书面《证明》，确认：公司近三年来能遵守有关劳动法规，执行国家劳动政策，保护职工的合法权益，已参加国家规定的各项社会保险，并按时足额缴纳保险费，无违反有关劳动、社会保障法规的行为，无受处罚的记录。杭州市社会保险服务局出具书面文件证明：立昂电子已参加社会保险，足额缴纳保险费，无违反社会保障法规的行为，无受处罚的纪录。杭州市社会保险服务局出具书面文件证明：立立科技已参加杭州市社会保险，足额缴纳保险费，无违反社会保障法规的行为，无受处罚的纪录。

## 十二、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

### （一）避免同业竞争的承诺函

参见本招股意向书“第七节、同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

### （二）发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

参见本节之“十、公司的股本情况”。

## 第六节 业务和技术

### 一、公司主营业务及其变化情况

#### （一）公司主营业务和主要产品

公司目前主营业务为半导体硅材料和半导体分立器件的研发、生产和销售。主要产品包括：4-6 英寸硅抛光片、4-6 英寸硅外延片，以及 6 英寸功率肖特基二极管芯片。

#### （二）公司主营业务和主要产品的变化情况

公司设立时从事的主要业务为硅单晶锭和硅外延片的生产、销售。

2002 年立昂电子、宁波海纳成为公司的控股子公司（详情参见“第五节 发行人基本情况——五、历次重大资产重组和收购兼并”），其中立昂电子主要从事功率肖特基二极管芯片的生产、销售，而宁波海纳主要从事硅抛光片的生产 and 销售。

上述收购完成后，公司合理延伸了产业链，形成了目前的主营业务和主导产品结构。

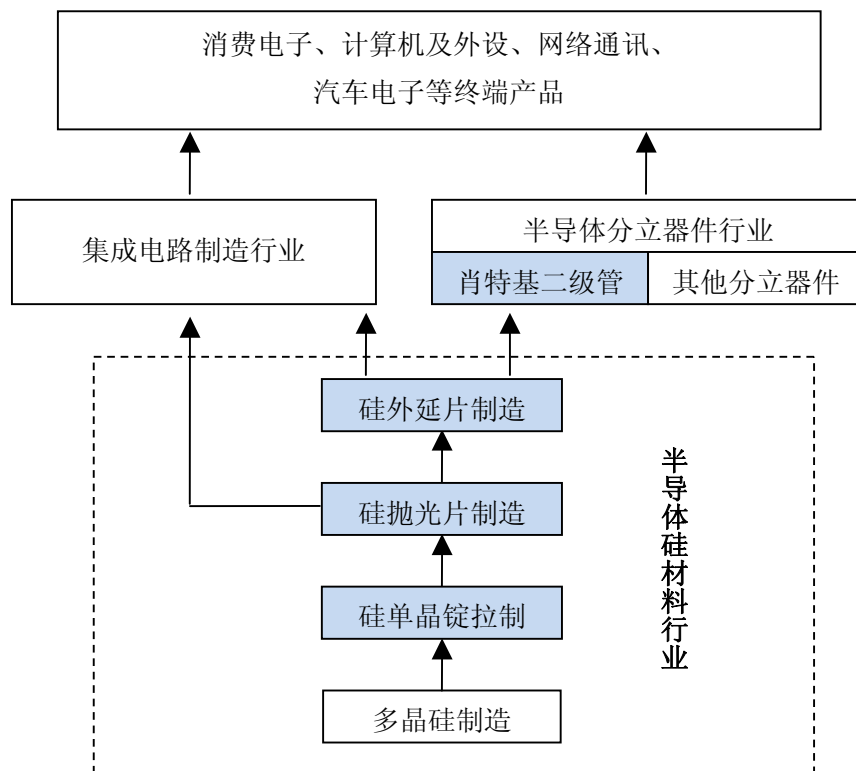
公司本次拟公开发行股票的募集资金将全部用于以下两个项目：6-8 英寸硅抛光片扩产项目和 8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目。该两项目的投产预计将大大提高公司的大尺寸硅抛光片和硅外延片等高端半导体硅材料的生产能力，进一步强化公司主营业务。

### 二、公司所处行业基本情况

#### （一）公司所处行业

公司主营业务分属半导体行业下的硅材料和分立器件两个子行业。公司主营业务及其产品在半导体产业链中的地位如下图所示：





注：阴影部分为公司主营业务在半导体产业链中的位置

## （二）所处行业简况

半导体硅材料行业和半导体分立器件行业是信息技术产业的重要组成部分。信息产业作为国民经济的基础产业、先导产业、支柱产业和战略性新兴产业，正对国民经济、国家安全、人民生活和社会进步发挥着越来越重要的作用。坚持优先发展信息产业和走新型工业化道路，是我国国民经济发展的重要战略指针；“提升我国的电子信息制造业”更是我国“十一五规划”的重要内容。

作为信息产业的基础和核心，得益于国家政策的支持和半导体产业新一轮景气周期的带动，中国半导体产业在近年来实现了快速发展。在半导体产业发展的强势拉动下，半导体硅材料行业和分立器件行业也取得了高速发展。

### 1、半导体硅材料行业

支撑半导体工业的基础半导体材料包括硅材料、化合物半导体材料等，其中硅材料最为重要、应用最为广泛。硅片是集成电路的基础材料，90%以上的大规模集成电路、超大规模集成电路都是制作在硅抛光片或硅外延片上的。因此，半

导体硅材料行业的发展对集成电路产业的发展具有重要的支撑作用，而集成电路产业的发展又反过来带动了半导体硅材料行业的扩张。从某种程度上讲，硅单晶锭、硅抛光片、硅外延片的制造水平是一个国家集成电路产业是否能够独立自主发展的重要保证之一。

## 2、半导体分立器件行业

半导体分立器件主用应用于消费电子、计算机及其外设和网络通信等领域，而随着信息技术的进一步发展，工业自动化、仪器仪表、医疗电子、汽车电子、电子显示等行业也正在成为半导体分立器件的新兴应用市场。

根据半导体分立器件的结构及用途，半导体分立器件产品可划分为二极管、光电二极管、三极管、功率晶体管以及其它半导体器件五大类。作为功率整流器的基本部件，肖特基二极管在汽车、电动自行车、液晶彩电、家用电器、数码产品、讯设备、计算机电源和手机等领域都有着广泛的用途。2006年国内肖特基二极管的市场销售量达到285亿支，较上年增长6.9%，为各类二极管产品中增长最快的一种。公司下属控股子公司立昂电子的主要产品就是功率肖特基二级管芯片。

## （二）行业监管体制

公司所处行业的主管部门为国家信息产业部，其主要职责为：拟订并组织实施产业发展战略、总体规划、产业政策和价格政策；拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章；行政执法和执法监督；指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术改造和质量管理等。

中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会为本公司所处行业的自律组织和协调机构。作为政府与企事业单位之间的桥梁和纽带，其主要职能为：广泛收集行业信息，为行业内企业提供指导、咨询、学术交流等服务，并协助政府主管部门实施行业自律管理，为行业发展规划提出建议等。本公司是中国电子材料行业协会的常务理事单位，中国半导体行业协会会员，宁波电子行业协会的副会长单位。

### （三）行业政策

公司所处半导体产业是国家重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府在 WTO 框架内针对国内半导体产业提供了各项优惠政策，从鼓励产业发展、税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化以及知识产权保护等方面对国内半导体产业发展加大了扶持力度，相关政策和规定主要包括：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）〉若干配套政策的通知（国发[2006]6 号）》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发[2000]18 号）》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展政策细则》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税[2000]25 号）》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知（财税[2002]70 号）》、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》等。

此外，国家改革与发展委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》将“6 英寸及以上单晶硅、多晶硅及晶片制造”列入鼓励类目录；国家改革与发展委员会、科学技术部和商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度）》将“8—12 英寸单晶硅及硅外延片”列入优先发展的电子材料。

## 三、公司所处行业的现状及其发展前景

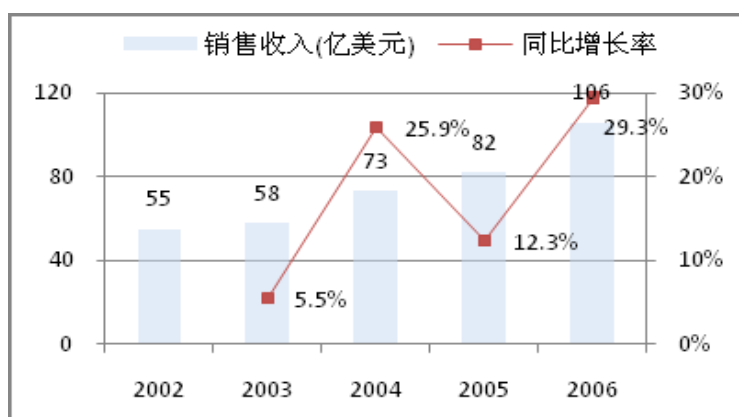
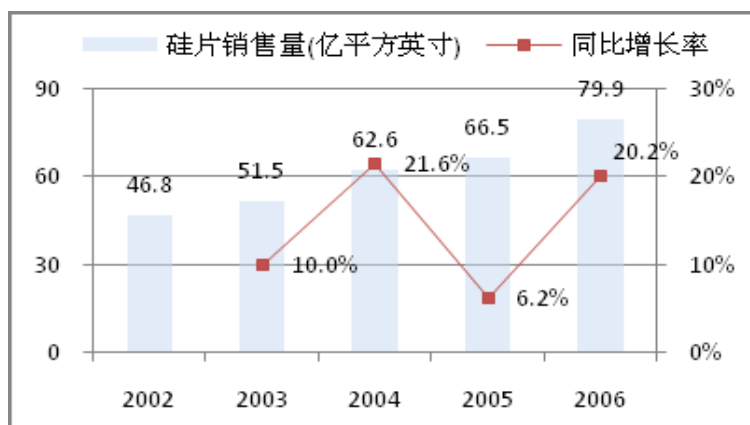
### （一）半导体硅材料行业

#### 1、半导体硅材料行业市场情况

##### （1）全球市场情况

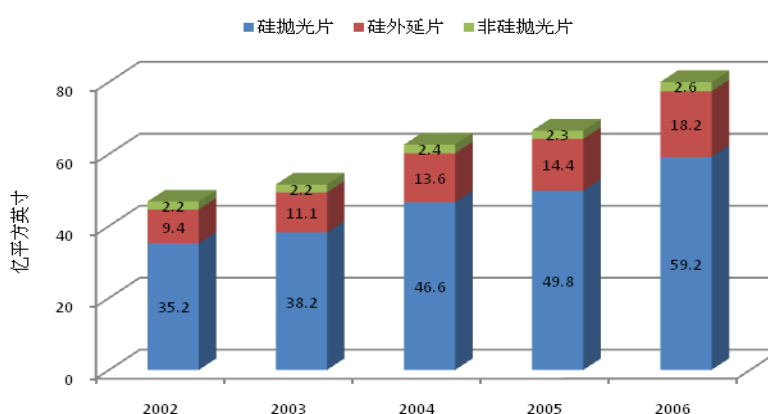
据 SEMI 统计，2006 年全球硅片市场销售额为 106 亿美元，较 2005 年增长 29.27%；硅片销售量达到了 79.94 亿平方英寸，较比 2005 年增长 20.20%。2000-2006 年全球硅片销售量、销售额及其结构如下：

### 2002-2006 全球硅片销售量及销售收入情况



数据来源：SEMI

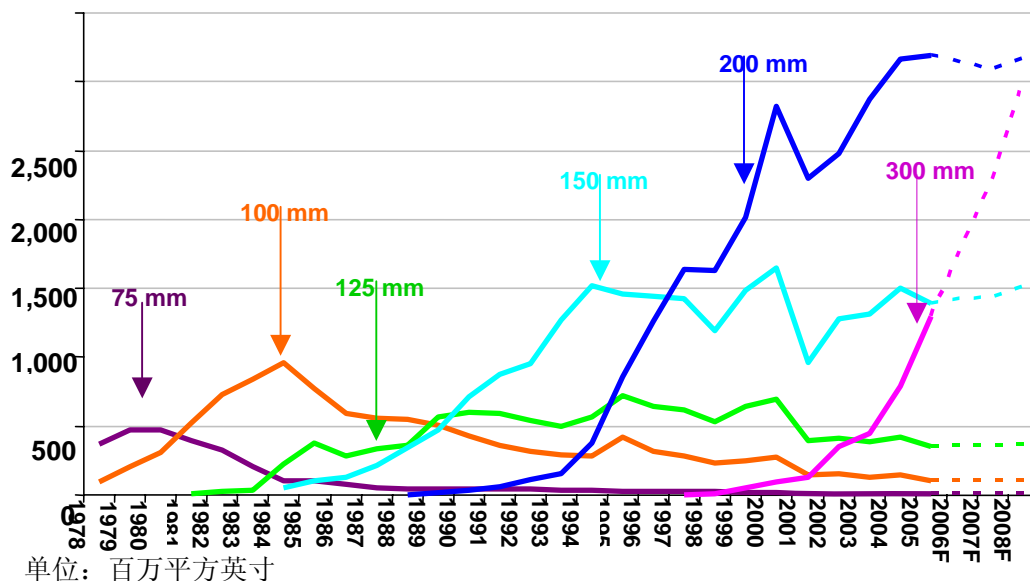
### 2002-2006 年全球硅片销售量结构



数据来源：SEMI

由于分立器件和中低端集成电路从 6 英寸（相当于 150mm）向 8 英寸（相当于 200mm）过渡比较缓慢，因此在相当长时间内市场对 6 英寸硅片仍会保持

较高数量的稳定需求。全球不同直径尺寸硅片市场发展趋势见下图：



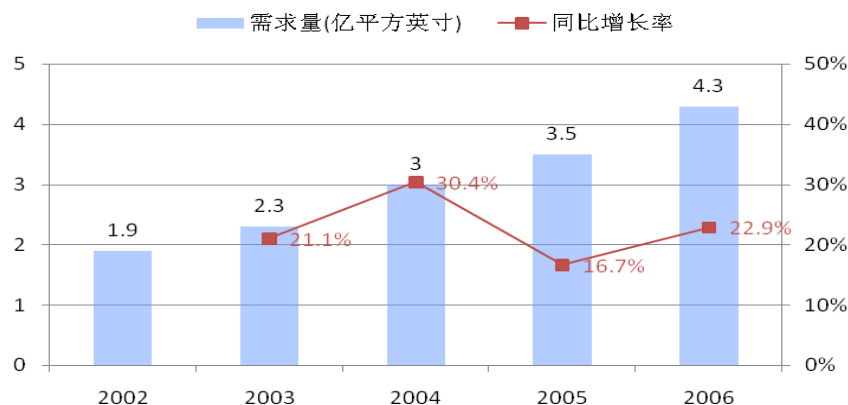
数据来源：SEMI

注：12英寸相当于300mm

### (2) 我国市场情况

近年来，我国电子信息产业保持了持续快速发展势头，随着电子消费产品的生产能力和消费能力不断增强，以及国际半导体业巨头向我国内地转移其集成电路产业，我国集成电路产业蓬勃发展。根据万胜博讯的统计，到2007年2月为止，我国已有15条8英寸、2条12英寸集成电路生产线建成投产，占行业总投片量的50%以上，成为集成电路芯片制造业的主要力量。2006年半导体用硅片需求量为4.3亿平方英寸，比2005年增长了23.6%；销售额则达到了40亿元，比2005年增长了25.6%。

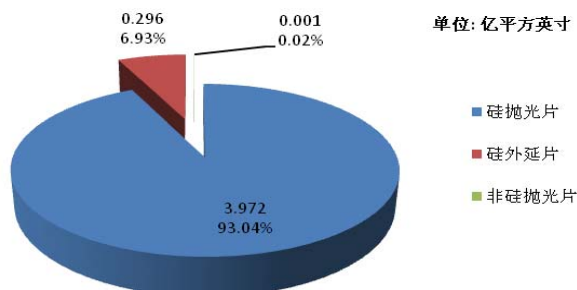
### 2002—2006年中国半导体用硅材料市场需求量



数据来源：赛迪顾问 2007.1

从产品结构上看，硅抛光片仍是半导体领域中最大的硅材料产品种类。2006年，硅抛光片和硅外延片的需求量达到4亿多平方英寸。

### 2006年中国半导体用硅材料分产品市场需求量



数据来源：赛迪顾问

从尺寸结构上看，目前国内对6英寸硅片保持旺盛市场需求，并仍呈上升趋势，对6寸硅片需求量2006年达0.91亿平方英寸；同时8英寸硅片需求量增长迅速，2006年达1.64亿平方英寸；随着国内12英寸集成电路生产线的投产，对12寸硅片的需求量也迅猛增加，2006年需求量达0.07亿平方英寸。

#### (3) 行业内竞争格局和主要企业

根据赛迪顾问的研究报告，全球范围内硅材料行业经过多年的发展和竞争，已形成垄断竞争格局，日本、德国和美国的六大硅片公司(Shin-Etsu、SUMCO、MEMC、Wacker、Komatsu、Toshiba)的总销量占全球的90%以上，短期内这种格局很难被扭转。我国半导体硅材料企业在国内外市场上，参与竞争的主要为目前仍有广泛且稳定市场需求的4、5、6英寸硅片产品，而国际大厂已经停产了4、5英寸硅片产品，6英寸硅片也不再被大厂商列为重点产品。目前，国内4英寸、5英寸硅抛光片市场竞争较为激烈，但因国外主要硅片生产企业已基本停产该两种产品，采购渠道相对较窄，市场较为稳定。而在8英寸以上大直径硅片领域中，我国目前仍不能量产，尚未进入这一细分市场与国际主要硅片厂商展开竞争。

尽管我国半导体硅材料行业的全球市场份额仍然较低，我国硅片生产企业尚未能对国际主要硅材料生产企业构成实质性的竞争威胁，但国内厂商经过多年的发展实力也有所增强，特别是本公司以及有研硅股等企业发展快速，已进入国内

市场销量前 10 名。根据赛迪顾问研究报告，2006 年国内销量前 10 名的厂商销售额占整体市场的 95.5%，其中前七名均为国外著名硅材料生产企业。

由于硅材料的生产具有较高的技术门槛，所以能够从事硅材料厂商数量不多，厂商集中度较高。国内生产硅抛光片的主要企业除了本公司外，还有有研硅股、上海合晶硅材料有限公司（以下简称：“上海合晶”）、麦斯克电子材料有限公司（以下简称“麦斯克”）、上海申和热磁电子有限公司（以下简称：“申和热磁”）等企业。特别是在 6 英寸硅抛光片市场中，目前中国大陆企业仅有本公司、有研硅股开始量产，韩国 LG Siltron、台湾合晶科技股份有限公司（以下简称：“台湾合晶科技”）也是有力竞争对手。从事硅外延片研制、生产的单位主要还有南京国盛电子有限公司（以下简称：“南京国盛”）、河北普兴电子材料有限公司（以下简称：“河北普兴”）、上海新傲科技有限公司（以下简称：“上海新傲”）、上海银笛微电子科技有限公司（以下简称：“上海银笛”）等。就产品而言，目前国内企业主要生产 4-6 英寸硅单晶片，虽少量生产 8 英寸硅抛光片，但大都作为陪片使用，尚未实现量产。通过引进设备和自主开发，本公司和浙江大学、有研硅股已经掌握 12 英寸硅单晶锭的生长技术，为 12 英寸硅单晶锭的产业化奠定了基础。

#### （4）市场前景

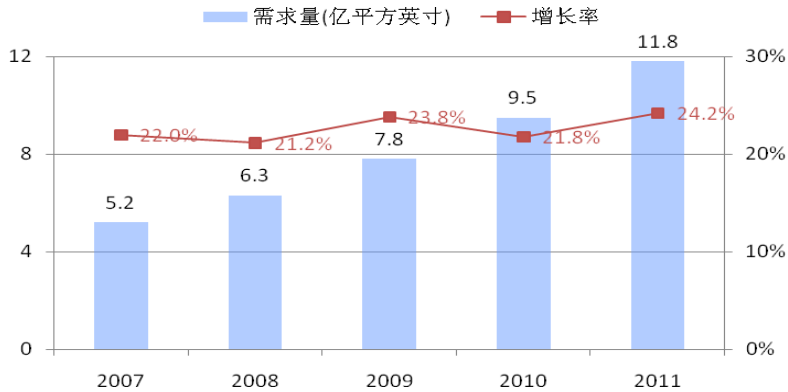
世界半导体市场的增长由半导体终端产品需求拉动，目前全球半导体市场正经历一场深刻的变革，推动市场发展的动力正在由计算机和通信产品演变到数字消费类电子产品，即主要来自手机、数码相机、数字电视和 MP3 播放器等消费类电子产品终端市场的驱动。从 2006 年起，消费类电子产品的快速增长已成为全球半导体市场最大推动力。

随着数字消费类产品，3G 网络、笔记本电脑和 PC 机的进一步普及，以及平板电视的增长，目前中国已成为全球最大的集成电路市场。根据赛迪顾问研究报告，2006 年中国集成电路的销售额已达 5000 亿元，预计 2007 年仍将保持高速增长趋势，增长率可达 33.6%，到 2010 年我国集成电路市场规模将达到 9000 亿元。

集成电路的发展要求不断提高芯片集成度、减小器件特征尺寸，同时硅片面积不断加大。目前，国际市场集成电路用主流硅片以 8 英寸、12 英寸为主，而中国硅片市场需求的主要动力来自 8 英寸硅片，未来中国集成电路制造业的产能提升

也主要集中于 8 英寸。随着国内新建 8 英寸、12 英寸集成电路生产线的陆续投产，目前国内 8 英寸及 12 英寸硅片的需求量已占总体市场需求（以平方英寸计）的 50%左右，预计到 2007 年将进一步提高到 70%左右。

### 我国半导体硅材料市场情况预计



数据来源：赛迪顾问

但是，由于目前市场上的功率 IC、Logic IC、Linear IC、消费类 IC、MCU、电力电子器件、光电器件、RF 元器件等大部分仍以 6 英寸及以下中小尺寸硅片来制作，因此中小尺寸硅片仍有一定市场空间，且市场需求稳定。由于国外硅材料厂商已经放弃了这部分中小尺寸硅片市场，因此国内厂商仍有相当大的市场机会。

## 2、进入本行业的主要障碍

(1) 技术壁垒。半导体硅材料行业是一个高度技术密集型行业，特别是随着大直径硅片的发展，对于硅片的生产技术和制造工艺提出了越来越高的要求，后进企业如果不具备相当的技术积累和技术支持力度，以及高素质的技术团队，将很难跟上市场发展需求。

(2) 认证壁垒。鉴于集成电路芯片的高精密性和高技术性，对半导体硅材料质量要求极高，因此芯片生产企业都对于硅片供应商的选择相当谨慎，并设置了严格的认证程序和标准，后进企业要进入主流芯片生产企业的供应商队伍，需要经过长期认证，这也抬高了该行业的进入壁垒。

(3) 资金壁垒。半导体硅材料行业作为一个资金密集型的行业，要形成规模化、商业化生产，投资规模巨大，如一台关键生产设备价值就达数千万元人民币，进入该行业的企业需要有雄厚的资金实力。



### 3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

#### (1) 行业周期影响

由于半导体硅材料行业处于半导体行业产业链的上游环节，因此半导体行业的周期性波动对半导体硅材料行业利润水平影响较大，在半导体行业景气上升阶段，行业利润水平呈现上升趋势，反之则呈下降趋势。

#### (2) 原材料价格波动影响

近年来，由于全球多晶硅供应紧张，价格持续上涨，对半导体硅材料行业利润率影响较大。当硅片生产企业无法转嫁原材料价格上涨所带来的成本增加时，其利润空间将受到挤压。

### 4、影响国内半导体硅材料行业发展的因素

#### (1) 有利因素

##### ① 国际半导体产业转移的影响

进入二十一世纪以后，国际半导体制造业开始从发达国家向亚洲及发展中国家转移。上世纪 80 年代的全球第一次产业转移，使日本成为世界半导体强国。近年来，我国强大的内需促使亚洲成为全球芯片销售的龙头，中国已经成为全球半导体市场新的增长极。巨大的消费市场和优惠的产业政策，吸引了大批资金涌入我国内地投资建设集成电路和分立器件生产线。集成电路和分立器件产业的快速发展，带动了我国半导体硅材料市场的发展。而目前国内供给明显不足，基本依赖进口，这为我国的半导体硅片生产企业提供难得的发展机遇和广阔的发展空间。

##### ② 国家产业政策的扶持

公司所处半导体硅材料行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从鼓励产业发展、税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化以及知识产权保护等方面，对半导体硅材料行业给与大力扶持。

##### ③ 国内市场需求旺盛

近年来随着中国经济迅速增长，国内消费结构升级，以电子消费类产品、3G

网络、计算机及外设为代表的电子信息产品市场扩展迅速，由此带来中国集成电路和分立器件产业市场的急速发展。目前中国已成为全球最大的集成电路和分立器件市场，对半导体硅材料的需求旺盛。

#### ④产品生命周期较长

目前，硅材料约占半导体材料使用量的 95%以上，与其他半导体材料相比，硅材料因具有原材料资源丰富、利于下游产业的高集成度和大规模化生产，降低生产成本等其他半导体材料不具备的优势，生命周期较长。在未来较长的一段时间内，硅材料在半导体制造业中的广泛运用尚无法被其它材料所替代。

### (2) 不利因素

#### ① 国际垄断业已形成

美国、日本、德国等少数国家已经垄断了国际半导体硅材料市场。日本信越、SUMCO、德国 Wacker、美国 MEMC 等硅片公司垄断了全球绝大多数的硅片市场。这些国际级硅材料生产企业，与全球的集成电路生产巨头同步成长，拥有较为稳定的客户群体。从半导体硅材料技术发展来看，这些硅片公司具有雄厚的资本实力，多年的研发投入与技术积累，使其始终掌握着国际上最先进的半导体硅材料制造技术、控制着高等级半导体硅材料生产设备的制造技术。

伴随着硅片大直径化发展趋势，硅单晶片的产品格局正在发生变化。目前，国际市场上 8 英寸硅单晶片的产量最大，12 英寸硅片产量快速扩张，即将成为市场最主流产品；而 6 英寸硅片的生产规模趋于稳定，但将来有逐步缩小之势。在此情况下，发达国家逐步退出 6 英寸、8 英寸硅片的生产，为我国半导体硅材料行业产品的更新换代提供了机会。

#### ② 多晶硅市场供应紧张

多晶硅是生产硅单晶的直接原料，高纯度、高质量的多晶硅是生产分立器件和集成电路用硅单晶片的直接原料。世界半导体工业的迅猛发展，使多晶硅的全球需求量以每年 10%-12%的速度增长。太阳能光伏产业近年来迅猛发展，加剧了多晶硅市场供应的紧张局面，致使上游多晶硅价格持续上涨。

目前，我国半导体级多晶硅需求几乎完全依赖进口，导致国内大多数半导体

硅材料生产企业必须面对多晶硅价格上涨、供应不畅的被动局面。这种态势已经制约了我国半导体硅材料行业的发展。

但是，全球多晶硅材料的短缺和丰厚的利润加速了国内外多晶硅项目的快速发展。目前，Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC 等全球多晶硅供货商，纷纷扩大产能；而国内厂家如四川新光硅业科技有限责任公司、洛阳中硅高科技有限公司等多个多晶硅项目也纷纷上马，这有利于缓解我国多晶硅供应紧张的局面。

根据 The third Solar Silicon Conference 的会议信息，七大多晶硅生产商 2005-2010 年产量及预测产量如下：

单位：吨

企业	2005 年 产量	2006 年 产量	2007 年 预测	2008 年 预测	2009 年 预测	2010 年 预测
Hemlock	7,700	10,000	10,000	14,500	19,000	19,000
Tokuyama	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
Wacker	5,000	5,500	5,500	10,000	14,500	14,500
REC Silivon	5,300	5,800	6,000	13,500	13,500	13,500
MEMC	3,700	3,700	3,700	8,000	8,000	8,000
Mitsubishi	2,850	2,850	3,150	3,150	3,150	3,150
Sumitomo	8,00	900	1,300	1,300	1,300	1,300
合计	30,950	34,350	35,250	56,050	65,050	65,050

资料来源：The Third Solar Silicon Conference April 3, 2006; Munich, Germany.

## 5、半导体硅材料行业技术水平及其发展趋势

缩小特征尺寸和使用更大直径的硅片，是提高集成电路性能和降低生产成本的主要手段。现阶段全球半导体行业发展的技术特征呈现出“硅片直径的增大及芯片特征尺寸的缩小，其中尤以特征尺寸缩小为优先”的趋势。因此为了满足集成电路发展的需求，硅片的尺寸也在不断增大。

国际先进硅片生产企业的 12 英寸硅片生产技术已成熟。日本、美国和德国等都已经开始逐步扩大 12 英寸硅片的产量。由于硅片直径的增大将提高集成电路的每片产出量，有效降低芯片生产成本，因此，国际先进硅片生产企业正在积极研发 12 英寸以上更大直径的硅片，目前研制水平已经达到 16-18 英寸硅片。伴随着硅片直径增大，因此对硅片表面局部平整度、表面附着的微量杂质、内部

缺陷、氧含量等关键参数的要求也不断提高，对硅片的生产技术和制造工艺提出了更高的要求。

经过多年发展，我国半导体硅材料行业的技术水平有了显著提高，但与国际先进水平相比还存在较大的差距。在硅单晶片种类上，国内主流产品为 4、5、6 英寸，8、12 英寸硅片尚未能实现量产。此外，国内半导体硅材料行业深加工能力较低，对于直拉硅单晶的后续加工，国产设备难以实现规模化生产，大尺寸硅片生产设备的引进又一直受到国外制约，这也限制了我国半导体硅材料行业的发展。

随着我国半导体行业的快速发展，国内 6-8 英寸硅片市场需求量不断扩大，同时国内部分硅片生产厂家通过引进设备和自主研发等措施，已经掌握了 6-8 英寸硅片的相关生产技术。我国的硅片生产已开始从 4、5、6 英寸向 8 英寸过渡，在实现规模化量产后，6-8 英寸硅片将成为我国硅材料行业的主流产品。

#### **6、半导体硅材料行业周期性、季节性**

半导体硅材料行业的下游客户主要为集成电路及分立器件厂商。因受市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等影响，半导体行业存在着较为明显的周期性波动，业内通常认为大约每隔四、五年全球半导体产业会经历一次“景气循环”。以 2000-2006 年为例，从销量、销售收入的变化趋势来看，全球半导体硅材料市场在 2001 年跌入低谷，2002 年开始回升，2004 年进入这一周期的高峰，2005 年增长速度又有所放缓，而 2006 年全球硅片销售量增长又开始提速。未来几年，半导体行业将持续增长，并且波动性将会趋小，这也将大大有利于半导体硅材料行业的稳定发展。

半导体硅材料行业的生产和销售受季节影响较小，行业季节性特征不明显。

#### **7、与上、下游行业的关系**

从传统意义上看，半导体硅材料行业处于半导体产业链的上游；紧接该行业段的是集成电路、分立器件行业；随后的消费电子、计算机与外设和网络通信是最主要的三大下游行业。而在半导体硅材料行业中，多晶硅又是整个硅材料行业的基础。半导体硅单晶材料行业的高速发展，是下游终端行业发展的有利保证；下游行业的景气度又会直接影响着上游半导体硅材料行业的发展。本公司兼处硅

材料和半导体分立器件行业，具有产业纵向整合的能力，其赢利能力和财务稳健性较强。

## 8、出口贸易情况

由于国际上的主要硅片生产企业已经将主营产品转向 8 英寸、12 英寸产品，而国际市场对 4 英寸、5 英寸以及部分 6 英寸硅片产品仍有较大稳定需求，这便为我国硅材料生产企业的产品出口提供了一个较好契机。

硅片属于高技术产品，从国际贸易争端历史来看，高技术产品占 WTO 贸易争端总额的比例较低，半导体硅材料贸易引发争端的比例更低。2006 年我国硅抛光片产量仅占全球产量的 4%，硅外延片产量仅占全球产量的 3.3%，且我国出口的 4-6 英寸硅单晶片已经不是国际大厂商的主营产品，因此构成反倾销等贸易争端的可能很小。

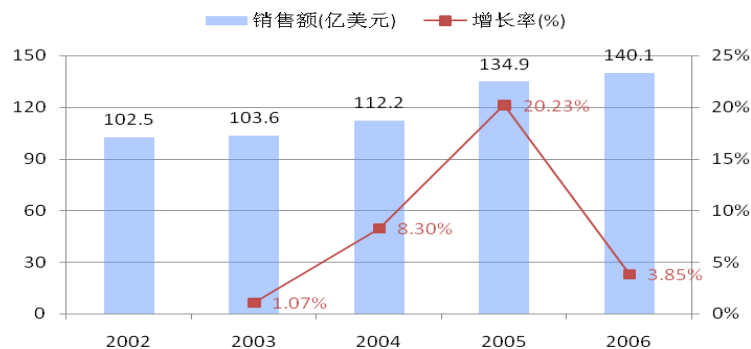
## (二) 半导体分立器件行业

### 1、半导体分立器件行业市场情况

#### (1) 全球市场情况

近几年全球分立器件市场呈现持续增长的态势，该市场虽然也受半导体行业发展周期性影响，但受影响程度小于集成电路市场。根据 SIA 的统计，2006 年全球分立器件市场规模为 140.1 亿美元，同比增长 8.8%。

近 5 年全球分立器件市场规模和增长情况



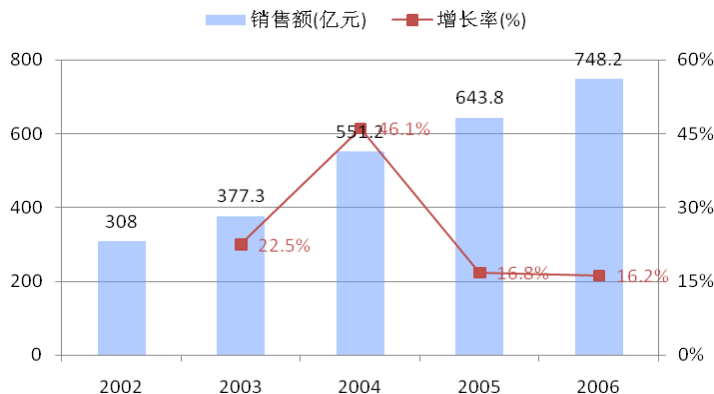
数据来源：SIA，赛迪顾问

#### (2) 国内市场情况

近年来，随着消费电子、计算机及外设、网络通讯、汽车电子等终端产品市

场的迅速发展，我国分立器件市场规模不断扩大，2006 年销售规模达到 748.2 亿元，同比增长 16.2%。

近 5 年中国分立器件市场规模和增长情况



数据来源：赛迪顾问

### (3) 竞争格局

在半导体分立器件领域，日本、美国、欧洲以及中国台湾厂家凭借核心技术和质量优势具备较大的竞争优势，东芝、Fairchild、On Semi、ST 等厂商都是全球知名的分立器件生产企业，具有举足轻重的市场地位。而亚太地区是近年来全球半导体市场发展最快的地区，适应这一趋势，该地区分立器件企业发展迅速，虽然企业规模还普遍较小，但发展势头迅猛。

近年来，我国先后从国外引进了先进的半导体分立器件生产设备和制造技术，新建和改建了多条生产线，在技术水平、研发能力、生产规模、产品质量、产品结构和经营管理等方面取得了长足的进步。根据 CSIA 的统计，2006 年中国分立器件总产量为 833.2 亿只，比 2005 年增长了 25.7%，实现销售收入 106.1 亿元，同比增长了 16.9%。

近 5 年中国分立器件厂商产销量及增长情况

年份 项目	2002 年度	2003 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度
总产量(亿只)	351.50	498.70	585.50	662.80	833.20
增长率(%)	53.60	41.90	17.40	13.20	25.70
销售收入(亿元)	50.60	58.50	75.20	90.80	106.10
增长率(%)	5.00	15.60	28.60	31.40	16.90

数据来源：CSIA，赛迪顾问

但是，国内分立器件企业仍处在发展的起步阶段，产业集中度较低，产品档次不高，普遍以技术含量较低的传统二、三极管为主，市场急需的新型分立器件产品大多需要从国外采购。目前国内市场所需分立器件的 60%以上依靠进口。2006 年国内前 20 大供应商中，境外企业达到了 19 家，其中前四名厂商分别是 ST、Fairchild、东芝和 On Semi。

#### (4) 市场前景

在全球计算机与外设产品、特别是笔记本电脑制造能力不断向国内转移趋势的带动下，包括分立器件在内的各类电子元器件产品的市场需求迅速扩大。此外，节能灯、工业自动化、仪器仪表、医疗电子、汽车电子、电子显示等行业也已经成为分立器件的新兴应用市场。就今后 5 年的中长期发展趋势看，国内分立器件市场将会继续保持稳定的增长态势。到 2011 年，中国分立器件的市场规模将达到 3574.6 亿只，销售额将达到 1443.2 亿元。

根据赛迪顾问的统计，肖特基二极管 2006 年市场销售量为 284.6 亿只，市场增幅达到 6.9%，为各类二极管产品中增长最快。今后 5 年内随着电子制造业的蓬勃发展，肖特基二极管还将以每年 6-15% 的速度增长。

## 2、影响国内分立器件行业发展的因素

目前影响国内分立器件的有利因素主要包括：

(1) 市场需求不断增长。目前中国电子信息产业正处于全面持续发展的周期，IT 产品和消费电子产品等电子整机产业的迅猛发展直接拉动国内分立器件市场需求的高速增长。这些都为中国分立器件市场带来了巨大的发展空间。

(2) 产业集群效应明显。随着以上海为中心，包括江苏和浙江两省在内的长江三角洲地区投资环境不断完善，国内外 IT 制造业正在向该地区集中，进而带动该地区对各类电子元器件采购的迅速增长，长三角地区已经成为目前国内分立器件市场增长最快的地区。2006 年该地区在全国市场总额中所占的比例也已经提高到 40%。长三角地区 IT 相关产业的集群效应得不断显现，有利于我国半导体分立器件的规模化、集约化发展，也有利于地区内企业的做大做强。

但是，核心技术上的缺失仍是制约国内分立器件生产企业健康发展的主要瓶颈。目前市场急需的高技术、高附加值的产品国内基本上都无法生产，国内企业

的产品主要集中在低端产品领域。特别是在功率肖特基二极管芯片领域，除了立昂电子等少数企业，国内大部分企业只能生产小电流、低反压的芯片，目前国内企业主要在这类产品领域竞争，利润空间不断压缩，对行业的持续健康发展不利。

### 3、分立器件行业技术水平及其发展趋势

目前，国内分立器件产业仍处于规模小、技术低、产业集中度不高的状态，自主研发能力薄弱、缺乏核心技术，产品主要集中在低端领域。国内功率肖特基二极管芯片生产企业受装备和技术开发能力的制约，只能集中在以小电流、低反压为主导产品的低端市场，其主流产品规格为正向电流 1-5A、反向电压 100V 以下，尤以 1-3A、40-60V 为常见，而国际市场上先进的功率肖特基二极管芯片已达正向电流 200A、反向电压 250V 的水平。

功率肖特基二极管芯片未来的发展，将会朝着大电流、高反压，以及在特定条件下应用如低正向压降、高抗静电能力等方向发展。

### 4、分立器件行业周期性、区域性和季节性

作为半导体行业的子行业，分立器件行业也受到半导体行业周期性的影响，但相比半导体材料领域或集成电路领域，由于其产业成熟度高，产品生命周期长且价格弹性小，因此受行业周期波动影响并没有前两者明显。

我国半导体分立器件市场呈现明显的区域性特征，即长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京津环渤海地区是国内分立器件的主要区域市场，我国主要的分立器件生产企业也集中在这三个地区。半导体分立器件行业的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。

## 四、公司在行业中的竞争地位

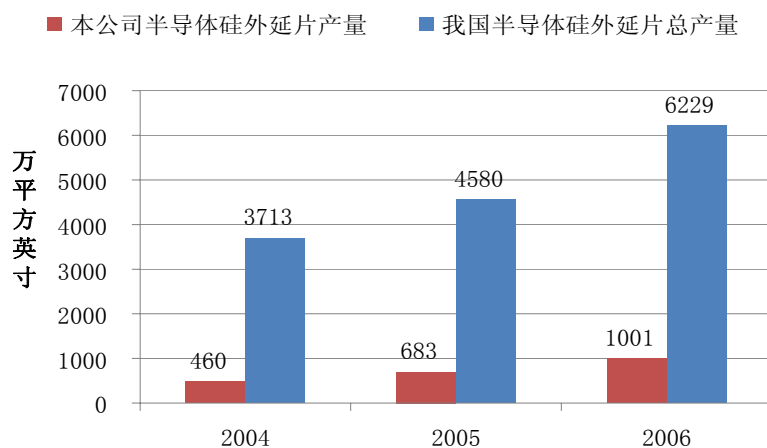
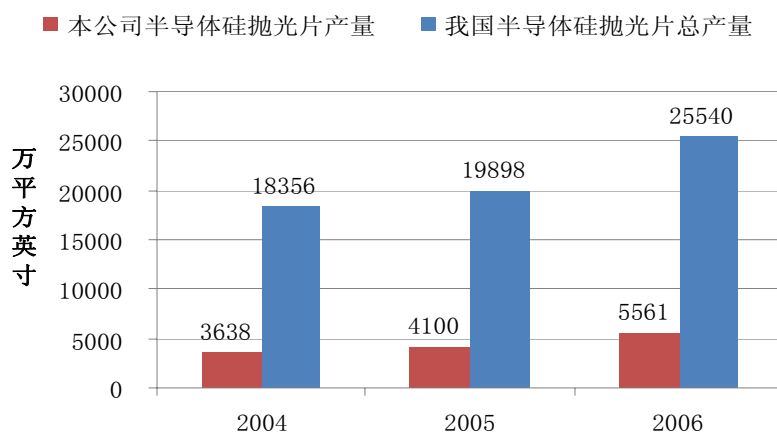
### （一）半导体硅材料行业

#### 1、市场份额

2006 年，我国半导体硅材料行业整体实现销售收入 40 亿元。本公司是国内最主要的半导体硅片生产企业之一，也是国内唯一同时具备硅抛光片与硅外延片规模化生产能力的企业。2006 年公司硅抛光片与硅外延片业务收入为 2.66 亿元，市场份额居于国内同行业领先地位。2004-2006 年本公司硅抛光片和硅外延片的



国产市场份额变化情况如下：



数据来源：万胜博讯、本公司

## 2、主要竞争对手

### (1) 硅抛光片

在硅抛光片产品上，与本公司形成直接竞争的国内同行业企业包括有研硅股、上海合晶、麦斯克、申和热磁等，境外企业有韩国 LG Siltron、台湾合晶科技等。

根据公司掌握的情况，有关竞争对手情况如下（以下信息与相关公司的实际情况可能存在一定差异）：

有研硅股，由北京有色金属研究总院独家发起，1999年2月8日设立，同年3月19日在上海证券交易所上市，是国内半导体硅材料行业主导企业之一，该公司的主要产品有：4、5、6英寸硅抛光片、区熔硅单晶钉、大直径硅单晶以及太阳能电池片等。

上海合晶，国内最早实现硅材料工业化生产的企业，主要产品为 4 英寸硅抛光片。该公司主要为台湾合晶科技公司代工其产品主要在国内销售。

麦斯克，国内较大的硅抛光片生产企业，其主要产品为 4、5 英寸硅抛光片，其产品主要在国内销售，国外主要销往韩国、新加坡。

申和热磁，是日本 Ferrotec 集团的子公司，该公司是一家主要从事磁流体、真空密封、热电模块、生化仪器、硅材料等新型材料的开发研究和生产销售的高科技公司。该公司 2002 年从日本引进硅抛光片生产线，硅抛光片得主要产品为 4、5、6 英寸，产品主要销往日本，目前与公司无直接竞争关系。

韩国 LG Siltron，成立于 1985 年，是韩国领先的半导体硅片生产商。该公司的主要产品为 6-12 英寸硅抛光片、硅外延片等，产品主要以轻掺硅片为主，该公司产品除本国销售外，还销往美国、中国台湾、新加坡、欧洲和中国大陆地区。

台湾合晶科技，即 Wafer Works，该公司是台湾半导体硅片著名生产企业，其主要产品为半导体级及太阳能级硅片，其中半导体级硅抛光片的主要以 4-6 英寸为主，产品除本地销售外，还销往美国、欧洲、日本等国。

## （2）硅外延片

国内硅外延片生产企业竞争主要集中在 4-6 英寸产品上。除本公司外，国内主要的硅外延片生产企业还包括南京国盛、河北普兴、上海新傲、上海银笛等，在国际市场上与本公司形成直接竞争的还有美国 Globitech 公司。

南京国盛，国内专业从事半导体硅外延材料的研发和生产的企业之一，该公司主要产品为 3-6 英寸的 P 型和 N 型外延片，产品主要在国内销售为主，国外主要销往我国台湾地区，日本、韩国、俄罗斯等。

河北普兴，国内较早从事硅外延片研究和生产的企业之一，该公司的主要产品为 4-6 英寸的 P 型和 N 型外延片，产品主要在国内销售为主。

上海新傲，是中国科学院上海微系统与信息技术研究所设立的一家新兴公司，具有较为雄厚的研发优势，除了常规外延产品外，公司还能向客户提供掺砷外延、厚膜外延、埋层外延、IGBT 等外延服务。公司产品主要为 4-6 英寸的 P 型和 N 型外延片。该公司产品除国内销售外，主要销往国外如日本、印度、中国台湾地区等。

美国 Globitech 公司，位于美国德州达拉斯，成立于 1999 年，主要产品为 6

英寸和 8 英寸硅外延片，除在本国销售外，还销往中国台湾地区等。

## （二）分立器件行业

### 1、市场份额

在分立器件市场细分上，肖特基二极管市场容量每年约 250-300 亿只，其中来自国内企业生产的约为 150-200 亿只，大部分属于低端小电流器件。公司控股子公司立昂电子拥有目前国内唯一一条 6 英寸肖特基二极管芯片生产线，在技术、品质上具有相当的优势。该公司是在与国际知名企业 On Semi 有紧密合作的背景下成立，其技术和质量保证体系均完全符合 On Semi 的严格要求。目前，立昂电子的肖特基二极管芯片主要供应 On Semi 和国内一些分立器件封装企业，产品以中高端功率肖特基二极管芯片为主，立昂电子产品以正向电流 5A 以上、反方电压 100V 以上的大电流高反压产品为主，避开了与国内其它厂家在 1-3A 以及低压产品领域的竞争。尤其是公司近期开发的面对国内高端市场应用的 100-200V 高反压肖特基二极管芯片，性能优良，已批量进入市场。目前立昂电子高反压肖特基二极管芯片的月出货量在国内同类厂家中居于前列。

### 2、主要竞争对手情况

国内、国外主要功率肖特基二极管芯片制造商有：

地区	厂商
中国大陆	济南晶恒、天水天光半导体有限责任公司、上海新进
中国台湾	强茂半导体股份有限公司、台湾半导体股份有限公司、福昌半导体股份有限公司
国外	IR、ST、Fairchild、On Semi 等

## （三）公司的竞争优势

### 1、技术与研发优势

公司非常注重产品研发和技术进步，并拥有一支高度专业化的技术团队，该技术团队具有较强的消化吸收国外先进技术和自主研发、创新的能力。在该技术团队的不懈努力下，公司已熟练掌握了硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片制造技术，特别是在重掺硅片领域有独特优势。目前，公司的硅材料产品以技术含量和附加值较高的重掺硅抛光片、重掺衬底硅外延片产品为主，并在相关技术领域获得了三项国家发明专利，在国内同行业中居领先地位；同时在集成电路用硅片的生产

制造上，公司在国内同行中也具有显著优势。公司的重掺硅片制造技术与国际同步发展，已具备与国际同行业知名跨国公司竞争的實力。

公司与浙江大学硅材料国家重点实验室（该领域中的唯一国家重点实验室）建立了长期、稳定的战略合作关系，并于 2006 年 6 月成立了浙江大学—立立电子硅材料联合研发中心。浙江大学硅材料国家重点实验室是在国内外享有较高声誉的硅材料研究机构。联合研发中心的任务是为公司产品质量的提高、新产品开发和人才队伍的建设提供智力支持和技术保障。通过与浙江大学硅材料国家重点实验室积极、有效的技术合作，公司确立了在国内同行业中的技术领先地位。

## 2、高端定位优势

公司自设立以来，始终坚持高品质标准，将满足半导体行业高端客户的要求作为公司努力的目标。为此，公司成立伊始就建立了严格的质量保证体系，先后通过了瑞士 SGS 公司的 QS9000、ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002 等质量体系认证和 ISO14001:2004 环境体系认证。目前，公司能够分别按国际 SEMI 标准、中国国家标准、销售目的地国家标准或顾客特殊要求控制产品质量。在严格和高标准的品质保证之下，公司已经成为国际知名跨国公司的稳定供应商，并通过了这些大公司对产品质量体系、产品工艺和产品质量的严格审核和认证。同时，这些客户的严苛要求和新的需求也进一步推动公司管理水平、质量控制水平的不断提高。

经过多年的努力，公司已开发出一批包括 ST、On Semi、CR Semi、GlobiTech Incorporated、Microsemi 等国际知名跨国公司，以及士兰微、上海先进、上海贝岭、华润晶芯等国内知名公司在内的稳定的高端客户群。半导体硅片行业的客户开发周期较长，这主要是由于集成电路、分立器件厂商对硅片的品质要求较高，一般需要长达半年以上的硅片质量考察，才能确定是否选定为基础材料供应商，因此，成为其硅片供应商的门槛较高。公司与众多高端客户业已建立起来的良好互信合作关系，是公司未来持续经营的有力保障。同时由于此类高端客户大都实力雄厚，具有较强的抵御市场风险的能力，生产波动性相对较小，因此其对本公司的产品订单较为稳定。

## 3、规模优势

公司是我国国内半导体硅材料行业的龙头企业之一。根据万胜博讯统计，

2006年我国硅抛光片、硅外延片的产量分别为25,540万平方英寸和6,229万平方英寸，同期公司硅抛光片、硅外延片的产量分别为5,561万平方英寸和1,001万平方英寸。本次发行募集资金拟投资项目6-8英寸硅抛光片项目和8-12英寸硅外延片项目投产后，将进一步确立公司产销规模和产品档次在国内同行业中的优势地位。

#### 4、半导体产业链上下游整合优势

公司作为目前国内唯一一家跨半导体硅材料和分立器件两个半导体子行业的半导体制造企业，涵盖了包括硅单晶拉制、硅抛光片、硅外延片以及分立器件芯片等半导体行业上下游多个生产环节，形成了一条相对完整的半导体产业链，便于发挥产业链上下游整合的优势，具体表现在以下三方面：

(1) 有利于保证公司产品的优良品质。从硅材料生产与器件生产相结合的角度看，公司掌握半导体两个子行业之间的业务衔接和技术衔接，一方面有利于从硅材料行业的上游直接控制和保证下游的产品质量，即从单晶拉制的源头就可以控制、调整相关工艺和技术参数，以生产符合市场需要的硅抛光片、硅外延片以及分立器件芯片；另一方面也有利于根据下游产品的技术要求和工艺要求及时上溯调整、优化上游环节的生产工艺和技术参数，从而实现产业链上下游之间的双向、互动调节，保证了上下游产品的优良品质。

(2) 缩短了新产品开发和市场推广的周期。公司上游产品直接供给下游生产使用，特别是新开发的产品可以在最短的时间内得到使用、验证，从而大大缩短上游新产品的开发、市场推广的时间；公司下游新产品的研制开发可对材料环节直接提出新的要求、进行技术改进，也可以大大缩短下游新产品的开发时间。这种优势在技术更新迅速的半导体产业中具有突出价值。

(3) 有利于提高公司抗风险能力。通过产业链的合理延伸，可以实现公司主导产品所需主要原材料的供给内部化，降低生产成本，提高公司的盈利能力和抗风险能力；另外，公司通过产业链的合理延伸，可以在拓展企业生存空间、提高盈利水平的同时，有效平抑上下游生产环节之间的供求波动或结构失衡。

## 五、公司主营业务情况

### （一）主要产品及其用途

公司以及下属控股子公司主要从事 4 英寸、5 英寸、6 英寸硅抛光片和硅外延片以及 6 英寸功率肖特基二极管芯片的生产、销售。公司主要产品及其用途如下：

1、4 英寸、5 英寸及 6 英寸轻掺硼、轻掺磷硅抛光片。其中，4 英寸、5 英寸硅抛光片适用于金属-氧化物-半导体集成电路（MOS-IC）和双极型集成电路（Bipolar IC）；6 英寸硅抛光片可以满足线宽大于 0.5 微米以上的金属氧化物半导体集成电路、双极型集成电路、电荷耦合器件（CCD）等器件的要求。

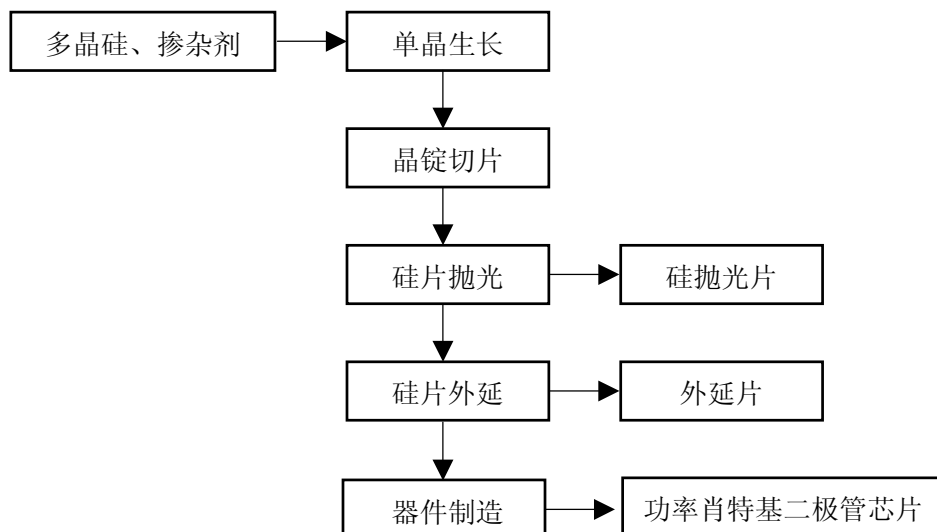
2、4 英寸、5 英寸及 6 英寸重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼硅抛光片。该类产品用作硅外延片的衬底和制造齐纳（Zener）二极管。

3、以 4 英寸、5 英寸及 6 英寸重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼硅抛光片作为衬底加工成的硅外延片。该产品适用于分立器件以及高耐压集成电路，可以满足生产功率场效应器件、绝缘栅双极晶体管、肖特基二极管、微处理器、电荷耦合器件和快闪存储器等的要求。

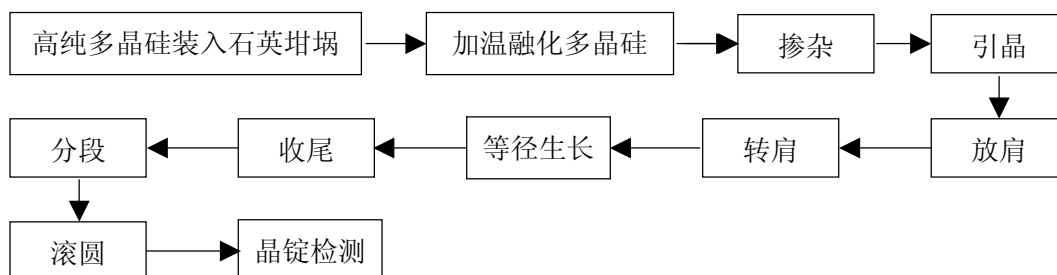
4、6 英寸功率肖特基二极管芯片。该产品主要用于各类整流电路中，主导产品涵盖范围为正向电流 1-100A，反向电压可达 250V，皆达到国内领先水平，在国际上也处于先进行列。用功率肖特基二极管芯片制成的整流器，具有低功耗、高速度的特点，广泛应用于各种高频电源和工控电路中。

## (二) 主要产品的工艺流程图

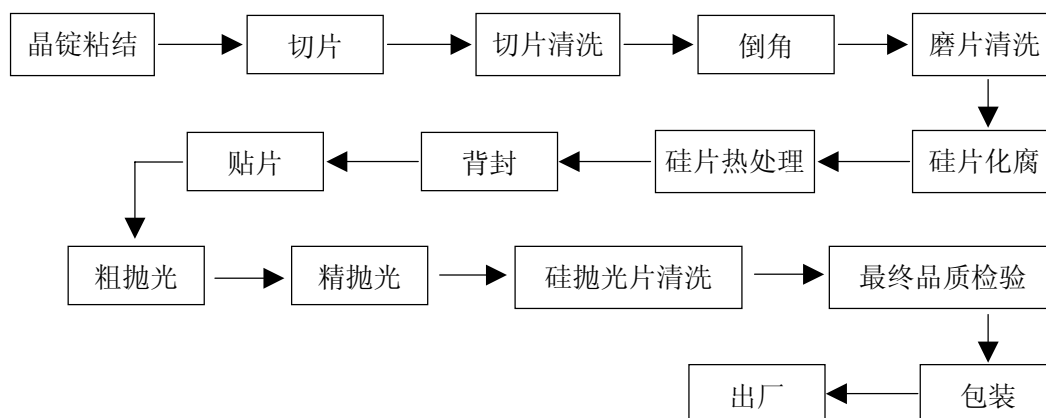
### 1、主要产品总体工艺流程图



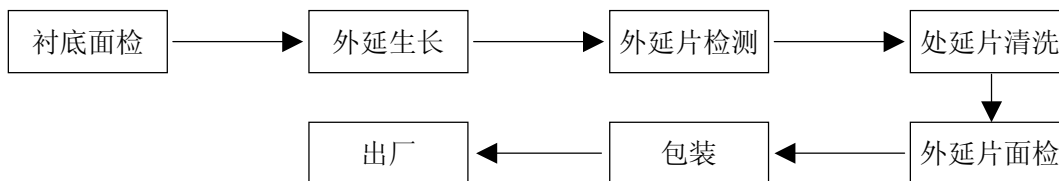
其中硅单晶锭生产工艺流程图如下：



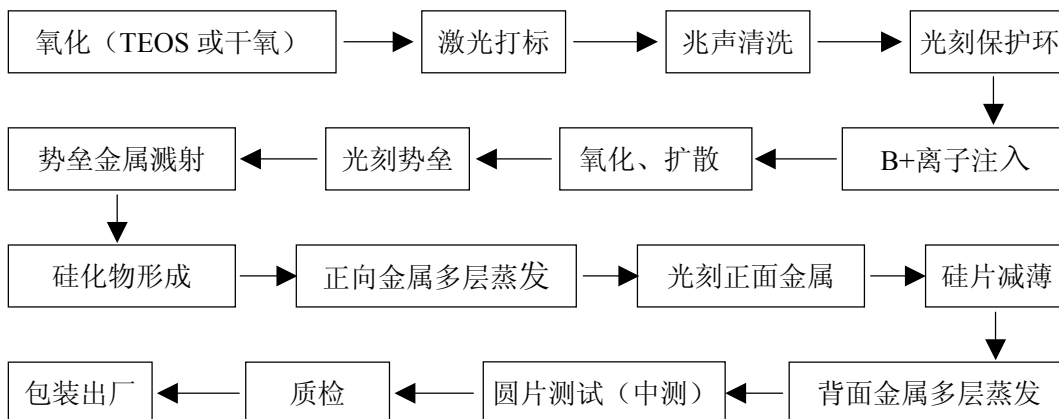
### 2、硅抛光片工艺流程图



### 3、硅外延片工艺流程图



### 4、功率肖特基二极管芯片工艺流程图



## （三）主要业务模式

### 1、采购模式

公司设置贸易部负责原辅材料采购。对于主要原辅材料，公司与供应商于每年年初进行协商，议定当年的交易价格、交易数量，其后如无特殊情况发生，公司将根据具体生产安排，向供应商发出订单，采购所需原辅材料。对于关键原材料供应商，公司会与其达成长期采购协议，以保证原材料采购数量和价格的相对稳定。

公司制定有专门的采购控制程序，以保证所需原辅材料、外协件、零备件和整机设备符合公司规定的质量标准和采购计划的要求，同时在满足生产需要的情况下，减少物料库存，降低采购成本，使采购活动有计划地在受控状态下进行。公司采购活动均严格按采购控制程序进行。

生产总监负责提出采购总量计划、公司贸易部据此编制具体采购计划，财务总监审核后报总经理批准。公司贸易部还具体负责采购的洽谈、签约、文件编制



和控制，并对采购的适时、适价、适量、质量负责，保持与供方的沟通，妥善处理质量争端；

## 2、生产模式

本公司及其下属各子公司的生产模式为“以销定产”，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需各规格产品的生产。公司设置生产计划部统一负责公司的日常生产管理，协调组织各部门的生产活动。

## 3、销售模式

公司主要产品国内销售采取直接面向客户销售的方式，海外销售采取直接面向客户销售和代理销售相结合的方式。公司下设海外事业部、销售部，其中海外事业部主要负责开拓国外市场，销售部主要负责开拓国内市场。公司与主要客户通常于每年初就当年销售价格、销售数量和销售品种达成初步协议，其后根据客户的具体订单发售产品。公司对主要客户采取赊销的方式。报告期内，公司主要根据产品的质量、性能、市场的变化情况并结合客户的资信状况和重要性等制定并调整信用政策，在产品供求比较平稳的时候，一般给予客户不超过四个月的赊销期，对大客户可适当延长 1 个月左右；公司在产品供不应求比较明显的时候，赊销期相应缩短，一般为 1-2 个月。

## （四）主营业务情况

### 1、主营产品种类及其结构

报告期内，公司主营业务发展迅速。近三年公司主要产品种类收入及其结构情况如下表：

单位：万元

项目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅抛光片	24,595.40	54.08%	19,480.59	53.66%	14,364.57	55.58%
硅外延片	11,009.56	24.21%	7,156.92	19.71%	5,300.12	20.51%
功率肖特基二极管芯片	9,830.15	21.62%	9,550.90	26.31%	6,181.40	23.91%
其他	43.19	0.09%	118.00	0.33%	-	-

项目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	45,478.30	100.00%	36,306.41	100.00%	25,846.09	100.00%

## 2、主要产品的生产销售情况

公司近三年主要产品的产能、产量和产销量情况如下：

单位：万片

6 英寸硅抛光片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	180	130.00	110.00
产量	117	105.00	86.90
销量	116.57	106.84	84.51
产销率	99.63%	101.75%	97.26%
5 英寸硅抛光片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	105	80.00	70.00
产量	73.2	70.13	58.84
销量	72.9	68.55	58.92
产销率	99.59%	97.74%	100.15%
4 英寸硅抛光片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	15	15.00	15.00
产量	12.85	12.70	12.01
销量	12.82	12.37	11.90
产销率	99.76%	97.43%	99.14%
6 英寸硅外延片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	51.6	39.60	20.00
产量	44.6	36.65	19.75
销量	44.85	35.63	18.69
产销率	100.56%	97.22%	94.59%
5 英寸硅外延片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	19.2	19.20	6.00
产量	13.83	16.67	5.74
销量	13.92	16.19	5.75
产销率	100.65%	97.08%	100.11%
4 英寸硅外延片：			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能	9.6	9.60	6.00
产量	9.58	9.88	4.17
销量	9.62	9.68	3.83
产销率	100.41%	98.00%	91.85%
功率肖特基二极管芯片			
项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度

产能	14.4	14.40	14.40
产量	10.81	10.10	6.70
销量	10.56	10.00	6.30
产销率	97.68%	99%	94.03%

### 3、主要产品价格变动情况

目前行业普遍采取的定价策略是毛利率定价法，即在核算生产成本的基础上加上一定的毛利率，形成最终的销售价格，并同时参考同行业的同类产品的价格。本公司对不同的产品采取不同的定价策略。对生产时间较长、质量稳定，并且已经在用户中建立良好口碑的产品品种确定较高的毛利率；对生产时间相对较短，产品性能尚未完全被客户熟知的产品品种确定较低的毛利率，以期开拓市场。

公司另一产品功率肖特基二极管芯片，市场价格透明度较高，行业内产品定价相对较为接近，价格差异主要由各厂商的质量水平、综合技术能力、生产能力等因素决定。公司在确定功率肖特基二极管芯片价格的时候，多参照市场同类产品价格，但在少数新研发的高端产品如 150V 以上的高压器件上，公司自主定价。

近三年公司主要产品平均销售价格变化情况如下：

单位：元/片

品种	2007 年度	2006 年度	2005 年度
硅抛光片（折合为五英寸硅片）	138.17	115.71	100.34
硅外延片（折合为五英寸硅片）	223.54	204.27	216.30
功率肖特基二极管芯片	958.58	958.67	973.88

### 4、主要客户情况

公司硅抛光片、硅外延片的客户为集成电路、分立器件生产厂商，公司在多年的发展过程中，建立了稳定的客户合作关系。目前公司的国内客户主要包括上海先进、上海新进、华润晶芯、士兰微、扬州晶新、上海贝岭、北京燕东微电子有限公司等国内知名的集成电路、分立器件生产厂商；国外客户主要包括ST、On Semi、CR Semi、GlobiTech Incorporated、Microsemi等国际知名半导体生产厂商。公司的功率肖特基二极管芯片的客户主要为功率器件封装企业，主要包括On Semi、济南晶恒、苏州固锝电子股份有限公司、银河半导体控股有限公司、绍兴旭昌科技企业有限公司等。

本公司近三年向前5名客户销售情况如下：

单位：万元

**2005 年度**

序号	客户名称	销售金额
1	ON SEMI	3,234.44
2	Evershine(STM)	3,052.15
3	上海新进半导体制造有限公司	2,576.82
4	SCG INDUSTRIES MALASIA SDN BH	2,260.75
5	杭州士兰集成电路有限公司	1,912.15
	前五名客户合计	13,036.31
	前五名客户销售金额占主营业务收入的比例	50.37%

**2006 年度**

序号	客户名称	销售金额
1	Evershine(STM)	5,869.83
2	ON SEMI	4,337.65
3	杭州士兰集成电路有限公司	3,021.98
4	济南晶恒有限责任公司	2,567.13
5	SCG INDUSTRIES MALASIA SDN BH	2,189.46
	前五名客户合计	17,986.05
	前五名客户销售金额占主营业务收入的比例	49.36%

**2007 年度**

序号	客户名称	销售金额
1	Evershine(STM)	10,512.71
2	杭州士兰集成电路有限公司	4,655.73
3	ON SEMI	3,256.58
4	扬州晶新微电子有限公司	2,696.75
5	济南晶恒有限责任公司	2,571.11
	前五名客户合计	23,692.88
	前五名客户销售金额占主营业务收入的比例	51.84%

近三年，本公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系，也未在其中占有权益。

**5、 国内外销售情况**

本公司近三年外销和内销比例基本保持稳定，具体情况如下：

单位：万元

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
内销	26,554.99	18,708.61	13,538.60
外销	18,923.31	17,597.80	12,307.49
合计	45,478.30	36,306.41	25,846.09

## （五）主要供应情况

### 1、原材料成本情况

近三年公司产品原材料成本情况如下：

单位：万元

	项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
硅抛光片	原材料成本	7,297.23	5,947.00	4,712.11
	占成本的比重	57.38%	51.86%	53.43%
硅外延片	原材料成本	4,017.56	2,667.06	1,730.80
	占成本的比重	59.89%	58.56%	51.18%
功率肖特基二 极管芯片	原材料成本	3,610.92	3,459.06	3,106.05
	占成本的比重	55.23%	50.73%	56.39%

硅抛光片、硅外延片主要原材料包括：多晶硅、石英坩埚、石墨件、抛光材料、研磨料、包装盒、特气、化学试剂等。功率肖特基二极管芯片的主要原材料除了内部采购的硅外延片以外，主要是一些化学品和金属材料。近三年公司主要原材料成本占原材料总成本的比例情况如下：

单位：万元

材料名称	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
多晶硅	4307.56	28.86%	3,008.25	24.92%	2,319.91	24.29%
石英坩埚	1216.45	8.15%	978.32	8.10%	808.02	8.46%
贵金属等生产材料	2249.30	15.07%	1,712.02	14.18%	1,392.91	14.59%
石墨件	616.43	4.13%	513.64	4.25%	323.23	3.38%
包装盒	671.65	4.5%	721.55	5.98%	598.94	6.27%
抛光材料	1052.26	7.05%	807.14	6.69%	560.95	5.87%

材料名称	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
研磨材料	628.37	4.21%	476.93	3.95%	332.73	3.48%
特气	947.78	6.35%	745.97	6.18%	589.42	6.17%
化学试剂	1917.96	12.85%	1,834.32	15.19%	1,425.94	14.93%

## 2、原材料供应情况

由于国内的半导体硅材料配套产业仍欠发达，公司生产所需的原材料除化学试剂、特殊气体和石墨件外主要依赖进口。由于多晶硅、涂层坩埚被国际上少数半导体硅材料生产企业垄断，公司供应商较为集中，因此对其存在一定程度的依赖。

(1) 近三年公司主要原辅材料供应渠道如下：

材料名称	归属主要产品	2007 年度	2006 年度	2005 年度
		主要供货商	主要供货商	主要供货商
多晶硅	硅单晶	Wacker、Tokuyama	Wacker、Tokuyama	Wacker、Tokuyama
石英坩埚	硅单晶	GE Quartz inc.、贺利氏信越	GE Quartz inc.、贺利氏信越	GE Quartz inc.、贺利氏信越
包装盒	硅抛光片	Entegris Inc、E-pack	Entegris Inc、E-pack	Entegris Inc、E-pack
研磨料	硅抛光片	Fujimi Incorporated	Fujimi Incorporated	Fujimi Incorporated
抛光材料	硅抛光片	Rohm and Haas	Rohm and Haas	Rohm and Haas
化学品	功率肖特基二极管芯片	天津众邦、Fujifilm	天津众邦、Fujifilm	天津众邦、Arch Chemical
金属材料	功率肖特基二极管芯片	ACA Technology Inc.、Praxair	ACA Technology Inc.、Praxair	ACA Technology Inc.、Praxair

目前，全球多晶硅市场供应紧张，价格持续上涨。根据SEMI的研究报告，全球2006年多晶硅的产量总产量约3.3万吨。其中半导体级为1.9万吨，太阳能级为1.3万吨。而太阳能级的需求量为1.5万吨，严重供不应求，这不可避免地导致太阳能产业挤占半导体用多晶硅，影响了半导体级多晶硅的供应，并拉升了多晶硅的市场价格。1997-2012年全球多晶硅供需现状和趋势如下图所示：

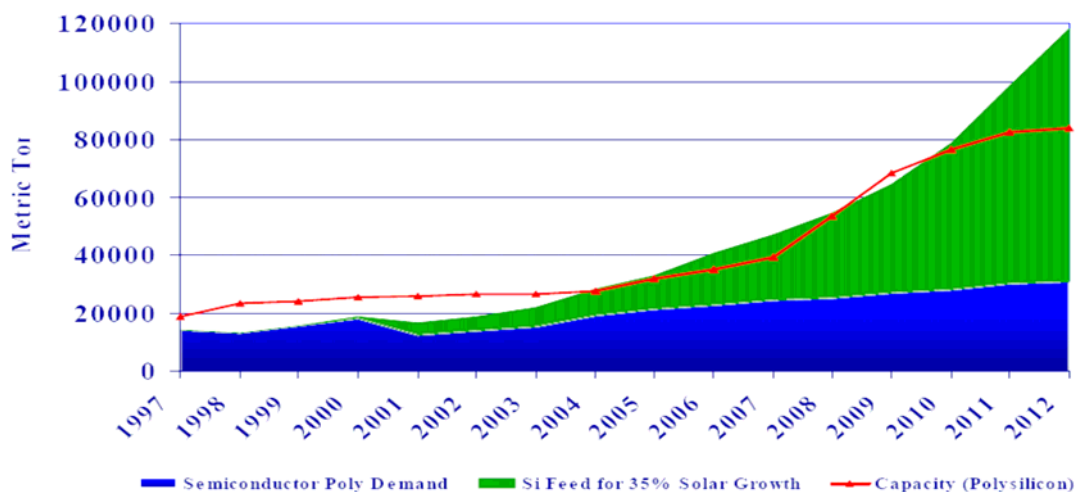


图 3.4 世界多晶硅供需趋势预测 资料来源：SEMI 2007

在多晶硅全球供不应求、价格持续上涨的市场背景下，公司采取了以下几个主要应对措施：

①与国外大型多晶硅供应商建立长期、稳定的合作关系

公司自成立以来一直专注于半导体硅材料的研发、生产与销售，近年来更是实现了快速、健康发展，已经成为国内最主要的半导体硅材料生产企业之一，在全球硅片市场上也具有一定的知名度。依靠自身的专业素质、市场地位和良好信誉，公司与国际上最大的多晶硅生产企业之一——德国Wacker在长期合作中建立了稳定、互信的合作关系，并与德国Wacker签订了长期供货协议，确定了稳定的多晶硅供应关系，有效保证了公司生产对多晶硅的基本需要，锁定了多晶硅采购价格。由于上述协议规定的采购价格远低于目前多晶硅的市场价格，因此在一定程度上降低了多晶硅价格上涨对公司的不利影响。

除通过签订上述长期供货协议将公司对多晶硅的基本需求量和价格预先锁定之外，对其余的多晶硅需求，公司采取签订中短期合同的方式予以解决。由于主要供货商也是德国Wacker等与公司有长期友好合作关系的企业，因此公司与其签订的中短期合同的采购价格仍明显低于市场价格。

②进一步拓展长期、稳定的供货渠道

目前，公司已与另外两家主要的多晶硅生产企业建立了多晶硅供应关系，并以低于市场价格的合同价格开始了实质性采购。同时，公司还正与它们协商建立长期、稳定的多晶硅供应关系，并已获重要进展。由于公司在硅材料领域的具有一定的市场地位，因此与新的长期供货商协商确定的多晶硅采购价格仍将明显低

于同期市场价格。

③通过适当调整产品售价转移多晶硅价格上涨造成的成本上升

由于公司产品质量优良、稳定，市场需求旺盛，公司具有较强的议价能力，特别是对部分产品具有相当的定价主导权。因此，公司具有一定的能力将多晶硅价格上涨带来的成本上升通过适当提高产品售价的方式转移给下游客户。

④通过提高技术、改进管理降低多晶硅耗材率

公司将继续提高装备和工艺水平，加强生产管理、技术研发、员工培训，进一步降低废品率与耗材率，最大程度地节省多晶硅材料。如公司新上线使用的线切割机大大提高了单晶硅锭的出片率，节省了多晶硅原材料。

⑤密切关注国内多晶硅生产的技术水平和供货能力

我国四川等地正投资新建多晶硅生产线，如四川新光硅业科技有限责任公司已建成投产，这种局面将有效缓解国内多晶硅供应紧张的情况。公司将密切关注上述多晶硅生产线的建设情况，并在其质量达到公司及客户要求时进行采购，以扩大多晶硅采购渠道，降低采购成本。

(2) 近三年公司主要原辅材料采购价格变动情况如下：

材料名称	2007 年度	2006 年度	2005 年度
多晶硅 (元/kg)	647.39	405.00	230.87
石英坩埚 18" (元/只)	4,002.81	4,308.12	4,303.42
石英坩埚 14" (元/只)	1,891.39	1,485.39	1,481.49
石英坩埚 12" (元/只)	849.25	898.51	893.94
包装盒 (元/只)	75.32	76.01	74.08
研磨料 (元/kg)	52.26	50.24	49.27
抛光材料 (精抛垫)	1,989.14	1,923.78	1,915.45
15%镍铂靶材 (元/块)	222,475.13	194,328.00	179,849.00
60%镍铂靶材 (元/块)	697,774.49	761,898.00	-
黄金靶材 (元/块)	960,294.13	659,342.00	633,502.00

由于多晶硅全球市场供不应求，2005 年以来多晶硅市场价格出现较大幅度上涨。公司与长期供应商合作关系稳定而良好，并签有长期采购协议，因此 2005 年采购价格并未受太大影响。2006 年 5 月公司与有关长期供应商重新签定了供



货合同，采购价格有所上涨。

(3) 近三年公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
向前五名供应商采购金额	8,134.27	6,735.86	5,217.05
占采购总额的比例(%)	49.26	50.83	49.49

公司主要原辅材料多晶硅、坩埚、包装盒的供应商均为境外供应商。近三年公司向关键供应商的采购金额及占当期采购总额比例的情况如下：

单位：万元

项目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
Wacker	4,978.15	30.15%	2,631.84	19.86%	2,431.04	23.06%
GE Quartz	795.12	4.82%	764.87	5.77%	542.93	5.15%
ACA Technology	957.80	5.8%	1,562.03	11.79%	590.09	5.60%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中不占有权益。

### 3、水电供应情况

本公司生产所需的水、电，主要由当地市政公共管网供应，能够满足生产所需。近三年公司能源消费情况如下：

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
耗电（万度）	4,589.04	4,553.24	4,141.23
耗水（万吨）	87.22	99.12	97.64
电费（万元）	2,591.47	2,518.11	2,278.23
水费（万元）	302.84	267.42	219.14
占主营业务成本比例	11.14%	12.11%	14.08%

## (六) 公司环保情况

本公司现有业务符合环保要求。公司严格按照国家及地方的有关环保标准和

规定执行。浙江省环境保护局对公司本次申请公开发行及上市进行了环保核查，并于 2007 年 9 月 7 日出具了《关于宁波立立电子股份有限公司环保核查情况的函》（浙环函[2007]270 号），指出本公司及本公司的控股子公司“能遵守国家环保法律法规，近三年来没有发生污染事故和纠纷，也没有违反环境法律法规而受到处罚”；“募集资金项目符合国家产业政策和环保投资导向”。

## 六、公司的固定资产与无形资产

### （一）主要固定资产情况

#### 1、主要经营性房产

截至 2007 年 12 月 31 日，公司拥有十宗房屋产权，共计 40,566.96 平方米，账面原值 9,600.95 万元，公司现有房产均为自建、自用，且使用状况良好。公司各房产情况如下：

房屋建筑物	分布情况	原值 (万元)	净值 (万元)	建筑面积 (平方米)	财务 成新率
甬房权证保字第 20040022 号	本公司	1,100.44	935.01	2,955.12	84.97%
甬房权证保字第 20050098 号	本公司	130.51	118.64	612.00	90.90%
甬房权证保字第 20050099 号	本公司	2,557.91	2,325.03	18,070.78	90.90%
甬房权证保字第 20040115 号	立立半导体	162.77	139.89	551.14	85.95%
甬房权证保字第 20040116 号	立立半导体	2,577.00	2,107.81	5,298.73	81.79%
杭房权证经字第 0006056 号	立昂电子	2,416.05	2,202.49	10,348.03	91.16%
杭房权证经字第 0006057 号	立昂电子	215.05	196.15	1,048.54	91.21%
杭房权证经字第 0006058 号	立昂电子	191.92	174.11	1,197.47	90.72%
杭房权证经字第 0006059 号	立昂电子	158.21	144.28	35.10	91.20%
杭房权证经字第 0006060 号	立昂电子	91.09	84.96	450.05	93.27%

#### 2、主要生产设备

本公司所使用设备为公司购置而来，目前均处于正常使用状态。截至 2007 年 12 月 31 日，公司主要生产设备的名称、使用情况、分布情况如下：

生产设备类别	数量 (台)	原值 (万元)	净值 (万元)	财务成新率	剩余安全运行时间(年)
<b>单晶生长所需关键设备:</b>					
单晶炉 KX150	1	358.00	312.65	87.33%	15
单晶炉 CG6000	4	769.51	684.22	89%	15
单晶炉 CG6000	14	3,293.99	992.34	30%	12
单晶炉 CG3000	1	87.65	4.38	5%	8
单晶炉 CG2000	5	112.94	5.65	5%	8
<b>硅抛光片生产所需关键设备:</b>					
切片机 S-LM-227D	19	257.23	31.85	12%	10
倒角机 WGM-200C-S	10	718.70	253.10	35%	10
抛光机 MT-611-26S	17	891.23	110.35	12%	12
抛光机 3806	4	173.16	8.66	5%	12
超声波清洗机	7	101.33	27.99	28%	12
磨片机	4	521.93	193.13	37%	12
线切割机	2	1,078.78	708.31	66%	15
硅片测试仪 wafercheck 7200	1	384.19	323.36	84%	15
硅片测试仪 Wis-cr82	1	291.06	244.97	84%	15
频率发生器	3	106.68	99.92	94%	15
硅表面分析仪	1	143	133.94	94%	15
<b>硅外延片生产所需关键设备:</b>					
桶式外延炉	6	6,788.59	1207.68	18%	10
单片外延炉	1	1,820.83	1042.43	57%	13
外延炉 PE3061D	1	979.14	793.10	81%	15
汞探针硅片电阻率测试仪	1	119.36	113.69	95%	15
硅片扩展电阻率测试仪	1	250.81	238.90	95%	15
红外测厚仪	1	131.43	127.27	97%	15
<b>肖特基功率芯片生产所需设备:</b>					
显影仪	1	112.26	27.22	24.25%	8
匀胶机	1	112.29	27.23	24.25%	8
减薄机	1	123.04	30.95	25.15%	8
探针台	6	137.80	33.35	24.20%	8
纯水系统	2	282.40	189.22	67.00%	8
溅射台	4	752.10	219.83	29.23%	8
蒸发台	3	537.50	134.13	24.95%	8
离子注入机	1	570.00	142.17	24.94%	8
扩散炉	2	659.11	159.57	24.21%	8
光刻机	3	999.70	421.6	42.17%	8

## （二）无形资产情况

### 1、土地使用权

截至 2007 年 12 月 31 日,公司拥有土地使用权六宗,均为自有,具体情况如下:



单位: 万元

土地使用权	面积 (平方米)	取得 时间	取得方 式	原值	净值	尚可使用期 限	对应房产证号
甬保土国用(2000) 字第 0084 号	10,418	2000/8	合法 转让	152.36	129.38	36 年 5 个月	甬房权证保字 第 20040022 号
甬保土国用(2002) 字第 0132 号	22,415	2002/11	合法 转让	173.49	158.07	36 年 5 个月	甬房权证保字 第 20050099 号
甬保土国用(2002) 字第 0159 号	5,060	2002/12	合法 转让	39.14	35.33	36 年 5 个月	甬房权证保字 第 20050098 号
仑保土国用(2004) 字第 0064 号	3,604	2004/8	合法 转让	54.08	45.81	36 年 5 个月	甬房权证保字 第 20040115 号
仑保土国用(2004) 字第 0065 号	10,569.12	2004/8	合法 转让	481.97	382.75	36 年 5 个月	甬房权证保字 第 20040116 号
杭经出国用(2003) 字第 0058 号	65,039	2003/9	国有 土地 出让	609.30	557.82	44 年 7 个月	杭房权证经字 第 0006056 号

### 2、商标权



公司正在使用的注册商标为：“QLEC”牌及“立立创新”牌，主要情况如下：

注册商标	商标注册号	核定使用商品	有效期
 <b>QLEC</b>	3502682	第 1 类	2005/5/14-2015/5/13
	3502681	第 7 类	2004/8/14-2014/8/13
	3502676	第 9 类	2004/9/7-2014/9/6
	3502680	第 11 类	2004/11/7-2014/11/6
	3502679	第 36 类	2005/4/28-2015/4/27
	3502688	第 42 类	2005/5/14-2015/5/13
	3502687	第 38 类	2004/12/28-2014/12/27
 <b>立立创新</b>	3502683	第 1 类	2005/5/14-2015/5/13
	3502684	第 7 类	2004/10/21-2014/10/20
	3502675	第 9 类	2004/9/7-2014.9/6
	3502685	第 11 类	2004/11/7-2014/11/6
	3502686	第 36 类	2005/4/28-2015/4/27

	3502677	第 42 类	2005/5/14-2015/5/13
	3502678	第 38 类	2004/12/28-2014/12/27

公司不存在使用他人商标的情况，也不存在许可他人使用本公司商标的情形。

### 3、专利权

公司现拥有专利 3 项，具体情况如下：

申请专利名称	类型	专利号	专利权人	有效期	用途及价值
用于八英寸重掺砷硅单晶制造的熔体上部保温装置	发明专利	ZL200310117760.2	本公司	自申请日（2003 年 12 月 30 日）起 20 年	适用于 8 英寸重掺砷直拉硅单晶锭的生产
用于重掺直拉硅单晶制造的掺杂方法及其掺杂漏斗	发明专利	ZL 200310117761.7	本公司	自申请日（2003 年 12 月 30 日）起 20 年	适用于 4、5、6、8 英寸重掺直拉硅单晶锭的掺杂工艺，用此掺杂方法生产的单晶，具有电阻率低，电阻率均匀性好等优点
用于六英寸及八英寸重掺磷直拉硅单晶制造的熔体上部保温装置	发明专利	ZL 200310117762.1	本公司	自申请日（2003 年 12 月 30 日）起 20 年	适用于 6 英寸和 8 英寸重掺磷直拉硅单晶锭的生产，用此热场拉制的重掺磷单晶，具有电阻率低，电阻率均匀性好等优点

### 4、其他无形资产

截至 2007 年 12 月 31 日，公司还拥有其他无形资产，具体情况如下：

项 目	取得方式	数量	取得时间	原值 (万元)	净值 (万元)	尚可使用期限 (月)
工程控制软件	购入	1 套	2004 年 11 月	13.50	7.62	82

## 七、公司的技术水平及其研发情况

### （一）核心技术情况

本公司是国内半导体硅材料行业内的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司自主掌握了4、5、6英寸集成电路和分立器件用硅抛光片制造技术，4、5、6英寸集成电路和分立器件用硅外延片制造技术，以及6英寸功率肖特基二极管芯片制造技术。公司还具备自主生产轻掺和重掺8英寸砷、磷、锑、硼硅单晶锭，12英寸硅单晶锭，以及8英寸硅抛光片和硅外延片等产品的能力。公司使用与掌握的技术处于国内同行业领先水平，部分达到国际先进水平。

目前公司拥有三项发明专利：用于重掺直拉硅单晶制造的掺杂方法及其掺杂漏斗、用于六英寸及八英寸重掺磷直拉硅单晶制造的熔体上部保温装置、用于八英寸重掺砷硅单晶制造的熔体上部保温装置。

公司下属子公司立昂电子自主开发的6英寸150-200V高反压大电流功率肖特基二极管芯片技术获得浙江省2006年度新产品称号，该系列产品处于国内领先水平，已产生明显的经济效益。

本公司及其子公司现有产品的生产处于大批量生产阶段，技术处于成熟阶段。

### （二）知识产权与非专利技术情况

公司目前拥有3项发明专利及多项非专利技术。

#### 1、公司已获得的发明专利

参见本招股意向书“第六节业务与技术”之“六、公司的固定资产与无形资产”。

#### 2、公司掌握的主要生产工艺与技术

（1）4、5、6、8英寸重掺砷硅单晶锭制造技术；4、5、6、8英寸重掺硼硅单晶锭制造技术；4、5、6、8英寸重掺锑硅单晶锭制造技术；4、5、6、8英寸重掺磷硅单晶锭制造技术。

使用以上技术加工成的硅单晶锭制作出来的硅抛光片，可直接用于半导体分

立器件的制造或将硅抛光片用做外延衬底加工成硅外延片用于半导体分立器件和集成电路的加工制造。

(2) 4、5、6、8 英寸集成电路用硅单晶锭制造技术。使用以上技术加工成的硅单晶锭制作出来的硅片的平坦度、表面金属沾污控制、硅片体内杂质控制、表面颗粒等指标可满足各种集成电路对硅抛光片的要求。

(3) 4、5、6、8 英寸掺氮硅单晶锭制造技术。通过在硅单晶中掺氮来控制空洞型缺陷和提高硅片的本征吸杂能力，这项技术能显著降低器件的漏电流，满足高端用户的需要。

(4) 集成电路和分立器件用硅片的线切割技术。该技术的使用大大降低了硅片的翘曲度值（WARP），并提高了硅单晶锭的出片率。

(5) 多晶硅背封（LPCVD）技术。该技术满足了高端用户提高硅片的吸杂能力的要求。

(6) 二氧化硅背封片边缘剥离技术。为减少外延的自掺杂效应需要在重掺衬底的背面生长二氧化硅密封层，用带二氧化硅背封层的重掺衬底长厚外延时，为正光刻质量高端用户需要将边沿 2mm 左右的二氧化硅层剥离掉。

(7) 有蜡抛光技术。该技术用于 5、6、8 英寸高平整度要求的硅抛光片的制造。

(8) 无蜡抛光技术。该技术用于 4、5、6 英寸一般平整度要求的硅片的制造，生产流程相对有蜡抛光简单。

(9) 4、5、6、8 英寸外延片制造技术。该技术用于分立器件和集成电路用重掺、轻掺衬底硅外延片的制造。

(10) 4、5、6、8 英寸埋层外延技术。该技术用于集成电路制造，是许多集成电路产品制造必需的工序。

(11) 硅外延片、硅抛光片缺陷控制处理技术。通过各种工艺手段控制硅片体内的各种缺陷，使制造出的硅外延片和硅抛光片的缺陷浓度能够满足不同客户的要求，确保用户的产品良率。

(12) 多层外延技术。该技术用于结构较复杂的半导体器件所需的硅外延片

的制造。

(13) 有关功率肖特基二极管芯片的生产工艺和技术。其主要生产工艺和技术主要有：离子注入、贵金属合金势垒制备、氧化硅薄膜的低温沉积、光刻和腐蚀、硅片表面清洗处理、多层金属薄膜制备和硅片减薄等。

### (三) 公司主要产品的技术水平及其所处阶段

#### 1、4、5、6 英寸重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼、轻掺硼、轻掺磷硅抛光片

公司设计生产的重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼硅单晶锭采用特殊的掺杂技术、特殊的热场设计，具有电阻率均匀性好、极限电阻率低、氧含量均匀可控、碳含量低以及微缺陷少等优点。公司生产的轻掺硼、轻掺磷硅抛光片具有电阻率均匀可控、氧含量均匀可控、碳含量少以及微缺陷低等优点。

4 英寸、5 英寸硅抛光片采用无蜡抛光加工工艺，应用公司自主开发的自转技术可有效提高硅抛光片的技术指标；6 英寸硅抛光片采用目前国际上最先进的有蜡抛光工艺，可保证硅抛光片达到高平坦度技术指标。采用酸腐蚀工艺使硅抛光片的背面光洁度高、颗粒沾污低。公司开发的硅片线切割工艺，不仅有效改善了硅片翘曲度和弯曲度等技术指标，还显著提高了硅片产出率。

公司的各类 4 英寸、5 英寸及 6 英寸硅抛光片产品已处于大批量生产阶段。

#### 2、4、5、6 英寸重掺衬底硅外延片

公司设计生产的掺磷硅外延片，是在重掺砷、磷、锑硅抛光片表面生长一层掺磷单晶硅；掺硼硅外延片，是在重掺硼硅抛光片表面生长一层掺硼单晶硅。用外延工艺生长的单晶硅具有电阻率均匀可控、微缺陷少、体质量好等优点。

公司采用桶式 (Batch) 和单片式 (single) 气相外延生长技术生产外延片，解决了重掺砷、磷硅片自掺杂、P 型外延层电阻率测量和硅片自掺杂等技术问题。内、外吸杂技术的使用使硅外延片的整体性能大大提高，产品性能达到国内领先水平。

公司的各类 4、5、6 英寸硅外延片产品已处于大批量生产阶段。

#### 3、6 英寸功率肖特基二极管芯片



本公司的 6 英寸功率肖特基二极管芯片生产线从美国 On Semi 公司整线引进,并在 On Semi 的帮助下,建立了符合国际半导体通行生产标准的工艺技术体系和质量保证体系,生产出电流从 0.5A 到 300A、电压从 10V 到 200V 的多种肖特基功率芯片。近年来,在现有的技术平台上,立昂电子自行开发了一系列产品以满足客户需求,例如高反压大电流系列肖特基二极管芯片已通过浙江省级新产品鉴定,并已批量生产和销售。

#### (四) 已开发或正在开发的新产品的技术水平

##### 1、8 英寸重掺砷、磷、锑、硼硅单晶锭和轻掺磷、硼硅单晶锭

8 英寸硅抛光片是目前国际上使用的主流产品,适用于超大规模集成电路及分立器件。8 英寸硅单晶锭则是生产 8 英寸硅抛光片的基础。公司采用磁场拉晶工艺(MCZ)拉晶工艺控制 8 英寸各种类硅单晶锭。采用 MCZ 工艺控制的硅单晶锭具有电阻率均匀性好、单晶氧含量可控、碳含量低、微缺陷少等特点。

公司已具备大批量生产 8 英寸硅单晶锭的能力,为公司下一步生产 8 英寸硅抛光片打下了基础。

##### 2、12 英寸轻掺磷、硼含氮硅单晶锭

硅片直径越大其开发的难度越大,制造 12 英寸硅抛光片是目前国际半导体材料行业的发展趋势,适用于超大规模集成电路。公司采用磁场拉晶工艺(MCZ)拉晶工艺控制 12 英寸硅单晶锭。采用 MCZ 工艺控制的硅单晶锭具有电阻率均匀性好、单晶氧含量可控、碳含量低、微缺陷少等特点,掺氮技术的运用,使单晶体内的空洞型微缺陷的浓度得到了有效地控制。

公司已具备小批量生产 12 英寸硅单晶锭的能力,为公司下一步生产 12 英寸硅抛光片打下了基础。

##### 3、特征线宽大于 0.18 微米的 8 英寸集成电路制造用硅抛光片

该硅抛光片产品完全满足 0.18 微米和 0.35 微米 8 英寸集成电路和高端分立器件制程的使用要求,应用各种缺陷工程技术将硅片的微缺陷控制在最低水平。

##### 4、8 英寸硅外延片

利用单片式外延炉开发 8 英寸硅外延片生产技术,该技术解决了 8 英寸硅外

延片厚度均匀性、电阻率均匀性、滑移线、自掺杂等方面的难题。目前，公司已具备大批量生产 8 英寸硅外延片的能力。

#### 5、埋层硅外延片

埋层外延是双极型器件以及高压 MOS 器件的一个工序。公司开发的埋层硅外延片产品解决了埋层外延图型漂移（pattern shift）和图形畸变（pattern distortion）的难题,目前公司已具备小批量生产埋层硅外延片的能力。

#### 6、多层硅外延片

随着国内器件产业的发展，多层硅外延片的用户逐渐增多，多层硅外延片主要适用于 IGBT、MOSFET 等一些特殊器件。目前，公司已经具备小批量生产能力。

#### 7、0.13 微米 IC 用 8 英寸硅抛光片

公司计划与浙江大学硅材料国家重点实验室合作，在其已有的缺陷工程研究成果的基础上，开发硅片的氩气热处理技术，以消除或减少硅片表面的晶体原生颗粒(COP)，计划开发出无 COP 或 COP 密度达到 $\leq 3000$  个/片 ( $\geq 0.12$  微米) 标准的硅抛光片制造工艺。目前该产品正在研制过程中。

#### 8、抗静电放电（ESD）芯片

由于国内外的客户对功率肖特基二极管芯片的抗 ESD 能力的要求越来越高，为满足客户的需求，公司正在自主开发抗 ESD 芯片，部分产品已经通过多家客户的测试要求，目前已具备批量生产能力。

### （五）研发费用

为提高公司技术水平，改进工艺质量，公司不断加大研发投入。近三年公司研发费用情况如下：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
研发费用（万元）	2,819.28	1,327.36	521.35
主营业务收入（万元）	45,478.30	36,306.41	25,846.09
所占比例	6.20%	3.66%	2.02%

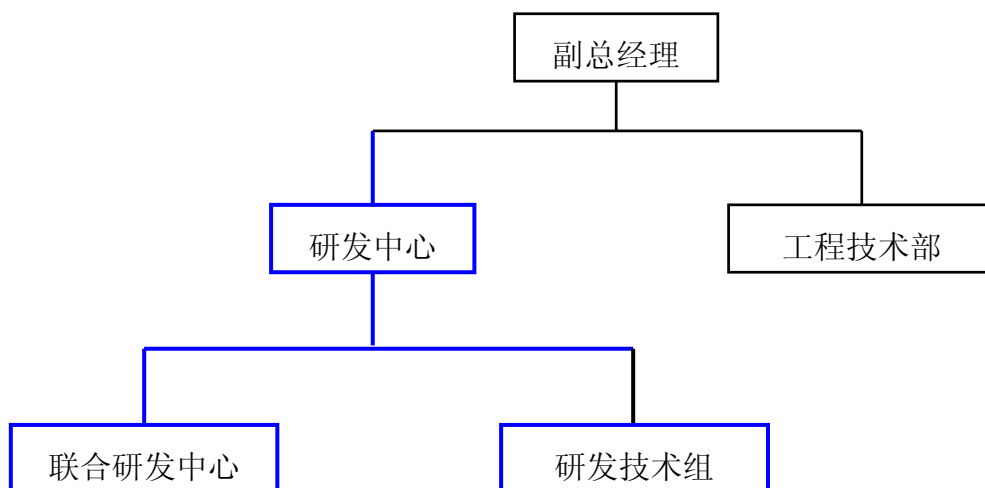
## （六）技术创新机制

公司作为国内半导体硅材料行业中的知名企业，十分重视产品开发和技术创新机制的建设，广泛吸纳同行业先进科技成果和高水平科技人才，加强产、学、研合作和技术交流，利用一切可利用资源提高公司的研究开发能力。同时，通过实行全方位资源整合机制、研发过程保证机制和多样化激励机制，为技术创新提供了制度保障。

### 1、研发体系构建

为保证公司研发工作的有序开展，促进技术创新，公司构建了总经理统一领导、分管技术的副总经理总负责、工程技术部与研发中心为实施主体的研发体系。其中，工程技术部负责各工序具体工艺的研究开发、设备调试、工艺指导、控制计划、失效分析的制定、工艺纪律检查、员工培训；研发中心负责新产品及相关工艺技术的开发，生产中重点和难点工艺技术问题的解决，新战略领域的研究及相关技术储备，以及专利的申报。

公司研发机构结构如下：



### 2、全方位的资源整合

公司利用研发中心这一平台，通过与行业协会、同行业企业、科研院所等的交流，加强国内外科技资源的全面整合，形成有形资源和无形资源的相互转化，建立全方位资源整合机制。

公司已通过与浙江大学硅材料国家重点实验室等科研院所的合作,进行自主基础上的联合研发。2006年6月,公司与浙江大学签订了《建立“浙江大学-立立电子硅材料联合研发中心”的协议》,建立联合研发中心。该中心研究人员由本公司工程师和浙江大学从事硅材料研究的人员组成,其主要职能是为企业提供材料的分析测试、技术培训、技术咨询等服务,承担公司的研究项目等。联合研发中心的研究经费由公司提供,在专项经费支持下取得的成果若要申请专利,则需双方共同署名,各拥有50%的所有权,但公司享有独家无偿使用权;在未经双方共同授权的情况下,任何一方均不得向第三方转让或授权使用。另外,公司还邀请相关行业专家对公司技术人员进行培训与指导,进行技术交流,借此提高公司自身技术人员的整体素质。

### 3、严格研发工作管理

为保证项目目标的实现,在立项及研发过程中,项目组成员和项目评估小组吸收有关市场和财务人员及专家参加,以便及时传递市场压力,实施有效的成本控制,并通过定期报告,定期评审验收,实行全过程控制。

### 4、多样化的激励机制

为激活现有科技资源、留住优秀人才、吸引优秀人才、淘汰不合格人员,实现人力资源优化配置,公司建立了多样化的研发激励机制。为使每一个研发人员均能各尽所能、各展所长,公司通过绩效考评,实行优胜劣汰;通过加大同职位的差距及相邻职级的重叠,使每位员工都能根据实际的工作量与绩效获得相应的报酬。公司还在固定薪酬的基础上推行目标激励机制,提取研究开发成果产业化后所取得的部分利润奖励给课题组及研发人员,对获得重大发明、省级以上科技成果奖或申请专利的人员将再给予特殊奖励。在将来条件许可的时候,公司还计划通过股权、期权等形式,进一步丰富激励手段。

此外,公司还为研究人员提供继续培训和深造的机会。公司采取内部专业业务培训、专家学者定期讲座、提供深造资助、提供出国学习机会等多种方式提高公司研发技术人员的专业素质。

## 八、公司境外经营情况

截至本招股意向书签署日,本公司除开展正常进出口业务外,未在中华人民

共和国境外设立分支机构以及开展其他经营活动。

## 九、公司产品质量控制情况

### （一）质量控制标准

立立电子于 2000 年 6 月开始运行质量保证体系，并先后通过了瑞士 SGS 公司的 QS9000、ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002 等质量体系认证和 ISO14001:2004 环境体系认证。公司控股子公司杭州立昂也已通过 ISO/TS16949:2002 质量体系认证。目前，除顾客有特殊要求，公司按国际 SEMI 标准、销售目的地国家标准以及我国国家标准控制产品质量。

### （二）质量控制措施

为符合公司“追求纯净完美、满足顾客期望”的质量方针，公司制定了一整套详尽、完备的质量体系文件，包括质量手册、质量体系程序文件、作业指导书及质量记录四部分。按照相关文件的要求，公司的生产制造部在生产过程中严格按照工艺标准，坚持“质量第一”的原则，对半成品、成品从生产、检验、包装、入库等进行跟踪管理，并及时做好在制产品和最终产品的检验，保证产品的各项技术指标符合用户的要求。

公司专设品质保证部，负责质量/环境体系的建立、运行，以及日常生产全过程的质量检验和监控。

### （三）质量纠纷处理

“百分之百认真及时处理用户意见，追求顾客的百分之百满意”是本公司的郑重承诺，公司为此专门制定了《顾客抱怨及退货处理程序》，目的是通过对顾客抱怨及退货的及时处理，了解和分析产品存在的问题，在增加顾客满意度的同时，为持续改进工艺技术和工艺管理提供支持。

根据《顾客抱怨及退货处理程序》，市场营销部和品质保证部负责顾客反馈信息的接收和投诉的登记；品质保证部同时负责组织处理及答复，并负责组织相关人员进行退货分析，并提出退货处理意见；贸易部负责办理退货的相关手续；生产计划部（仓库）负责查收和确认退货；其他相关部门在职责范围内给与积极

配合。通过这一质量纠纷处理程序既可以对公司存在的质量、技术问题实施切实有效的整改，又可以努力降低质量纠纷给公司造成的不良影响，使客户在获得满意服务的同时，增加对公司产品质量的信赖感，维护公司产品在市场上的良好口碑。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 公司的同业竞争状况

公司控股股东、实际控制人王敏文夫妇及其控制的其他法人不存在从事与本公司相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争问题。

#### (二) 避免同业竞争的措施

为避免未来可能的同业竞争，实际控制人王敏文夫妇于 2007 年 8 月 26 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要包括：

实际控制人目前没有其他对外投资的企业或能够直接或间接控制或能够施加重大影响的企业从事与发行人相同或相似业务。

实际控制人承诺保证直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营；实际控制人将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。

实际控制人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

### 二、关联交易

#### (一) 关联方及关联关系

本公司根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定披露关联方。

##### 1、公司实际控制人

关联方名称	关联关系
王敏文	本公司董事、实际控制人，直接持有本公司 25.95% 股权
陈茶花	本公司实际控制人，直接持有本公司 2.59% 股权

##### 2、持有公司 5% 以上股份的其他股东

关联方名称	关联关系
李 莉	直接持有本公司 6.24% 股权的股东

李立本	本公司董事长，直接持有本公司 5.99%的股权
林必清	本公司董事、总经理，直接持有本公司 5.85%的股权

### 3、股份公司下属控股子公司

关联方名称	关联关系
宁波立立半导体有限公司	本公司控股子公司
杭州立昂电子有限公司	本公司控股子公司
杭州立立科技实业有限公司	本公司控股子公司

### 4、公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称	关联关系
内乡仙鹤纸业有限公司	立立电子监事长王敏强任该公司董事长并持有 18.97%的股份,王敏强为公司实际控制人王敏文之兄

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

本公司与子公司以及各子公司之间的经常性交易已在合并报表时抵销。本公司与其他关联方无关联交易。

### 2、偶发性关联交易

截至 2007 年 12 月 31 日，公司与下属控股子公司存在相互提供担保的情形，具体担保情况如下：

担保人	被担保人	担保权人	担保金额	担保方式	担保期限
立立电子	立昂电子	中国银行浙江省分行	1,000 万元	保证	2007/7/11 至 2008/7/10
		中国银行浙江省分行	1,000 万元	保证	2007/8/7 至 2008/8/6
		招商银行凤起支行	1,000 万元	保证	2007/9/3 至 2008/9/2
立立半导体		中国农业银行宁波保税区支行	2,000 万元	保证	2007/3/13 至 2008/10/08
		中国银行宁波保税区支行	2,460 万元	保证	2007/3/19 至 2008/6/28
		上海浦东发展银行开发区支行	1,200 万元	保证	2007/9/28 至 2008/4/10



	交通银行股份有限公司宁波分行	500 万元	保证	2007/12/29 至 2008/6/09
	中国工商银行宁波市江东支行	2,500 万元	保证	2005/6/29 至 2009/6/25

公司上述关联担保均按照《章程》、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保制度》的规定，分别经过董事会的审议批准，符合该等规范性文件的要求。

公司持有控股子公司立立半导体和立昂电子的股权比例均在 90%以上，相互之间的担保在合并会计报表项下，类似于公司为自身债务提供担保；此外，公司及控股子公司立立半导体和立昂电子目前的资产负债率均未超过 70%，且均经营状况良好，因此上述关联担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大实质影响。

### （三）关于关联交易的制度规定

公司已在《章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，同时规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。另外，公司在《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易控制与决策制度》中对关联交易的决策权力与程序作了更加详尽的规定。

#### 1、《章程》中的相关规定

（1）股东大会审议批准公司拟与关联人达成的交易金额 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）；

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避；当关联股东未主动回避时，其他股东可以要求其回避。关联股东应当向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

（2）董事会有权审议批准公司拟与关联人达成的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、但尚未达到应由股东大会审议批准标准的关联交易。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出

席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

## 2、《关联交易控制与决策制度》中的相关规定

(1) 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 300 万元至 3,000 万元之间且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%至 5%之间的，须按照以下程序办理，并经董事会表决通过后方可实施。

经总经理办公会议按本制度第十一条的规定进行初审后认为必须发生关联交易的，总经理须在总经理办公会议结束后二个工作日向董事会书面报告，并须责成有关职能部门按照总经理办公会议决定，将有关关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议。

董事会在收到总经理书面报告后，应当向全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。出席会议董事可以要求总经理说明其是否已经积极在市场寻找可与之进行该项交易的第三方，以替代与关联方发生交易；总经理应对有关结果向董事会做出解释和说明。

(2) 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以下或比例在公司最近一期经审计净资产值 0.5%以下的，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。

## 3、《独立董事制度》中的相关规定

(1) 公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的重大关联交易，应在独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(2) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

#### **（四）发行人最近三年关联交易的执行情况**

公司近三年发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。

独立董事认为：公司在 2005 年度、2006 年度及 2007 年度的所有重大关联交易均为公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且各项重大关联交易已履行法定批准程序。

#### **（五）减少关联交易的主要措施**

公司目前的关联交易主要是与控股子公司立立半导体、立昂电子和立立科技之间产品购销，该等购销属正常的商业行为，预计上述关联交易仍然将持续发生。

公司将通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

#### (一) 董事会成员

**李立本**，男，中国籍，67岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任浙江大学硅材料国家重点实验室副主任、浙江大学半导体材料研究所副所长、浙江大学半导体厂厂长、浙大海纳科技股份有限公司总裁、宁波立立电子股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长，本公司下属立立半导体、立昂电子和立立科技董事长。李先生担任本公司董事长的任期自2006年11月至2009年11月。李先生是国内著名半导体硅材料专家，曾荣获“国家级有突出贡献中青年专家”、“浙江省突出贡献中青年专家”和“信息产业部劳动模范”等荣誉称号，享受政府特殊津贴。

**阙端麟**，男，中国籍，79岁，大学学历，教授，中国科学院院士。曾任厦门大学助教、浙江大学教授、浙江大学硅材料国家重点实验室主任、浙江省政协副主席、浙江省科协主席、宁波立立电子股份有限公司董事长；现任本公司董事。阙先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11月。阙先生是我国著名半导体材料专家，曾荣获“国家级有突出贡献的中青年专家”、“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号，享受政府特殊津贴。

**王敏文**，男，中国籍，44岁，MBA，工程师。曾任申能股份有限公司助理经济师、投资部经理助理、策划部经理、董事，申能（集团）有限公司副总经理，申能资产管理公司总经理、董事长，上海电气集团股份有限公司董事，东方证券股份有限公司副董事长等，现任本公司董事。王先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11月。

**林必清**，男，中国籍，43岁，经济学硕士，高级经济师，会计师。曾任杭州市财政税务局科长、杭州市国家税务局征管科长、浙大海纳科技股份有限公司财务经理、宁波立立电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职；现任本公司董事、总经理，本公司下属子公司立立半导体和立立科技董事、总经理，立昂电子董事。林先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11

月。

**杨德仁**，男，中国籍，43岁，工学博士，教授，博士生导师。曾任浙江大学硅材料国家重点实验室讲师、副教授、副主任；现任本公司董事、浙江大学硅材料国家重点实验室副主任。杨先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11月。杨先生是我国著名半导体材料专家，教育部长江学者奖励计划特聘教授，曾获第九届中国青年科技奖。

**陈卫忠**，男，中国籍，39岁，大学学历，工程师。曾任东方通信股份有限公司工程师、杭州成电电子有限公司总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，本公司下属立昂电子董事。陈先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11月。

**吴仲时**，男，中国籍，44岁，经济学硕士，副教授。曾任浙江工商大学财务会计教研室主任、浙江康恩贝制药股份有限公司财务部经理；现任本公司独立董事、康恩贝集团有限公司副总裁、财务总监。吴先生担任本公司独立董事的任期自2006年11月至2009年11月。

**苏勇**，男，中国籍，52岁，博士，教授。曾任上海电力安装公司职工，复旦大学讲师、副教授、教授；现任本公司独立董事、复旦大学教授、安徽马鞍山钢铁股份有限公司独立董事、上海国际机场股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上海宝信软件股份公司独立董事。苏先生担任本公司独立董事的任期自2006年11月至2009年11月。

**闫笑枫**，男，中国籍，43岁，法学硕士，律师。曾任广东省人大法委办办事员，广东太阳神集团公司经理，广发证券股份有限公司董事会秘书、办公室总经理；现任本公司独立董事，广东合盛律师事务所律师。闫先生担任本公司董事的任期自2006年11月至2009年11月。

## （二）监事会成员

**王敏强**，男，中国籍，49岁，大学学历。曾任浙江省区域地质调查大队团委书记、浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理；现任本公司监事会召集人、河南内乡仙鹤纸业股份有限公司董事长。王先生担任本公司监事会召集人的任期自2006年11月至2009年11月。

**陈伯良**，男，中国籍，63岁，大学学历，会计师。曾任浙江大学财务处会计、浙江大学五七干校会计主办、浙大半导体厂财务科长、浙大海纳科技股份有限公司审计部长等职；现任本公司监事。陈先生担任本公司监事的任期自2006年11月至2009年11月。

**马向阳**，男，中国籍，38岁，博士，教授。曾任浙江大学硅材料国家重点实验室讲师、副教授；现任本公司监事、浙江大学硅材料国家重点实验室教授。马先生担任本公司监事的任期自2006年11月至2009年11月。

### （三）高级管理人员

**林必清**，简历见董事会成员介绍。现任本公司总经理，任期自2006年11月至2009年11月。

**陈卫忠**，简历见董事会成员介绍。现任本公司副总经理、董事会秘书，任期自2006年11月至2009年11月。

**田达晰**，男，中国籍，41岁，硕士，高级工程师。曾任湖南建材高等专科学校教师，浙大海纳科技股份有限公司下属浙江海纳半导体分公司单晶制造部部长；现任本公司副总经理，任期自2006年11月至2009年11月。

**刘培东**，男，中国籍，44岁，博士，研究员。曾任浙大海纳科技股份有限公司下属浙江海纳半导体分公司总经理助理、品质保障部部长；现任本公司副总经理，任期自2006年11月至2009年11月。

**李晓军**，女，中国籍，40岁，硕士，高级工程师。曾任杭州西湖电子集团公司进出口部主任科员，杭州海纳半导体有限公司部长、副总经理等职；现任本公司副总经理，任期自2006年11月至2009年11月。

**吴能云**，男，中国籍，41岁，硕士，高级会计师。曾任杭州铁路分局财务分处助理会计师、会计师，杭州艮山门火车站总会计师、高级会计师，萧甬铁路有限责任公司总会计师、高级会计师、计划财务部经理；现任本公司财务负责人，任期自2006年11月至2009年11月。

### （四）核心技术人员

**李立本**，简历见董事会成员介绍。

**刘培东**，简历见高级管理人员介绍。

田达晰，简历见高级管理人员介绍。

以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不具有境外永久居留权。

## （五）发行人现任董事、监事的提名和选聘情况

### 1、董事的提名和选聘情况

2006年11月5日公司2006年度第二次临时股东大会审议同意选举由第二届董事会提名的李立本先生、阙端麟先生、杨德仁先生、苏勇先生、闫笑枫先生和由王敏文先生提名的王敏文先生、陈卫忠先生、林必清先生、吴仲时先生为公司第三届董事会董事。其中苏勇先生、闫笑枫先生、吴仲时先生为公司独立董事。

2006年11月6日公司第三届董事会第一次会议选举李立本先生为本公司董事长。

### 2、监事提名和选聘情况

2006年11月5日公司2006年度第二次临时股东大会审议同意选举由第二届监事会提名的王敏强先生、马向阳先生为第三届监事会监事。

2006年10月13日本公司职工代表大会选举陈伯良先生为职工代表出任监事。

2006年11月6日公司第三届监事会第一次会议选举王敏强先生为第三届监事会召集人。

## 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人持股情况及近三年的持股变动情况

单位：万股

姓名	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	持股数	变动数	持股数	变动数	持股数	变动数
王敏文	2000	0	2000	0	2000	0
李立本	461.40	0	461.40	-120.7	582.10	0
阙端麟	103	0	103	0	103	0
林必清	450.60	0	450.60	+220	230.60	0
陈卫忠	280	0	280	+50	230	0

姓名	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	持股数	变动数	持股数	变动数	持股数	变动数
杨德仁	78.40	0	78.40	0	78.40	0
马向阳	71.40	0	71.40	0	71.40	0
陈伯良	0	0	0	0	0	0
刘培东	132.10	0	132.10	+15	117.10	0
李晓军	120	0	120	+40	80	0
田达晰	133.90	0	133.90	+70	63.90	0
吴能云	60	0	60	+60	0	0

以上人员所持公司股份不存在质押或冻结的情况。上述之外的其它董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未直接或间接持有公司股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属持股情况及近三年的持股变动情况

单位：万股

姓名	与上述人员之关系	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
		持股数	变动	持股数	变动	持股数	变动
陈茶花	王敏文之妻	200	0	200	-60	260	0
陈峪	陈伯良之子	130	0	130	0	130	0
杨在亮	阙端麟之妻	120	0	120	0	120	0
李晓劲	李立本之子	46	0	46	+3	43	0

以上人员所持公司股份不存在质押或冻结的情况。

上述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属近三年所持股份增减变动的具体原因参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“三、公司股本及其变化情况”。

## 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其它对外投资情况

截至本招股意向书签署日，除公司董事长李立本持有浙江海纳科技股份有限公司 0.5%的股份（系该公司发起人股）及监事会召集人王敏强持有内乡仙鹤纸业有限公司 18.97%的股份之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资的情况。



王敏强对于内乡仙鹤纸业有限公司的投资和李立本对于浙江海纳科技股份有限公司的投资与本公司不存在利益冲突。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及相关联企业领取年薪情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 2007 年度在本公司领取报酬的情况如下：

姓名	现任职务	2007 年在本公司
		领取的税后薪酬（元）
李立本	董事长	604,863.68
阙瑞麟	董事	78,443.40
王敏文	董事	30,000.00
林必清	总经理	523,855.51
杨德仁	董事	45,903.00
陈卫忠	董事、副总经理、 董事会秘书	396,194.82
吴仲时	独立董事	30,000.00
苏勇	独立董事	30,000.00
闫笑枫	独立董事	30,000.00
王敏强	监事	20,000.00
陈伯良	监事	22,997.20
马向阳	监事	20,000.00
田达晰	副总经理	432,392.08
刘培东	副总经理	345,191.48
李晓军	副总经理	338,049.46
吴能云	财务总监	328,838.92
合计		3,276,729.55

## 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼任职务	与本公司 关联关系
李立本	董事长	宁波立立半导体有限公司董事长	控股子公司
		杭州立昂电子有限公司董事长	控股子公司
		杭州立立科技实业有限公司董事长	控股子公司
林必清	董事、总经理	宁波立立半导体有限公司董事、总经理	控股子公司
		杭州立昂电子有限公司董事	控股子公司
		杭州立立科技实业有限公司董事、总经理	控股子公司
杨德仁	董事	浙江大学教授	无
		杭州立立科技实业有限公司董事	控股子公司
陈卫忠	董事、副总经理、 董事会秘书	杭州立昂电子有限公司董事	控股子公司
		杭州立立科技实业有限公司董事、副总经理、 财务负责人	控股子公司
吴仲时	独立董事	浙江康恩贝集团有限公司副总裁、财务总监	无
苏勇	独立董事	复旦大学教授	无
		安徽马鞍山钢铁股份有限公司独立董事	无
		上海国际机场股份有限公司独立董事	无
		上海友谊集团股份有限公司独立董事	无
		上海宝信软件股份公司独立董事	无
闫笑枫	独立董事	广东合盛律师事务所律师	无
王敏强	监事会召集人	内乡仙鹤纸业集团有限公司董事长	关联公司
陈伯良	监事	杭州立立科技实业有限公司监事	控股子公司
马向阳	监事	浙江大学教授	无
		杭州立立科技实业有限公司董事	控股子公司

除上述情况以外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有其他兼职情况。

## 六、董事、监事、高管人员及与核心技术人员相互之间的亲属关系

本公司董事长李立本与副总经理李晓军为父女关系；董事王敏文与监事会召集人王敏强为兄弟关系；董事王敏文是董事、副总经理陈卫忠的姐夫，除此之外，

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

## 七、公司与董事、监事、高管人员及核心技术人员的协议安排

本公司与高级管理人员和核心技术人员之间签订有《劳动合同》、《聘任合同》和《敬业、保密和保护知识产权协议》，就上述人员的诚信义务，特别是知识产权和商业秘密方面的义务作了详细规定。

截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员未与本公司签署任何借款、担保协议。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事及高级管理人员符合法律法规和中国证监会规定的任职要求，均严格按照《公司法》和公司《章程》等规定产生。

## 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

2004年10月16日，经公司第二届董事会第四次会议决定，同意阙端麟因年龄原因辞去公司董事长职务，选举李立本为公司董事长，李立本不再担任公司总经理；聘任陈卫忠为公司董事会秘书，林必清不再担任公司董事会秘书。

2004年10月16日，经公司2004年第一次临时股东大会决定，同意冯春阳辞去董事、顾伟康辞去独立董事，增选江作良、王敏文、陈卫忠为公司董事，吴仲时为独立董事。会议同时选举王敏强为公司监事，王敏文因为担任公司董事不再担任公司监事。

2006年2月11日，经公司第二届董事会第七次会议决定，聘任林必清为公司总经理，林必清不再担任公司副总经理和财务总监；聘任田达晰、刘培东和李晓军为公司副总经理，吴能云为公司财务负责人。

2006年3月18日，经公司2005年度股东大会决定，同意江作良、李正明因个人原因辞去公司董事，增选苏勇、闫笑枫为公司独立董事。

2006年11月5日，经公司2006年第二次临时股东大会换届选举，第二届董事会、监事会成员全体当选为第三届董事会、监事会成员，职务不变。2006年11月6日，第三届董事会第一次会议聘任原班高管人员，职务不变。

## 第九节 公司治理

### 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2000年6月8日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会、监事会成员，并审议通过了公司《章程》，对股东大会、董事会和监事会的职责及运行作了规定。此后，根据《公司法》及有关规定，公司制定并健全了《章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会运作规范，具体情况如下：

##### 1、股东权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人，按照公司《章程》规定，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。

##### 2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会的报告
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议
- （8）对发行公司债券作出决议
- （9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议
- （10）修改公司章程

- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第四十一条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (14) 审议批准公司拟与关联人达成的交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）
- (15) 对标的在公司最近一期经审计的净资产 10% 以上的对外投资、资产经营、风险投资事项作出决议；（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）
- (16) 单笔或者连续十二个月累计金额占最近一期经审计净资产的 10% 以上的委托理财；
- (17) 单笔或者连续十二个月累计金额占最近一期经审计净资产的 10% 以上的资产抵押；
- (18) 根据国家法律、行政法规、部门规章规定须股东大会审议通过的其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项。
- (19) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (20) 审议股权激励计划；
- (21) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

### 3、股东大会的议事规则

根据公司《章程》的规定，公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：（1）董事会和监事会的工作报告；（2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（3）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（4）公司年度预算方案、决算方案；（5）公司年度报告；（6）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的

其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：（1）公司增加或者减少注册资本；（2）公司的分立、合并、解散和清算；（3）本章程的修改；（4）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（5）股权激励计划；（6）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

#### **4、股东大会召开情况**

自公司创立以来至 2007 年末，共召开了 20 次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），就公司章程的制定和修改、重大生产、投资和财务决策、股票发行、募集资金投向、股利分配、董事会和监事会人员变动等重要事项进行了审议，并作出相应决议。

### **（二）董事会制度的建立健全及运行情况**

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

#### **1、董事会构成**

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

#### **2、董事会职权**

根据公司《章程》的规定，公司董事会依法行使下列职权：

- （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(9) 决定公司内部管理机构的设置；

(10) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(11) 制订公司的基本管理制度；

(12) 制订本章程的修改方案；

(13) 管理公司信息披露事项；

(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(15) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

### 3、董事会议事规则

公司《章程》规定董事会会议分定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次董事会定期会议。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

### 4、董事会召开情况

自公司创立以来至 2007 年末，董事会共召开了 37 次会议（包括定期会议和临时会议），就公司生产经营方案、管理人员任命、公司内部管理制度制订等事项进行审议，并作出相关决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

## （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照公司章程和监事会议事规则的规定行使自己的权利，监事会运作规范，具体情况如下：

## 1、监事会构成

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表一人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换，其余监事会成员由股东代表担任，由股东大会选举产生或更换。公司监事会设召集人一名，由所有监事会成员过半数选举产生或更换。

## 2、监事会职权

根据公司章程的规定，监事会依法行使下列职权：

- (1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (6) 向股东大会提出提案；
- (7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

## 3、监事会议事规则

《公司章程》规定监事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开二次监事会定期会议。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决议必须经全体监事的过半数通过。

## 4、监事会的召开情况

自公司创立以来至 2007 年末，监事会共召开了 21 次会议，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的义务。



## （四）独立董事

公司制定了《独立董事工作制度》，保障独立董事履行职责，按规则的规定行使自己的权利。

### 1、独立董事聘任情况

2003年12月14日,经2003年度第一次临时股东大会审议批准,公司聘请了1名独立董事;2006年3月18日,经2005年度股东大会审议批准,公司增选了2名独立董事。目前,公司董事会成员中共有3名独立董事,占董事会成员总数的三分之一。

### 2、独立董事的制度安排

根据公司章程和《独立董事工作制度》的规定,独立董事应当根据法律、法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;具有法律法规、规范性文件及公司章程要求的独立性;具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;并满足公司章程规定的其他条件。

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。

### 3、独立董事的职责

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

根据《独立董事工作制度》,独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职责外,在取得全体独立董事二分之一以上同意的情况下,还应当履行以下特别职责:

(1) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其

判断的依据：

- (2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (4) 提议召开董事会；
- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

此外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (1) 提名、任免董事；
- (2) 聘任或解聘高级管理人员；
- (3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额 300 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

- (5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (6) 对公司累计和当期的对外担保有关情况进行专项说明并发表独立意见；
- (7) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍等意见。

#### **4、独立董事实际发挥作用的情况**

公司全体股东和董事会认为，独立董事对公司重大事项和关联交易的决策、公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

### **(五) 董事会秘书的职责**

董事会秘书负责协调和组织公司的信息披露事务，主要履行以下职责：

- (1) 准备和递交国家有关部门要求的董事会以及股东大会出具的报告和文件；
- (2) 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
- (3) 建立公司的信息披露制度，负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；
- (4) 保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关文件和记录；
- (5) 使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，应当遵守的国家有关法律、法规、规章、政策和《公司章程》的有关规定；
- (6) 协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规及《公司章程》有关规定时，应当及时提出异议，并报告有关部门；
- (7) 为公司重大决策提供咨询和建议；
- (8) 公司上市后，处理公司与证券监管部门，证券交易所及投资者之间的有关事宜；
- (9) 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他职责；
- (10) 接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的信息资料。

## （六）专门委员会设置情况

2006年7月22日，公司第二届董事会第八次会议决定设立董事会审计委员会，并推选独立董事吴仲时和董事陈卫忠、董事杨德仁为委员，吴仲时为召集人。

董事会审计委员会的主要职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

## 二、发行人最近三年违法违规行为情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，自成立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及

相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

### 三、发行人最近三年资金占用和对外担保的情况

公司制定并严格遵守资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司在章程中明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，并在实践中严格遵守相关规定，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

### 四、公司管理层对内部控制制度的自我评价

#### （一）内部控制制度的完整性

##### 1、“三会”制度

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》。同时，制定了《独立董事制度》、《关联交易控制与决策制度》、《信息披露制度》等相关制度。

##### 2、职能制度

公司制定了一系列的规章制度，范围涵盖财务管理、质量管理控制、物资管理、生产管理、销售管理、行政后勤等诸多方面。确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

##### 3、组织机构建设的完整性

除建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础架构的法人治理结构，公司还设立了包括审计部、财务部、贸易部、工程技术部、研发中心、行政部、人力资源部、品质保证部、投资发展部、生产计划部、销售部、公共动力部、设备保全部、海外事业部，并分别配备了具有良好专业知识和管理能力的管理人员。

#### （二）内部控制制度的合理性

1、公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会、总经理的工作性质、职责和工作程序，董事长、董事、监事、总经理的任职资格、权利、义务以及考

核奖惩等作了明确的规定，明确了公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，保证了公司最高权力决策和监督、管理机构的规范运作。

2、公司在内部规章制度建立过程中，充分考虑了半导体硅材料行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要。

3、在公司管理方面，公司按照业务流程和日常管理的需要设置了完整的职能部门，合理地界定了各个部门的职责，有效地贯彻了公司的各项经营决策。

### （三）内部控制制度的有效性

公司管理层认为，公司现有的内控制度基本覆盖公司法人治理结构的各个层面和人财物、产供销管理的各个方面，并已得到有效执行。公司对物资采购、生产工艺管理、技术开发、产品销售、财务管理、人员激励和信息披露等业务流程均能实施有效控制，保证了公司各项管理工作的正常运行，对现有经营风险可以起到有效的控制作用。随着公司业务的进一步发展和国家有关法律法规的变化，公司将内部控制制度体系不断加以改进和完善。

另外，公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干持有公司股份，使他们与公司形成利益和风险共同体，激发了将公司做强做大的工作热情，焕发了规范法人治理结构和严格执行内控制度的主人翁精神，形成了较好的约束机制，有利于提高公司的管理水平和企业素质。

## 五、注册会计师对内部控制制度的评价

浙江东方会计师事务所有限公司根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》（财会[2001]41号）及相关具体规范，对公司内部控制制度进行了审核，出具了无保留意见的《内部控制审核报告》（浙东会专[2008]125号），认为：“立立电子公司截至2007年12月31日内部会计控制制度已经按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》（财会[2001]41号）及相关具体规范制定、执行。”。

## 第十节 财务会计信息

本节引用的财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报表及其附注。公司财务数据和财务指标等除另有注明外，均以合并会计报表的数据为基础进行计算。

### 一、财务会计报表

#### （一） 注册会计师意见

本公司聘请浙江东方会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司2007年12月31日、2006年12月31日和2005年12月31日的合并及母公司资产负债表，2007年度、2006年度和2005年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了审计。浙江东方会计师事务所出具了文号为“浙东会审[2008]131号”的标准无保留意见的《审计报告》。

#### （二） 合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	90,090,792.93	48,510,147.51	32,876,222.01
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	16,798,097.56	7,676,949.81	3,980,653.02
应收账款	103,453,380.69	56,549,660.68	88,369,169.16
预付款项	83,863,822.90	42,232,566.74	10,363,046.40
应收利息	-	-	-
其他应收款	2,466,153.43	893,440.96	2,068,367.10
存货	123,920,572.41	126,187,098.56	125,517,052.47
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>420,592,819.92</b>	<b>282,049,864.26</b>	<b>263,174,510.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

资 产	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	245,457,173.92	269,217,331.41	288,705,488.90
在建工程	39,112,099.27	2,100,816.87	12,737,863.59
工程物资	225,000.00	2,436,146.40	3,771,151.40
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	13,167,768.26	13,525,462.11	13,871,429.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	345,725.22	435,914.46	-
递延所得税资产	4,863,701.60	5,127,846.33	9,289,555.26
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>303,171,468.27</b>	<b>292,843,517.58</b>	<b>328,375,488.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>723,764,288.19</b>	<b>574,893,381.84</b>	<b>591,549,998.54</b>

## 合并资产负债表（续）

负债和股东权益	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	202,237,090.00	113,260,476.00	120,858,838.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	22,676,449.06	17,218,594.43	34,847,453.79
预收款项	7,540,611.97	5,239,611.37	176,164.68
应付职工薪酬	4,425,549.90	7,106,398.54	7,618,543.04
应交税费	6,740,827.40	2,881,260.44	2,242,004.28
应付利息	513,350.46	412,825.30	455,631.87
应付股利	-	-	213,875.00
其他应付款	7,029,786.68	4,576,454.97	9,185,561.86
一年内到期的非流动负债	42,613,220.00	37,670,000.00	76,347,640.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>293,776,885.47</b>	<b>188,365,621.05</b>	<b>251,945,712.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	31,500,895.00	69,370,440.00	94,670,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-

负债和股东权益	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	34,933,500.00	23,458,600.00	19,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>66,434,395.00</b>	<b>92,829,040.00</b>	<b>113,670,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>360,211,280.47</b>	<b>281,194,661.05</b>	<b>365,615,712.52</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	77,080,000.00	77,080,000.00	71,080,000.00
资本公积	66,491,165.98	66,491,165.98	53,779,940.27
减：库存股	-	-	-
盈余公积	20,752,180.88	17,094,135.32	17,094,135.32
未分配利润	195,184,114.87	129,130,869.41	81,040,624.31
归属于母公司股东权益合计	359,507,461.73	289,796,170.71	222,994,699.90
少数股东权益	4,045,545.99	3,902,550.08	2,939,586.12
<b>股东权益合计</b>	<b>363,553,007.72</b>	<b>293,698,720.79</b>	<b>225,934,286.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>723,764,288.19</b>	<b>574,893,381.84</b>	<b>591,549,998.54</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>456,999,439.29</b>	<b>364,379,633.83</b>	<b>258,809,599.85</b>
减：营业成本	262,331,271.17	230,058,909.25	177,417,250.17
营业税金及附加	7,175,902.77	2,205,728.37	1,321,344.44
销售费用	7,036,317.28	7,241,891.54	6,362,490.63
管理费用	61,154,906.61	41,739,816.77	24,347,211.35
财务费用	14,222,111.95	13,060,240.54	9,679,081.03
资产减值损失	2,275,732.56	-2,046,851.27	1,271,433.74
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>102,803,196.95</b>	<b>72,119,898.63</b>	<b>38,410,788.49</b>
加：营业外收入	2,817,901.63	1,363,432.26	7,227,168.37
减：营业外支出	545,057.49	217,003.89	84,817.73
其中：非流动资产处置损失	6,596.75	0.00	5,196.31
<b>三、利润总额</b>	<b>105,076,041.09</b>	<b>73,266,327.00</b>	<b>45,553,139.13</b>
减：所得税费用	15,951,754.16	15,816,892.23	3,390,998.48
<b>五、净利润</b>	<b>89,124,286.93</b>	<b>57,449,434.77</b>	<b>42,162,140.65</b>
归属于母公司股东的净利润	88,981,291.02	56,975,245.10	42,413,915.05
少数股东损益	142,995.91	474,189.67	-251,774.40
<b>六、每股收益：</b>			



(一) 基本每股收益	1.15	0.78	0.60
(二) 稀释每股收益	1.15	0.78	0.60

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	425,209,119.97	407,459,996.35	241,119,172.84
收到的税费返还	2,421,602.83	7,303,561.55	11,082,629.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,383,102.22	10,282,881.53	27,839,283.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>443,013,825.02</b>	<b>425,046,439.43</b>	<b>280,041,086.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	252,517,013.29	230,431,656.64	139,350,796.05
支付给职工以及为职工支付的现金	32,703,145.16	31,008,966.24	21,529,447.74
支付的各项税费	54,855,963.83	36,039,657.59	17,736,765.83
支付其他与经营活动有关的现金	15,748,789.13	17,487,419.90	11,413,267.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>355,824,911.41</b>	<b>314,967,700.37</b>	<b>190,030,277.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,188,913.61</b>	<b>110,078,739.06</b>	<b>90,010,809.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	5,384.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>5,384.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,517,396.68	29,460,611.45	57,384,402.89
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>66,517,396.68</b>	<b>29,460,611.45</b>	<b>57,384,402.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-66,517,396.68</b>	<b>-29,460,611.45</b>	<b>-57,379,018.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	19,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	230,704,460.00	196,995,247.60	190,020,808.54
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>230,704,460.00</b>	<b>216,195,247.60</b>	<b>190,020,808.54</b>
偿还债务支付的现金	174,654,171.00	257,770,430.00	209,868,626.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,091,147.28	23,014,567.53	25,389,385.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>208,745,318.28</b>	<b>280,784,997.53</b>	<b>235,258,012.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,959,141.72</b>	<b>-64,589,749.93</b>	<b>-45,237,203.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,050,013.23</b>	<b>-394,452.18</b>	<b>-205,345.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>41,580,645.42</b>	<b>15,633,925.50</b>	<b>-12,810,757.85</b>
<b>期初现金及现金等价物余额</b>	<b>48,510,147.51</b>	<b>32,876,222.01</b>	<b>45,686,979.86</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>90,090,792.93</b>	<b>48,510,147.51</b>	<b>32,876,222.01</b>

4、合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2007 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,080,000.00	66,491,165.98		17,094,135.32		129,130,869.41		3,902,550.08	293,698,720.79
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,080,000.00	66,491,165.98	-	17,094,135.32	-	129,130,869.41	-	3,902,550.08	293,698,720.79
三、本期增减变动金额	-	-	-	3,658,045.56	-	66,053,245.46	-	142,995.91	69,854,286.93
（一）净利润	-	-	-	-	-	88,981,291.02	-	142,995.91	89,124,286.93
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的	-	-	-	-	-	-	-	-	-
影响									
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	88,981,291.02	-	142,995.91	89,124,286.93
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,658,045.56	-	-22,928,045.56	-	-	-19,270,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,658,045.56	-	-3,658,045.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-19,270,000.00	-	-	-19,270,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>77,080,000.00</b>	<b>66,491,165.98</b>	-	<b>20,752,180.88</b>	-	<b>195,184,114.87</b>	-	<b>4,045,545.99</b>	<b>363,553,007.72</b>

项目	2006 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,080,000.00	53,779,940.27	-	17,094,135.32	-	81,040,624.31	-	2,939,586.12	225,934,286.02
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	71,080,000.00	53,779,940.27	-	17,094,135.32	-	81,040,624.31	-	2,939,586.12	225,934,286.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,000,000.00	12,711,225.71	-	-	-	48,090,245.10	-	962,963.96	67,764,434.77
(一) 净利润	-	-	-	-	-	56,975,245.10	-	474,189.67	57,449,434.77
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-488,774.29	-	-	-	-	-	488,774.29	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-488,774.29	-	-	-	-	-	488,774.29	-

上述（一）和（二）小计	-	-488,774.29	-	-	-	56,975,245.10	-	962,963.96	57,449,434.77
（三）股东投入和减少股本	6,000,000.00	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	19,200,000.00
1. 股东投入股本	6,000,000.00	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	19,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-8,885,000.00	-	-	-8,885,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-8,885,000.00	-	-	-8,885,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>77,080,000.00</b>	<b>66,491,165.98</b>	<b>-</b>	<b>17,094,135.32</b>	<b>-</b>	<b>129,130,869.41</b>	<b>-</b>	<b>3,902,550.08</b>	<b>293,698,720.79</b>

项目	2005 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,080,000.00	53,779,940.27	-	13,095,026.83	-	53,287,817.75	-	3,191,360.52	194,434,145.37
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	71,080,000.00	53,779,940.27	-	13,095,026.83	-	53,287,817.75	-	3,191,360.52	194,434,145.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	3,999,108.49	-	27,752,806.56	-	-251,774.40	31,500,140.65
(一) 净利润	-	-	-	-	-	42,413,915.05	-	-251,774.40	42,162,140.65
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	42,413,915.05	-	-251,774.40	42,162,140.65
(三) 股东投入和减少股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本									
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,999,108.49	-	-14,661,108.49	-	-	-10,662,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,999,108.49	-	-3,999,108.49	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-10,662,000.00	-	-	-10,662,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>71,080,000.00</b>	<b>53,779,940.27</b>	-	<b>17,094,135.32</b>	-	<b>81,040,624.31</b>	-	<b>2,939,586.12</b>	<b>225,934,286.02</b>



### (三) 母公司报表

#### 1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
流动资产：			
货币资金	60,716,697.52	31,318,774.16	17,573,218.78
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	9,941,730.69	5,318,586.68	3,280,653.02
应收账款	70,714,676.18	51,312,104.48	73,986,275.93
预付款项	81,399,324.35	40,023,253.86	7,569,118.09
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,941,804.69	219,082.60	139,839.00
存货	64,788,110.99	63,355,018.55	76,900,843.45
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>289,502,344.42</b>	<b>191,546,820.33</b>	<b>179,449,948.27</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	119,664,005.00	119,664,005.00	97,664,005.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	114,554,870.43	131,198,147.95	156,161,300.84
在建工程	26,575,387.66	-	-
工程物资	-	53,100.00	858,105.00
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,299,824.35	3,415,224.42	3,520,045.38
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长摊待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,321,692.17	942,300.66	1,656,933.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	265,415,779.61	255,272,778.03	259,860,389.52
<b>资产总计</b>	<b>554,918,124.03</b>	<b>446,819,598.36</b>	<b>439,310,337.79</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
流动负债：			
短期借款	-	35,978,348.00	36,291,232.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	17,519,996.46	7,439,042.09	31,762,139.12
预收款项	3,125,919.82	3,585,078.58	10,800.00
应付职工薪酬	3,061,073.32	3,765,641.48	3,827,015.68
应交税费	2,770,642.61	3,353,017.76	4,849,882.65
应付利息	220,747.11	153,149.92	196,879.30
应付股利	-	-	213,875.00
其他应付款	30,354,914.31	72,196,322.93	63,763,171.98
一年内到期的非流动负债	17,613,220.00	17,670,000.00	33,894,840.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>165,216,243.63</b>	<b>144,140,600.76</b>	<b>174,809,835.73</b>
非流动负债：	-	-	-
长期借款	26,500,895.00	29,370,440.00	37,670,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	23,777,500.00	12,782,600.00	13,200,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>50,278,395.00</b>	<b>42,153,040.00</b>	<b>50,870,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>215,494,638.63</b>	<b>186,293,640.76</b>	<b>225,679,835.73</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	77,080,000.00	77,080,000.00	71,080,000.00
资本公积	60,700,000.00	60,700,000.00	47,500,000.00
减：库存股	-	-	-
盈余公积	20,752,180.88	17,094,135.32	17,094,135.32
未分配利润	180,891,304.52	105,651,822.28	77,956,366.74
外币报表折算差额	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>339,423,485.40</b>	<b>260,525,957.60</b>	<b>213,630,502.06</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>554,918,124.03</b>	<b>446,819,598.36</b>	<b>439,310,337.79</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>344,909,108.23</b>	<b>278,960,393.04</b>	<b>200,318,057.32</b>
减：营业成本	210,867,925.01	202,805,879.28	146,891,945.64
营业税金及附加	5,122,888.55	670,187.46	219,336.02
销售费用	5,475,971.01	5,591,594.31	5,547,645.52
管理费用	36,790,912.63	20,898,765.05	10,633,040.68
财务费用	6,734,247.90	7,014,466.92	2,489,366.61
资产减值损失	691,002.83	-2,861,685.75	3,998,857.40
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	27,000,000.00	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>106,226,160.30</b>	<b>44,841,185.77</b>	<b>30,537,865.45</b>
加：营业外收入	929,237.46	670,157.11	1,145,374.62
减：营业外支出	281,146.70	104,752.20	27,050.93
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>106,874,251.06</b>	<b>45,406,590.68</b>	<b>31,656,189.14</b>
减：所得税费用	8,706,723.26	8,826,135.14	4,995,465.83
<b>四、净利润</b>	<b>98,167,527.80</b>	<b>36,580,455.54</b>	<b>26,660,723.31</b>
<b>五、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	1.27	0.50	0.38
（二）稀释每股收益	1.27	0.50	0.38

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	249,380,655.05	259,279,815.18	144,740,323.08
收到的税费返还	259,800.00	580,204.38	3,887,153.32
收到其他与经营活动有关的现金	42,756,915.98	20,558,645.80	77,183,107.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>292,397,371.03</b>	<b>280,418,665.36</b>	<b>225,810,583.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	185,311,290.93	167,103,910.51	96,507,734.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,194,675.78	13,162,768.15	7,860,279.29
支付的各项税费	34,205,898.20	19,099,240.35	7,429,890.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,983,260.01	13,084,390.77	35,514,191.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>248,695,124.92</b>	<b>212,450,309.78</b>	<b>147,312,096.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>43,702,246.11</b>	<b>67,968,355.58</b>	<b>78,498,487.64</b>

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,130,355.08	13,971,349.24	36,269,577.54
投资支付的现金	-	22,000,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,130,355.08</b>	<b>35,971,349.24</b>	<b>40,769,577.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,130,355.08</b>	<b>-35,971,349.24</b>	<b>-40,769,577.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	19,200,000.00	-
取得借款收到的现金	102,227,585.00	80,700,267.60	43,994,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>102,227,585.00</b>	<b>99,900,267.60</b>	<b>43,994,240.00</b>
偿还债务支付的现金	50,582,528.00	105,222,640.00	76,101,167.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,949,787.28	12,576,744.21	15,692,619.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>75,532,315.28</b>	<b>117,799,384.21</b>	<b>91,793,787.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,695,269.72</b>	<b>-17,899,116.61</b>	<b>-47,799,547.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-869,237.39</b>	<b>-352,334.35</b>	<b>-111,158.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,397,923.36</b>	<b>13,745,555.38</b>	<b>-10,181,796.32</b>
<b>期初现金及现金等价物余额</b>	<b>31,318,774.16</b>	<b>17,573,218.78</b>	<b>27,755,015.10</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>60,716,697.52</b>	<b>31,318,774.16</b>	<b>17,573,218.78</b>

## 3、母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	2007 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	77,080,000.00	60,700,000.00	-	17,094,135.32	105,651,822.28	260,525,957.60
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,080,000.00	60,700,000.00	-	17,094,135.32	105,651,822.28	260,525,957.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,658,045.56	75,239,482.24	78,897,527.80
（一）净利润	-	-	-	-	98,167,527.80	98,167,527.80
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	98,167,527.80	98,167,527.80
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,658,045.56	-22,928,045.56	-19,270,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,658,045.56	-3,658,045.56	0.00
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-19,270,000.00	-19,270,000.00

3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>77,080,000.00</b>	<b>60,700,000.00</b>	-	<b>20,752,180.88</b>	<b>180,891,304.52</b>	<b>339,423,485.40</b>

单位：元

项 目	2006 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	71,080,000.00	47,500,000.00	-	17,094,135.32	77,956,366.74	213,630,502.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	71,080,000.00	47,500,000.00	-	17,094,135.32	77,956,366.74	213,630,502.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	13,200,000.00	-	-	27,695,455.54	46,895,455.54
（一）净利润	-	-	-	-	36,580,455.54	36,580,455.54
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	36,580,455.54	36,580,455.54

(三) 股东投入和减少股本	6,000,000.00	13,200,000.00	-	-	-	19,200,000.00
1. 股东投入股本	6,000,000.00	13,200,000.00	-	-	-	19,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-8,885,000.00	-8,885,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-8,885,000.00	-8,885,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>77,080,000.00</b>	<b>60,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,094,135.32</b>	<b>105,651,822.28</b>	<b>260,525,957.60</b>

单位：元

项 目	2005 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	71,080,000.00	47,500,000.00	-	13,095,026.83	65,956,751.92	197,631,778.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	71,080,000.00	47,500,000.00	-	13,095,026.83	65,956,751.92	197,631,778.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,999,108.49	11,999,614.82	15,998,723.31
（一）净利润	-	-	-	-	26,660,723.31	26,660,723.31

(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	26,660,723.31	26,660,723.31
(三) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	3,999,108.49	-14,661,108.49	-10,662,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,999,108.49	-3,999,108.49	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-10,662,000.00	-10,662,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>71,080,000.00</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,094,135.32</b>	<b>77,956,366.74</b>	<b>213,630,502.06</b>



## 二、会计报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况

### （一） 会计报表的编制基础

本公司2004年--2006年执行财政部《企业会计准则—基本准则》（财政部令[1992]5号）及具体准则和《企业会计制度》（财会[2000]25号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的有关规定，本公司自2007年1月1日起执行修订后的《企业会计准则—基本准则》（财政部令[2006]33号）和具体准则。

本财务报表已对新企业会计准则要求追溯调整的项目在可比会计期间进行了追溯调整，按新会计准则的规定重述了可比会计期间资产负债表和利润表有关项目的确认、计量和披露；并已按照新企业会计准则所要求列报的报表种类、报表项目对可比会计期间的报表类别、报表项目进行了追溯调整，不再列示“利润分配表”，增加了“股东权益变动表”。

### （二） 合并会计报表范围及变化情况

#### 1、纳入合并报表范围的公司情况：

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	经营范围
宁波立立半导体有限公司	宁波	工业	5,000 万	90.00%	硅单晶片制造等
杭州立昂电子有限公司	杭州	工业	7,000 万	93.57%	半导体芯片的开发、制造、销售
杭州立立科技实业有限公司	杭州	工业	500 万	90.00%	研发、销售：集成电路及应用软件，半导体材料

注：立立半导体持有立立科技10%的股权，立昂电子持有立立半导体10%的股权。

#### 2、报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

2005年11月本公司与子公司立立半导体共同投资设立杭州立立科技实业有限公司，该公司于2005年12月1日完成工商登记注册手续，本公司以货币资金出资450万元，占注册资本的90%。故自2005年12月起将该公司纳入合并报表范围。

### 三、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 收入的确认和计量

##### 1、销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### 2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 4、建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同

成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## (二) 金融工具的确认和计量

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价

值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工

具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (三) 存货的确认和计量

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货采用加权平均法。

3、资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表

日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、包装物、低值易耗品和其他周转材料均采用一次摊销法进行摊销。

#### **（四） 长期股权投资的确认和计量**

1、长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十五)3 所述方法计提长期投资减值准备。

4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认

定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## （五） 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50% 计提；5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），按个别认定法计提坏账准备。

对于收回基本无风险的出口退税款项，不计提坏账准备。

## （六） 固定资产的确认和计量

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.375
通用设备	5-8	5%	11.875-19
专用设备	5-8	5%	11.875-19
运输设备	8	5%	11.875

其他设备	5	5%	19
------	---	----	----

5、因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提固定资产减值准备。

## （七） 在建工程的确认和计量

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提在建工程减值准备。

## （八） 无形资产的确认和计量

1、无形资产按成本进行初始计量。

2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经



济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提无形资产减值准备。

6、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。

研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式；

d.有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （九） 资产减值

1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十） 借款费用的确认和计量

1、借款费用资本化的确认原则。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间。(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支

出已经发生； 借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## （十一） 企业所得税的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递

延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 四、适用的所得税税率及享受的主要税收优惠政策

### (一) 增值税

#### 1、法定税率

按 17% 的税率计缴。

#### 2、税收优惠

##### (1) 出口货物“免、抵、退”

出口货物实行“免、抵、退”税政策，2004 年至 2007 年 6 月 30 日，硅单晶片的退税率为 13%、肖特基二极管芯片的退税率为 17%。根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的公告》（财税[2007]90 号），自 2007 年 7 月 1 日起，硅单晶片的退税率降低为 5%，肖特基二极管芯片的退税率仍为 17%。

##### (2) 增值税即征即退

对增值税实际税负超过 3% 的部分，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号）及财政部、国家税务总局《关于停止集成电路增值税退税政策的通知》（财税[2004]174 号），自 2002 年 1 月 1 日起至 2005 年 3 月 31 日本公司与子公司立立半导体可享受即征即退政策。

### (二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

### (三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

### (四) 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。

### (五) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3% 计缴。

### (六) 地方教育附加

按应缴流转税额的 2% 计缴。

## （七）企业所得税

### 1、法定税率

按 33% 的税率计缴。

### 2、税收优惠

#### （1）产业优惠

根据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号），并经宁波市地方税务局批复同意，本公司享受 2003-2004 年度免征企业所得税、2005-2007 年度减半征收企业所得税的税收优惠政策，子公司立立半导体享受 2004-2005 年度免征企业所得税、2006-2008 年度减半征收企业所得税的税收优惠政策。

#### （2）技术改造国产设备抵免企业所得税

根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290 号）和《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》（国税发[2000]13 号）的规定，并经主管税务机关核准，本公司 6 英寸硅外延片生产线一期技改项目采购国产设备，可抵免 2005 年度应交企业所得税 2,730,539.06 元，本公司 6 英寸硅外延片生产线技改项目采购国产设备，可抵免 2007 年度应交企业所得税 5,923,756.58 元；子公司立昂电子公司功率半导体芯片生产线扩产技术改造项目采购国产设备，共可抵免应交企业所得税 586,811.20 元，2006 年度和 2007 年度已抵免应交企业所得税 586,811.20 元。

## 五、分部信息

本公司的分部信息按主营业务产品类别以及销售对象列示。下表是报告期内公司主要产品的分部状况；

单位：元

项 目	2007 年度		
	收入	成本	利润
单晶硅片	502,015,742.54	319,419,756.34	182,595,986.20
肖特基芯片	98,301,522.83	81,127,106.79	17,174,416.04

技术服务	4,600.00	-	4,600.00
小 计	600,321,865.37	400,546,863.13	199,775,002.24
抵 销	145,538,828.20	140,681,474.96	4,857,353.24
合 计	<b>454,783,037.17</b>	<b>259,865,388.17</b>	<b>194,917,649.00</b>

单位：元

项 目	2006 年		
	收入	成本	利润
单晶硅片	413,831,150.51	293,327,419.15	120,503,731.36
肖特基芯片	95,509,068.54	76,652,914.23	18,856,154.31
技术服务	2,480,000.00	1,286,499.45	1,193,500.55
小 计	511,820,219.05	371,266,832.83	140,553,386.22
抵 销	148,756,094.21	141,978,628.77	6,777,465.44
合 计	<b>363,064,124.84</b>	<b>229,288,204.06</b>	<b>133,775,920.78</b>

单位：元

项 目	2005 年		
	收入	成本	利润
单晶硅片	312,644,235.60	232,381,928.92	80,262,306.68
肖特基芯片	61,814,044.65	61,564,022.37	250,022.28
小 计	374,458,280.25	293,945,951.29	80,512,328.96
抵 销	115,997,411.31	116,853,810.61	-856,399.30
合 计	<b>258,460,868.94</b>	<b>177,092,140.68</b>	<b>81,368,728.26</b>

本公司根据最终产品的内外销分部信息如下：

单位：元

项 目	2007 年度		
	收入	成本	利润
内 销	411,088,792.64	273,237,197.47	137,851,595.17
外 销	189,233,072.73	127,309,665.66	61,923,407.07
小 计	600,321,865.37	400,546,863.13	199,775,002.24
抵 销	145,538,828.20	140,681,474.96	4,857,353.24
合 计	<b>454,783,037.17</b>	<b>259,865,388.17</b>	<b>194,917,649.00</b>

单位：元

项 目	2006 年度		
	收入	成本	利润
内 销	335,842,206.54	235,569,419.04	100,272,787.50
外 销	175,978,012.51	135,697,413.79	40,280,598.72
小 计	511,820,219.05	371,266,832.83	140,553,386.22
抵 销	148,756,094.21	141,978,628.77	6,777,465.44

合 计	363,064,124.84	229,288,204.06	133,775,920.78
-----	----------------	----------------	----------------

单位：元

项 目	2005 年度		
	收入	成本	利润
内 销	251,383,428.02	198,682,254.73	52,701,173.29
外 销	123,074,852.23	95,263,696.56	27,811,155.67
小 计	374,458,280.25	293,945,951.29	80,512,328.96
抵 销	115,997,411.31	116,853,810.61	-856,399.30
合 计	258,460,868.94	177,092,140.68	81,368,728.26

## 六、 发行人最近一年收购兼并情况

公司最近一年无收购兼并情况。

## 七、 非经常性损益

以下非经常性损益以合并财务报表数据为基础，并经东方会计师事务所（浙东会专[2008]126号）核验。

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
（一）非流动资产处置损益	-6,596.75	-	-5,196.31
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
（三）计入当期损益的政府补助	2,801,236.82	3,383,057.38	7,197,160.00
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
（五）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益	-	-	-
（七）委托投资损益	-	-	-
（八）因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	-	-	-
（九）债务重组损益	-	-	-
（十）企业重组费用	-	-	-
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-

(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
(十三) 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-	-	-
(十四) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-73,565.89	66,071.16	323,663.89
(十五) 中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-	-	-
非经常性损益小计	2,721,074.18	3,449,128.54	7,515,627.58
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-5,155,493.74	65,334.37	-1,075,993.85
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	50,758.36	185,144.80	301,843.56
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,825,809.55</b>	<b>3,198,649.36</b>	<b>8,289,777.87</b>

## 八、最近一期末主要资产情况

### （一） 预付账款

截至 2007 年 12 月 31 日，公司预付账款为 8,386.38 万元，最近一年的账龄情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2007 年 12 月 31 日				2006 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面金额	比例 (%)	坏帐准备	账面价值
1 年以内	83,262,084.26	99.28	-	83,262,084.26	42,225,034.65	99.98	-	42,225,034.65
1 至 2 年	599,752.28	0.72	-	599,752.28	7,532.09	0.02	-	7,532.09
2 至 3 年	1,986.36	-	-	1,986.36	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>83,863,822.90</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>83,863,822.90</b>	<b>42,232,566.74</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>42,232,566.74</b>

公司账龄为一年以上的预付账款金额很小，均系尚未结算的购货尾款；账龄一年以内、金额较大的预付账款为公司向主要原材料供应商支付的采购货款（主要为外币），由于公司预付账款不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

### （二） 固定资产

截至 2007 年 12 月 31 日，公司固定资产类别、折旧年限、原价、净值情况如



下：

单位：元

类别	原值	折旧年限	净值	折旧方法
房屋建筑物	108,532,799.45	40年	94,897,646.89	年限平均法
通用设备	74,871,438.25	5-8年	31,358,447.76	年限平均法
专用设备	315,510,420.64	5-8年	114,107,598.25	年限平均法
运输设备	2,997,821.51	8年	1,343,920.32	年限平均法
其他设备	7,658,694.90	5年	3,749,560.70	年限平均法
合计	509,571,174.75	-	245,457,173.92	-

### （三） 长期股权投资

公司合并报表中长期股权投资因合并抵销期末无账面价值。

本公司对三家子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时，按照权益法进行调整。截至2007年12月31日，母公司期末账面长期股权投资账面价值11,966.40万元，明细情况如下：

单位：元

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	2006-12-31	2007-12-31
立立半导体	90%	10年	2,569.32	4,936.40	4,936.40
立昂电子	93.57%	10年	2,550.00	6,580.00	6,580.00
立立科技	90%	20年	450.00	450.00	450.00
合计	-	-	5,569.32	11,966.40	11,966.40

经测试，期末长期股权投资不存在减值迹象，故未计提减值准备。

### （四） 无形资产

截至2007年12月31日，公司期末无形资产原值1,523.84万元，净值1,316.78万元。

单位：元

种类	初始金额	累计摊销	摊销年限	期末账面价值	取得方式
土地使用权	15,103,395.01	2,011,794.31	按使用权年限摊销	13,091,600.70	出让、受让
工程控制软件	135,000.00	58,832.44	10年	76,167.56	购入
合计	15,238,395.01	2,070,626.75	-	13,167,768.26	-

(1) 公司期末无形资产中已有账面原值为1456.26万元、净值为1262.74万元的土地使用权为本公司及子公司的借款提供抵押担保。

(2) 期末无形资产不存在减值迹象，故不需计提减值准备。

## 九、主要债项

截止 2007 年 12 月 31 日，公司合并报表的负债余额合计为 36,021.13 万元，其中流动负债 29,377.69 万元、非流动负债 6,643.44 万元。

### (一) 短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债

#### 1、短期借款

截至2007年12月31日，公司的短期借款余额20,223.71万元，期末无逾期借款。

##### (1) 短期借款——人民币借款

单位：元

借款类别	2007-12-31	2006-12-31
信用借款	61,649,730.00	21,278,348.00
保证借款	91,687,360.00	68,768,213.00
抵押借款	48,900,000.00	23,213,915.00
合计	<b>202,237,090.00</b>	<b>113,260,476.00</b>

##### (2) 短期借款——外币借款

单位：元

币种	2007-12-31			2006-12-31		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	9,150,000.00	7.30	66,837,090.00	2,940,000.00	7.81	22,957,578.00
欧元	-	-	-	1,812,000.00	10.27	18,602,898.00
小计	-	-	<b>66,837,090.00</b>	-	-	<b>41,560,476.00</b>

#### 2、长期借款

截至2007年12月31日，公司的长期借款余额3,150.09万元，期末无逾期借款。

##### (1) 长期借款明细

单位：元

种类	借款条件	2007-12-31	2006-12-31
银行借款	信用借款	13,170,000.00	20,000,000.00
银行借款	保证借款	5,000,000.00	25,000,000.00
银行借款	抵押借款	13,330,895.00	24,370,440.00

合计		31,500,895.00	69,370,440.00
----	--	---------------	---------------

## (2) 外币借款

单位：元

币种	2007-12-31			2006-12-31		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,825,000.00	7.30	13,330,895.00	1,200,000.00	7.81	9,370,440.00

## 3、一年内到期的非流动负债

截至2007年12月31日，公司的一年内到期的非流动负债余额4,261.32万元，期末无逾期借款。

单位：元

借款条件	2007-12-31
信用借款	12,500,000.00
担保借款	20,000,000.00
抵押借款	10,113,220.00
合计	42,613,220.00

## (二) 应付账款

截至2007年12月31日，公司应付账款期末数2,267.64万元。应付账龄分析如下：

单位：元

账龄	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	21,182,309.20	93.41%	15,752,081.05	91.48%
1至2年	714,076.50	3.15%	730,554.57	4.24%
2至3年	542,849.37	2.39%	561,971.91	3.27%
3年以上	237,213.99	1.05%	173,986.90	1.01%
合计	22,676,449.06	100.00%	17,218,594.43	100.00%

无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

## (三) 应交税费

截至2007年12月31日公司应交税费674.08万元，详情如下：

单位：元

种 类	2007-12-31	2006-12-31
增值税	924,227.24	423,162.13
城市维护建设税	1,006,870.85	97,963.67
企业所得税	3,417,502.87	1,879,692.70
代扣代缴个人所得税	313,084.66	404,005.10
土地使用税	344,933.00	-
教育费附加	715,988.15	69,974.05
地方教育费附加	3,205.32	-
印花税	2,906.19	-
水利建设基金	12,109.12	6,462.79
合 计	<b>6,740,827.40</b>	<b>2,881,260.44</b>

#### (四) 其他非流动负债

截至 2007 年 12 月 31 日，公司其他非流动负债数 3,493.35 万元。 本公司其他非流动负债均系政府补助。其他非流动负债余额情况说明如下：

单位：元

项目名称	拨入时间	未结转金额	发文部门	文号
300mm 微氮硅抛光片的研制	2007 年 12 月	2,000,000.00	信息产业部	信部运[2008]14号
8 英寸微氮重掺砷硅外延片	2007 年 7 月	9,000,000.00	信息产业部	信部运[2007]3号
固定资产投资补助	2007 年 7 月	480,000.00	杭州经济技术开发区财政局	杭经开财[2007]35号
6 英寸重掺磷直拉单晶生产技术的研制	2006 年 8 月	187,500.00	宁波市科技技术局	甬科计[2006]51号
0.13umIC 用 8 英寸硅单晶抛光片	2006 年 4 月	4,000,000.00	信息产业部	信部运[2005]637号
大直径重掺硅单晶研发创新平台	2006 年 3 月	300,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局	区科技[2005]25号
6 英寸功率半导体芯片产业化	2006 年 1 月	288,000.00	杭州经济技术开发区财政局	杭经开财[2006]005号
6 英寸功率半导体芯片产业化	2006 年 1 月	288,000.00	杭州市发展和改革委员会	杭发改高技[2005]1327号
可用于用功人员奖励的十佳企业	2006 年 1 月	90,000.00	宁波保税区(出口)加工区经济发展局	甬保经发[2006]18号

奖励资金				
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 9 月	2,500,000.00	宁波保税区（出口加工区）财政局	甬保财政[2006]12号
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 6 月	5,000,000.00	宁波市财政局	甬财政工[2005]361号
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 5 月	5,000,000.00	宁波市财政局	甬财政工[2005]230号
8 英寸抛光硅片	2005 年 5 月	4,000,000.00	宁波保税区财政局	甬财政教[2005]246号
8 英寸抛光片产业化技术研究	2005 年 5 月	600,000.00	宁波市科学技术局	甬科计[2005]51号
8 英寸抛光片产业化技术研究	2004 年 11 月	1,200,000.00	科学技术部	国科发财字[2004]378号
合计	-	<b>34,933,500.00</b>	-	-

## （五） 对内部人员和关联方的负债

### 1、对内部人员的负债

截至2007年12月31日，本公司不存在对内部人员负债。

### 2、对关联方的负债

公司除与子公司正常的业务往来形成的应收及应付款外，无其他对关联方的负债，该等事项在编制合并报表时均已抵销。本公司与子公司的具体关联交易请参见本招股意向书“第七节、同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

## （六） 主要合同承诺的债务及逾期未偿还款项

截至2007年12月31日，本公司无主要合同承诺的债务和逾期未偿还债项。

## 十、 股东权益

### （一） 股本

单位：元

股东类别	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
境内自然人股东	77,080,000.00	77,080,000.00	71,080,000.00

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
股本溢价	45,960,410.58	45,960,410.58	33,249,184.87
其他资本公积	20,530,755.40	20,530,755.40	20,530,755.40
<b>合计</b>	<b>66,491,165.98</b>	<b>66,491,165.98</b>	<b>53,779,940.27</b>

报告期内，2006年资本公积较2005年增加1,271.12万元，变动情况如下：

(1) 2006年8月增资时产生股本溢价1,320万元；

(2) 2006年冲减对子公司立昂电子追加投资2,200万元形成的股权投资借差48.88万元。

## (三) 盈余公积

单位：元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
法定盈余公积	20,752,180.88	17,094,135.32	11,396,090.21
法定公益金	-	-	5,698,045.11
<b>合计</b>	<b>20,752,180.88</b>	<b>17,094,135.32</b>	<b>17,094,135.32</b>

(1) 2007年盈余公积金的增加系根据公司章程规定按2006年度净利润的10%提取的法定盈余公积；2005年增加数均系根据公司章程规定按净利润的10%和5%提取的两项公积金。

(2) 根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)文件规定，2006年公司将2005年12月31日的公益金结余转作法定盈余公积管理。

## (四) 未分配利润

单位：元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
期初未分配利润	129,130,869.41	81,040,624.31	53,287,817.75
加：本期净利润	88,981,291.02	56,975,245.10	42,413,915.05
减：法定盈余公积	3,658,045.56	-	3,999,108.49
已分配普通股股利	19,270,000.00	8,885,000.00	10,662,000.00
期末未分配利润	195,184,114.87	129,130,869.41	81,040,624.31

根据 2007 年 3 月 24 日公司董事会三届二次会议审议通过，并经 2006 年度股东大会审议批准的 2006 年度利润分配方案，按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）元，共 19,270,000.00 元。截至 2007 年 6 月 30 日，上述利润分配方案已实施。

根据 2006 年 2 月 11 日公司董事会二届七次会议审议通过，并经 2005 年度股东大会审议批准的 2005 年度利润分配方案，按 2005 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，5% 的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共 8,885,000.00 元。截至 2006 年 6 月 30 日，上述利润分配方案已实施。

根据本公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

## （五） 少数股东权益

单位：元

项 目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
一、上年年末余额	3,902,550.08	2,939,586.12	3,191,360.52
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
二、本年初余额	3,902,550.08	2,939,586.12	3,191,360.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,995.91	962,963.96	-251,774.40
（一）净利润	142,995.91	474,189.67	-251,774.40
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	488,774.29	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-
4. 其他	-	488,774.29	-
上述（一）和（二）小计	142,995.91	962,963.96	-251,774.40
（三）股东投入和减少股本	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>4,045,545.99</b>	<b>3,902,550.08</b>	<b>2,939,586.12</b>

## 十一、 现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

公司在报告期内的现金流量情况简表如下：

单位：元

项 目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
一、经营活动产生的现金流量净额	87,188,913.61	110,078,739.06	90,010,809.50
二、投资活动产生的现金流量净额	-66,517,396.68	-29,460,611.45	-57,379,018.14
三、筹资活动产生的现金流量净额	21,959,141.72	-64,589,749.93	-45,237,203.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,050,013.23	-394,452.18	-205,345.31
五、现金及现金等价物净增加额	41,580,645.42	15,633,925.50	-12,810,757.85
六、期末现金及现金等价物余额	90,090,792.93	48,510,147.51	32,876,222.01

报告期内，公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

## 十二、 或有事项、期后事项及其他重要事项

### (一) 或有事项

本公司为关联方提供的担保事项如下：

2007年12月31日，本公司为子公司提供保证担保的情况：

单位：元/美元

被担保单位	贷款金融机构	币种	担保借款余额	担保借款期限
立立半导体	中国农业银行宁波保税区支行	RMB	5,000,000.00	2007-03-13 至 2008-03-12
立立半导体	中国农业银行宁波保税区支行	RMB	5,000,000.00	2007-08-24 至 2008-08-23
立立半导体	中国农业银行宁波保税区支行	RMB	5,000,000.00	2007-09-06 至 2008-09-05
立立半导体	中国农业银行宁波保税区支行	RMB	5,000,000.00	2007-10-09 至 2008-10-08
立立半导体	上海浦东发展银行宁波分行 开发区支行	RMB	7,000,000.00	2007-09-28 至 2008-03-28



立立半导体	上海浦东发展银行宁波分行 开发区支行	RMB	5,000,000.00	2007-10-10 至 2008-04-10
立立半导体	交通银行股份有限公司宁波 分行	RMB	5,000,000.00	2007-12-29 至 2008-06-09
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	RMB	8,000,000.00	2007-03-19 至 2008-03-18
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	RMB	5,000,000.00	2007-08-27 至 2008-02-26
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	RMB	10,000,000.00	2007-10-10 至 2008-04-07
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	USD	800,000.00	2007-04-04 至 2008-04-03
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	USD	500,000.00	2007-06-29 至 2008-06-28
立立半导体	中国银行宁波保税区支行	USD	300,000.00	2007-04-12 至 2008-04-11
立立半导体	中国工商银行宁波市江东支 行	RMB	25,000,000.00	2005-06-29 至 2009-06-25
立昂电子	中国银行浙江省分行	RMB	10,000,000.00	2007-07-11 至 2008-07-11
立昂电子	中国银行浙江省分行	RMB	10,000,000.00	2007-08-06 至 2008-08-06
立昂电子	招商银行杭州凤起支行	RMB	10,000,000.00	2007-09-03 至 2008-09-03

## (二) 其他重要事项

### 1、报告期内公司发生的相关政府补助情况

本公司政府补助均限定了用途，本公司收到的单笔金额在 100 万元以上的政府补助来源及其限定用途如下：

#### (1) 报告期已结转损益或权益的政府补助来源及其限定用途

单位：元

拨款方	拨入时间	发文部门	文号	拨入金额	限定用途
宁波保税区财 政局	2005 年 3 月	宁波保税区(出口 加工区) 财政局	甬保财政 [2006]22 号	4,020,000.00	6-8 英寸外 延片项目贷 款贴息
杭州市经济技 术开发区财政 局	2006 年 8 月	杭州经济技术开 发区招商局和杭 州经济技术开发 区财政局	杭经开商 [2006]228 号、杭经开 财	2,300,000.00	贷款贴息

			[2006]074号		
杭州市经济技术开发区财政局	2005年12月	杭州经济技术开发区财政局	杭经开财[2005]120号	3,015,000.00	水电费补贴

## (2) 报告期尚未结转损益或权益的政府补助来源及其限定用途

单位：元

拨款方	拨入时间	发文部门	文号	拨入金额	限定用途
信息产业部	2007年12月	信息产业部	信部运[2008]14号	2,000,000.00	300mm 微氮硅抛光片的研制
信息产业部	2007年7月	信息产业部	信部运[2007]3号	9,000,000.00	8英寸微氮重掺砷硅外延片
宁波保税区财政局	2005年9月	宁波保税区(出口加工区)财政局	甬保财政[2006]12号	2,500,000.00	8—12英寸硅外延片高技术产业示范工程
宁波保税区财政局	2005年6月	宁波市财政局	甬财政工[2005]361号	5,000,000.00	8—12英寸硅外延片高技术产业示范工程
宁波保税区财政局	2005年5月	宁波市财政局	甬财政工[2005]230号	5,000,000.00	8—12英寸硅外延片高技术产业示范工程
信息产业部	2006年4月	信息产业部	信部运[2005]637号	4,000,000.00	0.13umIC 用 8英寸硅单晶抛光片
宁波保税区财政局	2005年5月	宁波保税区财政局	甬财政教[2005]246号	4,000,000.00	8英寸抛光硅片

## 2、公司所获政府补助的依据及会计处理

## (1) 公司所获政府补助的宏观政策依据

公司所处半导体产业是国家重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府在 WTO 框架内针对国内半导体产业提供了各项优惠政策，从鼓励产业发展、税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化以及知识产权保护等方面对国内半导体产业发展加大了扶持力度，相关政策和规定主要包括：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要

(2006-2020年)若干配套政策的通知(国发[2006]6号)》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发[2000]18号)》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展政策细则》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知(财税[2000]25号)》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知(财税[2002]70号)》、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》等。此外,国家改革与发展委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》将“6英寸及以上单晶硅、多晶硅及晶片制造”列入鼓励类目录;国家改革与发展委员会、科学技术部和商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2004年度)》将“8-12英寸单晶硅及硅外延片”列入优先发展的电子材料。

此外,公司是中国最大的重掺硅抛光片和硅外延片生产基地之一,抛光片和硅外延片市场占有率均位于行业前列,且品牌知名度较高,具有雄厚的研发实力,中央政府及当地政府均给予大力扶持,公司每年可获得部分政府补助。

## (2) 公司所获政府补助的具体依据

报告期内立立电子公司所获取的政府补助的具体情况如下:

①立立电子公司2007年度收到政府补助共计13,675,236.82元,其相关批准文件及账务处理的依据如下:

单位:元

项目名称	拨入时间	拨入金额	发文部门	文号	会计处理
300mm微氮硅抛光片的研制	2007年12月	2,000,000.00	信息产业部	信部运[2008]14号	注1
8英寸微氮重掺砷硅外延片	2007年7月	9,000,000.00	信息产业部	信部运[2007]3号	注2
奖励资金	2007年6月	5,000.00	宁波保税区(出口加工区)环境保护局	甬保环[2007]5号	注3
科研项目经费补贴	2007年2月	200,000.00	宁波科学技术局和宁波市财政局	甬科计[2006]160号和甬财政教[2006]1046号	注4
工程技术中心奖励款	2007年1月	500,000.00	宁波保税区管理委员会	甬保税收[2007]7号	注5
十佳企业奖励	2007年1月	100,000.00	宁波保税区管理委员会	甬保税收	注6

			会	[2007]2号	
固定资产投资补助	2007年7月	600,000.00	杭州经济技术开发区财政局	杭经开财[2007]35号	注7
水电费补贴	2007年6月	520,236.82	杭州经济技术开发区招商局和杭州经济技术开发区财政局	杭经开商[2007]151号和杭经开财[2007]36号	注8
奖励资金	2007年4月	50,000.00	杭州经济技术开发区管理委员会	杭经开管[2006]73号	注9
大直径重掺硅单晶研发创新平台	2007年2月	700,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局	区科技[2006]22号	注10
<b>合计</b>	-	<b>13,675,236.82</b>	-	-	-

注 1：所涉及的项目尚未完工，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助暂列入“递延收益”；

注 2：所涉及的项目尚未完工，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助暂列入“递延收益”；

注 3：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 4：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 5：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 6：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 7：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的固定资产投资补助列入“递延收益”，并于 2007 年摊入“营业外收入”120,000.00 元；

注 8：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 9：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助直接列入“营业外收入”；

注 10：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，所收的政府补助列入“递延收益”，并于 2007 年摊入“营业外收入”525,000.00 元；

②立立电子公司 2006 年度收到政府补助共计 8,647,831.83 元，其相关批准

文件及账务处理的依据如下：

单位：元

项目名称	拨入时间	拨入金额	发文部门	文号	会计处理
6英寸重掺磷直拉单晶硅生产技术的研制	2006年8月	187,500.00	宁波市科学技术局、宁波市财政局	甬科计[2006]51号、甬财政教[2006]315号	注1
十佳企业奖励资金	2006年1月	100,000.00	宁波保税区(出口加工区)经济发展局	甬保经发[2006]18号	注2
浙江省名牌产品奖励资金	2006年1月	500,000.00	宁波保税区(出口加工区)财政局	甬保财政[2006]22号	注3
0.13umIC用8英寸硅单晶抛光片	2006年4月	4,000,000.00	信息产业部	信部运[2005]637号	注4
贷款贴息	2006年8月	2,300,000.00	杭州经济技术开发区招商局和杭州经济技术开发区财政局	杭经开商[2006]228号、杭经开财[2006]074号	注5
水电费补贴	2006年8月	583,057.38	杭州经济技术开发区招商局和杭州经济技术开发区财政局	杭经开商[2006]229号、杭经开财[2006]075号	注6
出口奖励资金	2006年2月	101,274.45	杭州市对外贸易经济合作局和杭州市财政局	杭外经贸计财[2005]258号、杭财企二[2005]690号文	注7
6英寸功率半导体芯片产业化	2006年1月	288,000.00	杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局	杭发改高技[2005]1327号、杭财企一[2005]1098号	注8
6英寸功率半导体芯片产业化	2006年1月	288,000.00	杭州经济技术开发区财政局、杭州经济技术开发区经济发展局	杭经开财[2006]005号	注9
大直径重掺硅单晶研发创新平台	2006年3月	300,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局	区科技[2005]25号、区财[2005]156号	注10
合计	-	8,647,831.83	-	-	-

注1：该研制项目尚在实施中,根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

注2：根据宁波保税区(出口加工区)经济发展局《关于“十佳”奖励资金的确认函》（甬保经发[2006]18号），该奖励可以用于奖励有功人员，公司收到时列“专项应付款”，发放时冲减“专项应付款”，目前尚余额90,000.00元；

注3：根据《企业会计制度》及其相关规定，在公司实际收到时列入“补贴收入”；

注4：所涉及的项目尚在实施中，根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

注5：根据财政部《关于企业技术改造贴息资金财务处理的函》（财企(2000)485号）的

规定，公司在实际收到时冲减“财务费用”；

注 6：根据《企业会计制度》及其相关规定，在公司实际收到时列入“补贴收入”；

注 7：根据《企业会计制度》及其相关规定，在公司实际收到时列入“补贴收入”；

注 8、注 9：所涉及的项目尚在实施中，根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

注 10：所涉及的项目尚在实施中，根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

③立立电子公司 2005 年度收到政府补助共计 29,005,157.06 元，其相关批准文件及账务处理的依据如下：

单位：元

项目名称	拨入时间	拨入金额	发文部门	文号	会计处理
2003 年度浙江省高新技术企业奖励费	2005 年 9 月	700,000.00	宁波保税区（出口加工区）财政局	甬保财政[2006]12 号	注 1
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 9 月	2,500,000.00	宁波保税区（出口加工区）财政局	甬保财政[2006]12 号	注 2
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 6 月	5,000,000.00	宁波市财政局	甬财政工[2005]361 号	注 3
8—12 英寸硅外延片高技术产业示范工程	2005 年 5 月	5,000,000.00	宁波市财政局	甬财政工[2005]230 号	注 4
6-8 英寸外延片项目贷款贴息	2005 年 3 月	4,020,000.00	甬保财政[2006]22 号	《关于确认宁波立立电子股份有限公司取得财政资金事项的函》	注 5
十佳企业奖励资金	2005 年 2 月	100,000.00	宁波保税区（出口加工区）经济发展局	甬保经发[2006]18 号	注 6
4-6 英寸重掺砷硅单晶锭技改	2005 年 1 月	160,000.00	宁波市财政局	甬财政外[2004]700 号	注 7
8 英寸抛光硅片	2005 年 5 月	4,000,000.00	宁波保税区财政局	甬财政教[2005]246 号	注 8
8 英寸抛光片产业化技术研究	2005 年 5 月	600,000.00	宁波市科学技术局、宁波市财政局	甬科计[2005]51 号、甬财政教[2005]200 号	注 9
水电费补贴	2005 年 12 月	3,015,000.00	杭州经济技术开发区财政局	杭经开财[2005]120 号	注 10
出口奖励资金	2005 年 12 月	101,274.00	杭州市对外贸易经济合作局和杭州市财政局	杭外经贸计财[2005]258 号、杭财企二[2005]690 号文	注 11
奖励	2005 年 11 月	2,160.00	杭州经济技术开发区管理委员会	杭经开管发[2005]102 号	注 12
增值税返还	2005 年	3,806,723.06	宁波经济技术开发区（保税区）国家税务	宁波经济技术开发区（保	注 13

			局	税区)国家税务局	
合计		29,005,157.06	-	-	-

注 1：根据宁波保税区（出口加工区）财政局《关于确认宁波立立电子股份有限公司取得财政资金事项的函》（甬保财政[2006]12 号），该奖励可以用于有功人员奖励，公司收到时列入“专项应付款”，发放时冲减“专项应付款”，截至 2007 年 12 月 31 日止，已发放完毕。

注 2、注 3、注 4：所涉及的项目尚在实施中，根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

注 5：根据财政部《关于企业技术改造贴息资金财务处理的函》（财企(2000)485 号）的规定，公司在实际收到时冲减“财务费用”；

注 6：根据宁波保税区(出口加工区)经济发展局《关于“十佳”奖励资金的确认函》（甬保经发[2006]18 号），该奖励可以用于有功人员奖励，公司收到时列入“专项应付款”，发放时冲减“专项应付款”，已于 2005 年度发放完毕；

注 7：根据财政部《关于企业技术改造贴息资金财务处理的函》（财企(2000)485 号）的规定，公司在实际收到时冲减“财务费用”；

注 8、注 9：所涉及的项目尚在实施中，根据《企业会计制度》及其相关规定，所收款项账列“专项应付款”；

注 10、注 11、注 12、注 13：根据《企业会计制度》及其相关规定，在公司实际收到时列入“补贴收入”；

### 十三、 发行人主要财务指标

财务指标	2007 年度	2006 年度	2005 年度
流动比率（倍）	1.43	1.50	1.04
速动比率（倍）	1.01	0.83	0.55
资产负债率（母公司）（%）	38.83	41.69	51.37
应收账款周转率（次/年）	5.23	4.57	3.10
存货周转率（次/年）	2.04	1.78	1.51
息税折旧摊销前利润（万元）	17,765.31	14,959.06	11,580.06
利息保障倍数（倍）	8.56	6	4.12
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.13	1.43	1.27
每股收益（元）	1.15	0.78	0.60
净资产收益率（全面摊薄）（%）	24.75	19.66	19.02

净资产收益率（加权平均）（%）	26.62	22.09	19.96
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）	0.02	0.03	0.05

## 十四、 净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

### （一） 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率（%）					
	全面摊薄			加权平均		
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
	年度	年度	年度	年度	年度	年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.75	19.66	19.02	26.62	22.09	19.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.57	18.56	15.30	24.28	20.85	16.06

### （二） 每股收益

#### 1、 明细情况

报告期利润	每股收益(元/股)					
	基本每股收益			稀释每股收益		
	2007 年度	2006 年度	2005 年度	2007 年度	2006 年度	2005 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.78	0.60	1.15	0.78	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.74	0.48	1.05	0.74	0.48

#### 2、 计算过程

##### （1） 基本每股收益



单位：元

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
归属于普通股股东的当期净利润	88,981,291.02	56,975,245.10	42,413,915.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	81,155,481.47	53,776,595.74	34,124,137.18
期初股本总额	77,080,000.00	71,080,000.00	71,080,000.00
本期增加股本	-	6,000,000.00	-
本期增加股本月份	-	8 月	-
本期减少股本	-	-	-
本期减少股本月份	-	-	-
当期普通股加权平均数*	77,080,000.00	73,080,000.00	71,080,000.00
基本每股收益(归属于普通股股东的当期净利润)	1.15	0.78	0.6
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	1.05	0.74	0.48

注\*：公司在不影响计算结果合理性的前提下，对本期增加股本时间、报告期时间和已回购时间等采用了简化的计算方法即按月来计算。

各年度普通股加权平均数计算过程如下：

单位：股

期间	计算过程	当期普通股加权平均数
2007 年度	$77,080,000.00 \times 12/12$	77,080,000.00
2006 年度	$71,080,000.00 + 6,000,000.00 \times 4/12$	73,080,000.00
2005 年度	$71,080,000.00 \times 12/12$	71,080,000.00

(2) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予以计算稀释性每股收益。

## 十五、 历次验资情况

公司自成立以来，共进行了七次验资，具体情况如下：

1、2000 年 6 月 8 日，宁波永德会计师事务所对公司设立时的实收资本情况进行了验证，并出具了《验资报告》（永德验字[2000]80 号），确认截至 2000 年 6 月 8 日宁波海纳及陈伯良等 45 名自然人现金出资 1,000 万元，公司实收注册资本为 1,000 万元。

2、2000 年 12 月 25 日，宁波永德会计师事务所对公司注册资本由 1,000 万元增加到 1,302 万元的实收资本情况进行了验证，并出具《验资报告》（永德验

字[2000]169号), 确认截至2000年12月25日杨在亮等38名自然人现金出资302万元, 公司的实收注册资本为1,320万元。

3、2002年2月26日, 浙江东方会计师事务所有限公司对公司减少注册资本300万元的实收资本情况进行了验证, 并出具《验资报告》(浙东会验[2002]字第18号), 确认截至2001年12月25日, 公司已减少注册资本300万元, 公司实收注册资本为1,002万元。

4、2002年7月1日, 浙江东方会计师事务所有限公司对公司注册资本由1,002万元增加到2,054万元的实收资本情况进行了验证, 并出具了《验资报告》(浙东会验[2002]第78号), 确认截至2002年7月1日陈伯良等51名自然人股东以每股人民币3元的价格认购股份, 增资后公司实收注册资本为2,054万元。

5、2002年9月11日, 浙江东方会计师事务所有限公司对公司注册资本由2,054万元增加到4,108万元的实收资本情况进行了验证, 并出具了《验资报告》(浙东会验[2002]第115号), 确认截至2002年8月31日公司以资本公积2,054万元转增股本, 公司实收注册资本为4,108万元。

6、2004年11月2日, 浙江东方会计师事务所有限公司对公司注册资本由4,108万元增加到7,108万元的实收资本情况进行了验证, 并出具《验资报告》(浙东会验[2004]第156号), 确认截至2004年10月29日王敏文等7名自然人现金出资5,700万元, 公司实收注册资本为7,108万元。

7、2006年8月21日, 浙江东方会计师事务所有限公司对公司注册资本由7,108万元增加到7,708万元的实收资本情况进行了验证, 并出具了《验资报告》(东方中汇会验[2006]2192号), 确认截至2004年8月18日公司注册资本增至7,708万元。

## 十六、 评估情况

公司设立时以及报告期内未进行过资产评估。

## 十七、 备考利润表

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定, 本公司假

定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则，在分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响的基础上，按照追溯调整的原则，确定可比期间最早期初资产负债表，以此为起点，编制比较期间的备考利润表如下：

### 1、备考合并利润表

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度
一、营业收入	364,379,633.83	258,809,599.85
减：营业成本	230,058,909.25	177,417,250.17
营业税金及附加	2,205,728.37	1,321,344.44
销售费用	7,241,891.54	6,362,490.63
管理费用	41,997,592.21	25,124,917.86
财务费用	15,360,240.54	13,859,081.03
资产减值损失	-2,046,851.27	1,271,433.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,562,123.19	33,453,081.98
加：营业外收入	9,270,414.51	15,683,105.80
减：营业外支出	217,003.89	84,817.73
其中：非流动资产处置损失		5,196.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,615,533.81	49,051,370.05
减：所得税费用	16,778,302.95	2,464,936.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,837,230.86	46,586,433.70
归属于母公司股东的净利润	61,365,454.87	46,741,592.86
少数股东损益	471,775.99	-155,159.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.66
（二）稀释每股收益	0.84	0.66

### 2、备考母公司利润表

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度
一、营业收入	278,960,393.04	200,318,057.32
减：营业成本	202,805,879.28	146,891,945.64

营业税金及附加	670,187.46	219,336.02
销售费用	5,591,594.31	5,547,645.52
管理费用	21,034,605.44	11,439,122.51
财务费用	7,014,466.92	6,669,366.61
资产减值损失	-2,861,685.75	3,998,857.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,705,345.38	25,551,783.62
加：营业外收入	3,270,157.11	8,625,374.62
减：营业外支出	104,752.20	27,050.93
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,870,750.29	34,150,107.31
减：所得税费用	9,232,721.48	5,406,962.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,638,028.81	28,743,144.98

## 第十一节 管理层讨论与分析

### 一、公司财务状况分析

#### (一) 资产质量与结构分析

##### 1、报告期内资产构成及变动情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 72,376.43 万元，主要由流动资产和固定资产构成，全部为生产经营性资产。报告期内流动资产占总资产的比重保持在 44%-58%，固定资产占总资产的比重保持在 34%-48%，其他资产所占比重较低。下表列示了本公司的总资产构成情况(按扣除折旧、减值准备后的净值列示)：

单位：万元

项 目	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	42,059.28	58.11%	28,204.99	49.06%	26,317.45	44.49%
非流动资产	30,317.15	41.89%	29,284.35	50.94%	32,837.55	55.51%
其中：固定资产	24,545.72	33.91%	26,921.73	46.83%	28,870.55	48.80%
在建工程	3,911.21	5.40%	210.08	0.37%	1,273.79	2.15%
无形资产	1,316.78	1.82%	1,352.55	2.35%	1,387.14	2.35%
合计	<b>72,376.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,489.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,155.00</b>	<b>100.00%</b>

公司资产构成情况与所从事的生产经营活动特点相适应，结构合理、稳定。

##### 2、流动资产分析

截至 2007 年 12 月 31 日，公司流动资产 42,059.28 万元，占总资产的 58.11%，主要为存货、应收账款、货币资金和预付款项，分别占流动资产的 29.46%、24.60%、21.42%和 19.94%。

单位：万元

项 目	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	9,009.08	21.42%	4,851.01	17.20%	3,287.62	12.49%
应收票据	1,679.81	3.99%	767.69	2.72%	398.07	1.51%
应收账款	10,345.34	24.60%	5,654.97	20.05%	8,836.92	33.58%
预付款项	8,386.38	19.94%	4,223.26	14.97%	1,036.30	3.94%
其他应收款	246.62	0.59%	89.34	0.32%	206.84	0.79%
存货	12,392.06	29.46%	12,618.71	44.74%	12,551.71	47.69%

流动资产合计	42,059.28	100.00%	28,204.99	100.00%	26,317.45	100.00%
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

### (1) 货币资金

货币资金2007年末余额较2006年末余额增加85.72%，主要系销售增加、借款增加等因素合计影响所致；货币资金2006年末余额较2005年末余额增加47.55%，主要系销售增加、增资等因素合计影响所致。

### (2) 应收账款

报告期内公司应收账款余额变化情况如下表所示：

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
应收账款账面余额（万元）	11,151.74	6,247.57	9,640.77
应收账款较上期期末增长比例	78.50%	-35.20%	36.88%
应收账款账面余额占主营业务收入的比例	24.52%	17.21%	37.30%
应收账款占流动资产比例	24.60%	20.05%	33.58%

报告期内公司应收账款的形成主要与公司给与客户的信用期限（即赊销期）有关，同时还受硅片产品市场供求关系是否平稳影响。

#### ①应收账款余额波动分析

2005年末，公司应收账款余额增长较快，主要系公司当年主营业务收入快速增长所致。2006年公司主导产品市场供不应求、销售形势良好，公司同时采取了一系列加强销售管理的措施，使销售回款速度进一步加快，因此在销售收入大幅增长的同时，2006年期末应收账款余额比期初大幅下降了35.20%，占流动资产比重也由2005年末的33.58%降至20.05%。

2007年12月31日，公司应收账款余额较2006年末有较大幅度上升，其主要原因在于：（1）2006年下半年公司产品供不应求，很多客户为争取货源而加快回款甚至预付货款，从而使期末应收账款低于通常水平，较低的比较基数是造成2007年12月31日应收账款余额较2006年末增幅较大的重要原因之一；（2）2007年公司销售收入较上年同期有较大幅度增长，增幅达25.42%；

（3）进入2007年度，公司主导产品供不应求的状况有所改变，为加大营销力度，巩固市场份额，公司对部分核心优质客户放宽了销售条件，适当延长了赊销期。

## ②信用政策分析

报告期内，公司主要根据产品的质量、性能、市场的变化情况并结合客户的资信状况和重要性等制定并调整信用政策，在产品供求比较平稳的时候，一般给予客户不超过四个月的赊销期，对大客户可适当延长 1 个月左右；公司在产品供不应求比较明显的时候，赊销期相应缩短，一般为 1-2 个月。

因此，在一般情况下，立立电子的 2005~2007 年的应收账款周转率约为 3-5 次/年。报告期内公司应收账款周转率与同行业其它企业比较如下表：

公司名称	2007 年度	2006 年度	2005 年度
有研硅股	5.9	4.77	3.48
中环股份	4.96	3.92	2.88
立立电子	5.25	4.57	3.10

报告期内公司应收账款占流动资产的比例与同行业其它企业比较如下表：

公司名称	2007 年度	2006 年度	2005 年度
有研硅股	23.39%	24.26%	20.99%
中环股份	21.76%	31.99%	26.94%
立立电子	24.60%	20.05%	33.58%

总的来看，由于公司既定信用政策的影响，虽然报告期内公司应收账款期末余额波动较大，但公司应收账款周转率、应收账款占流动资产的比例等指标与同行其它企业相比水平基本相当，变动趋势大致保持一致，与行业的经营特点相符。

## ③客户结构分析

报告期内各期间前 10 大客户的名称、应收帐款余额。

### a.2007 年底应收账款余额的前十名客户情况

客户	应收账款余额(万元)
杭州士兰集成电路有限公司	2,166
Evershine (STM)	1,526
ONSEMI	834
无锡华润晶芯半导体有限公司	821
扬州晶新微电子有限公司	754
北京燕东微电子有限公司	401
深圳深爱半导体有限公司龙岗分厂	398

扬州虹扬电子有限公司	386
上海先进半导体制造有限公司	313
福建福顺微电子有限公司	322
合 计	7,921
占应收账款总额比例	77%

## b.2006 年底应收账款余额的前十名客户情况

客 户	应收账款余额(万元)
Evershine(STM)	977
扬州晶新微电子有限公司	472
济南晶恒有限责任公司	438
上海先进半导体制造有限公司	409
无锡华润晶芯半导体有限公司	333
杭州士兰集成电路有限公司	333
SCI LLC	263
GlobiTech Incorporated	245
上海新进半导体制造有限公司	243
常州银河半导体有限公司	231
合 计	3,943
占应收账款总额比例	63%

## c.2005 年底应收账款余额的前十名客户情况

客 户	应收账款余额(万元)
上海新进半导体制造有限公司	906
Evershine(STM)	771
杭州士兰集成电路有限公司	684
扬州晶新微电子有限公司	607
济南晶恒有限责任公司	597
ONSEMI	552
北京燕东微电子有限公司	537
上海先进半导体制造有限公司	530
无锡华润晶芯半导体有限公司	456
SCG	361
合 计	6,001
占应收账款总额比例	62%

从客户结构看，报告期内各期前十名客户分布基本保持稳定，客户主要为



Evershine(STM)、上海先进半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司、无锡华润晶芯半导体有限公司、杭州士兰集成电路有限公司、扬州晶新微电子有限公司等国内外知名集成电路和分立器件生产厂商，各期期末前十名客户应收账款余额合计占当期应收账款余额的比例均在 60%以上，这些客户实力雄厚，信用良好，大多与公司建立了良好的长期合作关系，均未出现过坏账情况。

#### ④应收账款结构分析

报告期内公司应收账款账龄结构比较合理，账龄一年以内应收账款占应收账款总额的比例基本保持在 90%以上。2007 年 12 月 31 日和 2006 年 12 月 31 日应收账款结构及计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2007 年 12 月 31 日				2006 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏帐准备	账面价值
1 年以内	10,854.88	97.34	542.74	10,312.14	5,847.11	93.59	292.36	5,554.75
1 至 2 年	27.93	0.25	5.59	22.35	47.03	0.75	9.41	37.63
2 至 3 年	2.05	0.02	0.62	1.44	56.08	0.9	16.83	39.26
3 至 5 年	18.84	0.17	9.42	9.42	271.8	4.35	248.47	23.33
5 年以上	248.04	2.22	248.04	-	25.54	0.41	25.54	-
合计	11,151.74	100	806.40	10,345.34	6,247.57	100	592.6	5,654.97

截至 2007 年 12 月 31 日，账龄在一年以内应收账款占应收账款总额的比例为 97.34%，较上年末进一步提高。公司将进一步加强对应收款项的控制和管理，力争将发生坏账的可能性降到最低程度。

#### ⑤应收账款资金回笼分析

报告期内销售收入的回款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
销售商品、提供劳务所收到的现金	42,520.91	40,746.00	24,111.92
营业收入	45,699.94	36,437.96	25,880.96
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例	93.04%	111.82%	93.16%

2006 年公司在销售收入较上年大幅增长 40.47%的情况下，销售商品、提

供劳务所收到的现金占营业收入的比例却达 111.82%，明显高于正常水平，主要原因是公司产品的供不应求使得销售回款速度加快，部分客户预付货款，销售的现金回笼金额大于当期销售收入。报告期内公司在销售收入保持快速增长的同时，每年销售资金回笼在 93% 以上，公司的资金周转能力较强。

总的来看，立立电子应收账款余额的变动与公司产品的市场供求情况、主营业务收入和流动资产的增长基本匹配，处于合理的变动范围内。

应当注意的是，随着公司主营业务收入的快速增长，公司应收账款余额仍有进一步增加的可能，存在一定的坏账风险。特别是随着公司产销规模的不断扩大和市场不断拓展，公司将会与其他新客户建立交易关系，由于对新客户信用、偿债能力等情况的了解需要时间，因此开拓新客户亦会存在一定的信用风险。

报告期内，公司无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

## （2）存货

2005 年、2006 年和 2007 年期末公司存货金额在流动资产中所占比例分别为 47.69%、44.74%、29.46%。2007 期末年存货在流动资产中占比下降幅度较大的主要原因系预付款和货币资金增加较多导致流动资产基数增加。

报告期内，公司存货结构情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
库存材料	4,416.80	35.64%	5,981.38	47.40%	5,223.05	41.61%
库存商品	4,392.00	35.44%	3,868.29	30.66%	4,169.11	33.22%
在产品	3,000.73	24.21%	2,769.04	21.94%	2,809.18	22.38%
委托加工材料	570.86	4.61%	-	-	350.37	2.79%
材料采购	11.66	0.09%	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,392.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,618.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,551.71</b>	<b>100.00%</b>

### ①库存材料

报告期内，库存材料在存货所占比重最大，其主要原因是：

a. 原材料在公司主导产品成本构成中所占比重较大，报告期内平均占比为 54.82%。

b.公司产品覆盖的产业链比较长，每一道工序都需要保持一定水平的原材料储备，而大部分原材料均从国外进口，从发出订单到材料入库至少需三个月。因此，为保持生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点和安全库存。

c.公司主要原材料多晶硅等供应趋紧，价格持续上涨，为降低生产成本和确保公司生产经营活动正常进行，公司需保持相当数量的重要原材料库存。

## ②库存商品

报告期内，公司存货中库存商品约占30%，比例较高，主要原因如下：

a.由于公司产品覆盖产业链较长，且不同产品分别由母公司和不同子公司生产，因此产生了大量的内部销售，虽反映为库存商品，但实际应为在产品。具体来说，公司主要产品的产业链为：多晶硅→单晶锭→抛光片→外延片→肖特基芯片。单晶锭和外延片由立立电子母公司生产；抛光片由子公司立立半导体生产；肖特基芯片由子公司立昂电子生产。其中，单晶锭全部内部销售，抛光片、外延片部分用于继续加工形成内部销售，其余外部销售。由于公司前端产品中相当一部分将用作继续加工生产后端产品，因此部分中间环节产品被列为库存商品，如公司下属子公司立立半导体生产的硅抛光片中约30%用于继续加工生产硅外延片，但仍列为库存商品。公司财务报表附注披露的库存商品实际可划分用于内部销售的库存商品和用对外销售的库存商品，具体如下表所示：

单位：万元

时间	库存商品余额	直接对外销售		用于下一环节生产	
		账面余额	占比	账面余额	占比
2007年12月31日	4,576.81	2,019.78	44%	2,557.03	56%
2006年12月31日	4,153.70	2,382.64	57%	1,771.06	43%
2005年12月31日	4,454.53	1,894.04	43%	2,560.49	57%

报告期内各期末库存商品中用于内部销售的比例约占库存商品的一半左右，公司产品覆盖产业链较长是公司库存商品比例较高的主要原因。

b.由于公司主导产品具有客户固定和批次生产的特点，为满足部分主要客户不时发出的定单需求，同时减少小批次生产带来的较高成本，公司会采取适度扩大批次生产规模的策略，该策略在及时满足客户需求和降低单位产品生产成本的同时，也会造成库存商品的增加。

## ③存货周转率

报告期内公司与同行业存货周转率情况如下表所示：

单位：次/年

公司名称	2007年	2006年	2005年
有研硅股	2.17	1.60	1.09
中环股份	2.43	1.95	1.32
立立电子	2.04	1.78	1.51

公司存货周转率与同行其它企业相比水平基本相当，符合行业的经营特点。

## ④存货跌价准备

B报告期内，存货跌价准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2006-12-31	2007年增加	2007年减少		2007-12-31
			转回	转销	
库存商品	285.42	-	-	100.61	184.81
委托加工材料	-	19.32	-	-	19.32
合 计	285.42	19.32	-	100.61	204.13

2005年度本公司对存放时间较长，已陈旧过时，并有质量问题的部分单晶硅锭计提100.61万元的存货跌价准备；2007年3月本公司对已提存货跌价准备的库存商品重新利用，因此将该部分存货跌价准备转销；2003年度子公司立立半导体对存在质量问题的部分抛光片计提了184.81万元的存货跌价准备，2007年期末上述库存商品仍未出售，可变现净值也无显著变化故所提存货跌价准备予以保留；2007年度子公司立昂电子本期对拟用于出售的废旧靶材计提了19.32万元的存货跌价准备；除以上存货外的其他存货账龄或库龄都较短，没有残次冷背情况，期末无减值情形，无需计提存货跌价准备。

## (3) 预付款项

报告期内预付账款余额变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
预付账款余额	8,386.38	4,223.26	1,036.30

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
变动幅度	98.58%	307.53%	464.13%
占流动资产比例	19.94%	14.97%	3.94%

2005年末公司预付账款较少,占流动资产的比例为3.94%;2006年末和2007年末的预付账款明显增加,占流动资产的比例分别上升至14.97%和19.94%。2006年末余额较上年末余额增加3.08倍,主要是公司为规避原材料涨价风险,与境外原材料供应商签订长期原材料采购合同,并按合同约定预付了较多材料采购款所致;2007年末余额较2006年末余额增加98.58%,主要系原材料采购规模进一步扩大及与境外原材料供应商签订的长期采购合同预付部分材料款所致。

截至2007年12月31日,本公司的预付款项几乎全部为账龄一年以内的购货款。无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款,无预付关联方款项。

### 3、固定资产

截至2007年12月31日,公司固定资产总体情况如下:

单位:万元

项目	原值	占固定资产比例 (以原值计)	账面价值	占固定资产比例 (以账面价值计)	财务成新率
房屋建筑物	10,853.28	21.30%	9,489.76	38.66%	87.44%
通用设备	7,487.14	14.69%	3,135.84	12.78%	41.88%
专用设备	31,551.04	61.92%	11,410.76	46.49%	36.17%
运输设备	299.78	0.59%	134.39	0.55%	44.83%
其他设备	765.87	1.50%	374.96	1.53%	48.96%
合计	<b>50,957.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,545.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>48.17%</b>

截至2007年12月31日,公司固定资产原值50,957.12万元,账面价值24,545.72万元,整体财务成新率为48.17%。固定资产中专用设备约占固定资产原值的61.92%,主要是用于单晶生长和硅抛光片、硅外延片、肖特基功率芯片等产品生产的设备,如单晶炉、切片机、倒角机、抛光机、磨片机、外延炉等。详细情况参见本招股意向书“第六节业务与技术”之“六、公司的固定资产与无形资产”。

报告期内主要固定资产原值变动情况：

单位：万元

项目	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	原值	增长比例	原值	增长比例	原值	增长比例
房屋建筑物	10,853.28	0.00%	10,853.28	3.77%	10,458.75	1.66%
通用设备	7,487.14	4.61%	7,157.32	9.57%	6,009.90	19.87%
专用设备	31,551.04	10.57%	28,533.69	11.75%	26,041.06	20.64%
运输设备	299.78	0.00%	299.78	6.16%	282.43	0.00%
其他设备	765.87	14.39%	669.53	25.40%	536.99	60.84%
<b>合计</b>	<b>50,957.12</b>	<b>7.25%</b>	<b>47,513.60</b>	<b>9.66%</b>	<b>43,329.13</b>	<b>15.53%</b>

近年来，随着公司产能的提升，同时为进一步提高产品质量和成品率，公司不断购置新的生产设施和各种设备，2005年以来公司新增主要固定资产情况如下：

	固定资产名称	规格型号	计量单位	数量	原值（万元）
2007年	单晶炉	CG6000	台	4	769.51
	硅片测试仪	WAFERCHECK7200	台	1	384.24
	单晶炉	KX150	台	1	358.07
	硅片测试仪	WIS-CR82	台	1	291.12
	频率发生器	QLS07-SP-02	台	3	106.68
	汞探针硅片电阻率测试仪	QL07-SP-46	台	1	119.36
	硅片扩展电阻率测试仪	QL07-SP-46	台	1	250.81
	外延炉	LPE2061	台	2	1,620.29
	红外线测厚仪	NICOLET ECO 1000S	台	1	131.43
2006年	线切割机	DS261/4	台	1	523.52
	片盒清洗机	ULTRA-6410	台	1	207.66
	磨片机	MABUCHI	台	1	159.47
	单晶厂房				226.23
	外延炉及其配件	PE3061D	台	1	1,114.01
	光刻机	ALN001	台	1	261.05
2005年	立昂厂房				799.12
	单晶炉	CG6000	台	4	852.54
	外延炉	150MMEPI	台	1	1,820.80
	纯水设备		套	1	465.67
	倒角机	W-GM-4200B-4C	台	1	384.92
	背封机	WJ999R	台	1	137.46
	线切割机	DS261/4	台	1	566.95

公司固定资产状况良好，期末不存在减值迹象，故不需计提减值准备。

#### 4、在建工程

2007年度新增在建工程及结转固定资产情况如下：

单位：万元

工程名称	2006-12-31	2007年增加	2007年转入 固定资产	2007-12-31
8-12英寸硅外延片生产项目	-	2,657.54	-	2,657.54
6-8英寸硅抛光片扩产项目	-	1,200.36	-	1,200.36
6英寸功率半导体芯片生产线技改项目	210.08	21.24	181.60	49.72
8英寸抛光片技术改造项目	-	1,033.25	1,033.25	-
年新增2.4万片6英寸功率肖特基芯片生产线技改	-	3.59	-	3.59
合计	210.08	4,915.98	1,214.85	3,911.21

2007年在建工程进度情况如下表：

单位：万元

工程名称	2007-12-31	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例
8-12英寸硅外延片生产项目	2657.54	借款	10,324万	52.87%
6-8英寸硅抛光片扩产项目	1200.36	借款	44,411万	2.70%
6英寸功率半导体芯片生产线技改项目	49.72	自筹	2,574万	60.22%
年新增2.4万片6英寸功率肖特基芯片生产线技改	3.59	自筹	750万	0.48%
合计	3,911.21	—	58,059万	—

截至2007年12月31日，公司在建工程账面价值3,911.21万元，比2006年12月31日增加3,701.13万元，主要系公司为实施上表所列示项目而购置、安装线切割机、外延炉等相关设备。

截至2007年12月31日，本公司在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 5、资产减值准备计提情况

报告期内，公司提取资产减值准备情况如下表：

单位：万元

项 目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
坏账准备	825.67	620.1	824.78
其中：应收账款	806.40	592.6	803.85
其他应收款	19.27	27.5	20.93
存货跌价准备	204.13	285.42	285.42
其中：库存商品	184.81	285.42	285.42
委托加工材料	19.32	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-
合 计	<b>1,029.80</b>	<b>905.52</b>	<b>1,110.20</b>

公司管理层认为，公司制定了稳健的会计估计政策，符合谨慎性要求，主要资产的减值准备计提充分、合理，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。

## （二） 负债结构及偿债能力分析

### 1、 负债结构分析

报告期内各期末负债的构成情况：

单位：万元

项目	2007-12-31		2006-12-31		2005-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
短期借款	20,223.71	56.14	11,326.05	40.28	12,085.88	33.06
应付账款	2,267.64	6.30	1,721.86	6.12	3,484.75	9.53
预收款项	754.06	2.09	523.96	1.86	17.62	0.05
应付职工薪酬	442.55	1.23	710.64	2.53	761.85	2.08
应交税费	674.08	1.87	288.13	1.02	224.2	0.61



应付利息	51.34	0.14	41.28	0.15	45.56	0.12
应付股利		-	-		21.39	0.06
其他应付款	702.98	1.95	457.65	1.63	918.56	2.51
一年内到期的非流动负债	4,261.32	11.83	3,767.00	13.40	7,634.76	20.88
其他流动负债		-	-		-	
<b>流动负债合计</b>	<b>29,377.69</b>	<b>81.56</b>	<b>18,836.56</b>	<b>66.99</b>	<b>25,194.57</b>	<b>68.91</b>
长期借款	3,150.09	8.75	6,937.04	24.67	9,467.00	25.89
其他非流动负债	3,493.35	9.70	2,345.86	8.34	1,900.00	5.20
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,643.44</b>	<b>18.44</b>	<b>9,282.90</b>	<b>33.01</b>	<b>11,367.00</b>	<b>31.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,021.13</b>	<b>100.00</b>	<b>28,119.47</b>	<b>100.00</b>	<b>36,561.57</b>	<b>100.00</b>

公司负债主要为银行借款、应付账款。截至2007年12月31日，公司总负债为36,021.13万元，其中流动负债占81.56%，非流动性负债占18.44%；流动负债中，短期借款、应付账款和一年内到期的长期负债分别占负债总额的56.14%、6.30%和11.83%。报告期内，公司短期借款余额保持稳定，而长期借款下降较快，主要是公司经营状况较好，归还了较多的长期借款。

公司目前负债规模符合业务发展需要，负债结构较为合理，对银行借款和供应商贷款的偿付较为及时，无逾期未归还的情况。

## 2、短期借款

报告期内公司的短期借款基本呈逐步上升趋势。截至2007年12月31日，公司的短期借款余额为20,223.71万元，占全部负债的56.14%。其中公司的保证借款为9,168.74万元，均为公司向控股子公司提供的连带责任保证借款。

单位：万元

借款类别	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
信用借款	6,164.97	2,127.83	-
保证借款	9,168.74	6,876.82	9,090.09
抵押借款	4,890.00	2,321.39	2,995.79
<b>合计</b>	<b>20,223.71</b>	<b>11,326.04</b>	<b>12,085.88</b>

### 3、应付账款

2006年12月31日公司应付账款余额为1,721.86万元,2006年末余额较2005年末余额减少50.59%,主要系原材料涨价,供应商要求的信用期限缩短,期末支付了较多的原材料款所致;

2007年12月31日公司应付账款余额为2,267.64万元,较2006年末增长了31.70%,主要系增加应付浙江大学研发费用款项所致;

截至2007年12月31日,公司无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

### 4、应交税费

报告期内,公司应交税费的明细情况如下:

单位:万元

种 类	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
增值税	92.42	42.32	-240.13
城市维护建设税	100.69	9.80	11.87
企业所得税	341.75	187.97	441.26
代扣代缴个人所得税	31.31	40.40	4.42
土地使用税	34.49	-	-
教育费附加	71.92	7.00	6.78
印花税	0.29	-	-
水利建设基金	1.21	0.65	-
合 计	<b>674.08</b>	<b>288.13</b>	<b>224.20</b>

变动原因如下:

(1)2006年应交增值税余额比2005年底增加较大的原因主要系内销收入的增加导致应交增值税的增加;2006年底应交所得税的余额比2005年底减少了57.40%,主要系2006年度多预缴所得税所致。

(2)2007年期末余额比2006年期末余额增加了133.95%的原因主要系:内销销售收入的增加导致应交增值税的增加;2007年预缴所得税减少导致应交企业所得税余额的增加。

### 5、长期借款

2006年末公司长期借款余额较2005年末下降26.70%,2007年末较2006年末

下降了54.59%，其主要原因是公司经营效益大幅上升，现金流良好，偿还大量长期借款。2007年期末公司的保证借款为500万元，均为公司向控股子公司提供的连带责任保证借款。报告期内长期借款的明细情况如下表所示：

单位：万元

借款条件	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
信用借款	1,317.00	2,000.00	200
保证借款	500.00	2,500.00	4,500.00
抵押(质押)借款	1,333.09	2,437.04	4,767.00
合 计	<b>3,150.09</b>	<b>6,937.04</b>	<b>9,467.00</b>

## 6、偿债能力分析

### (1) 偿债能力指标分析

财务指标	2007年	2006年	2005年
流动比率（倍）	1.43	1.50	1.04
速动比率（倍）	1.01	0.83	0.55
资产负债率（母公司）（%）	38.83	41.69	51.37
息税折旧摊销前利润（万元）	17,765.31	14,959.06	11,580.06
利息保障倍数（倍）	8.56	6	4.12
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.13	1.43	1.27
净利润（万元）	8,912.43	5,744.94	4,216.21

报告期内公司流动比率、速动比率呈逐年上升趋势。公司的流动比率倍数从2005年的1.04上升到2007年的1.43，同期速动比率倍数也从0.55上升到1.01，反映公司短期偿债能力不断增强；另外，公司的业绩增长有着良好的现金流基础。良好的经营收益和充沛的经营现金流量增强了公司的偿债能力。

### (2) 公司经营活动现金流量情况分析

经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较：

单位：万元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	8,718.89	11,007.87	9,001.08
净利润	8,912.43	5,744.94	4,216.21
经营活动的现金净流量占净利润的比例	97.83%	191.61%	213.49%

销售商品、提供劳务所收到的现金与收入的比较：

单位：万元

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
销售商品、提供劳务所收到的现金	42,520.91	40,746.00	24,111.92
营业收入	45,699.94	36,437.96	25,880.96
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例	93.04%	111.82%	93.16%

2005 年、2006 年和 2007 年，公司经营活动产生的现金净流量分别占当期净利润的 213.49%、191.61%和 97.83%，销售商品、提供劳务所收到的现金占主营业务收入的比例均达到约 93%以上。良好的经营活动现金流创造能力为公司债务的偿还提供了可靠保障。

### (3) 影响偿债能力的其他因素分析

公司银行资信状况良好，所有银行借款、银行票据等均按期归还，无任何不良记录，亦无或有负债、表外融资等其他影响偿债能力的事项。

## 7、资产周转能力分析

项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
应收账款周转率（次/年）	5.23	4.57	3.1
存货周转率（次/年）	2.04	1.78	1.51

报告期内公司应收账款周转率呈上升趋势，主要原因是公司产品市场需求旺盛，销售形势良好，在经营资金周转、货款回笼等方面的管理水平较高。

报告期内公司存货周转率逐步提高，但存货绝对值偏高的特点符合半导体硅材料行业的特点。具体情况为：公司的多晶硅等主要原材料自国外采购，供应周期较长，公司需作适量储备；存货中库存商品也占相当比例，主要原因是由于公司采取适度扩大批次生产规模，及时满足客户需求和降低单位产品生产成本，由此也造成库存商品的增加；此外，由于公司产品覆盖产业链较长，前端产品中相当一部分将用作继续加工生产后端产品，也相应增加了公司库存。

总体上看，公司的资产周转能力始终处于不断提高的趋势中，说明公司具有较好的资产管理能力。

## 二、盈利能力分析

### (一) 主营业务收入的构成、比例及变化分析

单位：万元

项目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅抛光片	24,595.40	54.08%	19,480.59	53.66%	14,364.57	55.58%
硅外延片	11,009.56	24.21%	7,156.92	19.71%	5,300.12	20.51%
功率肖特基二极管芯片	9,830.15	21.62%	9,550.91	26.31%	6,181.40	23.91%
其他	43.20	0.09%	117.99	0.32%	-	0.00%
合计	<b>45,478.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,306.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,846.09</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司各主导产品销售收入均增长迅速。

2006年公司主营业务收入较上年增长40.47%，主要原因系占公司主营业务收入一半左右的硅抛光片销量较上年同期增长25.02%，同时由于市场销售形势较好，同期平均销售单价上涨约9.95%，由此带来销售收入大幅增长35.62%，占新增销售收入的48.90%。此外，功率肖特基二极管芯片和硅外延片销量分别较上年同期大幅增长35.03%和54.51%，也有力推动了公司主营业务收入的大幅增长。

2007年公司主营业务收入较上年同期增长25.26%，主要原因系硅抛光片销量较上年增长较多，销售收入同比增长26.26%，占新增销售收入的55.77%；同时公司加大了附加值更高的硅外延片的生产和营销力度，销售收入同比增长53.83%，占新增销售收入的42.00%，有力推动了公司主营业务收入的增长。公司功率肖特基二极管芯片销售收入较上年同期增长了2.92%。

本公司主营业务收入根据最终产品的内外销分部信息如下：

单位：万元

项目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	26,555.00	58.39%	18,708.61	51.53%	13,538.60	52.38%
外销	18,923.31	41.61%	17,597.80	48.47%	12,307.49	47.62%

业务收入合计	45,478.30	100.00%	36,306.41	100.00%	25,846.09	100.00%
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

截至2007年12月31日，公司产品境内外销售占比分别为60%和40%左右，国内销售占比较往年有所提高，境外销售占比从2005年的47.62%下降至2007年的41.61%，主要原因是近年来国际著名集成电路芯片生产企业纷纷进入国内设厂，带动了国内硅片需求量大幅上升，公司主营业务收入内销比例逐渐增加；其次，公司下属子公司立昂电子努力保持海外市场销量的同时，大力拓展国内市场，使其内销收入明显增长。

## （二） 主营业务成本变化分析

公司近三年主要产品成本构成情况如下表所示：

单位：万元

产品	成本	2007 年度	2006 年度	2005 年度
抛光片	材料成本	7,297.23	5,947.00	4,712.11
	人工成本	224.82	179.13	191.36
	制造费用	5,195.33	5,340.91	3,916.26
	<b>合计</b>	<b>12,717.38</b>	<b>11,467.05</b>	<b>8,819.73</b>
外延片	材料成本	4,017.56	2,667.06	1,730.80
	人工成本	120.68	74.47	67.4
	制造费用	2,569.99	1,812.76	1,583.57
	<b>合计</b>	<b>6,708.23</b>	<b>4,554.29</b>	<b>3,381.77</b>
功率芯片	材料成本	3,610.92	3,459.06	3,106.05
	人工成本	119.22	94.86	101.33
	制造费用	2,807.83	3,264.94	2,300.33
	<b>合计</b>	<b>6,537.97</b>	<b>6,818.86</b>	<b>5,507.71</b>
其他	材料成本	13.90	88.62	-
	人工成本	0.38	-	-
	制造费用	8.68	-	-
	<b>合计</b>	<b>22.96</b>	<b>88.62</b>	<b>-</b>
合计	材料成本	14,939.61	12,161.74	9,548.96
	人工成本	465.10	348.47	360.09
	制造费用	10,581.83	10,418.61	7,800.16
	<b>合计</b>	<b>25,986.54</b>	<b>22,928.82</b>	<b>17,709.21</b>

从上表可以看出，报告期内公司主要产品成本构成变动不大，主要为材料成本和制造费用。其中，材料成本占总成本的比重平均为57%左右，制造费用占总成本的比重平均为41%左右，而人工成本占总成本的比重较小。

### (三) 期间费用变动趋势及分析

本公司近三年期间费用情况如下：

单位：万元

项目	2007 年度			2006 年度			2005 年度		
	金额	营收占比 (%)	增幅 (%)	金额	营收占比 (%)	增幅 (%)	金额	营收占比 (%)	增幅 (%)
销售费用	703.63	1.55%	-2.84%	724.19	1.99	13.82	636.25	2.46	42.53
管理费用	6,115.49	13.45%	46.51%	4,173.98	11.46	71.44	2,434.72	9.41	55.58
财务费用	1,422.21	3.13%	8.90%	1,306.02	3.58	34.93	967.91	3.74	13.3
<b>合计</b>	<b>8,241.33</b>	<b>18.12%</b>	<b>32.83%</b>	<b>6,204.19</b>	<b>17.03</b>	<b>53.61</b>	<b>4,038.88</b>	<b>15.61</b>	<b>40.94</b>

报告期内，公司十分注重加强对期间费用的管理和控制，在主营业务收入大幅增长的同时，较好地控制了销售费用和财务费用支出。为严格销售费用支出管理，公司着重对运费、差旅费和送样进行控制，通过比选多家货运公司，选择运输质量有保障且价格合理的合作方。

但报告期内管理费用出现较大增幅，2006 年度较 2005 年度增加 71.44%，主要系研究开发费和办公费大额增加所致；2007 年管理费用较 2006 年增长了 46.51%，主要系 2007 年研发费用支出达 2,819.28 万元，比 2006 年全年研发费用支出增加了 112.40%。

### (四) 公司利润来源及经营成果变化分析

单位：万元

项目	2007 年度金额	2006 年度金额	2005 年度金额
一、营业收入	45,699.94	36,437.96	25,880.96
其中：主营业务收入	45,478.30	36,306.41	25,846.09
减：营业成本	26,233.13	23,005.89	17,741.73
其中：主营业务成本	25,986.54	22,928.82	17,709.21
营业税金及附加	717.59	220.57	132.13
销售费用	703.63	724.19	636.25
管理费用	6,115.49	4,173.98	2,434.72
财务费用	1,422.21	1,306.02	967.91
资产减值损失	227.57	-204.69	127.14

二、营业利润	10,280.32	7,211.99	3,841.08
加：营业外收入	281.79	136.34	722.72
减：营业外支出	54.51	21.7	8.48
其中：非流动资产处置损失	0.66	-	0.52
三、利润总额	10,507.60	7,326.63	4,555.31
减：所得税费用	1,595.18	1,581.69	339.1
五、净利润	8,912.43	5,744.94	4,216.21
六、扣除非经常性损益后的净利润	8,115.55	5,377.66	3,412.41

报告期内，公司的利润来源主要依靠营业利润，2005年、2006年和2007年营业利润占利润总额的比例分别为84.32%、98.44%和97.84%。报告期内公司还获得了较大金额的政府补助，2005年、2006年和2007年计入当期损益的政府补助分别占当年利润总额的15.80%、4.62%和2.67%。

报告期内公司营业利润获得快速增长，2005-2007年年复合增长率达63.60%。这主要归因于主营业务收入的强劲增长和毛利率的显著提高，2005-2007年年复合增长率为32.65%，而同期主营业务成本的复合增长率仅为21.14%。

## （五） 毛利率水平

### 1、综合毛利水平

#### （1）行业毛利率变动趋势

报告期内，公司综合毛利率保持较高水平并呈上升趋势，与国内外同行业公司毛利率变动趋势基本相符。国内外同行业公司近三年综合毛利率情况如下表所示：

项	目	2007年	2006年	2005年
国外同行企业	中美晶	29.69%	27.20%	20.18%
	台湾合晶	28.12%	25.85%	15.91%
	MEMC	52.06%	44.72%	33.10%
	平均毛利率	36.62%	32.59%	23.06%
国内同行企业	浙大海纳	37.97%	51.88%	36.12%
	有研硅股（注1）	21.74%	14.68%	16.60%



	中环股份	33.68%	32.45%	34.01%
	立立电子	42.86%	36.85%	31.48%
	平均毛利率	34.06%	33.97%	29.55%

注1.: 有研硅股主营业务收入以4、5、6英寸硅抛光片为主,但同时还有大单晶、太阳能电池用硅片、区熔硅单晶等业务收入;而中环股份主要从事半导体分立器件和区熔硅单晶锭及硅研磨片的生产与销售,数据上并不完全可比。

注2.: 上述数据均来源于相关公司年报。

由上表可以看出,随着全球半导体产业景气度的不断提升和国家对半导体硅材料支持力度的加大,国内外同行业公司平均毛利率均呈上升趋势,特别是进入2006年后出现加速上升之势,综合毛利率达30%以上。预计未来几年,全球半导体行业将持续增长,波动性将会趋小,行业毛利水平将趋于稳定。

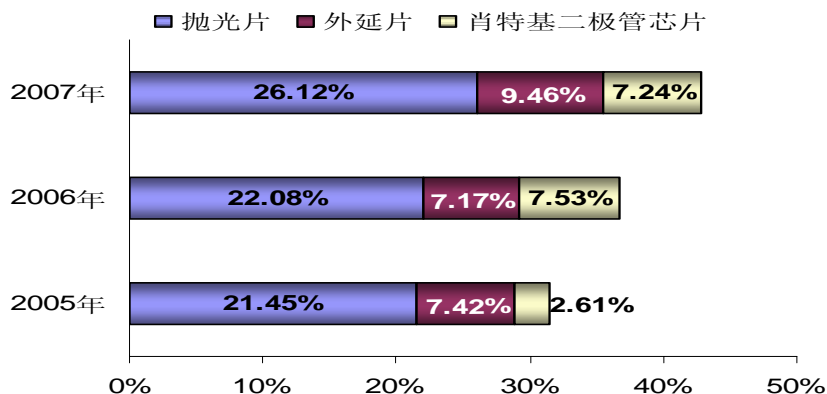
## (2) 发行人综合毛利率分析

报告期内公司主营业务综合毛利率水平明显高于同行业其它企业,并且逐年上升,各分项产品抛光片、外延片和肖特基二极管芯片的毛利率都呈上升趋势,销售收入也保持了快速增长。

报告期内,各产品毛利率及占销售收入和毛利总额的比例情况见下表:

项目	财务指标	2007年度	2006年	2005年
综合	综合毛利率	42.86%	36.85%	31.48%
其中:				
抛光片	销售收入占比	54.08%	53.66%	55.58%
	毛利占比	60.94%	59.91%	68.14%
	毛利率	48.29%	41.14%	38.60%
外延片	销售收入占比	24.21%	19.71%	20.51%
	毛利占比	22.07%	19.46%	23.57%
	毛利率	39.07%	36.37%	36.19%
肖特基二极管芯片	销售收入占比	21.62%	26.31%	23.91%
	毛利占比	16.89%	20.43%	8.28%
	毛利率	33.49%	28.61%	10.90%

报告期内,抛光片、外延片和肖特基二极管芯片对综合毛利率的贡献率见下图:



注：各产品对综合毛利率的贡献率=各产品毛利率×各产品销售收入占比

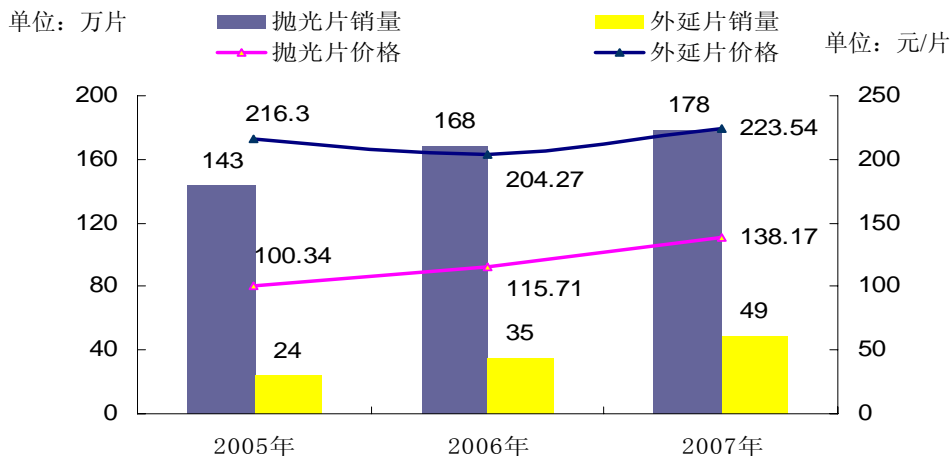
从上图可以看出，2006年综合毛利率较上年上升5.37个百分点，主要系肖特基二极管芯片毛利率和销售收入大幅上升所致；2007年综合毛利率较2006年上升6.01个百分点，主要系抛光片和外延片毛利率和销售收入大幅上升所致。

## 2、公司各产品毛利率逐年上升的原因

### (1) 公司主要产品价格明显上涨、销量大幅增加

公司主导产品质量可靠、性能稳定，在国内外享有较高声誉，由于近年来市场需求旺盛，同时受主要原材料多晶硅价格快速上涨推动，公司主要产品抛光片和外延片的售价均明显上涨，销量也大幅增加。这是公司综合毛利率持续快速上升的主要原因。

报告期内，公司主要产品抛光片和外延片的单价变动和销量增长情况如下图所示：



注：上图抛光片与外延片的销量或价格，均为折合为5英寸硅片的口径

## （2）公司积极采取多种措施有效地控制了成本的上升

为消化主要原材料涨价造成的成本压力，公司采取了多种措施控制生产成本。主要包括：

### ①控制原材料成本的上升

报告期内，公司生产所需的主要原材料多晶硅价格出现大幅上涨，造成原材料采购成本明显上升。为了尽可能降低原材料成本，公司采取了以下措施：

其一，与国外主要多晶硅供应商签订了长期供货协议，锁定多晶硅的采购价格。由于长期协议供货价格远低于市场价格，因此公司在材料成本方面与其它同行业企业相比有更大的优势。公司还计划与其它多晶硅供应商建立合作关系，多方拓展供货渠道，进一步降低材料采购价格。

其二，公司保持了较多的多晶硅和单晶硅等重要物资的储备，使原材料价格上升对成本的影响大大削弱。

其三，公司通过更新设备、改进工艺、加强管理，提高了硅单晶硅出片率和硅抛光片成品率。例如2005年和2006年公司分别购置了两台线切割机，替代了原来使用的内圆切割机，前者效率较后者明显提高，经统计分析，使用线切割机后，5、6英寸硅单晶硅的出片率可较内圆切割机提升20%左右，出片率和成品率的提高可大大降低单位材料成本。

### ②降低制造费用

随着公司主要产品产销规模的迅速扩大以及管理效率的不断提升，单位产品制造费用呈显著下降趋势。

通过采取上述措施，报告期内公司产品在销售单价逐年提高的情况下，产品单位成本上升幅度却相对较小，从而推动了综合毛利率水平的上升。

## （3）公司产品覆盖的产业链较长

公司产品覆盖的产业链较长也为公司带来的更多毛利空间，同时前、后端

产品之间还可以形成较好的协同和互补效应，尤其在近年上游多晶硅原料紧缺造成整个产业链后端供求趋紧的背景下，公司的这一优势得以充分发挥。

### 3、分产品毛利率变动情况

报告期内，公司硅抛光片产品毛利率始终维持在较高水平，2005年和2006年毛利率水平分别为38.60%和41.14%，2007年进一步提高到48.29%。2005年毛利率稍低，主要原因是公司大量新购生产设备造成折旧增加，而新增产能和销售收入未能及时体现。

公司硅抛光片产品毛利率较高的主要原因是：（1）通过更新设备、改进工艺、加强管理，提高了硅单晶锭出片率和硅抛光片成品率。2005年和2006年公司分别购置了两台线切割机，替代了原来使用的内圆切割机，前者效率较后者明显提高。经统计分析，使用线切割机后，5、6英寸硅单晶锭的出片率可较内圆切割机提升20%左右。出片率的提高可大大降低生产成本，显著提高产品毛利率；

（2）充分发挥规模效应，降低生产成本。公司充分利用良好的市场形势，加大营销力度，大幅提高硅抛光片的产销量，从而显著降低单位产品固定生产成本；

（3）有效控制原材料成本。公司通过与主要原材料供应商建立长期稳定的供货关系，采取签订长期采购合同的形式，尽可能降低多晶硅等原材料价格不断上涨对公司造成的成本压力。（4）根据市场供求关系，适当提高产品价格。自2006年以来，为抵销由于原材料价格上涨所带来的成本上升压力，公司适当提高了硅抛光片的销售价格，2006年、2007年硅抛光片产品平均销售价格分别比上一年增长了15.3%和19.4%。

2005年、2006年和2007年，公司硅外延片毛利率分别为36.19%、36.37%和39.07%，2007年较上年上升了2.7个百分点，其主要原因是：（1）硅外延片价格有所上涨。2007年较上年增长了9.43%；（2）销售量大幅度上升。2007年较上年同期增长了40%。此外，造成公司硅外延片2007年毛利率较上年有所上升的另一原因是产品结构优化，2007年度附加值相对较高的5、6英寸硅外延片约占硅外延片总销售量的85.93%，较上年提高了约5个百分点。

2005年，公司功率肖特基二极管芯片产品由于主要客户订单不饱满，产能利用率仅为42%左右，单位成本居高不下，毛利率仅为10.90%。2006年公司

积极拓展国际、国内两个市场,大幅提高产销水平,实现产品销量增长 51.52%,同时开发了高附加值产品,从而使产品毛利率提高至 28.61%。2007 年功率肖特基二极管芯片的产销量同比上年继续上升,同时公司进一步加大技术改造的力度,提高设备使用效率,严格控制生产成本,在公司固定成本相对稳定的情况下,功率肖特基二极管芯片毛利率较 06 年上升了 4.9 个百分点。

## (六) 可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

### 1、非经常性损益

单位: 万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
非流动资产处置损益	-0.66	-	-0.52
计入当期损益的政府补助	280.12	338.31	719.72
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7.36	6.6	32.36
小 计	272.11	344.91	751.56
减: 所得税费用	-515.55	6.53	-107.6
减: 少数股东损益影响数	5.08	18.52	30.18
非经常性损益净额	782.58	319.86	828.98

报告期内,公司非经常性损益主要为政府补助。由于公司主营业务所处集成电路制造业属国家重点扶持的高技术产业,公司每年可从政府获得一定数量的财政补助,2005年、2006年和2007年公司所获得的计入当期损益的政府补助收入,分别占同期利润总额的15.80%、4.62%和2.67%。来自相关政府部门的资助,为公司各项业务的迅速拓展提供了有力的资金支持,尽管报告期内前一年的政府补助成为公司利润的重要来源之一,但随着公司业绩的快速增长和盈利水平不断提高,其在公司利润构成中所占比例迅速下降。

未来公司还将根据国家产业政策导向,积极争取政府补助、资助和资金支持,以增强公司创新能力、降低财务费用,但公司业绩的增长并不依赖于政府补助。

## 2、税收优惠

报告期内公司享受的税收优惠主要包括增值税即退优惠、企业所得税产业优惠以及技术改造国产设备抵免企业所得税优惠。

### (1) 增值税即征即退优惠

对增值税实际税负超过 3%的部分，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号）及财政部、国家税务总局《关于停止集成电路增值税退税政策的通知》（财税[2004]174 号），自 2002 年 1 月 1 日起至 2005 年 3 月 31 日公司与子公司立立半导体可享受即征即退政策；2005 年度公司和子公司立立半导体共收到的增值税返还款 380.67 万元，直接增加利润总额 380.67 万元。

### (2) 出口退税

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，自 2004 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止，硅片的退税率为 13%、功率肖特基二极管芯片的退税率为 17%。根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90 号），自 2007 年 7 月 1 日起，硅单晶片的退税率降低为 5%，功率肖特基二极管芯片的退税率仍为 17%。假设以 2007 年全年为例，如果出口退税率从 13%下降到 5%，则公司增加缴纳相关税金 720 万元，相应减少利润总额 720 万元。

### (3) 企业所得税产业优惠

根据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号），并经宁波市地方税务局批复同意，公司享受 2003-2004 年度免征企业所得税、2005-2007 年度减半征收企业所得税的税收优惠政策，子公司立立半导体享受 2004-2005 年度免征企业所得税、2006-2008 年度减半征收企业所得税的税收优惠政策。2005 年、2006 年和 2007 年公司及子公司立立半导体公司共享的所得税优惠分别为 1,416.05 万元、1,165.52 万元和 2,004.47 万元；如果不享受该优惠政策，相应期间的净

利润将分别减少 1,416.05 万元、1,165.52 万元和 2,004.47 万元。

#### (4) 技术改造国产设备抵免企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290号）和《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》（国税发[2000]13号）的规定，并经主管税务机关核准，公司6英寸硅外延片生产线一期技改项目采购国产设备，可抵免2005年度应交企业所得税273.05万元，本公司6英寸硅外延片生产线技改项目采购国产设备，可抵免2007年度应交企业所得税592.38万元；子公司立昂电子公司功率半导体芯片生产线扩产技术改造项目采购国产设备，共可抵免应交企业所得税58.68万元，2006年度和2007年已抵免应交企业所得税58.68万元。该优惠政策如果不享受，则公司2005年的净利润将减少58.68万元，2007年的净利润将减少592.38万元。

#### (5) 剔除企业税收优惠因素后三年报表与申报会计报表的差异比较

单位：万元

年度	项目	有税收优惠	无税收优惠	差异	利润减少数占实际利润的比重
2007年	营业利润	10,280.32	10,280.32	-	-
	利润总额	10,507.60	10,507.60	-	-
	所得税费用	1,595.18	4,192.02	2,596.84	-
	净利润	8,912.43	6,315.59	-2,596.84	29.14%
	归属于母公司股东的净利润	8,898.13	6,301.29	-2,596.84	29.18%
2006年	营业利润	7,211.99	7,211.99	-	-
	利润总额	7,326.63	7,326.63	-	-
	所得税费用	1,581.69	2,747.21	1,165.52	-
	净利润	5,744.94	4,579.43	-1,165.52	20.29%
	归属于母公司股东的净利润	5,697.52	4,532.01	-1,165.52	20.46%
2005年	营业利润	3,841.08	3,841.08	-	-
	利润总额	4,555.31	4,174.64	-380.67	-
	所得税费用	339.1	1,688.20	1,349.10	-
	净利润	4,216.21	2,486.44	-1,729.78	41.03%
	归属于母公司股东的净利润	4,241.39	2,517.12	-1,724.28	40.65%

公司是国家级高新技术企业，公司子公司立立半导体公司和立昂电子为浙江省高新技术企业，依据2008年1月起实施的《中华人民共和国企业所得税法》

及相关规定，公司有可能享受相关税收优惠政策。

### 3、原材料供应情况

由于近年来半导体产业的快速增长，特别是太阳能光伏业的爆发性增长，导致半导体基础原料——多晶硅出现了全球性供不应求，并随之带来价格的剧烈波动。目前，公司生产产品所需多晶硅全部依赖进口，因此国际市场多晶硅供应情况和价格的波动将直接影响公司生产的稳定性和产品成本。

为解决原材料供应紧张问题，公司已采取了一系列有力措施，包括：与核心供应商签署长期性供货合同，稳定多晶硅供应渠道和价格；积极洽商新的供应商，拓展新的采购渠道，增加多晶硅原料供货量。经过上述努力，目前公司采购到的多晶硅原料已基本满足生产需求。

针对原材料价格波动对公司产品成本的影响，公司也采取了积极措施，具体包括：积极更新设备，改进工艺水平，提高多晶硅利用率；与主要客户协商销售定价模式，转移和分担原材料价格上涨带来的成本压力。

### 4、产品销售价格和原材料价格波动对公司利润的影响

报告期内，硅抛光片销售单价逐年上涨，硅外延片销售单价基本保持平稳，而功率肖特基二极管芯片由于相继开发出高反压、大电流系列产品，销售单价自2006年以来有小幅上涨。根据公司测算，在保持目前产品结构和成本结构不变的假设前提下，产品销售价格上升1%，则利润总额将上升约5%。

多晶硅是影响公司产品成本的核心原材料，近年来由于供不应求，价格出现较大幅度上涨，对公司产品成本形成较大压力。据公司测算，在保持目前产品结构和成本结构不变的假设前提下，按目前的多晶硅消耗量、采购价和人民币汇率估算，多晶硅单价每上涨10%，公司利润总额将减少约6%。

## (七) 同行业可比公司财务指标对比分析

财务指标	本公司	有研硅股	中环股份	平均
资产负债率（合并报表）	53.50	37.11	43.16	44.59
流动比率	1.33	1.29	1.94	1.52
速动比率	0.79	0.59	1.25	0.88



应收账款周转率（次/年）	4.31	4.86	4.01	4.39
存货周转率（次/年）	1.78	1.64	2.00	1.81
销售毛利率	37.02	17.67	33.38	17.14
净资产收益率（全面摊薄）	21.14	3.79	14.20	13.05
每股收益（全面摊薄）	0.84	0.19	0.26	0.43
每股经营活动的现金流量（元）	1.28	0.29	0.28	0.62
每股净现金流量（元）	0.19	-0.11	0.09	0.06

说明：有研硅股与中环股份财务指标取自wind资讯；公司财务指标为2005-2007年指标平均值。

本公司虽选取有研硅股与中环股份（全称为：“天津中环半导体股份有限公司”）作为国内相近的同行业可比上市公司，但需要说明的是该两家公司的业务和产品与本公司并不完全可比，具体体现在有研硅股主营业务收入以4、5、6英寸硅抛光片为主，但同时还有大单晶、太阳能电池用硅片、区熔硅单晶等业务收入；而中环股份主要从事半导体分立器件和区熔硅单晶锭及硅研磨片的生产与销售。

### 三、资本性支出

#### （一） 报告期内重大资本性支出情况

##### 1、对子公司立昂电子增资

2006年2月21日，立昂电子增加注册资本2,200万元，均由本公司出资，增资后立昂电子注册资本变更为人民币7,000万元。以上增资事宜，均已办妥相关工商变更登记手续。

##### 2、投资立立科技

2005年11月，本公司与子公司立立半导体共同投资设立杭州立立科技实业有限公司。该公司成立于2005年12月1日，位于杭州市滨江区，现注册资本500万元，法定代表人李立本，其中本公司以货币出资450万元，占注册资本的90%。立立科技的主要业务为集成电路及应用软件、半导体高新材料的开发和销售。

##### 3、其他资本性支出

公司2005年、2006年和2007年，购建固定资产、无形资产等长期资产支出

的现金分别为5,738万元、2,946万元、6,652万元，主要是生产用设备及厂房的购置，上述资本性支出为公司扩大产能、提高生产效率打下坚实基础。

## （二） 未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股意向书签署日，除本次发行募集资金有关投资外，发行人无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资项目请参见本招股意向书“第十四节、募集资金运用”。

## 四、 现金流量分析

公司近三年的现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,718.89	11,007.87	9,001.08
投资活动产生的现金流量净额	-6,651.74	-2,946.06	-5,737.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,195.91	-6,458.97	-4,523.72
现金及现金等价物净增加额	4,158.06	1,563.39	-1,281.08
期末现金及现金等价物余额	0.37	4,851.01	3,287.62
每股经营活动现金流量（元/股）	1.13	1.43	1.27
每股净现金流量（元/股）	0.54	0.2	-0.18

### （一） 经营活动产生的现金流量

报告期内公司经营活动净现金流变动原因如下：

2006年经营活动净现金流较2005年增加了22.30%，主要原因为2006年公司产品供不应求，销售回款速度加快，公司销售商品、提供劳务收到的现金上年度增长了68.99%。

2007年经营活动净现金流较2006年下降了20.79%，主要原因为2007年公司产品虽然仍供不应求，公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年度增长4.36%，但购买原材料规模扩大及预付货款导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了9.58%，支付的各项税费也比上年同期增加了52.21%。

总的来看，报告期内公司销售回款情况较好，经营性活动产生的现金流量

情况正常。

## （二） 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因是公司业务处于快速成长期，需进行大量追加投资，2005年、2006年以及2007年，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为5,738万元、2,946万元、6,652万元。

## （三） 筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动产生的现金流量净额2005年、2006年均为负数，其主要原因：2005年、2006年，公司在经营活动现金流大量增加的情况下，偿还部分银行借款，以降低公司负债率、减少财务费用。2007年筹资活动产生的现金流量净额为正的原因在于新增借款达到3,371万，而同期归还的借款较上年减少了8,311万。

## （四） 公司现金流量的总体分析

公司管理层认为，公司资金回收情况良好，现金流较为充足，同时公司注重维护良好的商业信誉，同各贷款银行有着良好的合作关系，拥有较高的授信额度，因此偿债风险较小，并能及时筹集经营所需流动资金。

# 五、 盈利前景分析

经过近年来的快速发展，公司已构筑起稳固的业务基础，在行业景气不断提升的背景下，公司主导产品市场需求旺盛，核心客户关系稳定并不断拓展，原材料供应渠道稳定、可靠，各项企业管理工作日益规范，管理层相信公司未来将保持目前的良好发展趋势。

未来几年影响公司财务状况和盈利能力的因素及其变化趋势如下：

## （一） 国家产业政策

集成电路产业属于国家重点鼓励发展的行业。近年来，为了促进我国集成

电路行业的发展，国家相继出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》等一系列法规和政策，在行业准入、税收优惠、政府补贴等方面给予支持和资助。

在国家和地方政府的大力扶持下，我国半导体产业发展十分迅速，一大批优质企业脱颖而出，但与国际先进水平相比，我国半导体硅材料产业尚显稚嫩，因此国家仍将在相当长的时期内对该行业给予较大力度的政策扶持。对公司来说，政府的扶持和资助将为企业下一步发展创造良好的外部环境，降低运营成本和经营风险。

## （二）世界半导体产业发展趋势的影响

世界半导体产业发展十分迅速。随着中国作为世界经济的重要驱动器和全球制造业中心地位的确立，众多制造性产业均出现了向中国转移的趋势，集成电路和分立器件行业也不例外。国际主要的芯片制造商如台积电、联电、ST等均以不同形式在中国投资建厂，同时国内企业通过合资合作引进技术，发展也十分迅猛，如中芯国际、华宏NEC、先进半导体等。据统计，目前我国已有15条8英寸、2条12英寸集成电路生产线建成投产，

国际、国内半导体产业发展趋势为公司迅速扩大规模、加快产业升级提供了一个难得的机遇：一方面，国际上主要硅片生产商生产重心向12英寸转移，导致其8英寸及8英寸以下硅片出货量下滑，但这些规格的硅片需求量仍较大，从而为我国硅片生产企业提供了扩大生产规模并加快产业升级的契机；另一方面，国内芯片制造企业的快速发展和生产规模的不断扩大，也为我国硅片生产企业提供了广阔的市场空间。国内目前尚未实现8英寸硅片的产业化规模生产，公司本次募集资金拟投资6-8英寸硅抛光片和8-12英寸硅外延片，将在扩充6英寸硅片产能的同时积极拓展8英寸硅抛光片和8-12英寸硅外延片，以抓住市场机遇。

## （三）原材料供应及价格波动

业内普遍预期，公司生产所需多晶硅原料未来一段时期在全球范围内仍将供

不应求，因此能否以合理的价格获得稳定、可靠的原材料供应对公司未来生产经营将产生重要影响。如前所述，国际上主要多晶硅制造企业的新增产能将很快释放，预期可以有效缓解多晶硅紧张的局面。此外，公司多晶硅供给已有充分准备，并采取了一系列措施保障生产所需多晶硅原料的供应。

## 第十二节 业务发展目标

### 一、发行人当年及未来二至三年内的发展计划

#### （一）整体经营目标及主营业务的经营目标

未来二到三年，公司将在现有基础之上，通过包括股票融资在内多种筹资渠道募集发展所需资金，拟投入 8-10 亿元人民币技术改造资金，进一步提高硅抛光片和硅外延片生产规模，提高公司在半导体硅材料行业内的核心竞争力，形成年产 300 吨 4-8 英寸硅单晶锭、660 万片（折合 18,123 万平方英寸）4-8 英寸系列硅抛光片、180 万片（折合 3,533 万平方英寸）4-8 英寸系列硅外延片和 18 万片 6 英寸功率肖特基二极管芯片的生产能力，使公司年销售规模达到人民币 10 亿元以上，将公司建成有国际影响力的半导体硅材料生产企业，成为全球半导体材料行业排名前十位的知名供应厂商。

#### （二）产品开发及技术创新计划

公司成立研发中心，计划每年按销售收入的 5%，作为研发经费投入。力争经过 2-3 年的努力，将其建成在国内硅材料行业处于领先地位的国家级企业研发中心。公司目前已与浙江大学硅材料国家重点实验室共同组建了联合研发中心，重点在 8-12 英寸硅抛光片的前沿研发中开辟出新的研究项目，进一步提升企业的自主创新能力。

在新产品工艺开发计划方面，公司拟定以下具体研发计划：

##### 1、线宽0.13微米IC用8英寸硅抛光片工艺技术

在两年内对线宽0.13微米IC用8英寸硅抛光片工艺技术的研发要有突破，拟解决的主要技术难点主要有：微缺陷问题、金属沾污问题、几何参数指标控制问题等。

##### 2、12英寸硅外延片的制造工艺

在一至两年内完成 12 英寸掺磷硅外延片的开发研制、中试鉴定及试生产。

##### 3、新型半导体复合材料的研究与开发

公司计划在未来五年广泛涉足新型半导体复合材料的研究开发，对有市场前

景的复合半导体材料做好技术储备，为产业化奠定基础。

### **（三）人才储备计划**

人力资源是企业最重要的战略资源，正确的人才战略是保证公司长治久安的根本举措。公司一直把对人才的引进、培养、优化配置作为实现可持续性发展的重要举措。公司将进一步确立总体发展战略中人才的重要地位，把培养、吸收和利用好人才作为一项重大的战略任务切实抓好，按照“德才兼备”的原则，着力培养一大批实用人才，不断提高全体员工的业务水平和技能，同时使员工总人数与实际产量最佳匹配。

公司将采取一系列措施稳定发展公司中高级管理人员，骨干技术人员，如未来适当时机推出股票期权激励计划，在骨干员工中推行住房补贴计划等。

### **（四）市场开发与营销网络建设计划**

为加强市场反应能力，公司直接面向市场、服务客户，构筑起专业化的区域营销的运作模式，并形成覆盖整个中国市场以及海外市场的营销网络，并使之成为公司未来的竞争资源。

在具体市场拓展上，公司目前已与国内很多知名公司建立了长期稳定的供应关系，公司计划在巩固现有客户关系，提升现有销售渠道销售能力的基础上，积极拓展新的销售渠道，努力与国内更多的用户建立长期合作的伙伴关系。公司国外市场拓展销售渠道的发展计划具体为，在美国、日本、韩国等国际市场上新开发 3-5 家国际知名半导体厂商作为核心客户。

### **（五）筹资计划**

本次公司公开发行股票募集资金后，将根据业务发展需要及生产经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较自我积累、商业信用、银行贷款、发行债券、配股、增发新股等多种融资渠道，选择最优的融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

### **（六）收购兼并及对外扩充计划**

公司将根据自身经营情况和融资能力，结合公司的发展战略，适当收购兼并一些资产质量和效益优良、对本公司发展具有战略意义的企业股权或资产，提高

立立电子生产经营能力和竞争实力，扩大市场份额，实现快速扩张。

### **（七）深化改革和组织结构调整的规划**

公司将以市场为导向，结合我国集成电路发展的形势，根据上市公司规范化运作要求、业务发展的需要以及管理科学有效的原则，逐步调整优化和完善组织结构，合理设置各个职能部门，建立起一套完整、科学的安全生产管理、经营管理、企业发展管理机制，不断完善公司法人治理结构，建立有效的激励和约束机制，实现企业的稳定运行和良性循环。

### **（八）国际化经营的计划**

本公司将坚定不移地走国际化道路，树立国际化经营意识、提高企业的经营管理水平。同时，为积极应对中国加入 WTO 带来的机遇和挑战，公司将重视占领战略市场和开发具有巨大潜力的市场，不断扩大国际合作，充分利用国家相关各项优惠政策，积极参与国际化市场竞争。公司将继续在国内外两个市场营造和扩大竞争优势，实施国际化经营战略，力争在未来 2-3 年内，使更多的产品进入国际市场。

## **二、发行人拟定上述计划所依据的假设条件**

公司能在 2008 年内成功完成股票公开发行并上市计划，募集资金能到位，拟投资的项目能尽快形成生产能力。

本公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态，没有出现重大的市场突变情形。

本公司所处的宏观经济环境，以及政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且不存在对公司发展将会产生重大影响的不可抗力事项发生。

国家对集成电路产业的积极鼓励政策不会有重大改变，且被较好地执行。

本公司管理层和核心技术人员保持相对稳定。

本公司对企业理想及目标的追求不因一时、一地的变迁而发生动摇。

## **三、实施上述计划将面临的主要困难**

（一）实施公司的发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持，资金因素成为主要的约束条件。



(二) 公司成为公众公司, 将在战略规划、营销策略等方面对公司的管理提出挑战。

(三) 公司未来几年将处于高速发展阶段, 对各类高层次人才的需求将变得更为迫切, 尤其是国际市场营销的人才。公司在今后的发展中面临如何进行人才培养、引进等方面的挑战。

#### **四、发展计划与现有业务关系**

上述业务发展计划是公司在现有业务的基础上, 为寻求发展空间、实现战略目标的具体策略。公司现有业务是上述发展计划的基础, 该发展计划的制定将从横向上扩展公司的业务(扩大生产能力和市场份额), 从纵向增强公司的业务深度(产品升级、适度的上下游一体化), 从整体上提高公司的经营管理水平, 进一步提升企业核心竞争力。

## 第十三节 募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

经公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股，计划募集资金约 5-6 亿元。公司将根据轻重缓急将本次募集资金用于以下两个项目：

项目名称	项目审批/备案情况	项目总投资 (万元)
6-8 英寸硅抛光片扩产项目	宁波市企业投资项目备案登记表—甬发改备[2007]31 号	53,735
8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程	国家发展和改革委员会发改高技[2004]2041 号文、宁波市发展与改革委员会甬发改工业[2007]369 号文	11,323
合 计	-	65,058

上表中，募集资金投资项目排列顺序按项目实施的轻重缓急顺序确定。

鉴于募集资金投资项目实施的紧迫性，对于两个募集资金投资项目，股份公司已先行通过银行贷款和政府补助进行建设，截至 2007 年 12 月 31 日，“6-8 英寸硅抛光片扩产项目”已投入 1,200 万元，“8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程”已投入 5,458 万元。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。

### 二、实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排

公司将按上述轻重缓急顺序安排募集资金运用。若本次发行实际募集资金超出拟投资项目的资金需求量，多余资金用于补充流动资金。

若本次发行实际募集资金低于拟投资项目的资金需求量，则差额部分除小部分来自政府补助外，公司将采用自筹资金或银行贷款等筹资方式解决。目前，公司已取得中国银行股份有限公司北仑支行的贷款承诺，该行承诺在公司完成本次发行并经该行审核批准后，向本公司提供最高额不超过人民币 25,000 万元的贷款，用于募集资金投资项目的建设。

政府给予公司募集资金投资项目补助的情况如下：

项目名称	政府补助批准文件	补贴金额（万元）
8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程	宁波市保税区财政局 甬财政工[2005]230 号文	500
	宁波市保税区财政局 甬财政工[2005]361 号文	500
	宁波市保税区财政局 甬财政工[2006]12 号文	250
合 计	—	1,250

### 三、6—8 英寸硅抛光片扩产项目

#### （一）项目概况

6-8 英寸硅抛光片扩产项目已经宁波市发展与改革委员会批复的宁波市企业投资项目备案登记表——甬发改备[2007]31 号备案登记，项目总投资 53,735 万元，其中固定资产投资 48,563 万元。该项目立足于公司对于硅抛光片产品的市场、技术、工艺、管理、营销方面的经验，引进国外先进的成套关键设备，改、扩建 6-8 英寸硅抛光片生产线。该项目建成达产后，将形成新增年产 6 英寸硅抛光片 300 万片（折合：8,478 万平方英寸）、8 英寸硅抛光片 60 万片的生产能力（折合：3,015 万平方英寸）。

#### （二）产能变化

目前，本公司硅抛光片的最大生产能力为年产各类硅抛光片 300 万片(折合：6630 万平方英寸)，其中 6 英寸的硅抛光片的产能为 180 万片（折合：5,086 万平方英寸），而 8 英寸硅抛光片尚未量产。本项目建成投产后，将使公司新增年产 6 英寸硅抛光片 300 万片、8 英寸硅抛光片 60 万片的生产能力。本项目建设工期预计为 2 年，项目建成后第一年可达到设计生产能力的 90%，项目建成后第二年可完全达产。

#### （三）市场前景分析

##### 1、报告期内 6 英寸硅抛光片生产、销售情况

报告期内，公司 6 英寸硅抛光片的产能、产量、销量、产销率、销售区域情况如下表所示：

单位：万片

项目		2007 年度	2006 年度	2005 年度
产能		180	130.00	110.00
产量		117	105.00	86.90
销量		116.57	106.84	84.51
产销率		99.63%	101.75%	97.26%
销售 区域	国际	50.25	52.85	43.79
	国内	66.30	53.99	40.72

上表显示，报告期内 6 英寸硅抛光片每年的产量均低于其产能。出现以上产量低于产能的原因，主要是由于公司在报告期内，根据市场发展的需要，每年引进先进设备、提高产品工艺，使 6 英寸硅抛光片的产能逐年提高；而公司披露的产能都是年末公司实际形成的产能，而事实上公司每年产能的扩大都是在原有生产线的基础上改、扩建实现的，从改、扩建到达产需要一个过程，造成全年的实际产量与年末形成的产能相比有一定差异。

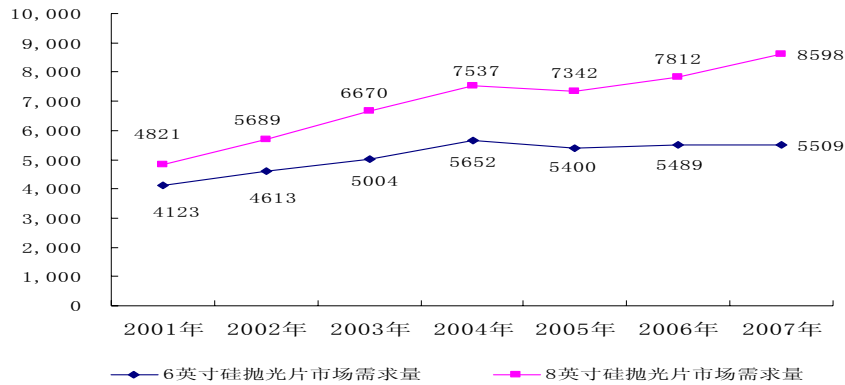
报告期内，公司 6 英寸硅抛光片产品呈现产销两旺势头，每年的产能都能较好利用，由于公司产品品质优良，深受客户信赖，客户订单呈现逐步上升趋势，为公司扩大产能提供了可靠的市场预期。另外，公司目前已经开始向老客户少量提供 8 英寸硅外延片，其衬底片均来自公司自己生产的 8 英寸硅抛光片，因此公司目前生产的 8 英寸硅抛光片实际上已经间接实现市场销售。目前公司 8 英寸硅抛光片的生产能力可达 1 万片，2007 年度公司实际生产了 3,560 片，均作为公司外延片衬底片使用。

本项目建成投产后，将使公司新增年产 6 英寸硅抛光片 300 万片、8 英寸硅抛光片 60 万片的生产能力。

## 2、行业发展趋势和市场容量

根据 SEMI 的研究报告，6 英寸硅片的全球市场需求未来仍呈现上升趋势，且市场需求量较大。根据日本《Semiconductor Materials Data Book》的统计资料，近年来 6-8 英寸硅片的全球市场需求量及趋势如下图所示：

单位：万片



根据赛迪顾问的研究报告，全球半导体硅片市场的需求量呈现逐年上升趋势，2006年全球半导体硅片市场需求量比2005年增长了17.2%，达到78.1亿平方英寸。未来随着全球电子信息产业的迅猛发展，半导体硅片市场需求仍会保持旺盛的上升势头。随着国际主流硅片制造商，如SEH、SUMCO、Siltronic及MEMC均投入巨额资金和技术到12英寸硅片市场，出于跟随主流市场的考虑，对投资扩张8英寸硅片产能的意愿正在减弱，而逐步放弃6英寸及以下小直径硅片市场。但根据SEMI的统计报告，全球范围内6-8英寸硅片有着很强的生命力，该市场仍呈现平稳上升趋势，市场前景广阔。

随着我国信息产业的发展，特别是电子消费产品的生产能力和消费能力不断增强，以及国际半导体业巨头向我国内地转移其集成电路封装工业，我国集成电路产业蓬勃发展，预计到2010年我国集成电路市场规模将达到9000亿元。集成电路行业的产能扩张，必然将带动以硅抛光片为代表的上游半导体材料需求的快速增长，但目前我国硅抛光片的供需存在结构性矛盾，我国高端硅抛光片需求严重依赖进口。根据万胜博讯的研究报告（2007），2006年我国硅抛光片产量为25,540万平方英寸，仅占2006年全国硅抛光片需求的60%左右。目前，国内集成电路对硅抛光片的需求以6英寸、8英寸产品为主，且需求量达而国内硅片生产企业的主流产品仍为4、5、6英寸，8英寸以上硅抛光片需求完全依赖进口，80%以上的6英寸硅抛光片也需要进口。因此，我国硅抛光片的供需结构矛盾急需半导体硅材料行业进行产业结构的升级换代，加快6英寸及以上产品的大规模生产。此外，随着国际主要硅片企业的主流产品已转为8、12英寸硅片，而功率IC、Logic IC、Linear IC、消费类IC、MCU、电力电子器件、光电器件、RF元

器件、MEMCS 等半导体产品仍然大部分采用中小尺寸硅片来制作，这也为中小硅片生产企业抢占 6 英寸硅单晶片市场份额提供了机会。根据赛迪顾问研究报告，2006 年中国半导体用硅材料按尺寸分市场需求量情况如下表所示：

尺寸	3"	4"	5"	6"	8"	12"
需求量(亿平方英寸)	0.55	0.75	0.36	0.91	1.64	0.07
增长率(%)	10.3	8.9	8.8	62.5	22.0	81.3
所占比例(%)	12.9	17.5	8.3	21.3	38.5	1.5

数据来源：赛迪顾问 2007，01

综上所述，全球 6-8 英寸硅抛光片市场空间巨大，且市场需求量长期处于平稳上升趋势，特别是 8 英寸硅抛光片在替代进口方面具有突出作用。

### 3、主要竞争对手

本项目建成投产后，公司 6 英寸硅抛光片产能将有较大幅度的提高，同时新增 8 英寸硅抛光片产品。公司 6 英寸硅抛光片产量扩张后，主要竞争对手为：有研硅股、韩国 LG Siltron、台湾合晶科技等公司。但因 6 英寸硅抛光片产量的增长，市场竞争将进一步加剧，可能导致产品价格有所下降。公司的 8 英寸硅抛光片投产后，主要竞争对手为全球六大硅片生产商 Shin-Etsu、SUMCO、MEMC、Wacker、Komatsu、Toshiba，以及 LG Siltron、台湾合晶科技等公司。以上竞争对手情况参见本招股意向书“第六节业务与技术”之“四、公司在行业中的竞争地位”。

### 4、市场开拓的计划和具体措施

募集资金项目建成投产后，公司将继续在目前海外事业部与销售部的架构下开展营销工作。针对我国集成电路、分立器件生产企业的地域布局情况，公司硅抛光片的境内客户主要集中在上海、北京、浙江、江苏等省市。目前公司处于产销两旺的态势。公司将在巩固现有客户关系，提升现有销售渠道销售能力的基础上，积极拓展新的销售渠道，努力与国内更多的用户建立长期合作的伙伴关系；公司的境外客户主要集中在美国、新加坡、日本、韩国、马来西亚等国，公司将在开发现有海外客户销售潜力的基础上，在美国、日本、韩国等国市场上新开发 3-5 家国际知名半导体厂商。

根据公司在海外市场销售过程中得到的信息，国外主要客户对公司 6—8 英

寸硅抛光片现有总需求量，以及立立电子目前供应量和国外客户对立立电子 6-8 英寸硅抛光片的潜在需求量情况如下：

客户(国外)	6 英寸硅抛光片			8 英寸硅抛光片		
	总需求 (万片/年)	公司目前供 应量 (万片/年)	客户对公司 潜在需求量 (万片/年)	总需求 (万片/ 年)	公司目前供 应量 (万片/年)	客户对公司 潜在需求量 (万片/年)
已经批量采购的客户	488	54	160	-	-	-
已经完成认证和正在 开发的客户	753	0	66	268	0	60
合 计	1,241	54	226	268	0	60

根据公司在国外市场销售过程中得到的信息，国内主要客户对公司 6—8 英寸硅抛光片现有总需求量，以及立立电子目前供应量和国内客户对立立电子 6-8 英寸硅抛光片的潜在需求量情况如下：

客户(国内)	6 英寸硅抛光片			8 英寸硅抛光片		
	总需求 (万片/ 年)	公司目前供 应量 (万片/年)	客户对公司 潜在需求量 (万片/年)	总需求 (万片/ 年)	公司目前供 应量 (万片/年)	客户对公司 潜在需求量 (万片/年)
已经批量采购的客户	361.2	73	150.4	-	-	-
已经完成认证和正在 开发的客户	114	0	30	396	0	28.8
合 计	475.2	73	180.4	396	0	28.8

另外，由于公司本身还从事硅外延片的生产和销售，公司目前已经将 6 英寸以上硅外延片的生产和销售列为外延片的重点发展业务，公司 6 英寸以上硅外延片所需的衬底片消化了相当部分公司生产 6-8 英寸硅抛光片。

#### （四）技术水平

##### 1、技术保障

本公司是国内半导体硅材料行业内的国家火炬计划重点高新技术企业，自主拥有三项发明专利，还自主掌握了多项硅抛光片核心生产工艺。公司已具备自主生产 6 英寸、8 英寸重掺砷、磷、锑、硼硅单晶锭以及 6 英寸、8 英寸硅抛光片、硅外延片等产品的能力。公司掌握的相关技术处于国内同行业领先水平，部分达到国际先进水平。

公司生产 6 英寸硅单晶锭采用特殊的掺杂技术，特殊的热场设计，具有电阻率分布均匀、氧含量可控且分布均匀、碳含量低以及微缺陷少等优点。公司采用 MCZ（磁场拉晶工艺）拉晶工艺拉制 8 英寸各种硅单晶锭，产品电阻率均匀性

好、单晶氧含量可控、碳含量低、微缺陷少。公司采用线切割、酸腐蚀和有蜡抛光等工艺生产 6 英寸硅抛光片，该生产工艺成熟，产品性能达到国际同类产品先进水平。公司目前已经具备自主开发、生产 8 英寸硅抛光片的能力。

## 2、生产方法

本项目生产 6-8 英寸硅抛光片采取的生产工艺分为以下二部分：

A、生长硅单晶锭。利用单晶炉将多晶硅熔化，然后通过引晶、放肩、转肩、等径和收尾等工艺步骤生长成用户所需的直径和电学性能参数的硅单晶锭。

B、加工硅抛光片。将硅单晶锭在专用设备上进行切片、磨片、抛光生产，加工成 6-8 英寸硅抛光片，控制其几何尺寸和表面质量，使之能满足下游厂家的要求。

工艺流程请参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“（五）主营业务情况”相关内容。

## 3、技术指标

本项目 6-8 英寸硅抛光片产品要求达到的主要技术性能指标如下表：

硅片直径	技术指标				
	6 英寸 抛光片	晶向	<100>或<111>		
电阻率 ( $\Omega\cdot\text{cm}$ )		P 型/掺硼	N 型/掺锑	N 型/掺砷	N 型/掺磷
		0.0005-60	重掺 <0.015-0.025	重掺 <0.005-0.01	轻掺 >1-40 重掺 0.0007-1
8 英寸 抛光片	晶向	<100>或<111>			
	电阻率 ( $\Omega\cdot\text{cm}$ )	硼	锑	砷	磷
		0.006-50	<0.02	0.002-0.004	0.001-50

## （五）项目建设情况

### 1、投资估算

本项目总投资 53,735 万元,其中固定资产投资总额为 48,563 万元,铺底流动资金为 5,172 万元。其中,固定资产投资具体安排为: 厂房投资 658 万元新增设备购置费 42,353 万元(其中引进设备 5,524 万美元),安装工程费 1,400 万元,其他费用为 555 万元,预备费 3,597 万元。

本项目总投资使用计划与资金筹措见下表:

单位:万元

项目名称	年份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	合计
项目总投资		16,997	19,425	19,118	10,263	-	-	65,803



项目名称	年份	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	合计
建设投资		16,997	19,425	12,141		-	-	48,563
建设期利息		-	-	-	-	-	-	-
流动资金		-	-	6,977	10,263	-	-	17,240
<b>资金筹措</b>		<b>16,997</b>	<b>19,425</b>	<b>19,118</b>	<b>10,263</b>	-	-	<b>65,803</b>
自筹资金		16,997	19,425	14,234	3,079	-	-	53,735
其中：用于建设投资		16,997	19,425	12,141	-	-	-	48,563
用于支付建设期利息		-	-	-	-	-	-	-
用于流动资金		-	-	2,093	3,079	-	-	5,172
借款		-	-	4,884	7,184	-	-	12,068
长期借款		-	-	-	-	-	-	-
流动资金借款		-	-	4,884	7,184	-	-	12,068

## 2、项目组织方式、选址及土地、厂房

本项目由公司本部负责实施，项目将纳入到公司现有组织体制下统一管理，不设置新的部门。

项目建设在本公司位于宁波保税区东区的预留厂房空间内，扩产区域涉及单晶区、抛光区、切磨区、动力厂房、仓库及其配套设施。

项目名称	占地面积	取得方式	土地使用权证	土地用途
6-8 英寸硅抛光片扩产项目	9,394 平方米	合法转让	甬保土国用（2000）字第 0084 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20040022 号）
			甬保土国用（2002）字第 0159 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20050098 号）
			仑保土国用（2004）字第 0065 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20040116 号）

## 3、主要设备选择

本项目新增单晶炉 33 台，置于新单晶厂房内。每台单晶炉与变压器、控制柜、取晶仪构成一组生产单元，单元集群形成生产区；同时，本项目还要在切磨和抛光厂房共布置 10 个功能区域，安装新增的生产设备、检测设备等，形成硅片切、磨及抛光的整条生产流水线。

本项目所需主要生产设备绝大多数由美国、日本、意大利、德国、瑞士等发达国家进口，部分由国内配套，配用设备具有先进、优质、节能的特点。本项目主要新增设备情况如下：

## 新增主要进口设备表

单位：万美元

序号	名称	型号规格	数量	单价	总价	参考厂商	用途
1	单晶炉	CZ6000	30	29	870	美国 KAYEX	6-8 英寸
2	单晶炉	KAYEX150	3	120	360	美国 KAYEX	8-12 英寸
3	晶锭滚圆机	RS-Kh80Nah	2	30	60	日本 UEDA	4-8 英寸
4	切断机	OC-215D	2	60	120	MAYARUN	4-8 英寸
5	X-Ray 测试仪	MOD101MG103	2	3	6		4-8 英寸
6	氧含量测试仪	QS300J	2	10	20	美国	4-8 英寸
7	GFA 仪	RO-416S	2	10	20	LECO	4-12 英寸
8	相衬干涉 光学显微镜		2	3	6	日本 NIKON	4-8 英寸
9	线切割机	DS261/E4008FI	7	88	616	瑞士 HTC/M&B	4-8 英寸
10	清洗机	SST-200	2	120	240	日本 SES	4-8 英寸
11	倒角机	W-GM-4200	7	25	175	日本 ACCRETECH	6-8 英寸
12	磨片机	22B	6	30	180	日本 SPEEDFAM	4-8 英寸
13	贴片机	SCMM-23/19	2	111	222	FUJIKOSHI	4-8 英寸
14	酸腐蚀设备		2	60	120	STEAG	5-8 英寸
15	抛光机	SPEEDFAM-59/SPM23	8	67	536	日本 SPEEDFAM	6-8 英寸
	抛光机	SPEEDFAM-50/SPM19	16	60	960	日本 SPEEDFAM	4-8 英寸
16	背封机	WJ999R	4	30	120	WATKINS- JOHNSON	4-8 英寸
17	颗粒度测试仪	ADECR81E	2	45	90	美国 ADE	4-8 英寸
18	表面测试仪	ADE7200	3	60	180	美国 ADE	4-8 英寸
19	去蜡清洗机		2	80	160	ATLAS	4-8 英寸
20	片盒清洗机	ATCOR6410	1	35	35	SEMITOOLS	4-8 英寸
21	贴片前清洗机		2	3	6	ATLAS	4-8 英寸
22	热处理前 清洗机		2	20	40	MARUWA	4-8 英寸
23	热处理炉	KAKUSAI	2	20	40	KAKUSAI	4-8 英寸
24	打标机	SIGACLEAN	2	31	62	GSILUMONICS	4-8 英寸
25	纯水系统		1	80	80		4-8 英寸
26	其他设备				200		
合计（汇率按 1：7.68 折算）					5,524	人民币 42,424 万元	

## 新增主要国产设备表

单位：万元

序号	名称	型号规格	数量	单价	总价	参考厂商	用途
1	晶锭滚圆机	GM6000	2	23	46	北京广技通	4-8 英寸

序号	名称	型号规格	数量	单价	总价	参考厂商	用途
2	氧化炉		1	150	150	北京七星电子	6 英寸
3	干式变压器	SCB9-1250/10 1250kVA	1	23	23	浙江三变	
4	GCL 联动补偿柜	额定电流 500A	1		173.8	宁波耐吉	
5	GCL 自动补偿柜	额定电流 500A	1			宁波耐吉	
6	GCL 隔离开关柜	额定电流 630A	1			宁波耐吉	
7	GCL 电源进线柜	额定电流 1200A	1			宁波耐吉	
8	GCL 馈线柜	额定电流 32A- 1200A	6			宁波耐吉	
9	变频式 空压机组	ZR160VSD	1		40		
10	冷却水塔	KFT-2000RT 1400m <sup>3</sup> /h	2	24	48	上海今日	
	合 计		18		480.8		

#### 4、原辅材料供应

本项目建成投产后需要的原辅材料主要有：多晶硅、石英坩埚、石墨坩埚、高纯石墨件、线切割材料、研磨砂、抛光液、抛光垫、包装盒、高纯气体 Ar、氮气等，其中高纯气体 Ar、氮气由国内市场提供，其余物料需要进口。

本项目所需原辅材料与公司现有业务所需的原辅材料相同，公司将通过扩大对现有供应商的采购量以及引进新供应商的方式，保证项目的原辅材料供应。公司募集资金投资项目投产后，公司对多晶硅的需求将大幅度提高，公司将新增多晶硅的需求 340 吨。通过以下措施，公司完全有能力解决募集资金投资项目所需的多晶硅供应：

(1) 通过签定长期合同解决了募集资金投资项目多晶硅的基本需求。公司与德国 Wacker 自 2004 年以来就建立了长期供应关系，且签订了两份长期供货合同，将多晶硅长期供应关系锁定到 2018 年。公司通过签定多晶硅长期供货合同可以满足公司募集资金投资项目投产后多晶硅原材料需求的一半，其余多晶硅需求可以根据市场情况采用现货短期采购合同解决

(2) 公司除了与德国 Wacker 瓦克和日本公司 Tokuyama 建立了稳定的多晶

硅供应关系，还不断开拓新的多晶硅供应渠道，并与另一全球大型供货商建立了供货关系，并计划与其签订长期供货合同。

(3) 随着国内多晶硅生产商纷纷加大投资力度，国内电子级多晶硅的供应即将变为现实，公司已与国内多家多晶硅生产厂商建立了良好的合作关系，并达成了初步供货意向。

本项目建成投产后，所需要的能源为电、水，通过当地市政公共管网供应，不存在供应困难。

## 5、项目建设进度

本项目建设工期 2 年（2007 年 7 月-2009 年 7 月），建设内容包括：

- (1) 设备采购、安装和调试，形成生产流水线；
- (2) 人员招聘、培训，能以胜任岗位工作；
- (3) 新增 6 英寸、8 英寸抛光硅片试生产，工艺技术的熟练掌握，生产线验收；
- (4) 产品性能、质量鉴定周期；
- (5) 抛光硅片扩产线正式投产。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司通过银行贷款筹措资金对该项目已投入 1,200 万元。

## （六）环保情况

### 1、要求达到的环境保护标准

- (1) 大气：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；
- (2) 地面水：GB3838-88《地面水环境质量标准》III类标准；
- (3) 噪声：GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的相关标准；GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》；
- (4) 污水：GB8978-88《污水综合排放标准》中的相关标准。

### 2、本项目建成投产后污染物排放情况及控制处理措施

#### (1) 废水

本项目生产中产生的废水主要为：清洗废水、抛光废水以及纯水制备过程反冲洗产生的废水。公司对生产废水、酸/碱性废水，经集水池、中和沉淀池、A/O 生化处理后，排入保税区污水管网，再进入岩东污水处理厂。公司现有废水处理

能力 250t/d，实际处理量为 210t/d，本项目生产废水产生量为 299.5t/d，拟扩建生产废水处理装置，使之达到 800t/d 处理能力，以满足本项目需求。

本项目新增人员所增加的生活废水，将由管道集中排入保税区污水处理站处理并达到国家一级排放标准后排放。

## （2）废气

本项目废气源于清洗机、化腐机使用氢氟酸、硝酸，由于酸的挥发及与硅的反应产生酸性废气，生产过程中集中在密闭槽子内进行，通过引风机引入废气洗涤吸收塔进行处理，其废气排放量为 3544.6m<sup>3</sup>/h。本项目产生废气处理，主要通过集气罩经引风机送入废气水洗塔处理，达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准后排入大气中。对含 HNO<sub>3</sub>、HF 之废气，采用意大利 CIR 公司进口的专用尾气处理塔处理，达标后排放。

## （3）固态废弃物

本项目生产过程中，固态废弃物主要为：多晶硅废渣；生产中使用的石墨基座产生的废料，主要成份为废石墨，年产生量为 23t/a；污水处理站混凝沉淀后产生污泥，根据废水中 SS 浓度，确定其污泥排放量为 120t/a；此外，办公及生活垃圾产生量为 9.1t/a。公司对固态废弃物分别作集中回收处理或填埋。多晶硅废渣，经清洗后回收利用；废石墨固定基座、废污泥（经干化后）由环卫部门清运填埋；生活垃圾由环卫部门清运。

## （4）噪声

本项目产生的噪声，主要为安装在厂房内的所有动力设备、切片机、研磨机、清洗机产生的机械噪声，以及废水、废气处理设备的动力噪声。公司通过在动力设备底部装置减震设置、将厂房门窗设计为双层隔音玻璃、在厂房四周布置绿化带等手段使动力设备作业时的噪声水平达到标准规定要求。

# （七）对财务状况及经营成果的影响

## 1、对公司经营发展的影响

发行人本次募集资金的运用是以发行人现有主营业务为基础，结合未来市场需求而优化产品系列、扩大产业规模的重大战略举措。项目的建设完成将进一步提高本公司核心产品之一——硅抛光片的产能和产销量，形成年产 660 万片 4-8 英寸系列硅抛光片，巩固并提高公司在半导体硅材料行业内的核心竞争力，成为

全球半导体材料行业排名前十位的知名供应厂商。

## 2、对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司资产将大幅增加，资产负债率将有所降低，公司净资产和每股净资产将大幅增加，这将对优化公司财务结构，提升公司持续融资能力和抗风险能力，起到积极作用。

同时还应当看到，公司募集资金项目实施后，将大规模增加公司固定资产，公司每年计提折旧量较大，假如公司新增产能不能完全利用，将会对公司业绩造成较大影响，但如果新增产能能够得到完全利用，将大大有利于提供公司业绩。

单位：万元

年度	项目建成后第 1 年	项目建成后第 2 年	项目建成后第 3 年
达产率	90%	100%	100%
新增收入	64,584.00	71,760.00	71,760.00
新增折旧	9,226.97	9,226.97	9,226.97
新增利润总额	7,210.60	9,037.00	9,037.00
新增所得税	1,802.65	2,259.00	2,259.00
新增净利润	5,407.95	6,778.00	6,778.00

## 3、本项目盈利性及对公司经营成果的影响

本项目建设周期两年，设计生产能力为年新增 6 英寸硅抛光片 300 万片、8 英寸硅抛光片 60 万片。预计项目建成投产后第一年可达到设计生产能力的 90%，建成投产后第二年可达到设计生产能力的 100%。本公司估计：本项目将新增销售收入 71,760 万元、利润总额 9,037 万元、所得税 2,259 万元。项目各项技术经济指标均较好，具有较好的盈利能力。本项目其他财务指标如下：

财务内部收益率（税后）：	20.52%
财务净现值（税后）： $(i_c=12\%)$	21758 万元
投资回收期（税后，含建设期）：	5.99 年（静态） 7.67 年（动态）
财务内部收益率（税前）：	25.07%
财务净现值（税前）： $(i_c=12\%)$	35456 万元
投资回收期（税前、含建设期）：	5.47 年（静态） 6.62 年（动态）

## 四、8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目

### （一）项目概况

本项目已经国家发展和改革委员会发改高技[2004]2041 号文批准，并被列入 2004 年国家高技术产业发展项目计划，项目总投资 11,323 万元。新建 8-12 英寸硅外延片生产线，是公司基于对大尺寸硅外延片良好市场前景的研判以及对大尺寸硅外延片技术、工艺的积累做出的发展规划。本项目建成投产后，将使公司形成年产 8 英寸硅外延片 24 万片（折合：1,206 万平方英寸）的生产能力，并初步具备 12 英寸硅外延片开发研制和小批量生产的能力。

由于以下原因，导致本项目未能按照原定计划建设：一方面，由于项目建设所需设备均需进口，导致设备选型进程大受影响，采购时间比预期长很多；另一方面，8-12 英寸硅外延片市场的开发需要一定时间，为适应近年来市场对 6 英寸硅外延片产品的旺盛需求的形势，公司集中精力组织研发人员进行技术攻关，对 6 英寸硅外延片进行扩产和结构调整，也相应放缓了 8-12 英寸硅外延片项目的建设进度。目前，公司已向宁波市发展与改革委员会提出了项目竣工验收延期的申请，并于 2007 年 9 月 5 日获得批复（甬发改工业[2007]369 号）同意。截至 2007 年 12 月 31 日，“8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程”项目目前已投入 5,458 万元。

目前，已有多家知名半导体制造厂商与公司就 8 英寸硅外延片片达成供货意向，其中有些高端半导体芯片制造厂商需求迫切，正在积极开展就 8 英寸样片试制及质量认证进行紧密合作，由于该项目的实施对公司业务的发展仍具有重要的现实意义，因此本次公开发行股票仍将其列为募集资金投资项目，以确保该项目顺利实施。由于该项目立项较早，以下关于项目的可行性分析均依据当前市场情况。

### （二）产能变化

目前，本公司硅外延片的设计生产能力为年产 4-6 英寸硅外延片 80 万片，本项目达产后，将使公司新增年产 8 英寸硅外延片 24 万片的生产能力；同时，开发研制出 12 英寸外延片，形成小批量生产能力，从而将公司建成为国内最大的外延片生产基地。

### （三）市场前景分析

#### 1、报告期内 8 英寸硅外延片生产、销售情况

2007 年，公司开始生产并销售 8 英寸硅外延片，实现 8 英寸硅片市场销售零的突破。目前公司具有 1 万片的 8 英寸外延片生产能力，2007 年度公司 8 英寸外延片实际产量为 3,560 片，实际对外销售 3,004 片，均销往国外。

报告期内，公司 4-6 英寸硅外延片产品呈现产销两旺势头，根据市场发展的需要，引进先进外延片生产设备、提高产品工艺，使 4-6 英寸硅外延片的产能逐年提高。目前，本公司硅外延片的生产能力为年产 4-6 英寸硅外延片 80 万片。由于公司外延片产品品质优良，深受客户信赖，客户订单呈现逐步上升趋势，公司少量提供的 8 英寸硅外延片也得到了老客户的认可，并通过了老客户严格认证，为公司 8 英寸硅外延片募集资金投资项目的投产提供了可靠的市场预期。

本项目达产后，将使公司新增年产 8 英寸硅外延片 24 万片的生产能力；同时，开发研制出 12 英寸硅外延片，形成小批量生产能力，从而将公司建成为国内最大的外延片生产基地。

#### 2、行业发展趋势和市场容量

硅外延片用于制造集成电路、POWER MOS 器件、肖特基二极管和集成电路埋层等。硅外延片生产是在硅抛光片之上再淀积一薄层不同掺杂浓度的单晶硅，硅外延层的晶体质量通常会比衬底的好，其缺陷密度显著降低，特别是当衬底硅片直径达到 8 英寸以后，硅片中存在源于晶体生长带来的缺陷，会降低器件的成品率，而使用硅外延片则可以大大降低这种缺陷带来的影响。2006 年，全球硅外延片销量占整体硅片市场的 23%。

8 英寸、12 英寸硅外延片是国际市场的主流产品，而国内硅外延片生产企业的主流产品仍为 4-6 英寸硅外延片，8 英寸以上硅外延片尚未形成量产。但我国正在快速形成一个巨大的 8 英寸以上硅外延片市场。一方面随着我国集成电路产业的迅速发展，国内集成电路芯片厂纷纷上马 6-8 英寸芯片生产线；另一方面，随着国际集成电路产业向中国的战略性转移，国外集成电路企业在我国新建和在建的 8 英寸芯片生产线就多达 15 条。面对迅速发展的分立器件产业和 IC 产业，国内硅外延加工能力明显不足，高精度、大尺寸的硅外延片主要依赖进口，尤其是 8 英寸及以上的硅外延片几乎被进口产品垄断。预计在“十一五”期间硅外延片



的需求将出现大幅度的增长，尤其是 6、8 英寸外延材料将逐步成为国内 IC 产业的主流原材料，市场前景巨大。

目前，国际上外延片的需求主要以 8-12 英寸为主，国内主要以 6、8 英寸为主，从产量角度来看，全球外延片占抛光片的比例为 29%，国内比例为 20%，而且这一比例正在变大。面对大直径高质量硅外延片的强劲需求，国内 8 英寸以上硅外延片的供给明显不足，基本依赖进口，这为国内的硅外延片生产企业提供了发展机遇。

### 3、主要竞争对手

目前国内的 8 英寸以上硅外延片几乎全部需要进口，因此本项目建成投产后，将直接面对与国外硅片生产企业的竞争，但相对于国际级硅片企业，公司硅外延片生产规模仍然偏小。而国内主要的硅外延片生产企业河北普兴、南京国盛等也有可能投资生产 8 英寸硅外延片，将来成为公司竞争对手。以上竞争对手情况参见本招股意向书“第六节业务与技术”之“四、公司在行业中的竞争地位”。

### 4、市场开拓的计划和具体措施

募集资金项目建成投产后，公司将继续在目前海外事业部与销售部的架构下开展营销工作。针对我国集成电路、分立器件生产企业的地域布局情况，公司硅外延片的境内客户主要集中在上海、北京、浙江、江苏等省市。公司的境外客户主要集中在新加坡、美国、马来西亚等国。公司将提高对现有客户的供应量，并在此基础之上发展新客户。公司现有 6 英寸硅抛光片和硅外延片的销售客户如 ST、上海先进已经建成 8 英寸芯片生产线，鉴于公司与上述国内外芯片厂家建立的稳定合作关系，公司估测上述厂家 2006 年对 8 英寸硅外延片的需求量达到 55.33 万片/月，而对公司 8 英寸硅外延片的需求量未来可达 3.95 万片/月左右。因此该项目建成投产后，产品市场需求将有可靠的保障。

公司根据自己在重掺技术上的优势，选择 8 英寸重掺衬底和外延片作为 8 英寸硅片的市场切入点，可以迅速获得客户认可，进入国家重点支持、国内硅片厂商最期望的 8 英寸硅片大规模量产。

根据公司在海外市场销售过程中得到的信息，国外主要客户对公司 8 英寸硅外延片现有总需求量，以及立立电子目前供应量和国外客户对立立电子的潜在需求量情况如下：

客户(国外)	8 英寸硅外延片		
	总需求 (万片/年)	公司目前供应量 (万片/年)	客户对公司潜在需求 量 (万片/年)
已经批量采购的客户	72	0.3	30
已经完成认证和正在开发的客户	196	0	0
合 计	268	0.3	30

根据公司在海外市场销售过程中得到的信息,国内主要客户对公司 8 英寸硅外延片现有总需求量,以及立立电子目前供应量和国内客户对立立电子的潜在需求量情况如下:

客户(国内)	8 英寸硅外延片		
	总需求 (万片/年)	公司目前供应量 (万片/年)	客户对公司潜在需求 量 (万片/年)
已经批量采购的客户	-	-	-
已经完成认证和正在开发的客户	81.6	0	9.6
合 计	81.6	0	9.6

#### (四) 技术水平

##### 1、技术保障

公司在国内首家开发了有蜡贴片抛光工艺、多层外延片工艺,以及掺氮的重掺硅单晶衬底制备技术、新型外延热场的设计技术等。目前公司已经具备 8 英寸硅外延片的量产能力,各项技术性能指标均已达到国际标准。本公司利用单片外延炉,并改进了外延炉的热场结构,使炉内的温度场和流场更为合理,成功开发了 8 英寸硅外延片及 8 英寸薄硅外延片。公司还解决了 8 英寸硅外延片厚度均匀性、电阻率均匀性、滑移线、外延缺陷、自掺杂以及过渡区宽度控制方面的难题,使产品性能达到国内领先水平。

本公司已具备拉制 12 英寸硅单晶锭的能力,通过委托加工衬底片,对 12 英寸硅外延片的研究开发工作正在进行中,并力争在 2007 年 12 月底前取得成果,并具备小批量生产能力。

##### 2、生产方法

公司 8-12 英寸硅外延片的生产工艺分为三部分:

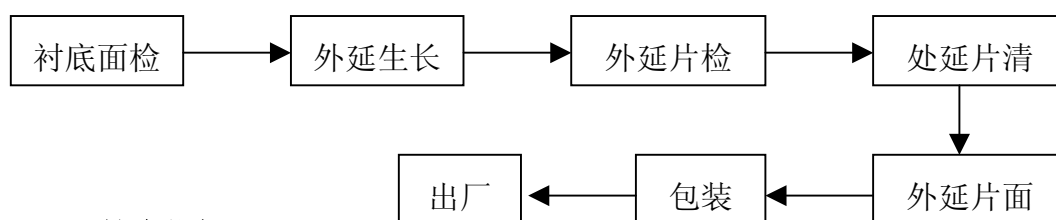
(1) 生长硅单晶锭。利用单晶炉将多晶硅熔化,然后通过引晶、放肩、转肩、等径和收尾等工艺步骤生长成用户所需的直径和电学性能参数的硅单晶锭。

(2) 加工硅抛光片。将硅单晶锭在专用设备上进行切片、磨片、抛光,加

工成 6-8 英寸硅抛光片，控制其几何尺寸和表面质量，使之能满足下游厂家的要求。

(3) 加工成外延片（即本项目涉及的生产工艺）。外延生长的技术原理是：在外延炉内，在单晶硅抛光片（衬底）的表面生长一层一定厚度和电阻率的硅单晶层，该单晶层与衬底具有相同的原子排列方式。外延层的生长采用化学气相沉积（CVD）方法，硅源为三氯氢硅或二氯氢硅，化学反应式为  $SiHCl_3+H_2 \rightarrow Si+3HCl$  或  $SiH_2Cl_2 \rightarrow Si+2HCl$ ，生长温度 1000—1150 度。

本项目生产工艺流程见下图：



### 3、技术指标

参照国际标准，本项目 8 英寸硅外延片产品要求达到的主要技术性能指标如下表。经权威部门检测，公司 8 英寸硅外延片各项指标完全达到了国际同类产品标准。

同样参照国际标准，公司 12 英寸外延片研发所要求达到的技术指标也列于下表。

项目技术指标表

8"硅外延片	衬底	掺杂类型			硼、砷、锑、磷	
		晶向			<100>或<111>	
		电阻率 (Ω.cm.)	硼	锑	砷	磷
	0.006-50		<0.02	0.002-0.004	1-50	
	外延层	掺杂类型			磷	
		电阻率 (Ω.cm.)			1-50	
电阻率均匀性 (%) (片内.片间)			±7			
厚度 (μm)			1-15			
12"硅外延片	衬底	厚度均匀性 (%) (片内.片间)			±5	
		掺杂类型			硼、砷、锑、磷	
		晶向			<100>或<111>	
		硼	锑	砷	磷	

	电阻率 ( $\Omega\cdot\text{cm}$ )	0.006-50	<0.02	0.002-0.004	1-50
外延层	掺杂类型				磷
	电阻率 ( $\Omega\cdot\text{cm}$ )				1-50
	电阻率均匀性 (%) (片内.片间)				$\pm 7$
	厚度 ( $\mu\text{m}$ )				1-15
	厚度均匀性 (%) (片内.片间)				$\pm 6$

## (五) 项目建设情况

### 1、投资估算

本项目总投资 11,323 万元，其中本项目固定资产投资总额为 10,155 万元。其中，固定资产投资具体安排为：设备购置及安装费 9,215 万元，其他费用为 184 万元，预备费 655 万元，建设期利息 101 万元。

本项目总投资使用计划与资金筹措见下表：

单位:万元

项目名称 \ 年份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	合计
<b>项目总投资</b>	<b>7,805</b>	<b>4,948</b>	<b>1,080</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,046</b>
建设投资	6,895	3,159	0	0	0	0	10,054
建设期利息	46	55	0	0	0	0	101
流动资金	0	1,235	1,947	709	0	0	3,891
<b>资金筹措</b>	<b>7,805</b>	<b>4,948</b>	<b>1,080</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,046</b>
自筹资金	6,941	3,585	584	213	0	0	11,323
其中:用于建设投资	6,895	3,159	0	0	0	0	10,054
用于支付建设期利息	46	55	0				101
用于流动资金	0	371	584	213	0	0	1,168
借款	864	1,363	496		0	0	2,723
长期借款							
流动资金借款	864	1,363	496		0	0	2,723

### 2、项目组织方式、选址及土地、厂房

本项目由立立电子股份有限公司本部负责实施，项目将纳入到公司现有组织体制下统一管理，不设置新的部门。

项目建设在本公司位于宁波保税区东区的预留厂房空间内，扩产区域涉及外延厂房、动力厂房、仓库及其配套设施。

项目名称	占地面积	取得方式	土地使用权证	土地用途
------	------	------	--------	------

6-8 英寸硅抛光片扩产项目	9,394 平方米	合法转让	甬保土国用（2000）字第 0084 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20040022 号）
			甬保土国用（2002）字第 0159 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20050098 号）
			仑保土国用（2004）字第 0065 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20040116 号）
8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程	1,095 平方米	合法转让	甬保土国用（2002）字第 0132 号	建设厂房（房产证号：甬房权证保字第 20050099 号）

### 3、主要设备选择

本项目拟进口外延炉及相关的生产、检测设备 21 台，安装在外延厂房等扩产区域，主要新增进口设备见下表：

单价：万美元

序号	设备名称	厂商	型号	单位	数量	单价	总价
1	外延炉	美国 ASM 或日本 NUFLARE	E2500 <sup>TM</sup> 或 HT2000	台	5	120	600
			Levilor <sup>TM</sup> 4000 或 HT3000	台	1	138	138
2	C-V 测试仪	美国 SSM	495CN	台	1	15	15
3	SRP 测试仪	美国 SSM	SSM-2000	台	1	30	30
4	FTIR 测试仪	美国 NICOLET		台	1	7	7
5	LTV 测试仪	日本		台	1	3	3
6	颗粒度测试仪	美国 ADE	ADE CR81e	台	1	35	35
7	清洗机	美国 VERTEQ		台	1	110	110
8	4PP 测试仪	日本 NNPSON		台	1	6	6
9	激光打标机	美国 GSI	Sigmaclean	台	1	30	30
10	甩干机	美国 VERTEQ		台	1	6	6
11	外延炉尾气处理系统	意大利 CIR	8NR20	台	6	6	24
总计	万美元	汇率 1:7.68			21		1004
	折合人民币 万元						7710.72 万元

### 4、原辅材料供应

本项目建成投产后需要的原辅材料主要有：8 英寸衬底片、12 英寸衬底片、石

墨基座、石英钟罩、三氯氢硅、氯化氢、磷烷、硼烷、氮气、氢气等。生产所需的8英寸衬底片由本公司自行生产，12英寸衬底片目前需要外购；所用氢气将由林德气体（宁波）有限公司提供；其他原辅材料需外购，目前市场供应稳定。此外，因硅外延片生产有较高的温度、湿度环境参数要求，公司利用燃油锅炉产生蒸汽进行调控，为此本项目建成投产后约年需0#柴油13,200升。项目生产所需的电、水，通过当地市政公共管网供应，不存在供应困难。

## 5、项目建设进度

本项目建设工期原计划18个月（即自2005年1月至2006年6月底），后调整为自2006年1月至2008年12月底，共36个月。

本项目建设内容主要包括：

- A、设备购置、安装和调试；
- B、进行人员招聘、培训；
- C、8英寸硅外延片试生产；
- D、8英寸硅外延片正式投产；
- E、12英寸硅外延片开发研制、中试鉴定、试生产。

截至2007年12月31日，本项目已经先期投入5,458万元，主要是购置外延炉等相关设备，具体情况如下：

进度	投资内容	金额(元)	投资时间	资金来源
截止2007年12月31日已投入	3061外延炉一台	9,791,375.00	2006年11月	项目借款
	单片炉一台	18,208,300.00	2005年7月	流动资金借款
	3061外延炉一台	10,086,418.74	2007年6月	项目借款
	LPE2061外延炉二台	16,488,968.92	2007年7月	项目借款

## （六）环保情况

### 1、要求达到的环境保护标准

- （1）大气：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；
- （2）地面水：GB3838-88《地面水环境质量标准》III类标准；
- （3）噪声：GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的相关标准；GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》；
- （4）污水：GB8978-88《污水综合排放标准》中的相关标准。

### 2、本项目建成投产后污染物排放情况及控制处理措施

### （1）废水

本项目在生产过程中，硅外延片清洗机使用盐酸、氨水、双氧水清洗硅片后，排放的清洗液废液含有盐酸、氨水，含量约为 100m<sup>3</sup>/d。对上述酸性废水，将经厂区内中和池处理后，排入保税区污水管网，再进入岩东污水处理厂。

本项目新增人员所增加的生活废水，将由管道集中排入保税区污水处理站处理后达到国家一级排放标准后排放。

### （2）废气

本项目在生产过程中，硅外延片清洗机使用盐酸、氨水、双氧水清洗硅片，由于盐酸、氨水的挥发产生酸性废气，废气产生量约 1000m<sup>3</sup>/h。外延炉产生的工艺尾气中含有一定量的氯化氢气体及几个 PPM 浓度的磷烷或硼烷气体。

为解决盐酸、氨水挥发的酸性废气及与硅反应产生的废气等废气污染问题，公司将生产过程中集中在密闭槽子内进行，并通过引风机引入废气洗涤吸收塔进行专门处理，经达标后排入大气中；对含氯化氢、磷烷或硼烷的废气，采用意大利 CIR 公司进口的外延炉专用尾气处理塔处理，达标后排放，每台外延炉均配置一台尾气处理塔装置。

### （3）噪声

本项目产生的噪声主要为安装在厂房内的动力设备的机械噪声。公司通过在动力设备底部装置减震设置、将厂房门窗设计为双层隔音玻璃、在厂房四周布置绿化带等手段使动力设备作业时的噪声水平达到标准规定要求。

## （七）对财务状况及经营成果的影响

### 1、对公司经营发展和财务状况的影响

项目的建设完成将进一步提高本公司核心产品之一——硅外延片的产能和产销量，形成年产 104 万片（折合：2,556 万平方英寸）4-8 英寸系列硅外延片，成为国内最大的硅外延片生产企业，进一步巩固并提高公司在集成电路硅材料行业内的核心竞争力，成为全球半导体材料行业排名前十位的知名供应厂商。本次募集资金到位后，公司资产将大幅增加，资产负债率将有所降低，公司净资产和每股净资产将大幅增加，这将对优化公司财务结构，提升公司持续融资能力和抗风险能力，起到积极作用。

另外还应当看到，公司募集资金项目实施后，将大规模增加公司固定资产，

公司每年计提折旧量较大，假如公司新增产能不能完全利用，将会对公司业绩造成较大影响，但如果新增产能能够得到完全利用，将大大有利于提供公司业绩。

8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目实施后，假定产销平衡，固定资产规模扩大对业绩的影响如下：

单位：万元

年度	项目开始建设 后第 2 年	项目开始建设后 第 3 年	项目建成后 第 1 年	项目建成后 第 2 年
达产率	30%	80%	100%	100%
新增收入	4,638.90	12,370.40	15,463.00	15,463.00
新增折旧	1,310.05	1,910.26	1,910.26	1,910.26
新增利润总额	-113.27	1,281.15	2,079.00	2,079.00
新增所得税	-28.32	320.29	520.00	520.00
新增净利润	-84.95	960.86	1,559.00	1,559.00

## 2、本项目盈利性及对公司经营成果的影响

本项目的的设计生产能力为年产 8 英寸外延片 24 万片。本项目计划第 2 年投产 8 英寸外延片 7.2 万片（设计生产能力的 30%），第 3 年达到设计生产能力的 80%，从第 4 年开始达到设计生产能力的 100%，即形成年产 24 万片 8 英寸硅外延片的规模。本公司估计：本项目达产后将新增销售收入 15,463 万元、利润总额 2079 万元，所得税 520 万元。项目各项技术经济指标均较好，具有较好的盈利能力。本项目其他财务指标如下：

财务内部收益率（税后）：	21.94%
财务净现值（税后）： $(i_c=12\%)$	5322 万元
投资回收期（税后，含建设期）：	5.74 年（静态） 7.59 年（动态）
财务内部收益率（税前）：	26.33%
财务净现值（税前）： $(i_c=12\%)$	8235 万元
投资回收期（税前、含建设期）：	5.32 年（静态） 6.64 年（动态）

综上所述，本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度提高，而募集资金投资项目从资金的投入到产生效益需要一定的建设周期，在达产之前难以及时对公司盈利产生显著的盈利贡献，将导致净资产收益率较以前年度有所摊薄。项目达产后，公司盈利能力将有较大提高，净资产收益率也将随之提高。



本次募集资金到位后可有效提高公司现有产能，增强市场营销能力，改善公司的产品结构，进一步提高公司产品的附加值；同时可增大公司资产规模，促进公司资产负债结构优化，扩大利用财务杠杆融资空间，为促进公司综合竞争力的提高和可持续发展奠定基础。

## 第十四节 股利分配政策

### 一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

#### （一）发行人最近三年股利分配政策

发行人在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份的比例进行年度股利分配。具体分配比例由发行人董事会视公司经营发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。发行人可以采取现金或者股票方式分配股利。在分派股利时，发行人按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。

根据公司章程的有关规定，发行人税后利润分配顺序为：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、提取法定公积金10%；
- 3、提取法定公益金5%（2006年之前）；
- 4、提取任意公积金；
- 5、支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。从2006年1月1日起，公司不再提取法定公益金。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （二）最近三年实际分配股利情况

经2005年年度股东大会审议通过，公司2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本7,108万股为基数，每10股派发现金股利1.25元（含税），共计888.5万元。

经2006年年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本7,708万股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计1,927万元。

经2007年年度股东大会审议通过，公司2007年度利润分配方案为：暂不分配。

## 二、滚存利润的分配安排

2007年8月12日，经发行人2007年第一次临时股东大会审议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

## 第十五节 其他重要事项

### 一、发行人信息披露制度

#### （一）责任机构和相关人员

- 1、本公司负责信息披露和协调投资人关系的部门：投资发展部
- 2、主管负责人：陈卫忠（董事会秘书）
- 3、地址：浙江省宁波市保税区0125-3地块（315800）
- 4、联系电话：0574-86820223
- 5、传真号码：0574-86881152
- 6、电子邮箱：securities@ql-electronics.com

#### （二）信息披露制度

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，本公司除按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度外，还专门制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的程序、信息提供、信息披露的媒体、保密措施、公司信息披露常设机构和联系方式、投资者关系管理内容和方式等作了具体的规定。

### 二、发行人重要合同

本节重要合同指公司目前正在履行的交易金额超过500万元的合同，或者交易金额虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至本招股意向书签署之日，发行人及发行人合并报表范围内的公司已签署、正在履行的重大合同如下：

#### （一）产品销售合同

1、公司与ST公司签订销售合同，约定：公司根据ST公司出具的交货计划表将产品送交ST公司，并向其提供送货订购单，送货的成本、安排以及运输等应

由公司负责。双方约定本协议适用新加坡国法律。

2、2007年9月13日，子公司立立半导体与杭州士兰集成电路有限公司签订销售订单，约定于2007年10月25日前向杭州士兰集成电路有限公司提供34,500片测试和生产硅片，总金额5,635,500元。该订单正在履行中。

3、2007年9月26日，子公司立立半导体与杭州士兰集成电路有限公司签订销售订单，约定于2007年10月30日前向杭州士兰集成电路有限公司提供35,000片生产硅片，总金额6,334,500元。该订单正在履行中。

## （二）原材料供应合同

1、公司与德国Wacker分别于2006年5月、2007年10月，共签定了两份多晶硅长期供货合同，采购数量、价格稳定，合同双方约定适用德国法。该合同正在履行中。

2、2006年9月，本公司与GE Advanced Materials, Quartz(简称：“GE Quartz inc.”)签订了一份2007年到2009年的坩埚供货协议一份。约定自2007年1月1日至2009年12月31日每年向GE Quartz inc.购买约定数量的各型号坩埚，本协议双方约定适用美国纽约州法律。该合同正在履行中。

## （三）设备采购合同

2007年5月，公司与LPE S.P.A签订外延炉采购合同，约定公司向LPE S.P.A购买两台外延炉，交货时间为2007年8月15日前。该合同正在履行中。

## （四）半导体代工协议

2002年2月14日，立昂电子与On Semiconductor Trading Ltd.（以下简称“On-Semi Trading”）签订了一份半导体代工协议，协议约定由On Semi Trading向立昂电子提供一条6英寸肖特基二极管芯片生产线，同时向立昂电子提供相关的技术培训，由立昂电子为On Semi Trading代工，并返销On Semi Trading，合同有效期自合同签订之日起至2007年12月31日止。该合同适用美国德克萨斯州法律。

## （五）借款合同

## 立立电子借款合同：

贷款银行	借款合同号	贷款期限	金额/利率 (年息)	担保方式/担保人或抵押物
中国银行北仑支行	BL2007 人贷 C034 号	07/10/10-08/04/09	500 万人民币 /6.48%	信用合同
	BL2007 人贷 C041 号	07/12/06-08/12/05	150 万人民币 /7.29%	信用合同
	BL2005 人贷 064 号	05/12/27-09/12/26	767 万人民币 /5.85%	立立电子抵押以机器设备抵押/《抵押合同》BL2005 人抵 018/ 期限：05/12/8—07/10/29
	BL2007 外贷 C019 号	07/4/17-08/4/15	140 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外固 C002 号	07/4/20-09/4/19	132.5 万 美 元 /Libor+1.66	立立电子土地及地上建筑物抵押/《抵押合同》BL2005 人抵 019 期限：05/12/31—07/12/31
	BL2006 外固 C002 号	06/10/8-10/10/7	120 万 美 元 /Libor+1.66	
	BL2007 外贷 C006 号	07/02/12-08/02/11	50 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外贷 C032 号	07/09/14-08/09/13	30 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外贷 C033 号	07/10/08-08/04/07	100 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外贷 C039 号	07/12/04-08/12/03	80 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外贷 C040 号	07/12/29-08/12/28	315 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
	BL2007 外贷 C031 号	07/8/27-08/2/266	80 万 美 元 /Libor+1.66	信用合同
中国农业银行宁波保税区支行	82101200700002706	07/3/8--08/3/7	890 万人民币 /6.12%	立立电子房产抵押/《抵押合同》NO82906200600000749 期限：06/4/14-09/4/14
中国工商银行宁波市江东支行	2004 江东字第 0094 号	04/5/31--09/4/16	1400 万人民 币/5.115%	信用
	2004 年江东字第 0098 号	04/6/7--09/4/16	850 万人民币 /5.115%	信用
中国建设银行宁波第二支行	2007 甬二工流字第 60 号	07/12/28-08/12/27	2000 万人民 币/基准利率 +5%	立立电子设备抵押/《抵押合同》2007 甬二最高抵押字第 18 号 期限：07/11/30-08/11/29
立立半导体借款合同：				
中国工商银行宁波市江东支行	2005 年江东字第 0070 号	05/6/29-09/6/25	4500 万人民 币/5.85%	由立立电子提供担保/《保证合同》2005 年江东（保）字 0014 号/期限：05/6/29-09/6/25 最高担保额：4500 万

中国银行北仑支行	BL2007 人贷 C011	07/3/19-08/3/18	800 万人民币 /6.39%	由立立电子提供担保/《最高额保证合同》/BL2006 保字 C014 期限：06/12/26-08/12/26 最高担保额：4000 万
	BL2007 外贷 C013	07/4/04-08/4/03	80 万 美 元 /7.01%	
	BL2007 外贷 C029	07/6/29-08/6/28	50 万 美 元 /7.02%	
	BL2007 外贷 C017	07/4/12-08/4/11	30 万 美 元 /7.015%	立立半导体土地及地上建筑物抵押/《抵押合同》2007 人抵字 C010 号 期限：07/11/21-09/11/20
	BL2007 人贷 C028	07/8/27-08/2/26	1000 万人民 币/5.589%	
	BL2007 人贷 C031 号	07/9/27-08/9/26	1000 万人民 币/7.29%	
	BL2007 人贷 C033 号	07/10/10-08/4/7	1000 万人民 币/6.48%	1)由立立电子提供担保/《最高额保证合同》/BL2006 保字 C014 期限：06/12/26-08/12/26 最高担保额：4000 万 2) 立立半导体土地及地上建筑物抵押/《抵押合同》2007 人抵字 C010 号 期限：07/11/21-09/11/20
交行宁波分行	0701A10052	07/12/29-08/6/29	500 万人民 币/6.57%	由立立电子提供担保/《保证合同》0701 最 保 10032/ 期 限 ：07/12/29-09/12/24 最高保证额 4500 万
农行宁波保税区支行	82101200700002950	07/3/13-08/3/12	500 万人民 币/6.12%	由立立电子提供担保/《保证合同》最高额担保 82905200700000340/期限：07/4/30-09/10/31 最高保证额 2000 万
	82101200700011005	07/8/24-08/8/23	500 万人民 币/7.02%	
		07/9/6-08/9/5	500 万人民 币/7.02%	
	82101200700012551	07/10/9-08/10/8	500 万人民 币/7.29%	
上海浦东发展银行开发区支行	94112007280302	07/9/28-08/3/28	700 万人民币 /7.29%	由立立电子提供担保/《保证合同》ZB9411200728012701/ 期 限 ：07/4/16-08/4/16 最高保证额 1200 万
	94112007280306	07/10/10-08/04/10	500 万人民币 /7.29%	

**立昂电子借款合同：**

中国银行浙江省分行	07ERJ071	07/8/6-08/8/6	1000 万人民 币/7.524%	立立电子提供担保/《保证合同》07ERB071
	07ERJ066	07/7/11-08/7/11	1000 万人民 币/7.227%	立立电子提供担保/《保证合同》07ERB066
	06EREQ002	06/9/19-08/3/31	2000 万人民 币/6.27%	立昂电子房产抵押/《抵押合同》06ERD004

招商银行凤起支行	2007 年贷字第 81 号	07/9/3-08/9/3	1000 万人民币/基准利率+10%	立立电子提供担保/《保证合同》2007 年保字第 39 号/期限：07/9/3-08/9/2 最高保证额 1000 万
----------	----------------	---------------	--------------------	---

## （六）对外担保合同

发行人对控股子公司立立半导体提供五笔借款担保，对控股子公司立昂电子提供三笔借款担保；

以上八笔担保的详细情况请参见本招股意向书第七节“同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

## （七）技术合同

发行人与浙江大学硅材料国家重点实验室签订《建立“浙江大学—立立电子硅材料联合研发中心”的协议》，约定发行人每年向实验室提供50万元的经费，若企业根据发展需要提出专项课题，则需另外支付专项研究费。取得的成果申请专利，则双方共同署名，各拥有50%的所有权，但发行人独家拥有无偿使用权。合同有效期为2006年6月8日至2011年6月7日。

## （八）氢气站土地使用权转让、设备转让及人员接收和氢气供应合同

1、立立半导体与林德气体(宁波)有限公司（以下简称：“林德气体”）于 2007 年 5 月 24 日签订《土地使用权转让合同》，约定：立立半导体将其拥有的面积为 3566 平方米的土地使用权转让给林德气体，土地使用权转让价为人民币 397,500 元，建筑物转让价为人民币 2,168,520.84 元，本合同应持续有效至 2044 年 5 月 26 日。截至 2008 年 3 月 31 日，已办妥房产和土地变更登记手续。

2、立立电子与林德气体于 2007 年 5 月 24 日签订《设备转让和人员接收合同》，公司将其目前正在使用的水电解制氢装置、相关设备资产以及操作设备必需的经过相应培训的员工转让予林德气体，设备总价为人民币 4,651,157.19 元，林德气体无须就人员的接收支付相应费用。2008 年 1 月 3 日，该资产处置及人员安排协议已经履行完毕。



3、2007年5月24日，立立电子与林德气体签订《氢气供应合同》，约定：立立电子应按照合同约定的标准向林德气体的水电解装置提供公用工程，林德气体分三个阶段向公司供应氢气，自水电解装置所有权根据《设备转让和人员接收合同》转移给林德气体之日起，由林德气体收购的水电解装置向公司供气，该合同有效期为15年。

### 三、重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日，公司不存在尚未了结或可合理预见的对财务状况、经营成果、公司声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至招股意向书签署之日，公司的控股股东或实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

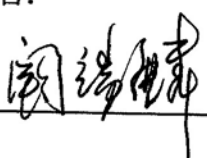


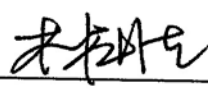
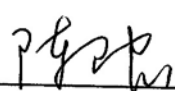
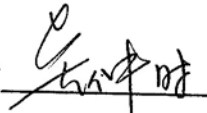
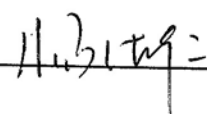


截至本招股意向书签署日，未发生发行人董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

### 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明


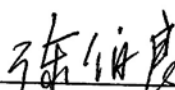
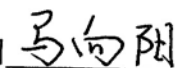
#### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

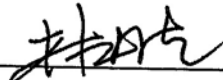
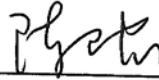
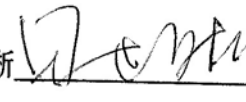
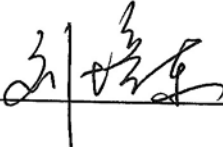
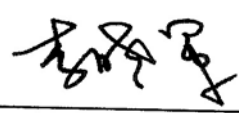
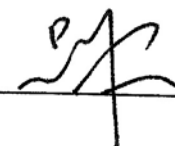
全体董事签名：

阙端麟  李立本  王敏文   
 林必清  陈卫忠  吴仲时   
 杨德仁  苏勇  闫笑枫 

全体监事签名：

王敏强  陈伯良  马向阳 

全体高级管理人员签名：

林必清  陈卫忠  田达晰   
 刘培东  李晓军  吴能云 



## 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

  
张佑君

保荐代表人：

  
宋永祎

  
张鸣溪

项目主办人：


  
常亮


中信建投证券有限责任公司

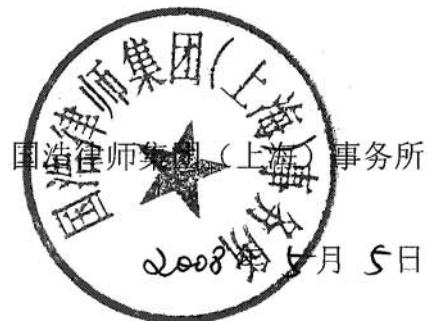


## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



律师事务所负责人: 

经办律师: 

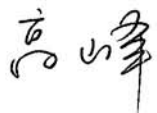



### 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

经办会计师： 


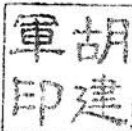
 



### 验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  

经办会计师：  

浙江东方会计师事务所有限公司



## 第十七节 备查文件

### 一、备查文件目录

发行者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制审核报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅联系方式

（一）**查阅时间：**工作日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 4：00。

（二）**查阅地点：**

**1、发行人：宁波立立电子股份有限公司**

办公场所：浙江省宁波市保税区 0125-3 地块

查询电话：0574—86821903

传 真：0574—86881152

联 系 人：涂洪浪

**2、保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司**

办公场所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 2601 室

查询电话：021-68801546、68801554

传 真：021-68801552

联 系 人：郝东旭、赵明、王广学、周菠、冯烜、郭姗姗、潘锋、朱明强、翟程